

创业板风险提示

本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

Shenzhen JT Automation Equipment Co.,Ltd

(深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区)

首次公开发行股票并在创业板上市



声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）



(福建省福州市湖东路 268 号)

发行概要

发行股票类型	人民币普通股（A股）		
发行股数	2,000万股	发行后总股本	8,000万股
每股面值	1.00元	每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日	拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份限售安排、股东对所持股份自愿锁定承诺	<p>1、本公司控股股东及实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、本公司股东劲通电子、孔旭、朱武陵、主逵、张纪龙、柴明华、毛一静、罗昌昌、朱玺、陈洁欣、罗习雄、邹英和张卫华承诺：股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>3、担任公司董事、监事、高级管理人员的吴限、朱武陵、主逵、罗昌昌、朱玺、陈洁欣、罗习雄、邹英承诺：上述期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。</p>		
保荐机构（主承销商）	兴业证券股份有限公司		
招股说明书签署日期	2012年2月21日		

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

一、关于发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的利润分配政策

（一）发行前滚存利润的分配

根据2011年3月11日召开的公司2010年年度股东大会决议，公司将以现金分红的方式向股东分配900万元利润，本次分红完成后至发行前的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。

（二）发行上市后的利润分配政策

本次发行上市后，本公司将继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。请投资者关注本公司发行上市后的股利分配政策、现金分红比例及分红回报规划。

2011年12月23日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》及修改《公司章程（草案）》利润分配条款的议案。本次发行后公司利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应保持政策的连续性和稳定性。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

3、现金分红发放条件及比例

上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：

- （1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；
- （2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；

(3) 公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元；

公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

根据公司未来三年分红计划，公司发行上市当年及之后两年每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的 15%。

发行人发行上市后的利润分配政策、分红回报规划详见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层讨论”之“二十一、股利分配政策”相关内容。

二、重大风险提示

（一）宏观经济波动的风险

发行人生产的波峰焊、回流焊等电子整机装联设备主要提供给下游的电子制造企业，因此发行人所处的电子整机装联设备行业与电子制造业的发展具有一定的联动性。由于电子制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，因此在宏观经济环境不佳的情况下，电子制造企业会相应缩减设备类固定资产的投资支出，从而影响本行业的发展。

2008 年以来，由于受国际金融危机的影响，电子产品市场需求减缓，电子制造企业相应削减或推迟了生产设备的投资，导致电子整机装联设备行业的发展也受到了较大的影响。

虽然自 2009 年下半年开始，在宏观经济形势好转和一系列国家政策相继出台等利好因素驱动下，电子整机装联设备行业呈现迅速复苏的态势，行业各项经济指标快速增长；但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与发行人面临的市场规模存在一定的关联性，如果未来宏观经济景气度继续出现大幅波动，有可能对电子整机装联设备行业需求的持续快速增长带来不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

目前，国内电子整机装联设备行业竞争状况呈现两级分化格局：一是数量众

多的低端设备生产商，企业规模较小，生产部分低档次、低价格的产品，上述企业主要参与低端市场的竞争，竞争激烈；二是生产中、高端产品的企业，生产的部分设备性能接近或达到了国际先进水平，主要参与中高端市场的竞争，市场竞争者相对较少。

发行人作为国内电子整机装联设备行业焊接设备的龙头企业，在市场上已占据较大的份额。目前公司主要参与焊接设备中高端市场的竞争，主要的竞争者包括美国 BTU、Heller 等。由于国内市场容量巨大，中高端市场较高的毛利率将吸引国内其他竞争对手进入；同时，一些国际同行业制造商也可能加快实施本土化生产战略，加剧市场竞争状况，未来发行人存在因市场竞争加剧导致市场份额下降的风险。

（三）技术开发及技术更新的风险

发行人所从事的行业涵盖物理学、热工学、自动控制、力学和数学等多门学科，对进入该行业的企业技术整合要求很高，需要企业进行不断的研发投入并相应地予以市场化和产业化。

为保持持续的技术领先优势和拓展新的市场空间，自 2009 年以来，发行人先后通过受让运英软件、西南公司相关的技术及引进核心人才，介入与主业密切相关的 AOI 检测设备和 PECVD 设备的研制生产。经过两年的发展，发行人已经完全消化吸收了与 AOI 相关的技术，并在此基础上形成了具有自主研发能力和核心技术优势的 AOI 研发团队。

但对于 PECVD 设备，由于该产品正处于样机研制阶段，发行人在现阶段对转让的氮化物沉积系统技术存在一定的技术依赖，如果未来相关技术未能有效转化为产品，并顺利进行市场化，将会对发行人未来的技术开发和经营业绩产生一定的影响。

（四）新增产能无法消化的风险

本次募集资金项目实施后，公司将新增焊接设备和 AOI 设备产能 1,350 台，这对公司销售提出了更高的要求。尽管目前与这些设备相关的行业仍将面临较好的市场发展空间，但如果未来市场环境出现较大变化，销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募集资金项目的新增

产能将对公司销售构成一定的压力。

（五）税收优惠风险

公司自 2007 年开始获利，经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局下发的《减、免税批准通知书》（深国税宝西减免【2007】0115 号）核准，公司减免税期限为：2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征企业所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减半征收。2011 年 7 月 28 日，深圳市国家税务局出具深国税函【2011】261 号《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司企业所得税税率问题的复函》对公司所得税税率实缴比例核实如下“该企业 2008 年实征税率为 0%，2009 年实征税率为 10%，2010 年实征税率为 11%，2011 年实征税率为 12%”。

2011 年公司根据深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局深国税宝西减免备案【2011】134 号税收优惠登记备案通知书，按高新技术企业 15% 的税率申报缴纳企业所得税。2012 年公司仍可享受 15% 的高新技术企业优惠税率。若 2013 年公司无法通过国家高新技术企业复核，则将面临所得税税率上升的风险。

报告期发行人据此减免的企业所得税分别为 161.32 万元、444.41 万元和 441.34 万元，占当期净利润的比例分别为 10.66%、12.60%和 10.82%，占比较低。公司 2008-2010 年所享受的税收优惠政策仅是深圳市人民政府的相关规定，缺乏相关法律、国务院或者国家税务总局颁发的税收规范性文件作为依据，公司存在补缴企业所得税的风险，因此公司报告期内已将各年度据此所减免的所得税列入非经常性损益。除此之外，2011 年 3 月，发行人控股股东及实际控制人吴限出具《承诺函》：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”，故公司 2008-2010 年所得税补缴风险不会对公司业绩造成重大不良影响。

目 录

重大事项提示.....	4
一、关于发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的利润分配政策.....	4
二、重大风险提示.....	5
第一节 释义.....	12
第二节 概览.....	16
一、发行人简介.....	16
二、公司控股股东、实际控制人简介.....	17
三、发行人主要财务数据和财务指标.....	18
四、本次发行情况.....	19
五、募集资金用途.....	19
六、公司的核心竞争优势.....	20
第三节 本次发行概况.....	24
一、发行人基本情况.....	24
二、本次发行的基本情况.....	24
三、本次发行相关中介机构.....	25
四、本次发行预计时间表.....	27
第四节 风险因素.....	28
一、宏观经济波动的风险.....	28
二、市场竞争加剧的风险.....	28
三、技术开发及技术更新的风险.....	29
四、新增产能无法消化的风险.....	29
五、税收优惠风险.....	29
六、应收账款增长较快的风险.....	30
七、产品毛利下降的风险.....	31
八、原材料采购价格波动的风险.....	31
九、净资产收益率下降的风险.....	31
十、核心技术人员流失及技术失密的风险.....	32
十一、募集资金项目管理和组织实施的风险.....	32
十二、资产结构变化带来的风险.....	32
十三、行业政策变化风险.....	33
十四、实际控制人控制风险.....	33
十五、租赁房产未取得产权证书的风险.....	33
第五节 发行人基本情况.....	35
一、发行人改制重组及设立情况.....	35
二、发行人独立运行情况.....	37
三、实际控制人焊接设备业务的形成及演变过程.....	38
四、发行人设立以来的资产重组情况.....	40

五、发行人组织结构.....	50
六、发行人控股子公司、参股公司情况.....	53
七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.....	54
八、发行人股本情况.....	65
九、发行人内部职工股、职工持股会等情况.....	67
十、发行人员工及其社会保障情况.....	69
十一、实际控制人、持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况.....	72
第六节 业务和技术.....	74
一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.....	74
二、发行人所处行业的基本情况.....	80
三、电子整机装联设备行业发展概况.....	85
四、太阳能光伏设备行业发展概况.....	117
五、发行人主营业务的具体情况.....	127
六、发行人的主要固定资产及无形资产.....	142
七、特许经营权.....	152
八、发行人生产研发和技术情况.....	152
第七节 同业竞争与关联交易.....	163
一、同业竞争.....	163
二、关联方及关联关系.....	164
三、报告期的关联交易.....	167
第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....	187
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.....	187
二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属的持股情况.....	191
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.....	192
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.....	193
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.....	194
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系情况.....	194
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署协议及承诺情况.....	195
八、董事、监事及高级管理人员任职资格情况.....	195
九、近两年董事、监事及高级管理人员变动情况.....	195
第九节 公司治理.....	197
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书的依法运作情况.....	197
二、公司最近三年违法违规行情况.....	206
三、公司最近三年资金占用和对外担保情况.....	206
四、公司重大经营投资决策程序与投资者权益保护.....	207
五、公司内部控制制度情况.....	211
第十节 财务会计信息与管理层分析.....	212
一、财务报表.....	212
二、审计意见.....	220

三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况	220
四、主要会计政策和会计估计	221
五、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响	233
六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策	233
七、分部信息	237
八、最近一年收购兼并情况	237
九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	237
十、主要财务指标	239
十一、发行人盈利预测情况	241
十二、发行人设立时及报告期内资产评估情况	241
十三、发行人设立时及报告期内历次验资情况	241
十四、备考利润表	243
十五、财务状况分析	243
十六、盈利能力分析	278
十七、现金流量分析	308
十八、资本性支出分析	310
十九、期后事项、或有事项及其他重要事项	311
二十、发行人财务状况和盈利能力的趋势分析	311
二十一、股利分配政策	313
第十一节 募集资金运用	317
一、本次发行募股资金的基本情况	317
二、募集资金投资项目概况	318
三、固定资产投资必要性及新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响	338
四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响	339
五、募集资金专户存储的相关措施	341
第十二节 未来发展与规划	342
一、公司发展目标、发展规划及具体经营计划	342
二、拟定发展规划与经营计划所依据的假设条件	347
三、实施发展规划可能存在的困难	347
四、本次发行对公司实现发展规划的作用	348
五、确保实现规划和计划拟采用的方法	348
六、对未来发展规划与经营计划的声明	349
七、业务发展规划与现有业务的关系	349
第十三节 其他重要事项	350
一、重大合同协议	350
二、发行人对外担保的有关情况	354
三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项	354
四、发行人控股股东等涉及的重大诉讼或仲裁事项	354
五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况	354
第十四节 有关声明	355
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	355

保荐机构（主承销商）声明	356
发行人律师声明	357
审计机构声明	358
验资机构声明	359
资产评估机构声明	360
第十五节 附件	361

第一节 释义

在本招股说明书中，除另行说明，下列简称具有如下意义：

一、一般术语		
发行人、本公司、劲拓股份、公司	指	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身深圳市劲拓自动化设备有限公司）
劲拓有限	指	深圳市劲拓自动化设备有限公司
劲拓实业、实业	指	深圳市劲拓实业有限公司
劲拓精密	指	惠州市劲拓精密装备有限公司
劲同矿业	指	贵州劲同矿业有限公司
劲同投资	指	贵州劲同投资有限公司
劲同高温材料	指	贵州劲同新型高温材料有限公司
劲同耐火材料	指	贵州劲同耐火材料有限公司
劲同机械	指	贵州劲同机械设备有限公司
劲通电子	指	劲通电子设备（深圳）有限公司
运英科技	指	深圳市运英科技有限公司
运英软件	指	深圳市运英软件开发有限公司
合口味	指	深圳市合口味食品有限公司
利进设备	指	利进设备有限公司
本次发行	指	本次劲拓股份发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市
新股、A 股	指	发行人即将发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	发行人股东大会
董事会	指	发行人董事会
监事会	指	发行人监事会
《公司法》	指	2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	发行人的《公司章程》
保荐机构、主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
鹏城、会计师	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司

发行人律师	指	广东信达律师事务所
天健国众联	指	深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司
管理办法	指	《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》
创业板上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市	指	本公司股票获准在深圳证券交易所创业板市场挂牌交易
报告期、最近三年	指	2009年、2010年及2011年
元	指	人民币元
二、专用词语		
选择性波峰焊	指	可编程逐点焊接式波峰焊，又称机器人焊接
双曲线回流焊	指	在一台设备中同时运行两种完全不同的工艺，并通过软件对两种工艺参数进行自动优化，属创新概念技术
AOI	指	Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，基于光学原理对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测
MHD 电磁泵	指	利用电磁场对导磁性流体进行驱动的装置
太阳能电池	指	通过光电效应或光化学效应直接把光能转化成电能的装置
晶体硅	指	晶体硅材料，包括单晶硅、多晶硅等晶体形式
太阳能电池片、电池片	指	即太阳能发电单元。通过在硅片上生长各种薄膜，形成半导体 P-N 结，把太阳光能转换为电能
太阳能电池组件、组件	指	将若干片太阳能电池芯片组合成为一个独立作为电源使用的最小单元
烧结炉	指	通过快速热处理的方式，使印刷在晶体硅上的电极浆料与硅片形成良好欧姆接触的设备
PECVD	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 的缩写，即等离子体增强化学气相沉积
选择性波长加热	指	针对工件的频谱分布，在不同的加热阶段以不同的辐射波长分布进行加热，以获得最佳的热传导效率。
高效热传导技术	指	通过优化对流、辐射传热参数，以获得最佳热传递效率的技术。
矢量图像识别	指	通过计算机对数字图像的特征矢量进行提取，并进行偏分运算分析
粘性半流体控制技术	指	对粘性半流体，如熔融金属的流动形态、附面层参数、表面张力等的精确控制。
MHD	指	Magneto Hydro Dynamic 的缩写，即磁流体力学
CEPEA	指	China Electronic Production Equipment Industry Association 的缩写，即中国电子专用设备工业协会
EMS	指	Electronic Manufacturing Services 的缩写，即电子专业制造服务，相对于传统的 OEM 或 ODM 服务仅提供产品设计与代工生产，EMS 厂商所提供的是知识与管理的服務，例如物料管理、后勤运输，甚至提供产品维修服务

PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即印刷电路板组件
THT	指	Through Hole Technology 的缩写，即穿孔技术
SMT	指	Surface Mounting Technology 的缩写，即表面贴装技术
锡膏	指	一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上。
钎焊	指	采用比母材溶化温度低的钎料，操作温度采用低于母材固相而高于钎料液相线的一种焊接技术。钎焊分为硬钎焊和软钎焊，美国焊接学会(AWS)规定钎料液相线温度高于 450°C 所进行的钎焊为硬钎焊，低于 450°C 所进行的钎焊为软钎焊
COB	指	Chip On Board 的缩写，即板上芯片贴装
COG	指	Chip On Glass 的缩写，即玻璃板芯片贴装
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示屏
XY-TABLE	指	X-Y 工作平台
NCT	指	Numerical Control Turret 的缩写，即数控转塔冲床
CNC	指	Computerized Numerical Control 的缩写，即计算机数控
PWI	指	Process Window Index 的缩写，即工艺窗口指标
RTP	指	Rapid Thermal Process 的缩写，即快速热处理技术
PLC	指	Programmable Logic Controller 的缩写，即可编程序控制器
UPS	指	Uninterrupted Power Supply 的缩写，即不间断电源
RoHS	指	Restriction of Hazardous Substances 的缩写，即欧盟制定的《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
ISO	指	International Standardization Organization 的缩写，即国际标准化组织
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源计划
QCC	指	Quality Control Circles 的缩写，即品质圈
CE	指	可作为 Conformity with European 的缩写，是欧洲统一的商品标准
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会，是全球性的产业协会，致力于于促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展
CMIC	指	中国市场情报中心，隶属于工信部直属机构中国电子信息产业发展研究院
三、主要竞争对手和客户企业		
BTU	指	美国 BTU International, Inc., NASDAQ 上市公司
HELLER	指	美国 Heller Industries, 海勒工业
REHM	指	德国 REHM, 瑞姆公司
ERSA	指	德国 ERSA Global Connection, 埃莎焊接
日东电子	指	日东电子科技（深圳）有限公司

科隆威	指	东莞市科隆威自动化设备有限公司
神州视觉	指	东莞市神州视觉科技有限公司
振华兴科技	指	深圳市振华兴科技有限公司
TRI, 德律科技	指	台湾 Test Research, Inc., 德律科技
欧姆龙	指	欧姆龙株式会社
Flextronics, 伟创力	指	新加坡 Flextronics International LTD., 伟创力
富士康	指	富士康科技集团
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
无锡尚德	指	无锡尚德太阳能电力有限公司

注：本招股书中任何涉及总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）发行人简要情况

公司名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

注册资本：6,000 万元

法定代表人：吴限

注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），机械设备、电子设备及其零配件的购销，无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、接驳台、AOI 产品、太阳能设备的研发、设计、生产和销售及租赁，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

公司是由深圳市劲拓自动化设备有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，并于 2010 年 2 月 8 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为“440306103195065”的《企业法人营业执照》。公司发起人为：吴限、劲通电子、孔旭、朱武陵、主逵、张纪龙、柴明华及其他 7 名自然人。

（二）主营业务情况

公司主营业务为电子整机装联设备的研发、生产和销售，主要产品为焊接设备、AOI 检测设备、高温烧结炉设备和 SMT 周边设备，其中焊接设备、AOI 检测设备和高温烧结炉设备为公司的核心产品。最近三年，公司核心产品实现销售收入分别为 8,506.11 万元、20,150.49 万元和 24,497.75 万元，占当期公司营业收入的 88.17%、92.15%和 92.25%。

公司产品广泛应用于通讯电子产品、国防电子产品、航空航天电子产品、汽车电子及日常的消费电子产品的制造。

（三）公司荣誉及行业地位

公司自成立以来，就专注于电子整机装联焊接设备的研发和制造，积累了深厚的技术沉淀和丰富的市场经验，目前已经发展成为我国电子整机装联焊接设备领域内的龙头企业。公司现为国家高新技术企业、广东省战略性新兴产业培育企业、中国电子专用设备工业协会理事单位、深圳市电子装备产业协会常务副会长单位，其“JT/劲拓”商标荣获广东省著名商标称号，公司同时也是“深圳知名品牌”企业。

（四）公司核心技术概况及自主创新能力的体现

目前公司主要有 3 大类 17 项核心技术，具体如下：

1、焊接设备有 7 大核心技术：高效热传导技术、高纯度动态气氛控制技术、微隙间距局部焊接技术、金属流体控制技术、粘性半流体控制技术、视觉扫描无缝拼接技术、液态金属泵送技术；

2、AOI 检测设备有 7 大核心技术：视觉快速定位技术、矢量图像识别原创核心技术、智能一维二维码识别技术、多路多通道工业实时控制技术、高速高精度 X-Y 工作平台的设计与制造技术、高亮度 LED 光源的精确控制技术、高亮度 LED 对于 SMT 板的照明技术；

3、高温烧结炉及 PECVD 有 3 大核心技术：高温快速热处理技术、等离子控制技术、真空技术。

截至本招股说明书签署日，公司拥有专利权 38 项，国际专利 2 项，计算机软件著作权 15 项，已受理申请的专利权有 22 项。

二、公司控股股东、实际控制人简介

本公司控股股东和实际控制人为吴限先生。截至本招股说明书签署日，吴限持有本公司 27,243,000 股，占本次发行前总股本的 45.41%。

吴限先生：男，中国国籍，身份证：52250219680501****，无境外永久居留权，住所：广东省深圳市宝安区宝城上川路 32 号 8 栋。

三、发行人主要财务数据和财务指标

以下财务数据摘自经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所股审字【2012】0003号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产	20,298.03	18,799.29	10,390.66
其中：货币资金	4,800.56	5,030.58	2,063.44
应收账款	7,272.47	4,985.06	2,698.75
固定资产	5,615.49	5,253.35	4,787.42
资产总额	28,457.83	25,670.54	16,890.03
流动负债	10,106.76	10,119.02	6,339.94
非流动负债	2,983.63	3,361.30	1,886.51
负债总额	13,090.39	13,480.31	8,226.45
股东权益	15,367.44	12,190.22	8,663.58

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	26,555.42	21,866.29	9,647.55
营业利润	4,451.33	3,927.10	1,615.72
利润总额	4,782.05	3,948.57	1,665.77
净利润	4,077.21	3,526.65	1,513.65
归属母公司所有者净利润	4,077.21	3,526.65	1,513.65
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润	3,813.46	3,067.61	1,307.28

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,925.60	3,045.06	1,018.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,305.92	-1,076.72	212.49
筹资活动产生的现金流量净额	135.63	234.50	-507.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.32	-35.70	-1.02
现金及现金等价物净增加额	-284.02	2,167.13	722.14

（四）主要财务指标

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31	
流动比率（倍）	2.01	1.86	1.64	
速动比率（倍）	1.33	1.11	0.94	
资产负债率（母公司）	45.99%	52.51%	48.71%	
归属母公司股东每股净资产（元）	2.56	2.03	1.44	
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	4.72%	8.19%	13.87%	
项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	
应收账款周转率（次）	4.33	5.69	4.38	
存货周转率（次）	2.15	2.09	1.53	
息税折旧摊销前利润（万元）	5,806.20	4,672.85	2,138.56	
利息保障倍数（倍）	23.35	56.32	16.88	
归属母公司股东净利润（万元）	4,077.21	3,526.65	1,513.65	
归属母公司股东扣除非经常损益后净利润（万元）	3,813.46	3,067.61	1,307.28	
每股经营活动现金净流量（元）	0.32	0.51	0.17	
每股净现金流量（元）	-0.05	0.36	0.12	
基本每股收益（元）	扣除前	0.68	0.59	0.25
	扣除后	0.64	0.51	0.22
稀释每股收益（元）	扣除前	0.68	0.59	0.25
	扣除后	0.64	0.51	0.22
加权平均净资产收益率	扣除前	30.08%	33.82%	19.14%
	扣除后	28.14%	29.42%	16.53%

注：上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。

四、本次发行情况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行股数：	拟发行2,000万股，占发行后总股本的25%
发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格
发行方式：	网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行对象：	符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或符合创业板市场投资者适当性规定的合格境内自然人投资者

五、募集资金用途

根据本公司2010年年度股东大会、2011年第二次临时股东大会，公司拟向社

会公众公开发行人民币普通股2,000万股，占发行后总股本的25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为_____，账号为_____。

本次发行股票募集资金投资的项目包括：

单位：万元

序号	投资项目	项目实施主体	投资总额	拟募集资金使用量
1	SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目	劲拓精密	10,517.83	10,517.83
2	研发中心建设项目	劲拓精密	4,142.16	4,142.16
3	其他与主营业务相关的营运资金	劲拓股份	-	-

首次公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；募集资金不足时，不足部分由公司自筹资金解决。

六、公司的核心竞争优势

（一）技术与研发优势

1、领先的技术优势

经过多年的技术沉淀，公司已形成较强的技术与产品创新能力。公司目前是电子整机装联焊接设备子行业的龙头企业，在热工学温度控制方面取得了多项创新成果。公司已取得电磁推进（MHD 电磁泵）技术等 38 项专利技术，软件著作权 15 项，已受理申请的专利 22 项。同时拥有高效热传导、液态金属的泵送技术、矢量图像识别和等离子控制技术等技术 17 项非专利技术。

公司研发的 SM 无铅波峰焊锡机上的电磁推动式波峰炉胆在 2008 年获得欧盟的专利荣誉，公司完全自主研发的新一代“全节能环保型双曲线回流焊”技术及“全模组化的选择性波峰焊”技术达到了国际先进水平。其中，双曲线回流焊（Multi-Profiles）是具有创新概念的产品，即在一台回流焊设备中同时运行两种完全不同的工艺制程，通过软件对每件产品进行工艺监控及优化，不仅具有优秀

的技术指标，而且在比传统产品产量大一倍的情况下能耗低 30%。而模组化的选择性波峰焊则是业内率先标配视觉定位及自动误差补偿的选择焊，采用多轴、多平台实时伺服控制系统，智能无缝扫描数据输入等独创技术。

近年来，发行人利用热传导方面的传统优势，自主研发并掌握了可用于太阳能光伏设备领域的高温快速热处理技术，该技术采用高温、高速、高精度、陡升、陡降的尖峰工艺曲线，能够保证剧烈温度变化下的温度均匀性，从而实现高温条件下的高效热传递。

2、优秀的研发团队和完善的研发体系

公司始终把建设稳定的研发技术团队放在首要位置，建立了从选拔、实习、培训、考核、晋升等一整套公开、公平的以业绩为导向的管理方法，打造了一支专业化、富有激情的研发团队。截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 95 人，汇集了电气、机械、软件等各个领域的专业人才，上述人才占员工总数的 14.80%。

公司建立了较为完善的研发体系：成立了以营销、财务、技术专家组成的跨部门项目评审小组，对项目的立项、实施、验收等环节进行监督管理；实行公司指定战略项目和员工自荐项目相结合的研发管理体制；根据研发项目的技术深度和预期的经济效益以及项目开发的效果、进度及成果对项目开发人员进行绩效考核和奖励，提高研发人员的积极性。

3、持续不断的研发投入

为了保障技术的先进性，公司常年保持领先于行业水平的研发投入，近三年，发行人在研发方面的投入分别为 607.30 万元、1,192.27 万元和 1,192.77 万元，保持了较高的增长。

（二）产品品质优势

公司通过深入理解客户需求，制定详细供应链，从产品设计，研发到生产及售后都有完善的审核、评估及改善的机制。目前，公司已通过了 SGS 的 ISO9001（2008 版）质量管理体系认证，并引入 ERP 系统实现了内部信息化管理，提升了内部控制与财务分析水平。公司设置有专职的工艺部门，制定合理、可靠、先进的制造工艺，推动产品质量的不断提高。近年来公司一直组织品质圈（QCC）和改善提案活动，充分调动了全体员工参与改善的积极性，使工作场所充满生机

和活力，产品质量处于同行领先水平。另外，在回流焊、波峰焊缺乏国家及行业标准的情况下，公司积极探索并建立了企业标准，该标准已于 2007 年通过了深圳市质量技术监督局的备案审核。

由于对生产质量的严格管控，公司的产品屡获殊荣。公司的回流焊、波峰焊产品获“中国国际专利技术与产品交易会金奖”和“第七届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖”等奖项。2007 年 6 月，公司产品中的 VS 无铅热风回流焊机、SM 全自动无铅电磁波峰焊锡机，通过了深圳市高新技术产业协会专家鉴定，结论为“该产品的综合技术性能指标达到国内领先、国际先进水平”。同时上述产品还被评为 2007 年广东省重点新产品并通过了产品 CE 与 ROHS 认证。

（三）生产制造优势

在生产制造型企业中，企业的生产制造体系直接决定了生产效率，从而决定了该企业的成本控制、产品质量、市场响应速度等环节，最终影响到企业绩效目标的实现。公司追求精益生产，注重生产制造的每一个环节。

1、自主生产模式的优势

公司拥有钣金、机加、装配等完整的生产工序链，坚持采取自主生产模式，只有在产能不能满足订单需求时才进行少量外协生产。公司这种自主生产的模式一方面使得生产环节可以更好地与市场 and 研发相衔接，从而确保新产品的推出速度及交货周期；另一方面有利于公司严格监控设备制造过程中整条生产线的运行状态，从而保证产品品质。

2、生产组织的创新

在生产方式上，公司借鉴国外企业的一些管理精髓（如 JIT 准时化生产方法和 TOC 约束理论生产模式等），结合行业特征和自身特点进行创新，将代工厂的快速、灵活、弹性化的生产方式引入到日常生产管理过程中。每天根据订单情况进行生产线调整，合理地进行产品的生产排单，将计划的推动生产与各车间各工序的拉动生产进行对接，从而实现优化资源配置，快速响应变化，提高生产效率；在生产的标准化上，公司设立专门的工艺小组，细化生产工艺并推广标准化和模块化生产，降低对员工个人技能的依赖，同时提高生产效率；在生产布置上，布局合理，用较少的占地面积实现产量最大化。公司在仅有 2 万平方米厂房面积的条件下，焊接设备单月产量突破 140 台，远高于同行业平均

水平。通过上述优化和创新后，公司在与行业内其他企业相比时，市场反应速度更快、交货期更短、产品的单位生产成本更具优势，这也是公司近年来销售持续增长和产品利润率领先于行业平均水平的重要因素。

第三节 本次发行概况

本次发行已经公司 2011 年 2 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议以及公司 2011 年 3 月 11 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

一、发行人基本情况

公司名称	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
英文名称	Shenzhen JT Automation Equipment Co.,Ltd
成立日期	2004 年 7 月 27 日
整体变更设立日期	2010 年 2 月 8 日
法定代表人	吴限
注册资本	6,000 万元
注册地址	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
邮政编码	518126
电话	0755-89481726
传真	0755-29586336
互联网地址	http:// www.jt-ele.com
电子信箱	zqtb@jt-ele.com
负责信息披露和投资者关系部门	证券投资部
联系人	罗习雄、刘泉福
联系电话	0755-89481726

二、本次发行的基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：1.00元
- 3、发行股数：2,000万股，占发行后总股本的25.00%
- 4、每股发行价格：由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果确定
- 5、发行市盈率：**【】**倍（每股收益按照2011年经审计归属于公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
【】倍（每股收益按照2011年经审计归属于公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行

后总股本计算）

- 6、发行前每股净资产：【】元（按照2011年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
- 7、发行后每股净资产：【】元（按照2011年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产考虑募集资金的影响除以本次发行后总股本计算）
- 8、发行市净率：【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
- 9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
- 10、发行对象：符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或符合创业板市场投资者适当性规定的合格境内自然人投资者
- 11、承销方式：以主承销商余额包销的方式承销
- 12、募集资金总额：【】万元（未扣除发行费用）
- 13、募集资金净额：【】万元
- 14、发行费用概算：【】万元
- 其中：
- （1）承销及保荐费用：【】万元
- （2）审计、验资及评估费用【】万元
- （3）律师费用：【】万元
- （4）发行手续费用：【】万元
- （5）信息披露及招股书说明书印刷费用：【】万元

三、本次发行相关中介机构

（一）保荐机构（主承销商）

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

注册地址：福建省福州市湖东路268号

保荐代表人：刘秋芬、徐长银

项目协办人：郑杰

项目经办人：杨帆、周丽涛

电话：021-38565656

传真：021-38565707

（二）律师事务所

广东信达律师事务所

负责人：麻云燕

注册地址：深圳深南大道4019号航空大厦24楼

经办律师：张炯、邓海标

电话：0755-88265288

传真：0755-83243108

（三）会计师事务所

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

法定代表人：饶永

注册地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

经办会计师：赖玉珍、谢翠

电话：0755-82310008

传真：0755-82237546

（四）资产评估机构

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：黄西勤

注册地址：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室

经办资产评估师：熊钢、王允星

电话：0755-88832456

传真：0755-25132275

（五）股票登记机构

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电 话：0755-25938000

传 真：0755-25988122

（六）收款银行

收款银行：兴业银行福州分行清算中心

开户名称：兴业证券股份有限公司

账号：117000172600001636

（七）本公司与上述中介机构之间的关系

本公司同本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行预计时间表

- 1、刊登发行公告的日期：【】年【】月【】日
- 2、开始询价推介的日期：【】年【】月【】日
- 3、刊登定价公告日期：【】年【】月【】日
- 4、申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日
- 5、股票上市日期：本次发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌上市。
请投资者关注本公司与保荐机构（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，发行人存在的风险如下：

一、宏观经济波动的风险

发行人生产的波峰焊、回流焊等电子整机装联设备主要提供给下游的电子制造企业，因此发行人所处的电子整机装联设备行业与电子制造业的发展具有一定的联动性。由于电子制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，因此在宏观经济环境不佳的情况下，电子制造企业会相应缩减设备类固定资产的投资支出，从而影响本行业的发展。

2008 年以来，由于受国际金融危机的影响，电子产品市场需求减缓，电子产品制造企业相应削减或推迟了生产设备的投资，导致电子整机装联设备行业的发展也受到了较大的影响。

虽然自 2009 年下半年开始，在宏观经济形势好转和一系列国家政策相继出台等利好因素驱动下，电子整机装联设备行业呈现迅速复苏的态势，行业各项经济指标快速增长；但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与发行人面临的市场规模存在一定的关联性，如果未来宏观经济景气度继续出现大幅波动，有可能对电子整机装联设备行业需求的持续快速增长带来不利影响。

二、市场竞争加剧的风险

目前，国内电子整机装联设备行业竞争状况呈现两级分化格局：一是数量众多的低端设备生产商，企业规模较小，生产部分低档次、低价格的产品，上述企业主要参与低端市场的竞争，竞争激烈；二是生产中、高端产品的企业，生产的部分设备性能接近或达到了国际先进水平，主要参与中高端市场的竞争，市场竞争者相对较少。

发行人作为国内电子整机装联焊接设备行业的龙头企业，在市场上已占据了较大的份额，公司主要参与焊接设备中高端市场的竞争，目前主要的竞争者包括

美国 BTU、Heller 等。由于国内市场容量巨大，中高端市场较高的毛利率将吸引国内其他竞争对手进入；同时，一些国际同行业制造商也可能加快实施本土化生产战略，加剧市场竞争状况，发行人存在因市场竞争加剧导致市场份额下降的风险。

三、技术开发及技术更新的风险

发行人所从事的行业涵盖物理学、热工学、自动控制、力学和数学等多门学科，对进入该行业的企业技术整合要求很高，需要企业进行不断的研发投入并相应地予以市场化和产业化。

为保持持续的技术领先优势和拓展新的市场空间，自 2009 年以来，发行人先后通过受让运英软件、西南公司相关的技术及引进核心人才，介入与主业密切相关的 AOI 检测设备和 PECVD 设备的研制生产。经过两年的发展，发行人已经完全消化吸收了与 AOI 相关的技术，并在此基础上形成了具有自主研发能力和核心技术优势的 AOI 研发团队。

但对于 PECVD 设备，由于该产品正处于样机研制阶段，发行人在现阶段对转让的氮化物沉积系统技术存在一定的技术依赖，如果未来相关技术未能有效转化为产品，并顺利进行市场化，将会对发行人未来的技术开发和经营业绩产生一定的影响。

四、新增产能无法消化的风险

本次募集资金项目全部达产后，公司将新增焊接设备和 AOI 设备产能 1,350 台，这对公司销售提出了更高的要求。尽管目前与这些设备相关的行业仍将面临较好的市场发展空间，但如果未来市场环境出现较大变化，销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力。

五、税收优惠风险

公司自 2007 年开始获利，经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局下发的《减、免税批准通知书》（深国税宝西减免【2007】0115 号）核准，公司减免税

期限为：2007年1月1日至2008年12月31日免征企业所得税，2009年1月1日至2011年12月31日减半征收。2011年7月28日，深圳市国家税务局出具深国税函【2011】261号《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司企业所得税税率问题的复函》对公司所得税税率实缴比例核实如下“该企业2008年实征税率为0%，2009年实征税率为10%，2010年实征税率为11%，2011年实征税率为12%”。

2011年公司根据深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局深国税宝西减免备案【2011】134号税收优惠登记备案通知书，按高新技术企业15%的税率申报缴纳企业所得税。2012年公司仍可享受15%的高新技术企业优惠税率。若2013年公司无法通过国家高新技术企业复核，则将面临所得税税率上升的风险。

报告期发行人据此减免的企业所得税分别为161.32万元、444.41万元和441.34万元，占当期净利润的比例分别为10.66%、12.60%和10.82%，占比较低。公司2008-2010年所享受的税收优惠政策仅是深圳市人民政府的相关规定，缺乏相关法律、国务院或者国家税务总局颁发的税收规范性文件作为依据，公司存在补缴企业所得税的风险，因此公司报告期内已将各年度据此所减免的所得税列入非经常性损益。除此之外，2011年3月，发行人控股股东及实际控制人吴限出具《承诺函》：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”，故公司2008-2010年所得税补缴风险不会对公司业绩造成重大不良影响。

六、应收账款增长较快的风险

2009年末、2010年末和2011年末，发行人应收账款余额分别为2,795.80万元、5,168.77万元和7,564.65万元，2010年末和2011年末应收账款余额分别比同期增长84.88%和46.35%。报告期内应收账款的快速增长主要源于收入的快速增长所致（同期营业收入的增长分别为126.65%和21.44%）。

报告期内，账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例平均约为93%左右。发行人的客户主要是信誉良好的大型跨国公司或国内大中型企业，发生坏账的可能性较小。为降低发生坏账的可能性，发行人已经制定了行之有效的《往

来账款管理制度》。

虽然发行人采取了一系列行之有效的措施控制应收账款回收的风险，但如果未来国内外宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别客户的经营出现困难，则发行人亦存在应收账款发生坏账的风险。

七、产品毛利下降的风险

2009年、2010年和2011年，发行人主营产品焊接设备的销售毛利率分别为41.93%、44.38%和41.27%，毛利率保持在较高的水平。报告期内，国内电子整机装联设备生产厂商之间的竞争加剧，从而使得相关设备价格逐年下降。随着经济危机的阴霾逐渐消散，发行人焊接设备产品，尤其是高端产品市场需求的增长使得其焊接设备销售均价逐步企稳，但是未来不排除出现由于市场竞争等因素导致焊接设备产品单价下降的可能性，且若在这一条件下发行人未能使得自身产品成本同比例下降，则发行人将面临焊接设备产品毛利下降的风险。

八、原材料采购价格波动的风险

报告期内，公司主要产品焊接设备的单位成本构成中直接材料占比始终保持在85%以上的比例，报告期内，各类原材料，尤其是其中金属板材采购价格的波动直接影响到公司焊接设备产品的单位成本。虽然公司焊接设备产品技术含量高、毛利空间较大，且公司通过制定合理、严格的采购制度严控采购成本，但如果未来原材料价格发生较大波动，而公司又不能采取相应的有效措施，将有可能导致公司产品成本出现波动，从而对公司经营业绩产生不利影响。

九、净资产收益率下降的风险

在报告期内发行人始终保持较快的增长速度，净资产增长幅度较大，发行人2009年、2010年和2011年的加权平均净资产收益率分别为19.14%、33.82%和30.08%；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别16.53%、29.42%和28.14%。预计本次募集资金到位后，发行人资产规模和净资产将有较大幅度的增加。由于募集资金运用项目的完成和利润的实现需要一定时间，因此，预计本次发行后，发行人的全面摊薄净资产收益率与以前年度相比将出现一定程度的

下降。

十、核心技术人员流失及技术失密的风险

发行人近年来发展迅速，生产规模及行业地位不断提高，主要得益于发行人高素质的员工队伍和管理、研发团队，其在发行人降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务等方面起到了至关重要的作用。随着发行人规模的扩大和实力的不断增强，保证员工队伍和管理、研发团队的稳定性，继续培养和引进优秀人才成为发行人未来发展的关键。

为了避免可能出现的技术失密，发行人加强了技术资料的安全管理工作，并对技术资料进行安全等级评估，按照授权使用原则统一管理；对新产品、新项目按开发流程进行统一管理；同时还与技术人员签订了《保密协议书》，改进了技术部门管理机制，提高了技术人员的福利待遇，并对技术人员提供在职培训。另外发行人根据各个技术人员自身的特点，为其确定职业发展规划，并提供明确的晋升渠道，拓宽个人发展空间，从而极大地提高了技术人员的企业荣誉感和凝聚力。

尽管如此，如果发行人未来在人才引进和管理方面出现问题，导致核心技术人才流失、技术人才队伍不稳定，都可能导致发行人技术失密，从而对未来发展产生不利影响。

十一、募集资金项目管理和组织实施的风险

发行人本次募集资金拟用于实施SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目和研发中心建设项目，涉及技术研发与市场开拓等多项内容。尽管发行人董事会已对本次募集资金项目进行了认真细致的可行性论证，并且发行人已经在电子整机装联设备制造的客户和市场开拓方面积累了丰富的经验，但不排除由于预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致可能产生市场前景不明、技术保障不足、融资安排不合理等风险。

十二、资产结构变化带来的风险

根据本次发行人的发行方案，本次募集资金投资项目新增固定资产

12,030.61 万元，较发行人 2011 年末固定资产原值有大幅度增加，发行人资产结构变化明显。根据发行人的折旧政策，固定资产投资年折旧额总计为 787.96 万元，占 2011 年度发行人利润总额 4,782.05 万元的 16.48%。另外，固定资产的增加也使得发行人经营业绩对营业收入变动的敏感性增加。如果市场情况发生变化或募集投资项目预期目标未能实现，对发行人业绩的影响将更为明显。

十三、行业政策变化风险

为推动装备制造业行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。内容详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”。从目前来说，发行人所从事的行业或直接或间接地受到了国家政策的扶持，但不能排除有关扶持政策的变化给发行人经营带来的风险。

十四、实际控制人控制风险

本次发行前，吴限先生作为发行人的实际控制人在发行人中的股权比例为 45.41%。本次发行后，其持有发行人股份仍处于相对控股地位。虽然发行人已经并将继续在制度安排方面加强防范控股股东操控发行人现象的发生，而且发行人自设立以来也未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但即使如此，也不能排除在本次发行后，控股股东如果利用其大股东地位，通过行使表决权对发行人发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，有可能损害发行人及中小股东的利益。

十五、租赁房产未取得产权证书的风险

2010 年 12 月 24 日，公司与深圳市天富安物业管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，租赁期为 3 年，厂房面积 2,450 平米。公司租赁的房产属于历史遗留生产经营建筑，因未办理报建手续而未取得产权证书（深圳市普遍存在的现象），存在被拆迁的风险，但该产权瑕疵不会对公司生产经营产生重大影响，具体情况如下：

- ① 该租赁的厂房主要用于公司研发实验，厂房主要用于放置试验设备、样

机及部分研发人员办公，对厂房无特殊要求，易找到可替代场地。截止本招股说明书签署日，该研发实验室已投入使用。

② 天富安物业于 2011 年 3 月 12 日向公司出具声明“如该房产因被政府拆迁或声明人单方原因，无法履行合同，将提前通知深圳市劲拓自动化设备股份有限公司，并给予合理的搬迁时间，承担因其搬迁而受到的损失”。

③ 深圳市宝安区西乡街道办事处已经出具证明，确认该房产在 2013 年 12 月 31 日前没有被列入拆迁范围，不存在被强制拆迁的情形。

此外为确保生产经营持续稳定及业务进一步发展的需要，发行人购买了位于惠州市大亚湾原西区第一工业园的土地使用权，用于生产规模的扩大及本次募投项目的建设。2011 年 11 月 22 日，发行人子公司劲拓精密取得了惠州市人民政府核发的惠湾国用（2011）第 13210100786 号《国有土地使用权证》。发行人通过购买土地自建厂房解决该房产租赁问题，以彻底实现生产经营的持续稳定。

第五节 发行人基本情况

一、发行人改制重组及设立情况

（一）股份公司设立方式

发行人是由深圳市劲拓自动化设备有限公司以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所审字[2010]034号”审定的截至2009年11月30日账面净资产84,503,760.08元为基准，按照1: 0.710028的折股比例整体变更设立的股份有限公司。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发起人出资进行了验证，并出具了“深鹏所验字[2010]041号”《验资报告》。

2010年2月8日，发行人在深圳市市场监督管理局办理了工商登记，工商注册号为440306103195065，注册资本60,000,000元，实收资本60,000,000元，法定代表人为吴限。

（二）发起人

发行人于2010年2月8日整体变更设立时，全体发起人及其持有股份数与持股比例如下表：

股东	股份数	出资方式	占注册资本比例（%）
吴 限	27,243,000	净资产折股	45.41%
劲通电子	5,730,600	净资产折股	9.55%
孔 旭	4,512,600	净资产折股	7.52%
朱武陵	4,315,100	净资产折股	7.19%
主 逵	3,997,200	净资产折股	6.66%
张纪龙	3,530,000	净资产折股	5.88%
柴明华	2,815,500	净资产折股	4.69%
毛一静	1,588,600	净资产折股	2.65%
罗昌昌	1,420,600	净资产折股	2.37%
朱 玺	1,350,000	净资产折股	2.25%
陈洁欣	1,008,200	净资产折股	1.68%
罗习雄	988,600	净资产折股	1.65%
邹 英	825,000	净资产折股	1.38%
张卫华	675,000	净资产折股	1.13%
总 计	60,000,000	-	100.00%

（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

公司主要发起人为吴限。吴限拥有的主要资产和从事的主要业务详见本节之“七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）、控股股东、实际控制人及其所控制其他企业的情况”。公司设立前后，吴限拥有的主要资产和从事的业务未发生变化。

（四）发行人成立及改制设立时拥有的主要资产和从事的主要业务

公司2010年2月8日设立时拥有的资产全部为承继劲拓有限的整体资产，包括房屋建筑物、机器设备、存货、应收账款、货币资金等。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所审字[2010]034号”《审计报告》，截至2009年11月30日，深圳市劲拓自动化设备有限公司的净资产审计值为84,503,760.08元。

发行人变更前后从事的主要业务为电子整机装联设备的研发、生产和销售。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年度劲拓有限主营业务收入为91,719,698.77元。

在改制设立前后，发行人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

公司系由原有限公司整体变更设立的股份公司，其改制前后的业务流程均未发生变化，公司具体的业务流程和业务模式详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、发行人主营业务的具体情况”之“（二）主要业务和产品工艺流程图、（三）主要业务模式”。

（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人成立以来，在生产经营过程中，与主要发起人吴限控制的劲拓实业在产品购销方面曾经存在部分关联交易。成立以来与主要发起人的关联关系及演变情况参见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联关系”。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人由劲拓有限整体变更，劲拓有限拥有独立资产，变更设立后，发行人完整继承了劲拓有限的全部资产和负债，截至本招股说明书签署日，除一项国际专利正在办理产权变更手续外，劲拓有限的所有资产和负债均已过户至发行人名下。发行人房产、土地、商标、专利、专有技术具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人的主要固定资产及无形资产”。

二、发行人独立运行情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务为电子整机装联设备的研发、生产和销售，公司已经建立了完善的职能部门，具有独立完整的供产销系统，具备独立完整的业务及自主经营能力。

（二）资产独立情况

发行人系由劲拓有限整体变更设立，原劲拓有限资产与业务体系等由发行人完整承继。目前，发行人独立拥有全部有形资产及无形资产的产权，不存在资产不完整情况。截至本招股说明书签署日，发行人没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，发行人对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

发行人已设立股东大会、董事会及监事会，建立、健全了相应的《议事规则》。公司股东大会、董事会及监事会依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。同时，发行人根据经营发展的需要，建立了符合其业务实际的独立、完整的内部组织架构，确保发行人业务的良好开展。发行人经营和办公场所与股东及其关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（四）人员独立情况

目前发行人生产经营和行政管理完全独立于股东单位，发行人独立招聘员工，设有独立的劳动、人事和工资管理体系，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理，全部录用人员均与发行人签订了《劳动合同》，执行独立的劳动人事及工资管理制度。发行人董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等规定合法产生，不存在控股股东越过本公司股东大会、董事会及监事会而作出人事任免决定的情况。

发行人的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪，均不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。发行人财务人员均在公司专职工作并领取薪酬，没有在其他企业兼职或领取薪酬的情况。

（五）财务独立情况

发行人设立了完整、独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人设立了内部审计部并向董事会汇报工作。发行人独立开立银行账户，依法独立纳税。

三、实际控制人焊接设备业务的形成及演变过程

实际控制人吴限曾在贵州铁合金厂、日东电子设备有限公司任职，在此期间，

对焊接设备有一定的了解并积累了部分经验。1996年7月，吴限创办了深圳市劲拓实业有限公司，初始业务为经营电子生产线各种配件并提供相关技术服务。

1998年，劲拓实业开始研发设计并销售回流焊、波峰焊低端机型，产品生产以组装调试为主，生产加工全部外发。

1999年，劲拓实业注册地址变更为深圳市宝安区黄田甜口工业区轻工厂房第二栋，面积约3000平方米。由于生产场地的扩大，劲拓实业购进了部分生产设备并具备了部分机械加工能力。

2001年，劲拓实业放弃了与焊接设备业务无关的其它业务，集中公司人力、财力专门研发、销售由国外厂商垄断的高端回流焊和波峰焊（全自动电脑控制）。同时申请了防氧化套与一种改进的泵送无铅钎料的液态金属电磁泵两项实用新型专利及波峰机外观专利。

2003年，劲拓实业抓住发达国家开始推行电子行业无铅焊接的机遇，在国内率先推出适应无铅焊接的GS系列回流焊和WS系列波峰焊等高端机型。同年，实际控制人吴限的香港朋友黄志华拟在深圳投资设厂，吴限通过协商与黄志华达成如下口头约定：双方共享在焊接设备生产领域的相关技术生产销售波峰焊、回流焊，劲拓实业主要负责国内市场，劲通电子主要负责国外市场，同时，劲拓实业的主要外协生产交由黄志华设立的公司负责，黄志华设立的公司应具备大型的钣金、机械加工能力。2003年3月，黄志华邀请其合作伙伴柴明华在香港设立劲拓设备有限公司，并通过劲拓设备有限公司在深圳设立了劲通电子设备（深圳）有限公司。

2004年，为了保障公司的长远发展，劲拓实业实际控制人吴限决定自建厂房并设立了劲拓有限。

2002年-2004年，劲拓实业通过自身在波峰焊与回流焊焊接技术方面的研发积累，先后申请并取得了5项实用新型专利与2项外观专利，推动并加速了国内电子生产企业由有铅焊锡生产向无铅焊锡生产过渡的更替过程。

2005年，为解决新厂房的建设资金问题，劲拓实业实际控制人吴限决定引入多个投资股东加入劲拓有限。同年，劲拓工业园开工建设。

2007年，建筑面积2.1万平方米的劲拓工业园落成投产。

2008年，实际控制人吴限按此前引进新股东时的口头约定将劲拓实业拥的

商标、专利、市场、人员设备等逐步过渡到劲拓有限，2008 年底，劲拓实业股东会同意劲拓实业开始清算注销。鉴于与劲通电子紧密的业务合作关系，公司决定吸收劲通电子成为公司的股东，并约定劲通电子在成为公司股东后不得继续从事相关焊接设备业务，劲通电子原有与生产焊接设备相关的所有机器设备和部分电子办公设备以评估价值出售给劲拓有限。2008 年 10 月，劲通电子经营范围变更为无铅锡膏的生产与销售。

2009 年开始，公司在业务、技术、资产、人员等方面完全独立于劲拓实业与劲通电子，并于 2010 年 2 月完成股份制改制。2010 年 10 月，劲拓实业完成工商注销。

发行人 2004 年成立后实际控制人吴限从事焊接设备业务的主体包括劲拓有限和劲拓实业，劲拓实业主要资产为机器设备，劲拓有限主要资产为房屋建筑物及其他机器设备，2004 年-2008 年各期末劲拓实业固定资产余额及劲拓有限固定资产、在建工程合计余额情况如下表所示：

单位：万元

	2004 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
劲拓有限	443.97	1,200.84	1,983.98	4,568.98	4,910.83
劲拓实业	120.69	97.24	71.10	47.97	-

在筹备公司上市计划时，由于业务、生产场地、人员及大部分固定资产均在劲拓有限名下，且劲拓有限能够全面反映经营状况和股权架构，因此以劲拓有限作为本次发行上市的主体。

四、发行人设立以来的资产重组情况

（一） 发行人设立以来的资产购买和重组情况

1、收购劲拓实业相关资产

深圳市劲拓实业有限公司系劲拓有限实际控制人吴限所设立的公司，吴限持有其90%的股份，主营业务为焊接设备的生产与销售。为避免与劲拓有限构成同业竞争，劲拓实业于2008年12月31日召开股东会，全体股东一致同意对劲拓实业解散、清算。

为了处置劲拓实业注销后的存货和经营性资产，劲拓有限与劲拓实业签订

《关联交易协议》，根据该协议，公司与劲拓实业所发生的关联交易包括：

(1) 购买存货


鉴于劲拓实业于 2008 年 7 月起已不再对外承接业务，而截止 2008 年 7 月底劲拓实业仍存在一定金额的存货。因此，劲拓实业自当月起逐步将其闲置的存货按照账面价值出售给公司。2008 年内、2009 年 1 月内公司按照账面价值收购劲拓实业存货总计金额分别为 525.69 万元、45.03 万元。

(2) 购买固定资产

2008 年 7 月公司按账面价值收购了劲拓实业闲置的叉车、空压机、在线测试仪、冲床以及电脑等生产与管理用固定资产，收购价款总计 16.13 万元。

(3) 受让无形资产

自 2008 年 2 月起，劲拓实业逐步将其所拥有的与生产焊接设备相关的专利、商标等无形资产无偿转让给公司，所转让的无形资产清单如下：

专利			
转让专利编号	专利名称	类型	转让合格书通知日期
ZL 02 3 32933.5	波峰焊机	外观设计	2008.02.20
ZL 02 2 44386.X	抗氧化套	实用新型	2008.02.15
ZL 03 3 58782.5	波峰焊机	外观设计	2008.05.28
ZL 03 2 09433.7	线路板夹持输送结构	实用新型	2008.02.15
ZL 03 2 82518.8	线路板夹持输送结构的 导电报警装置	实用新型	2008.02.15
ZL 02 2 89236.2	一种改进的泵送无铅钎 料的液态金属电磁泵	实用新型	2008.02.15
ZI 03 2 40152.3	波峰焊机喷嘴	实用新型	2008.02.15
商标			
商标注册号	类别	商标样式	转让证明出具日
3192675	第 35 类	劲拓	2009.12.06
3192676	第 7 类	劲拓	2009.12.06
3211319	第 7 类		2009.12.06
4202636	第 9 类	劲拓	2009.12.06
4202637	第 7 类	劲拓	2009.12.06
4202653	第 40 类	劲拓	2009.12.06
4202654	第 37 类	劲拓	2009.12.06
4202655	第 11 类	劲拓	2009.12.06
4369676	第 42 类	劲拓	2009.12.06

上述资产转让款与公司、劲拓实业间代收货款已在 2009 年内全部结清，公司受让的存货、固定资产在验收合格后于交易当月内在公司账面相应确认为存货

与固定资产，受让的无形资产鉴于未支付对价并未在账面确认为无形资产。

关于报告期内公司购买劲拓实业相关资产及其他往来的具体情况详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、报告期的关联交易”之“（二）偶发性关联交易”之“3、因劲拓实业拟注销而与其发生的关联交易”。

关于劲拓实业设立与注销情况详见本节之“七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人及其所控制其他企业的情况”之“1、劲拓实业”。

2、收购劲通电子相关资产

鉴于公司与劲通电子在焊接设备制造领域内的良好合作关系，且 2008 年初公司上市计划已定，故在公司 2008 年 9 月增资扩股时劲通电子出资成为公司股东，双方由业务合作关系转为股权关系。在劲通电子成为公司股东后，出于避免同业竞争的考虑，公司分别于 2008 年 8 月与 2008 年 9 月分两次收购了劲通电子与生产焊接设备相关的固定资产与无形资产。

2008 年 8 月，公司与劲通电子签订《资产收购协议》，根据该协议约定，公司按照评估价值收购了其生产焊接设备相关的所有机器设备及其他部分电子办公设备。据深圳永信瑞和会计师事务所出具的“深永信评字【2008】第 025 号”《关于劲通电子设备（深圳）有限公司的资产评估报告》评估结果显示，劲通电子拟转让的机器设备、电子设备在评估基准日 2008 年 5 月 31 日评估前账面净值为 647.24 万元，评估净值为 603.63 万元，公司为此资产收购共计支付 29.90 万元相关税费，收购价款总计 633.53 万元。该笔收购款项公司已于 2008 年 8 月 31 日支付完毕。

2008 年 9 月，公司与劲通电子签订《无形资产收购协议》，根据该协议约定公司按照账面价值收购了劲通电子拥有的与设计焊接设备相关工程制图软件，收购价款总计 20.11 万元，并于当月内按照收购成本在公司账面将收购的相关资产确认为无形资产。收购款项于 2008 年 10 月在与劲通电子结算货物采购款时一并支付。

报告期内，公司并未自劲通电子受让任何专利或非专利技术，双方不存在技术转移关系。上述资产收购完成后，劲通电子主营业务转为无铅锡膏的生产与销售，所从事业务与公司主营业务不存在同业竞争。

资产转让完成后劲通电子与公司在业务、技术、客户等方面的具体情况对比列示如下表：

	发行人	劲通电子
主要业务	研发、生产和销售电子整机装联设备、太阳能光伏设备	研发、生产经营无铅锡膏（焊接材料）
主要产品	波峰焊、回流焊、AOI 及高温烧结炉等设备产品	无铅锡膏
核心技术	涉及温度控制、真空技术和视觉识别等方面	配方
主要原材料	不锈钢板、铝材、铜材、钛材、电子元器件、测温仪等	锡粉与松香
主要客户	伟创力、富士康、捷普、TCL、格力电器、海尔集团等大中型电子制造企业和家电生产企业	前五大客户为：深圳市兆恒兴电子有限公司、东莞信彩电子有限公司、深圳市普能达电子有限公司、深圳市卓呈电子有限公司、深圳市蓝达镭得电子有限公司，上述客户合计占比 90% 以上

从上表可以看出，公司主要业务为电子制造企业提供专业的电子整机装联设备，主要产品为电子专用焊接设备、AOI 和高温烧结炉等设备产品，而劲通电子主要业务为研发、生产经营无铅锡膏；在核心技术方面公司拥有三大类共 17 项核心技术，主要涉及温度控制、真空技术和视觉识别等方面，而劲通电子的核心技术在于对原材料的调制能力和自身的独特配方；在原材料方面，公司的主要原材料为不锈钢板、铝材、铜材、钛材、电子元器件、测温仪等，而劲通电子主要原材料为锡粉和松香；最后在客户方面，尽管劲通电子经营的锡膏与公司经营的焊接设备等理论上存在相同的客户，但实际上由于劲通电子规模较小，年销售收入仅为一百多万元人民币，客户主要为规模较小的电子制造企业，而发行人年销售收入两亿多元，下游客户主要为伟创力、富士康、捷普以及 TCL、格力等大中型电子制造企业和家电制造企业，目标客户定位不一致。报告期内，发行人与劲通电子存在相同客户仅深圳市兆恒兴电子有限公司一家，期间公司累计向深圳市兆恒兴电子有限公司销售设备及配件 96.9 万元，金额较小，且销售的并非同一产品。因此，综合来看，劲通电子业务转型后即不再与公司存在同业竞争的现象，2009 年初劲通电子将剩余的少量焊接设备零配件存货及其他存货处理给劲拓有限后双方不再发生任何业务、资金往来。

3、收购运英软件与生产 AOI 检测设备相关资产

2009 年 8 月为了充分利用公司在电子整机装联设备多年来积累的客户资源

和品牌优势，进一步丰富公司的产品线，公司决定通过购买深圳市运英软件开发有限公司 AOI 设备的相关无形资产。鉴于该无形资产占比较小，未构成重大资产重组。

关于报告期内公司购买运英软件相关资产与其他往来的具体情况详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、报告期的关联交易”之“（二）偶发性关联交易”之“2、收购运英软件与生产 AOI 检测设备相关资产”。

4、剥离劲同矿业与劲同投资

公司为了受让贵阳耐火材料厂破产财产，分别于2007年8月16日、2007年9月28日设立了贵州劲同矿业有限公司及贵州劲同投资有限公司。2008年6月，基于集中精力发展主业的考虑，公司逐步剥离了与主营业务无关的劲同投资与劲同矿业，本次资产重组简要情况如下：

（1）本次资产剥离的程序

① 非主业相关资产纳入劲同投资

2008年6月28日，经劲同投资股东会决议，一致同意劲拓有限以从贵阳耐火材料厂竞拍而来的土地使用权作价人民币18,567,071.73元（评估价值人民币21,413,003.88元）增资劲同投资，同时劲同矿业以现金增资人民币7,032,928.27元，增资后劲同投资注册资本变更为人民币26,600,000元，并于2008年7月10日完成工商变更。

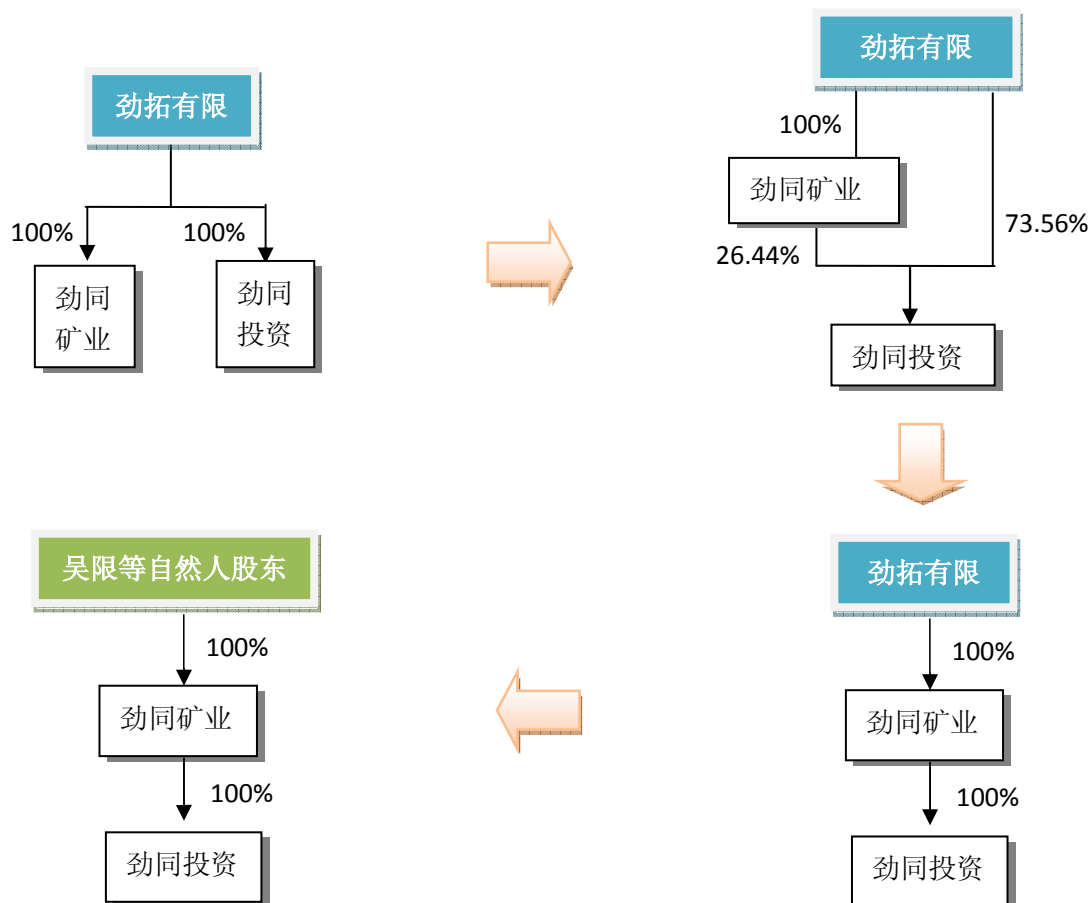
② 劲同投资从劲拓有限的剥离

2008年7月16日，经劲同投资股东会决议，一致同意劲拓有限将其持有劲同投资73.56%的股权按人民币19,567,071.73元的价格转让给劲同矿业。2008年7月16日，劲拓有限与劲同矿业在贵州贵阳签订了《股权转让协议》。劲同投资就上述股东转让事宜对公司章程进行了相应修订，并于2008年7月28日完成了工商变更登记。上述股权转让完成后，劲拓有限不再持有劲同投资的股权。

③ 劲同矿业从劲拓有限的剥离

2008年8月15日，经劲同矿业股东会决议，一致同意劲拓有限将其持有的劲同矿业100%股权以人民币45,321,700元的价格转让给吴限、张纪龙、朱武陵等6个自然人股东。2008年8月18日，劲拓有限与受让方签订了《股权转让协议书》，受让方已按照协议要求支付了股权转让款。

劲同矿业就上述股东转让事宜对公司章程进行了相应修订，并于2008年9月23日完成了工商变更登记。上述股权转让完成后，劲拓有限不再持有劲同矿业的股权。劲同矿业与劲同投资剥离的股权变化如下图所示：



上述股权转让事宜均已履行了必要的法律手续，符合法律、法规和规范性文件的要求，剥离与主营业务无关的资产，符合公司本次发行上市的要求。

（2）本次资产剥离的定价依据

根据发行人说明并经核查，发行人 2007 年设立两公司而短期转让的具体原因为：2007 年劲拓有限为受让贵阳市耐火材料厂破产财产，应当地政府的要求，在贵州设立了劲同投资、劲同矿业两家子公司，2008 年基于公司上市的考虑，劲拓有限剥离了这部分与主营业务不相关业务，将持有的两家公司权益转让给吴限、主逵、张纪龙等人。由于本次转让距离购买耐火材料厂时间较短，且在此期间企业未有具体经营活动，因此劲同投资与劲同矿业的剥离均按照取得成本作为定价依据，即以原出资额的价格转让。

5、劲拓有限竞拍贵阳耐火材料厂破产财产基本情况

（1）贵州耐火材料厂历史演变、股权结构及实际控制人、实际从事主要业务

贵阳耐火材料厂成立于 1958 年，为贵州省省属国有独资企业。根据贵州省冶金工业厅出具的贵冶金（89）第 342 号文件，1989 年 7 月贵阳耐火材料厂重新进行工商登记注册，设立时注册资本为 5,000 万元，法定代表人为赵显继，经营范围为耐火砖、特级高铝熟料及其它耐火材料制品，主管部门为贵州省冶金工业厅。1996 年 6 月，贵阳耐火材料厂变更法定代表人为陶普林，注册资本为 3452 万元。1999 年 3 月贵阳耐火材料厂提出申请破产，并于 2005 年 12 月由贵州省企业兼并破产职工再就业工作协调小组出具文件同意启动破产工作，经贵阳市中级人民法院裁定宣告破产。贵阳耐火材料厂破产清算时，注册资本为 3,323.20 万元，主要经营耐火材料产品加工及销售。2011 年 2 月 22 日，贵阳市工商行政管理局出具了（贵阳）登记内销字【2011】第 0215 号《准予注销登记通知书》，同意贵阳耐火材料厂予以注销登记。

贵阳耐火材料厂为贵州省省属国有独资企业，实际控制人为贵州省国资委。贵阳耐火材料厂实际主要从事的业务为耐火砖、特级高铝熟料及其它耐火材料制品的生产和销售。

（2）破产原因及履行的法律程序

贵阳耐火材料厂因历史遗留问题和经营管理不善，严重亏损，无力清偿到期债务，截至 2005 年 6 月 30 日，该厂账面资产总额为 23,315.54 万元，负债总额为 33,558.86 万元，净资产为-10,243.43 万元，资产负债率为 143.93%。贵阳耐火材料厂经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组列入国家政策性破产关闭计划，贵州省企业兼并破产职工再就业工作协调小组同意其启动破产程序，2005 年 12 月，该厂主管部门贵州省冶金国有资产经营有限责任公司同意该厂申请破产。

①2001 年 4 月，全国兼并破产职工再就业工作领导小组【2001】9 号下达《关于下达天津冶炼厂等 103 户企业破产项目的通知》，贵阳耐火材料厂被批准列为 2001 年全国政策性破产企业。

②2005 年 12 月 14 日，贵州省冶金国有资产经营有限责任公司同意贵阳耐火材料厂申请破产。

③2005年12月16日，贵州省兼并破产职工再就业工作协调小组出具了【2005】36号《关于启动贵阳耐火材料厂破产工作的通知》，同意启动贵阳耐火材料厂的破产工作。

④2005年12月29日，贵州省贵阳市中级人民法院出具了（2005）筑法民三破字第3-1号《民事裁定书》、《民事决定书》和《关于对贵阳耐火材料厂进行规范接管的通知》，宣告申请人贵阳耐火材料厂破产并指定破产清算组成员；

⑤2007年5月25日，贵阳耐火材料厂在贵州日报第八版刊登了《贵阳耐火材料厂破产财产拍卖公告（暨国有资产转让信息公告）》。

⑥2008年11月28日，贵州省贵阳市中级人民法院出具了（2005）筑民三破字第3-17号《民事裁定书》和《公告》，裁定终结贵阳耐火材料厂破产程序并予以公告。

（3）破产财产的具体明细、转让价格及定价依据、是否存在国有资产流失

根据贵阳和禧地产资产评估事务有限公司2006年12月出具的和禧评报字[2006]第23号《资产评估报告书》，公司2007年受让破产财产包括存货、固定资产和土地使用权、采矿权等无形资产，该资产评估以2005年12月29日破产日为评估基准日，资产清算价值合计为7,962.24万元。具体明细如下表所示：

单位：万元

资产项目	评估价
存货	417.74
房屋建筑物类	1,348.06
设备类	592.21
在建工程	143.70
土地使用权	4,387.62
开采权	1,072.90
合计	7,962.24

发行人以公开拍卖方式在拍卖会中以3,600万元的最高出价竞得破产财产，此外还需支付72万元的资产拍卖手续费。由于本次拍卖资产中存货因长年存放未用已无实际使用价值，房屋建筑和在建工程时间久远、破旧不堪，同时该次拍卖资产还需提供不少于1,100个就业岗位用于安置原贵阳耐火材料厂职工，且就业职工正常劳动的年均薪酬不得低于企业所在地当年企业职工平均工资，根据贵阳中道朗信资产评估事务所出具的中道朗信评报【2008】11号《资产评估报告

书》贵阳耐火材料厂资产清算价值应为 3,821.72 万元。因此发行人以 3,600 万元受让贵阳耐火材料厂破产财产系通过公开拍卖方式取得，不存在国有资产或集体资产流失的情形，且受让破产财产履行了相关的法律程序，亦不存在违法违规行为。

（4）受让破产财产履行的法律程序、接收人员情况、及目前经营情况

①2007 年 5 月 28 日，劲拓有限股东会决议，同意购买贵阳耐火材料厂破产资产；

②2007 年 6 月 12 日，劲拓有限与贵州安华白云拍卖行有限公司签订了《拍卖成交确认书》（合同编号：2007-06-12），拍卖成交价款为 3,600 万元；

③2007 年 6 月 15 日，发行人与贵阳耐火材料厂破产清算组签订了《贵阳耐火材料厂破产财产转让合同》。

④2008 年 6 月 2 日，劲拓有限与贵阳耐火材料厂清算组签订了《贵阳耐火材料厂破产财产移交协议》

（5）人员接收情况及目前业务经营情况

劲拓有限于 2007 年 6 月收购因政策性破产企业贵阳耐火材料厂，根据原收购要求，购买方需要向原贵阳耐火材料厂职工提供不少于 1,100 个就业岗位。劲拓有限严格履行该协议，对原贵阳耐火材料厂职工做了妥善安排，同时根据职工的自愿选择，由劲同矿业接收原贵阳耐火材料厂职工 160 多人，由于 2008 年，发行人将劲同矿业和劲同投资剥离，因此发行人目前的员工没有一人来自原贵阳耐火材料厂。

截至目前，贵州劲同矿业有限公司已开展正常经营活动。

（6）土地使用权竞拍价格及其与评估值、增资价格的关系

2007 年 6 月 12 日，发行人通过拍卖竞得贵阳耐火材料厂破产财产，该破产财产整体竞拍价格为 3,600 万元，破产财产包括存货、固定资产、无形资产（土地使用权、采矿权）。因此发行人入账时，将 3,600 万元按各资产占总清算价格的占比重新进行分摊。

由于此次拍卖资产中存货无实际使用价值，公司将存货以 0 元入账；固定资产以其在总清算价格中的占比确定 282.58 万元入账；采矿权以北京中煤思维咨询有限公司 2006 年 10 月 15 日出具的中煤思维评报字【2006】第 48 号《采矿权

评估报告》确定 1,532.71 万元作为入账值，劲同有限公司于 2007 年 9 月将该采矿权以评估值增资劲同矿业。

拍卖价扣除上述固定资产 282.58 万元、采矿权 1,532.71 万元，加上因受让土地使用权产生的手续费 72 万元，因此发行人最终确定土地使用权入账值为 1,856.71 万元。

2008 年 6 月 25 日，贵阳中道朗信资产评估事务所出具中道朗信评报【2008】11 号《资产评估报告书》，该土地使用权评估价值为 2,141.30 万元，略高于公司的入账值，因此 2008 年 7 月，发行人按谨慎性原则，以入账价值 1,856.71 万元作为劲同投资的增资价格。

（二）发行人设立以来资产购买和重组对公司的影响

1、对报告期财务数据的影响

发行人设立以来的上述资产重组行为大部分发生在 2008 年，发生在 2009 年的仅包括：

2009 年 1 月收购劲拓实业 45.03 万元的存货，并于当年内完成商标无偿转让的变更手续；该交易占同期同类交易的占比为 0.71%；

2009 年 1 月收购劲通电子 140.52 万元存货，该交易占同期同类交易的占比为 2.23%；

2009 年 8 月收购运英软件与生产 AOI 相关的专利和技术（4 项专利技术、3 项软件著作权），总金额为 1,308 万元人民币，占 2009 年末无形资产账面价值的 72.33%，尽管从金额占比看对公司无形资产影响比较大，但同年公司 AOI 设备业务实现的销售收入仅占公司总营业收入比重的 2.78%，对公司的财务数据不构成重大影响。

2、对业务经营的影响

2008 年在完成劲拓实业和劲通电子的业务重组后，基本解决了其与劲拓有限的同业竞争和关联交易，增强了公司业务和资产的独立性。

2009 年在完成运英软件 AOI 检测设备无形资产的收购后，劲拓有限的产品线从焊接设备扩展到 AOI 检测设备，增强了其在 SMT 行业的地位。

劲同矿业与劲同投资业务与劲拓有限主营业务不相关，且从 2007 年设立劲同矿业与劲同投资至 2008 年将两者剥离出劲拓有限，劲同矿业与劲同投资均未

正式开展生产经营活动，此次资产剥离行为对公司业务经营不构成重大影响。

3、上述收购、剥离等重组与发行人独立性的关系

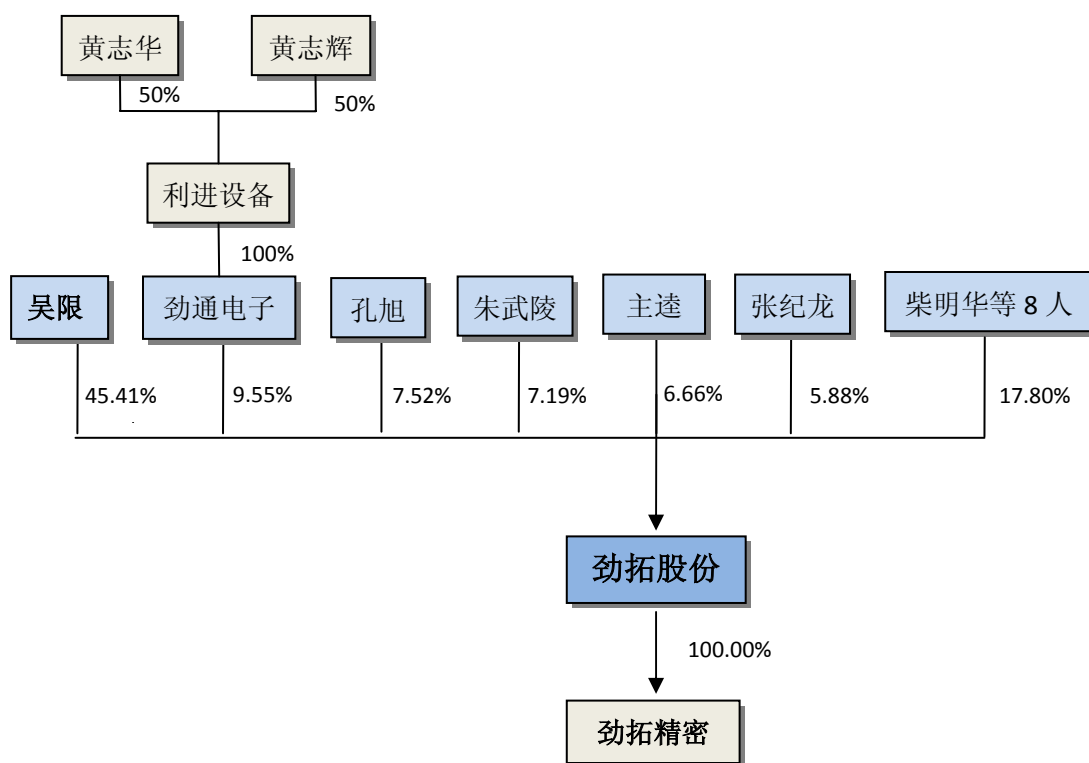
劲同矿业和劲同投资与发行人的主营业务不相关，同时该业务具备独立的供产销系统及人员，因此剥离劲同矿业和劲同投资的股权不影响发行人业务、技术、资产、人员、财务等方面的独立。

通过收购运英软件无形资产形成的 AOI 检测设备业务是发行人原有业务的延伸，报告期内形成的销售收入比例低于 10%。收购完成后，运英软件及其实际控制人以及实际控制人控制的运英科技均不再从事 AOI 业务。收购运英软件不影响发行人业务、技术、资产、人员、财务等方面的独立。

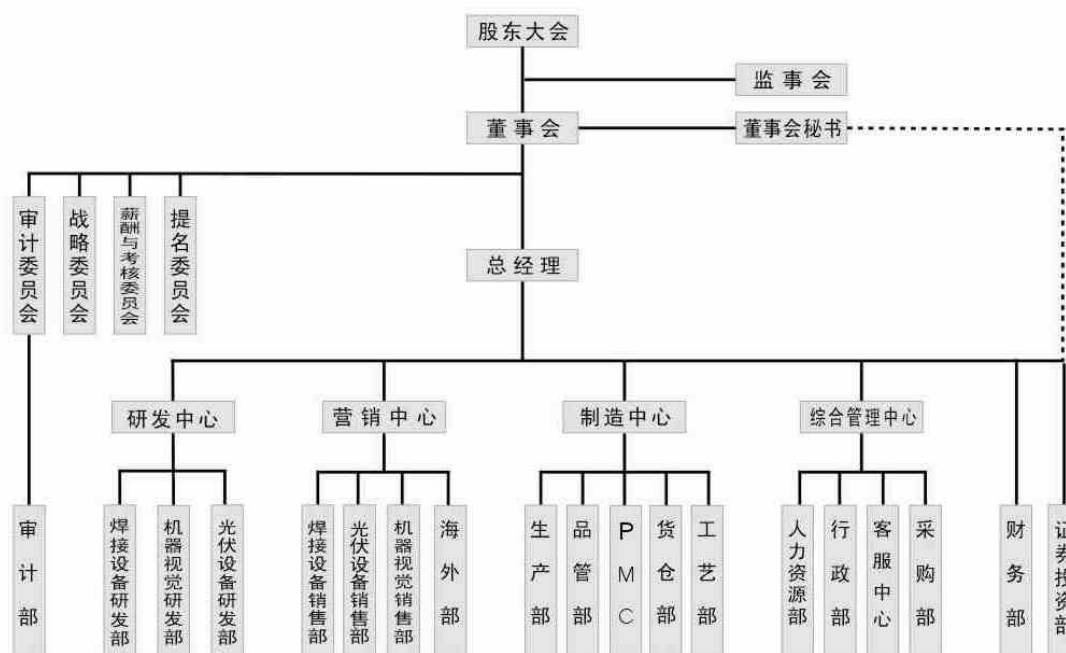
发行人对劲拓实业和劲通电子的业务重组完成后，劲拓实业和劲通电子与焊接业务相关的资产、技术、人员全部进入发行人，发行人在业务、资产、技术、人员、财务等方面完全独立。

五、发行人组织结构

（一）发行人股权结构图



（二）发行人内部组织结构图



（三）本公司各职能部门的职责

股东大会是公司的权力机构；董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责；董事会秘书负责董事会的日常事务，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会；监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会的决议，总经理下设总经理办公室，协助总经理办理日常业务。公司各职能部门的主要职责如下：

1、研发中心：根据公司战略和市场供需情况，制定新产品的开发计划和现有产品的改进计划；负责产品研发的整个流程，包括项目规划、产品设计、工艺设计、样机组装、设计改良等；组织产品研发过程中的阶段评估、技术验证和技术确认；制定新产品的使用说明书及各项操作规范和服务制度；建立健全的研发管理制度，负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；参与制定产品企划及推广方案，会同财务部实施定额考核。

2、营销中心：负责围绕公司销售目标拟定市场开发计划，推广产品品牌，完成销售任务；负责现有市场分析和未来市场预测，分析竞争对手，建立及维护营销信息库等。

3、制造中心：该部门下设生产部、品管部、PMC、货仓部及工艺部。生产

部主要负责制定并执行生产计划，监察工作程序，处理应急事件，确保生产任务的完成；严格执行研发和工程的技术要求，并对生产工艺进行细化和明确；不断的推进题案改善，提高生产效率，提升品质，提高作业安全度及降低成本；负责生产人员的管理、培训和调配；维护及保养生产设备。品管部主要负责制定及监督实施质量标准，推行及组织认证质量体系；负责原料入厂质量检验的执行及异常情况处理；负责各生产工序在产品生产过程中质量的检查与记录；负责成品各项功能的检测；跟踪处理质量异常产品，协同处理质量投诉等。PMC主要负责组织生产计划的制定，控制生产进度以及进行生产任务的调配；负责物料计划、请购、调度及控制；负责生产负荷统计和产销平衡调度；负责各个车间之间的协调等。仓管部主要负责物料、半成品、成品的仓库管理，包括办理入库出库、库存管理、存货盘点、退料换料；仓库现场管理、库存有序排放、各类报表的编制；分析库存结构和存货周转状况，编写相关报告。工艺部主要负责对研发设计的可靠性、安全性、可制造性、合理性进行验证，并提出改善方案；解决生产中的工艺问题，制定相关的作业标准、设计对应的治具、检具，并制定防错措施；研究研发设计的钣金图纸，简化生产线员工的操作难度；对重点的机加工件制定生产工艺流程，提高制造质量等。

4、综合管理部：该部门下设人力资源部、行政部、客服中心和采购部四个部门。人力资源部主要负责人力资源规章制度的建立、颁布和修改；负责新员工的招聘、培训计划的制定和实施、员工考勤管理和离入职手续办理；负责生产安全、消防安全管理；推动并跟进绩效管理考核，管理薪酬福利，处理各种劳动关系等。行政部主要负责厂区基建与厂区内土建工程的维护；负责生产及生活设备检验、维修、水电施工等；负责清洁用品、工衣、办公设备等物资管理，厂区卫生的维护和清洁人员的管理；负责伙食供应与管理，休闲娱乐设施管理；负责前台管理、门卫管理、司机管理和车辆管理。客服中心主要负责提供产品售后服务；收集客户信息，进行客户信用调查，建立及维护客户资料库；受理客户投诉；负责海外经销商售后物料的发放管理等。采购部主要负责采购合同的签订和实施；供应商的选择与考评；建立供应商管理机制，控制采购成本；收集市场供求信息，保质、优质采购等。

5、财务部：负责公司日常财务核算，会计资料归档保管，出具外部财务报

告，做好内部控制，参与公司经营管理。负责公司纳税筹划及税务申报，协调税务、工商、财政、统计等政府部门工作。负责组织预算的制定，分析反馈预算执行情况，加强财务分析，出具内部财务管理报告，为公司决策提供依据。负责融资渠道建设、管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金安全、高效运转。负责严格财务管理，加强财务监督。

6、证券投资部：筹备股东大会、董事会和监事会会议的召开；协助董事会依法行使职权，督办董事会相关决议的执行和落实；保管公司股东、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料，以及董事会印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录等；及时了解募集资金投入项目的进度、资金投入情况，及公司的重大事件的进度；公司上市后负责与政府监督部门、新闻媒体、证券研究机构等部门和机构的联络工作，做好公司临时信息和定期报告编制和披露工作等。根据公司中、长期战略规划，组织编制公司年度综合投资预算及投资计划；制订并完善对外投资管理制度，对投资、年度预算、资金运作、项目的管理等进行总体控制；监督检查投资管理制度的执行情况以及适当及时的调整；投资项目调研论证；投资项目跟踪管理。

7、审计部：制定公司内部审计工作制度，编制公司年度审计工作计划；审查公司的内控制度；监督公司财务信息的披露；根据董事会的意见，组织对公司重大的带倾向性的财务收支和经济利益进行审计调查；负责内部审计与外部审计之间的沟通，完成相关审计工作。

六、发行人控股子公司、参股公司情况

发行人控股子公司为惠州市劲拓精密装备有限公司，目前发行人持有劲拓精密100%股权。

劲拓精密成立于2011年2月23日，注册资本人民币1,000万元，实收资本1,000万元；注册地为惠州大亚湾澳头安惠大厦2栋802号房，法定代表人为吴限，经营范围为：机械设备、电子设备及其零配件的购销；无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片、上下料机、接驳台、AOI产品、太阳能设备的研发、设计和销售（不含商场、仓库经营）。劲拓精密目前暂未开展具体经营活动。

七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

公司的控股股东和实际控制人为吴限，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 52250219680501****。截至本招股说明书签署日，吴限持有本公司股份 27,243,000 股，占本次发行前总股本的 45.41%。吴限的情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。

（二）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况

1、劲通电子设备（深圳）有限公司

（1）劲通电子简要历史沿革及实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，劲通电子设备（深圳）有限公司持有本公司股份 5,730,600 股，占本次发行前总股本的 9.55%。劲通电子于 2003 年 5 月在深圳市工商行政管理局注册成立，注册号：440306503315605，住所为深圳市宝安区西乡黄田村甜口工业区第五栋，注册资本（实收资本）为港币 300 万元，法定代表人、执行董事为柴明华。2008 年 6 月 27 日劲通电子法定代表人、执行董事变更为黄志华。

2004 年 6 月 29 日，劲拓设备有限公司对劲通电子增资，劲通电子注册资本变更为港币 500 万元。自此之后，劲通电子股权结构与注册资本未再发生变化。

2008 年 10 月 22 日，劲通电子住所变更为深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 C6 栋 1802A。

截至本招股说明书签署日，劲通电子股东为利进设备有限公司，实际控制人为黄志辉、黄志华。

利进设备有限公司原名为劲拓设备有限公司，成立于 2003 年 3 月 26 日，注册资本金 1 万港币，其中黄志华和柴明华各拥有 50% 的股权，业务性质为贸易。

2007年12月14日，柴明华将其拥有的全部股权转让给黄志辉。2008年7月3日，劲拓设备有限公司更名为利进设备有限公司。

（2）劲通电子从事业务情况、最近三年的主要财务数据及经营合规性

① 劲通电子从事业务情况

劲通电子设立后至2008年10月15日，主要从事焊接设备的生产和销售及机械加工业务。在劲拓有限收购劲通电子固定资产前，劲通电子在国内市场主要业务为劲拓有限提供焊接设备半成品，在海外市场主要业务为销售焊接设备产品。2008年8月劲通电子将其全部固定资产出售给劲拓有限，2008年10月15日其业务范围变更为无铅锡膏的生产和销售，自此之后其与发行人不再存在同业竞争关系。

② 劲通电子主要财务数据

劲通电子最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表			
	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
资产总额	2,373.08	2,425.39	1,577.40
总负债	1,023.08	1,062.64	142.11
所有者权益	1,350.01	1,362.76	1,435.29
利润表			
	2009年	2010年	2011年
营业收入	109.56	175.56	84.50
净利润	-29.75	12.75	72.55

注：2009年、2010年数据经深圳弘信联合会计师事务所审计，2011年数据未经审计。

③ 劲通电子无铅锡膏销售定价情况

无铅锡膏根据含银量的不同，可分为Ag3.0和Ag0.3两大类产品，劲通电子销售的锡膏主要为Ag3.0。目前市场上进口Ag3.0的锡膏价格较贵，一般单价在650元/公斤以上，国产品牌Ag3.0锡膏目前单价约为520元/公斤。锡膏由于受原材料金属银价格波动影响，全年价格波动较大，劲通电子2011年销售的无铅锡膏全年平均单价为560元/公斤，目前对外售价为525元/公斤，与国产品牌无铅锡膏的销售均价基本持平。

④ 劲通电子与发行人存在相同客户情况

报告期内，劲通电子锡膏客户中仅存在一家与发行人相同客户的情形，相同

客户为深圳市兆恒兴电子有限公司，发行人与该公司业务往来产品主要为焊接设备及配件。

锡膏价格受原材料价格波动影响较大，且销售单价也和采购数量相关。报告期内，劲通电子销售给深圳市兆恒兴电子有限公司的锡膏单价与劲通电子对外销售单价基本保持一致，接近国产品牌锡膏的市场价格，交易真实、定价公允。经核查，深圳市兆恒兴电子有限公司与发行人及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

⑤ 其他合规情况

根据劲通电子实际控制人黄志华的访谈记录及深圳市人居环境委员会及深圳市区国家税务局、深圳市地方税务局出具的无违规函，近三年劲通电子不存在重大违法违规行。

(3) 劲通电子及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的具体关系

报告期内，劲通电子股东为利进设备有限公司，实际控制人为黄志辉、黄志华，法定代表人、执行董事为黄志华，未设监事。2007年12月柴明华将其所持利进设备有限公司股份转让给黄志辉前为劲通电子实际控制人之一，并在劲通电子担任法定代表人与执行董事。除此之外利进设备有限公司、黄志辉、黄志华与公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，报告期内也未发生任何往来。

2、孔旭

中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为22010519781017****。截至本招股说明书签署日，孔旭持有本公司股份4,512,600股，占本次发行前总股本的7.52%。

3、朱武陵

中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为43030319650212****。截至本招股说明书签署日，朱武陵持有本公司股份4,315,100股，占本次发行前总股本的7.19%。

4、主 逵

中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为52252519691012****。截至本招

股说明书签署日，主逮持有本公司股份3,997,200股，占本次发行前公司总股本的6.66%。

5、张纪龙

中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为44030119630830****。截至本招股说明书签署日，张纪龙持有本公司股份3,530,000股，占本次发行前公司总股本的5.88%。

（三）控股股东、实际控制人及其所控制其他企业的情况

报告期内，实际控制人吴限除控制发行人股权外，还实际控制五家境内公司，分别为劲拓实业、劲同矿业、劲同投资、劲同机械和劲同耐火材料。

1、劲拓实业

劲拓实业曾为实际控制人吴限持有 90% 股权的公司，并于 2010 年 11 月完成注销，具体情况如下：

（1）劲拓实业简要历史沿革

深圳市劲拓实业有限公司设立于 1996 年 7 月 1 日，设立时注册资本为 100 万元，法定代表人为吴限，其设立时各股东出资额及持股比例如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
吴限	90.00	90.00%
谢谨	10.00	10.00%
合计	100.00	100.00%

劲拓实业自设立直至注销时其注册资本金额与股权结构均未发生变化。实际控制人一直为吴限。

根据劲拓实业 2008 年 12 月 31 日股东会决议，各股东一致同意对劲拓实业解散清算，清算基准日为 2009 年 1 月 1 日。2010 年 11 月 30 日，深圳市市场监督管理局出具了《企业注销通知书》，核准劲拓实业注销。

（2）劲拓实业业务情况、设立以来主要财务数据及最近三年经营合规性

劲拓实业主营业务为焊接设备的生产与销售。2007 年发行人新厂房建成投产前，劲拓实业是实际控制人吴限焊接设备业务的主要经营主体；新厂房投产后，实际控制人吴限根据与劲拓有限股东的口头约定，逐步将劲拓实业的焊接业务转移到劲拓有限。2008 年劲拓有限收购劲拓实业与焊接业务相关的固定资产、无

形资产、原材料，并接收其主要人员。2008年7月底起，劲拓实业实际已停止主营业务的经营，2004年以来劲拓实业历年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表							
	2004年 12月31日	2005年 12月31日	2006年 12月31日	2007年 12月31日	2008年 12月31日	2009年 12月31日	2010年 12月31日
资产总额	2,700.09	4,448.06	5,238.21	4,205.81	1,280.38	468.69	-
总负债	1,861.28	3,489.16	4,120.46	3,352.20	875.27	44.13	-
所有者权益	838.81	958.90	1,117.75	853.61	405.11	424.56	-
利润表							
	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
营业收入	4,463.86	5,136.51	7,354.34	5,081.38	1,376.99	-	-
净利润	162.88	120.09	158.85	-264.14	-94.97	-19.60	-

注：其中2004-2007年为未经审计数据，2008年数据经亚太集团会计师事务所有限公司深圳分所审计，2009年、2010年为清算数据。

根据深圳市市场监督管理局、深圳市人居环境委员会、深圳市宝安区国家税务局及深圳市宝安区地方税务局出具的证明，证明报告期内劲拓实业在工商和税收缴纳上不存在重大违法违规行为。

（3）劲拓实业注销的具体情况

① 劲拓实业注销的原因及合理性

鉴于劲拓自动化工业园区建设所需资金量较大，实际控制人吴限决定引进柴明华、张纪龙、朱武陵等股东投资劲拓有限，以解决劲拓有限厂房建设资金问题。在上述股东投资劲拓有限时，实际控制人吴限曾对其口头承诺在劲拓有限新厂房投入使用后将焊接设备业务完整转移至劲拓有限。2007年，劲拓自动化工业园区开始投入使用。2008年初，劲拓实业资产结构中焊接设备业务相关的固定资产等占比较低，主要资产为应收账款与货币资金，经劲拓有限相关股东协商后决定不整体收购劲拓实业，仅收购其与焊接设备业务相关的资产。2008年末，劲拓实业将相关资产、技术、业务、人员均转移至公司后，其股东决议清算注销劲拓实业。

鉴于劲拓实业2008年末账面存在较大金额的应收账款，清理收回该部分应收账款耗时较长，因此直至2010年11月30日，劲拓实业才注销完毕。

② 劲拓实业注销履行的程序

i、2008年12月31日，劲拓实业股东会决议，同意解散公司进行清算，并成立清算组。

ii、2009年1月2日，清算组在深圳特区报刊登了劲拓实业清算公告；2009年1月6日，深圳市工商行政管理局出具了【2009】第1884485号《备案通知书》，对劲拓实业清算组成员予以备案。

iii、2009年3月17日，深圳市国家税务局出具了深国税宝西登销【2009】3619号《注销税务登记通知书》；

2010年7月28日，深圳市长江税务师事务所有限公司出具240692010020023号《关于深圳市劲拓实业有限公司注销地税税务登记鉴证报告》；

2010年7月31日，深圳市长江税务师事务所有限公司出具240692010020075号《关于深圳市劲拓实业有限公司办理税务注销清算所得鉴证报告》；

2010年11月15日，深圳市宝安区地方税务局出具了深地税宝注【2010】10004824号《注销税务登记通知书》。

iv、2010年11月30日，深圳市市场监督管理局出具了《企业注销通知书》，核准劲拓实业办理注销登记。

③ 劲拓实业注销前财务状况及其资产、业务、人员的处置情况

2008年12月31日劲拓实业召开股东会，全体股东一致同意对劲拓实业解散、清算，同日劲拓实业清算组成立，实际控制人吴限为清算组负责人。根据深圳市长江税务师事务所有限公司240692010020075号《关于深圳市劲拓实业有限公司办理税务注销清算所得鉴证报告》，截至2010年6月30日，劲拓实业财务状况如下表所示：

单位：元

项目	金额	项目	金额
货币资金	882,974.39	负债	-
应收账款	3,692,598.85	所有者权益	4,241,731.90
减：坏账准备	333,841.34	-	-
资产总计	4,241,731.90	负债及权益总计	4,241,731.90

劲拓实业注销前资产账面余额总额为4,575,573.24元，其中2,063,525.92元应收账款因无法收回，经深圳市长江税务师事务所有限公司240692010020075号鉴证报告认定全额确认为坏账损失，剩余财产总计2,512,047.32元在支付相关清算费用、职工工资与保险等费用、税款、清偿债务后按照股东投资比例分配给

吴限、谢瑾两位股东。

劲拓实业注销前资产、业务、人员的处置情况如下：

i、截至 2008 年 12 月 31 日，劲拓实业所有的固定资产均已处置，存货仍有账面余额是因当期部分收入按照验收日期需要调整至 2009 年确认从而导致期末存货余额调增，其余资产均为货币资金或应收款项，负债均为应付款项。截至 2009 年 12 月 31 日，劲拓实业与公司之间的应收应付款项全部结清，故劲拓实业清算完成后、注销前不存在与公司应收应付余额。

ii、注销前劲拓实业已停止从事焊接设备业务，在公司销售人员市场开拓与维护工作的基础上，劲拓实业原有的客户基本均与公司建立了业务关系。

iii、自 2008 年年初开始劲拓实业相关销售、生产、行政人员即陆续转移到公司，至 2008 年底劲拓实业全部人员中除少部分自愿离职外大部分均转移至公司，并与公司重新签订了劳动合同。

2、劲同矿业

实际控制人吴限持有劲同矿业95.90%的股权，具体情况如下：

（1）企业基本信息

中文名称：贵州劲同矿业有限公司

设立时间：2007年8月16日

注册资本：人民币70,327,100元

注册地址：清镇市云岭西路

法定代表人：吴限

经营范围：铝矾土、铁矿开采；铝矾土熟料、耐火材料、保温材料、建筑材料、黑色金属、有色金属、铁合金、五金机电销售；机械加工、模具制造、生产加工、销售。

劲同矿业最近三年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表			
	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
资产总额	7,324.84	17,263.88	17,462.00
总负债	2,570.41	9,934.56	10,197.11
所有者权益	4,754.43	7,329.32	7,264.89

利润表			
-----	--	--	--

	2009年	2010年	2011年
营业收入	201.03	699.93	4,438.77
净利润	427.88	15.04	-18.18

注：2009年、2010年数据经贵阳天汇会计师事务所审计，2011年数据未经审计。

（2）简要历史沿革

2007年8月30日，劲拓有限股东会决议以拍卖获得贵阳市耐火材料厂破产资产采矿权对劲同矿业增资，该采矿权经评估后价值为1,532.71万元，本次增资完成后劲同矿业注册资本变更为4,532.71万元，股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
劲拓有限	4,532.71	100%
合计	4,532.71	100%

2008年8月15日，劲同矿业股东会决议，同意劲拓有限将持有的股权转让，其中44.98%股权转让给吴限、12.24%股权转让给柴明华、9.12%股权转让给朱武陵、23.44%股权转让给张纪龙、3.20%股权转让给主逵、7.01%股权转让给林建武。上述股东于2008年8月18日签订了《股权转让协议书》，转让价格以注册资本数额作为依据。本次股权转让完成后，劲同矿业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
吴限	2,039.22	44.99%
柴明华	554.71	12.24%
朱武陵	413.38	9.12%
张纪龙	1,062.47	23.44%
主逵	145.05	3.20%
林建武	317.88	7.01%
合计	4,532.71	100.00%

2010年1月12日，劲同矿业股东会决议，同意柴明华将持有的全部股权按持股比例转让给其余5名股东，转让价格为1元/出资额。2010年1月13日，劲同矿业股东会决议，同意股东按出资比例增加注册资本2,500万元，增资后注册资本为7,032.71万元。2010年1月20日，柴明华与吴限、张纪龙等5人签订了《股权转让协议书》。本次股权转让及增资完成后，劲同矿业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
吴限	3,605.12	51.26%
朱武陵	730.83	10.39%
张纪龙	1,878.36	26.71%

主遼	256.42	3.65%
林建武	561.98	7.99%
合计	7,032.71	100.00%

2010年2月20日，劲同矿业股东会决议，同意朱武陵将持有的10.39%股权转让给吴限，主遼将持有的1.37%股权转让给吴限、1.14%股权转让给张静、1.14%股权转让给张文运。同日，上述股权转让各方签订了《股权转让协议书》，股权转让的价格为1元/出资额。本次股权转让及增资完成后，劲同矿业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
吴限	4,432.10	63.02%
张纪龙	1,878.36	26.71%
林建武	561.98	7.99%
张静	80.135	1.14%
张文运	80.135	1.14%
合计	7,032.71	100.00%

2010年7月20日，张纪龙、林建武分别与吴限、张静、张文运签订了《股权转让协议》，股权转让价格为1元/出资额。2010年7月23日，经劲同矿业股东会决议，同意张纪龙、林建武将持有全部的股权分别转让给吴限、张静、张文运。股权转让后，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
吴限	6,744.67	95.90%
张静	144.02	2.05%
张文运	144.02	2.05%
合计	7,032.71	100.00%

目前劲同矿业的实际控制人吴限也为发行人的实际控制人，除此之外，两公司及其股东与发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

根据清镇市工商行政管理局、清镇市国家税务局红枫管理分局、清镇市地方税务局、清镇市人力资源和社会保障局、清镇市环境保护局、清镇市安全生产监督管理局等部门出具的证明，劲同矿业自2009年1月1日至2011年12月31日无违法违规行为。

3、劲同投资

劲同投资于2008年7月成为劲同矿业的全资子公司，具体情况如下：

(1) 企业基本信息

中文名称：贵州劲同投资有限公司

设立日期：2007年9月28日

注册资本：人民币26,600,000元

注册地址：贵阳市白云区中坝小店街13号（贵阳耐火材料厂俱乐部）

法定代表人：吴限

经营范围：耐火材料、金属和非金属矿、有色金属、黑色金属材料、铁合金产品销售；土地房产出租开发利用、水电汽管理服务。

劲同投资最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表			
	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
资产总额	3,325.59	3,239.90	7,429.19
总负债	149.80	62.49	4,471.35
所有者权益	3,175.79	3,177.41	2,957.84
利润表			
	2009年	2010年	2011年
营业收入	28.49	215.78	1.40
净利润	554.94	2.83	-219.58

注：2009年、2010年数据经贵阳天汇会计师事务所审计，2011年数据未经审计。

（2）简要历史沿革

2008年6月26日，劲同投资股东会决议，同意劲同矿业以货币出资向劲同投资增资703.29万元、劲拓有限以土地使用权向劲同投资增资1,856.71万元，增资后注册资本为2,660万元。劲同投资此次增资后，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
劲拓有限	1,956.71	73.56%
劲同矿业	703.29	26.44%
合计	2,660.00	100.00%

2008年7月16日，劲同投资股东会决议，同意劲拓有限将其持有的劲同投资73.56%的股权以1,956.71万元转让给劲同矿业，定价依据为注册资本对应的金额。同日，劲拓有限和劲同矿业签订了《股权转让协议》。劲同投资本次股权转让后，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
劲同矿业	2,660.00	100.00%
合计	2,660.00	100.00%

截至报告期末，劲同投资注册资本金额及股权结构未再发生变化。

目前劲同投资的实际控制人吴限也为发行人的实际控制人，除此之外，两公司及其股东与发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

根据贵阳市白云区工商行政管理局、贵阳市白云区地方税务局、贵阳市白云区国家税务局、贵阳市白云区人力资源和社会保障局、贵阳市白云区安全生产监督管理局等部门出具的证明，证明劲同投资自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日无违法违规行为。

4、劲同耐火材料

劲同耐火材料于2010年8月成为劲同矿业全资子公司，具体情况如下：

中文名称：贵州劲同耐火材料有限公司

设立时间：2007年9月19日

注册资本：人民币9,000,000元

注册地址：清镇市云岭大街

法定代表人：张文运

经营范围：耐火材料生产、销售（凭环保手续从事经营活动）

劲同耐火材料最近一年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表（2011年12月31日）	
资产总额	832.28
总负债	-55.47
所有者权益	887.75
利润表（2011年）	
营业收入	-
净利润	-4.91

注：以上数据均未经审计

5、劲同机械

劲同机械于2010年11月成为为劲同矿业全资子公司，具体情况如下：

中文名称：贵州劲同机械设备有限公司

设立时间：2007年12月27日

注册资本：人民币3,500,000元

注册地址：贵阳市白云区中坝刚玉南街8号

法定代表人：张文运

经营范围：铝矾土、铁矿开采；铝矾土熟料、耐火材料、保温材料、建筑材料、黑色金属、有色金属、铁合金、五金机电销售；机械加工、模具制造、生产加工、销售。

劲同机械最近一年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表（2011年12月31日）	
资产总额	342.95
总负债	-
所有者权益	342.95
利润表（2011年）	
营业收入	-
净利润	-0.31

注：以上数据均未经审计

（四）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人股份是否存在瑕疵的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东及实际控制人吴限直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）发行人本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，本次发行股份占发行后总股本的比例为 25.00%，发行前后公司股本结构如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
吴 限	27,243,000	45.41%	27,243,000	34.05%
劲通电子	5,730,600	9.55%	5,730,600	7.16%
孔 旭	4,512,600	7.52%	4,512,600	5.64%
朱武陵	4,315,100	7.19%	4,315,100	5.39%
主 逵	3,997,200	6.66%	3,997,200	5.00%
张纪龙	3,530,000	5.88%	3,530,000	4.41%
柴明华	2,815,500	4.69%	2,815,500	3.52%
毛一静	1,588,600	2.65%	1,588,600	1.99%
罗昌昌	1,420,600	2.37%	1,420,600	1.78%

朱 玺	1,350,000	2.25%	1,350,000	1.69%
陈洁欣	1,008,200	1.68%	1,008,200	1.26%
罗习雄	988,600	1.65%	988,600	1.24%
邹 英	825,000	1.38%	825,000	1.03%
张卫华	675,000	1.13%	675,000	0.84%
社会公众投资者	-	-	20,000,000	25.00%
合 计	60,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%

（二）前十名股东

本次发行前，发行人共有 14 名股东，其前 10 名持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	吴 限	27,243,000	45.41%
2	劲通电子	5,730,600	9.55%
3	孔 旭	4,512,600	7.52%
4	朱武陵	4,315,100	7.19%
5	主 逵	3,997,200	6.66%
6	张纪龙	3,530,000	5.88%
7	柴明华	2,815,500	4.69%
8	毛一静	1,588,600	2.65%
9	罗昌昌	1,420,600	2.37%
10	朱 玺	1,350,000	2.25%
	合 计	56,503,200	94.17%

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，本公司前 10 名自然人股东持股及在本公司任职情况如下：

股东姓名	持股数量（股）	持股比例	在本公司任职
吴 限	27,243,000	45.41%	董事长、总经理
孔 旭	4,512,600	7.52%	无任职
朱武陵	4,315,100	7.19%	董事
主 逵	3,997,200	6.66%	董事、副总经理
张纪龙	3,530,000	5.88%	无任职
柴明华	2,815,500	4.69%	无任职
毛一静	1,588,600	2.65%	财务部经理
罗昌昌	1,420,600	2.37%	监事会主席
朱 玺	1,350,000	2.25%	监事
陈洁欣	1,008,200	1.68%	副总经理

本公司自然人股东之间不存在关联关系。

（四）国有股份、外资股份及战略投资者持股情况

本次发行前，发行人不存在国有股份和外资股份。

（五）最近一年发行人新增股东情况、战略投资者持股情况

最近一年发行人不存在新增股东情况；发行人股东中不存在与发行人业务相关的战略投资者。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

本次发行前，发行人各股东之间不存在关联关系。

（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺

1、本公司控股股东及实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、本公司股东劲通电子设备（深圳）有限公司、孔旭、朱武陵、主逵、张纪龙、柴明华、毛一静、罗昌昌、朱玺、陈洁欣、罗习雄、邹英和张卫华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的吴限、朱武陵、主逵、罗昌昌、朱玺、陈洁欣、罗习雄、邹英承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

九、发行人内部职工股、职工持股会等情况

本公司自设立以来，未发行过内部职工股，不存在工会持股、职工持股会、信托持股或股东数量超过 200 人的情况。

2004 年 7 月~2005 年 6 月，吴限曾委托主逵、毛一静和朱玺代为持有其全部

的股权，具体情况如下：

（一）委托持股情况说明

主逵、毛一静和朱玺三名股东均为原劲拓实业老员工，负责日常行政管理工作。劲拓有限首次设立时，实际控制人吴限因业务关系出差较多，出于方便办理公司设立及合口味土地出资手续的考虑，吴限委派上述三人代为持有公司股权。劲拓有限首次设立注册资本为 500 万元，均由吴限个人出资，其中吴限委托主逵代持 40% 股权，委托毛一静代持 30% 股权，委托朱玺代持 30% 股权。

（二）委托持股关系的终止

1、股权的转让过程

2005 年由于劲拓有限建设自有新厂房时，资金需求较大，基于公司发展的考虑，吴限决定引进外部股东。根据劲拓有限 2005 年 5 月 23 日股东会决议，将原先主逵、毛一静和朱玺为吴限代持的股权分别转让给柴明华、朱武陵等 5 人，上述新进股东均为吴限多年的合作伙伴。本次股权调整后，主逵作为共同创业者保留了 5.41% 的股权，其他 16.23% 股权由吴限收回，并将其中 15.80% 的股权分别转让给柴明华、朱武陵和张纪龙。上述股权转让各方均签订了《股权转让合同书》，并经深圳市公证处公证。本次股权转让后，原公司首次设立时的股权代持关系终止。

2、吴限、主逵和毛一静等对相关股权的确认

基于前述吴限委托主逵等人代持股权及 2005 年 5 月劲拓有限股权转让的事实，2011 年 2 月，吴限与主逵、毛一静和朱玺共同签署了《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司股权相关事宜的确认书》，各方承诺如下：

主逵、毛一静和朱玺共同确认：“2004 年 7 月劲拓有限设立时其持有的全部股权均为代吴限持有，对 2005 年 6 月将其名义持有劲拓有限的股权转让给吴限、朱武陵、柴明华、张纪龙和王伟的行为不存在任何异议，并承诺不会向吴限、朱武陵、柴明华、张纪龙和王伟等人主张任何债权或其他权利。”

吴限确认：其与主逵、毛一静和朱玺等人关于劲拓有限股权代持关系已于 2005 年 6 月股权转让完成后终止；对主逵、毛一静和朱玺等人将代持的股权转让给朱武陵、柴明华、张纪龙和王伟等人的行为不存在任何异议；对本次转让后

公司各股东持有的股权比例不存在任何异议；并承诺不会向朱武陵、柴明华、主逵、张纪龙和王伟等人主张任何权利。

（三）结论

综上所述，2005年7月~2005年6月，吴限委托主逵、毛一静和朱玺代为持有劲拓有限的全部股权事宜为真实的。截止2005年6月23日，上市股权代持关系已终止，上述股权权属清晰，不存在任何异议或潜在纠纷。

十、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工基本情况

报告期内，发行人员工人数及变化情况，以及截至2011年12月31日在册员工的专业结构、受教育程度、年龄情况分别如下：

1、员工人数及变化情况

时间	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
员工人数（人）	642	606	488

2、员工专业结构（截至2011年12月31日在册员工）

部门分工	人数（人）	占员工总数比例
研发人员	95	14.80%
技术支持	90	14.02%
销售人员	61	9.50%
财务人员	12	1.87%
行政人员	53	8.26%
生产人员	331	51.56%
合计	642	100%

3、员工受教育程度（截至2011年12月31日在册员工）

受教育程度	人数（人）	占员工总数比例
本科及以上	73	11.37%
大专	159	24.77%
中专及以下	410	63.86%
合计	642	100%

4、员工年龄分布（截至2011年12月31日在册员工）

年龄区间	人数（人）	占员工总数比例
40岁以上	59	9.19%

31-40 岁	184	28.66
30 岁以下	399	62.15%
合计	642	100%

（二）发行人执行社会保障制度情况

1、发行人社保和住房公积金缴纳情况

公司与员工按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定签订了劳动合同，员工根据劳动合同承担义务和享受权利，公司对全体员工提供了必要的社会保障。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已按照国家有关法律、法规为所有适用缴纳社保和住房公积金的员工缴纳了社会保险和住房公积金，具体情况如下表所示：

员工人数	社会保险(五险)			住房公积金		
	五险缴纳人数	未缴纳人数	未缴纳的原因	缴纳人数	未缴纳人数	未缴纳的原因
642	639	3	未缴纳的社保仅为养老保险，其中 1 人属于退休返聘，另 2 人属于超过购买养老保险年龄	638	4	住房公积金每月 18 日扣款，因其中 4 人于 12 月 18 日后入职，只能次月缴纳

①发行人社保缴纳情况

劲拓有限设立以来至 2007 年 7 月，主要从事自有厂房建设，2004 年至 2007 年 7 月，存在未为员工办理社会保险，累计未缴社保金额为 3.00 万元。自 2007 年 8 月起，劲拓有限开始为员工办理社会保险。

发行人办理社会保险员工人数及缴费比例如下表所述：

日期	人数	户籍	养老保险		医疗保险		工伤保险	失业保险	生育保险
			单位	个人	单位	个人			
2007 年	5	深户	10%	8%	6.5%	2%	0.5%	0.4%	0.5%
	64	非深户	10%	8%	8 元	4 元	0.5%	--	--
2008 年	22	深户	10%	8%	6.5%	2%	0.5%	0.4%	0.5%
	277	非深户	10%	8%	8 元	4 元	0.5%	--	--
2009 年	37	深户	10%	8%	4.5%	2%	0.25%	0.4%	0.5%
	440	非深户	10%	8%	6 元	4 元	0.25%	--	--
2010 年	43	深户	10%	8%	4.5%	2%	0.25%	0.4%	0.5%
	561	非深户	10%	8%	6 元	4 元	0.25%	0.4%	--

2011年	35	深户	10%	8%	6.5%	2%	0.25%	0.4%	0.5%
	607	非深户	10%	8%	8元	4元	0.25%	0.4%	--

注：深户员工缴纳的医疗保险为综合医疗保险，非深户员工缴纳的是农民工医疗保险。

根据《深圳市社会医疗保险办法》，生育保险适用于参加综合医疗保险且未达法定退休年龄的人员，但参加综合医疗保险需具有深圳市户籍，且发行人为非深户籍员工缴纳农民工医疗保险。因此，发行人未为非深户籍员工缴纳生育保险。2007年8月至2010年6月期间，公司存在未为非深户籍员工缴纳失业保险的情况，累计未缴纳金额为12.8万元。

针对发行人上述未按规定为员工缴纳社会保险的情形，实际控制人吴限出具承诺：“如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。”

报告期内，公司各项社会保险缴纳的具体金额如下表：

单位：元

年份	养老保险	医疗保险	工伤保险	失业保险	生育保险	合计
2009年	641,351.18	90,337.20	10,765.89	4,770.85	3,791.48	751,016.60
2010年	1,408,154.63	156,033.66	21,736.78	59,913.66	7,728.32	1,653,567.05
2011年	2,124,405.69	190,618.2	45,200.33	124,903.6	8,878.8	2,494,006.6

注：本表中所列示的养老保险与医疗保险金额为公司与个人缴纳部分的合计数

② 发行人住房公积金缴纳情况

根据2010年12月20日开始实施的《深圳市住房公积金管理暂行办法》（深府[2010]176号），公司自2010年12月20日起为员工缴纳住房公积金。该《暂行办法》实施之日以前，深圳市未制订有关住房公积金管理的具体办法，深圳市当时的住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府【1992】128号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府【1992】179号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，深圳市住房公积金仅适用于深圳市常住户口的职工。因发行人非深户籍员工较多，发行人根据自身实际情况，在2010年12月20日前采取发放住房补贴或提供宿舍的方式为员工提供住房保障。同时发行人控股股东及实际控制人吴限承诺：“如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司

不支付任何对价情况下承担该等责任。”

根据深圳市社会保险基金管理局出具的《深圳市用人单位参加社会保险情况证明》，发行人自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，没有因违法违规而被该局处罚的情况。

根据公司所在地深圳市宝安区劳动监察大队出具的《证明》，证明公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日无因违反劳动法律法规而被深圳市宝安区劳动监察大队行政处罚的纪录。

2、发行人子公司办理社会保险和住房公积金的具体情况

发行人子公司劲拓精密自 2011 年 2 月设立以来，未实际开展经营活动，仅由发行人委派一名管理人员兼职处理土地使用权受让及登记等相关事宜。截至本招股书签署日，劲拓精密未办理相关社会保险及住房公积金。

十一、实际控制人、持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况

（一）重要承诺

1、关于股份锁定的承诺

本公司股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就其所持股份的流通限制做出自愿锁定股份的承诺，详细情况详见本节“八、发行人股本情况”之“（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺”。

2、关于避免同业竞争的承诺

发行人的控股股东及实际控制人吴限向发行人出具了关于不同业竞争的承诺，具体内容详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

3、关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺

发行人的控股股东及实际控制人吴限向发行人出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺，具体内容详见“第四节 风险因素”之“五、税收优惠风险”。

4、关于社会保险、住房公积金被追缴风险的承诺

发行人的控股股东及实际控制人吴限向发行人出具了关于社会保险、住房公积金被追缴风险的承诺，具体内容详见本节“十、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）发行人执行社会保障制度情况”。

（二）承诺履行情况

截至本招股说明书签署日，实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事和高级管理人员所做承诺的履行情况良好。

第六节 业务和技术

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况

（一）主营业务

公司的主营业务为研发、生产、销售各类电子工业专用设备，包括无铅波峰焊机、无铅回流焊机、选择性波峰焊机、AOI 视觉检测设备等电子整机装联设备及高温烧结炉等太阳能光伏设备。

公司的电子整机装联设备主要应用于组建电子工业中的 PCBA（Printed Circuit Board Assembly，印刷电路板组装）生产线。印刷电路板，是电子产品中电子元器件之间电气与机械连接的载体，也是现代电子工业的基础，因此本公司生产销售的电子整机装联设备具有广泛的应用空间。下表为使用本公司电子整机装联设备所生产的产品应用领域示例：

应用行业	涉及产品
消费电子制造业	电脑、笔记本电脑、数码摄像机、平板电视、DVD 播放机、机顶盒、DC/DV、移动存储、PND、MP3/MP4、电子书、CD、PS3、Xbox、UPS、LED 显示器等
汽车电子制造业	汽车信息系统（行车电脑）、导航系统（GPS）、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等
通信设备制造业	手机、程控交换机、互联网设备等
航空航天制造业	各类仪表仪器、无线通信、导航卫星
国防电子制造业	各类侦测仪器、雷达、指挥控制系统
其它电子制造业	打印机、复印机、投影仪等

（二）主要产品

公司以多年形成的焊接设备工艺技术和客户群体为依托，开发生产了广泛应用于电子整机装联设备行业的系列设备产品，并利用在热工学领域方面拥有的领先技术优势，将产品范围延伸至太阳能光伏设备制造领域，成功研制出高温烧结炉产品，目前该产品已实现销售。同时发行人的平板式 PECVD 也正在研制之中。

公司代表产品及其应用领域如下所示：

具体产品及型号	产品介绍	产品应用领域
焊接设备--无铅回流焊 (ES/NS/RS/ AS/R 系列)	<p>设备内部的加热电路，将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的 PCB，让元件引脚处的焊料融化使元件与 PCB 连结。</p> 	无铅回流焊主要应用在 PCB 表面组装生产过程中，主要用在 SMT 生产线上。
焊接设备--无铅波峰焊 (KK/WS/NSM/ CELL-450/ TAB 系列)	<p>设备可以将熔化的软钎焊料，经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰，使预先装有元器件的 PCB 通过焊料波峰，实现元器件焊端或引脚与 PCB 焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。</p> 	无铅波峰焊主要应用在 PCB 表面组装生产过程中，主要用在插件式元器件焊接生产线上。
AOI 视觉检测设备 (JTA-200/JTA-300/JTA-400/JTA-500 系列)	<p>基于光学原理及图像识别机器视觉技术来对电子装配生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。</p> 	AOI 主要用于电子产品生产中 PCB 上元件的装配品质检测及工艺品质控制。
周边设备 (FS-450A/ INC-350A/ OUC-400/ BC-350C/ LD Series/ULD)	<p>入板机、出板机和全自动上下料机</p> 	周边设备主要用于电子装配生产中主设备之间的连接与配套。
高温烧结炉 (FF-600 ADF-600 DDF-600)	<p>通过快速热处理的方式，使印刷在晶体硅上的电极浆料与硅片形成良好欧姆接触的设备。</p>  <p style="text-align: center;">烘干/烧结一体炉</p>	高温烧结炉主要用于太阳能电池片生产的烧结工序。

（三）公司主营产品之间的关系和主营业务的演变情况

1、发行人焊接设备、AOI 检测设备、高温烧结炉等产品之间的关系

焊接设备、AOI 检测设备、高温烧结炉以及 PECVD 真空炉在原材料、核心技术、加工工艺、产品性能与用途、市场应用、客户群体等方面的关系及区别如下表所示：

产品	原材料	核心技术	工作原理	加工工艺	产品性能及用途	市场应用及客户群体
AOI	伺服马达，电脑，相机等视觉和运动控制系统	运动控制和视觉识别技术	<p>该图展示了AOI系统的工作流程：首先通过摄像头获取图像，然后由逻辑处理器进行分析，最后输出缺陷检测结果。</p>	摄取图像、运算比对、判断	通过图像识别与处理，用于PCB产品质量的视觉检测	应用于电路板制程领域，与回流焊等组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家，如富士康、伟创力、比亚迪、捷普等
焊接设备	冷、热轧板、电热丝、不锈钢板、合金铝板、温控模块、马达、网带等通用设备产品	温度控制及传热	<p>该图展示了焊接工艺的流程：物料经过预热区、焊接区（含加热器和网带）、冷却区，最后由保温材料包裹。</p>	预热、焊接、冷却	多腔室隧道式低温热风加热方式，300℃左右，用于融化锡浆将电路板与元件焊接在一起	应用于电路板制程领域，客户为电子产品生产厂家，如富士康、伟创力、比亚迪、捷普等
高温烧结炉	冷、热轧板、温控模块、马达、不锈钢板、红外发热管、网带等通用设备产品	温度控制及传热	<p>该图展示了高温烧结炉的工艺：物料经过预热区、烧结区（含红外发热管和网带）、冷却区。</p>	干燥、预热、烧结、冷却	多腔室隧道式高温红外加热方式，1000℃左右，用于融化银浆将硅片与电极烧结在一起	应用于太阳能晶硅电池片生产线上电极烧结过程，客户为太阳能电池生产厂家，如尚德、天合、伟创力、比亚迪、捷普等
PECVD	冷、热轧板、不锈钢板、温控模块、马达、真空泵、电脑、马达等通用设备产品	温度控制及传热 + 等离子	<p>该图展示了PECVD的工艺：物料经过预热区1、工艺区（含加热器和升降台）、冷却区2、冷却区1，最后由不锈钢板包裹，并由运输系统运出。</p>	预热、等离子沉积、冷却	多腔室隧道式中温红外加热方式，450℃左右，利用等离子在硅片上沉积减反射膜	应用于太阳能晶硅电池片生产线上沉积减反射膜过程，客户为太阳能电池生产厂家，如尚德、天合、伟创力、比亚迪、捷普等

2、对发行人是否主要经营一种业务的说明

（1）从行业监管体系来看：

从行业分类上来看，电子整机装联设备和太阳能电池生产设备均属于电子工业专用设备制造业，两个细分行业的主管机构均为工业和信息化部，自律组织均为中国电子专用设备工业协会（CEPEA）。

（2）从发行人业务形成过程来看

发行人自 2004 年成立以来一直专注于电子整机装联设备领域内焊接设备的研发、生产和销售，并在此领域内积累了较为成熟的技术和经验。在业务的发展过程中，一方面，发行人逐渐意识到单一设备销售的市场空间有限，需要丰富产品线；另一方面，电子专用焊接设备一般用于组建 PCBA 生产线，发行人在向下游客户销售焊接设备时，许多客户需对焊接的质量和其他各个生产环节半成品或成品进行质量监测，因此产生了对 AOI 等机器视觉检测设备的大量需求，发行人为顺应客户需求和市场发展趋势，以焊接设备领域内多年形成的成熟客户体系为依托，将产品范围横向延伸，并于 2009 年以技术收购和引进人才的方式切入 AOI 视觉检测设备的研发、生产和销售。

从装备制造业领域的西方发达国家的发展经验来看，近年来，部分电子制造业的设备供应商和电子制造服务企业（EMS）纷纷对其原有的传统电子业务进行升级改造，向具有更高技术含量和更高利润率的半导体设备和太阳能光伏设备行业拓展，发行人深刻洞悉到行业的发展趋势，及时对产品结构进行优化布局。2008 年以来，基于追求高品质设备的制造理念及拓展新利润增长点的战略布局，发行人运用多年积累的热工学知识和自动化技术水平优势，以回流炉和波峰炉设备为依托，将产品范围纵向延伸，将现有温度控制技术和自动化技术应用于隧道式高温炉的开发，该高温烧结炉用于太阳能电池生产线烧结环节上，于 2010 年自主开发成功，并已实现销售。未来公司继续将这些成熟的技术拓展应用于温度精度要求更高的真空炉中，该真空炉将应用于太阳能电池生产核心设备之一的 PECVD（氮化硅薄膜沉积设备）中。

下图为发行人业务形成的脉络及未来发行人业务拓展方向的示意图：



(3) 从核心技术、原材料及客户群体等角度来看

对于发行人传统的焊接设备和目前正着力发展的高温烧结炉、PECVD 真空炉等产品就核心技术、原材料等方面的比较如下：

① 核心技术：发行人业务中的高温烧结炉完全基于焊接设备中回流焊的核心技术——温度控制及传热而发展起来的，不同之处仅在于回流焊大多使用热风对流加热（也有采用红外加热方式的），使用温度较低（最高 300℃），高温烧结炉由于要求快速升温，一般采用红外辐射加热方式，使用温度较高（最高 1000℃），PECVD 真空炉则是在前者的基础上加上了等离子技术，三种产品都应用了工作原理相同的隧道式连续加热装置。

② 原材料：使用相同的原材料及绝大部份相同的元器件，包括冷、热轧板、电热丝、不锈钢板、马达、温控模块、网带等，发行人在大多数原材料的采购方面与上游供应商建立了长期良好的合作关系，因此这些原材料采购管理方面的经验同样适用于太阳能高温烧结炉等产品。

③ 生产工艺：焊接设备、高温烧结炉和 PECVD 真空炉在前端的钣金、机加、喷涂等制造环节完全兼容，三者只是在装配环节有所不同。发行人在焊接设备领域已经具备成熟的研发及生产制造能力，并已拥有大量生产过程中所需的工艺技术和诀窍，这些技术和诀窍同样可以适用于太阳能高温烧结炉等产品的生产制造过程。

④ 客户群体：焊接设备的主要客户群体为电子制造企业，而高温烧结炉的主要客户群体为太阳能光伏企业，表面上看，两者面对的客户群体完全不同，但

实际上，近年来随着新能源的崛起和制造商寻求降低成本的内在要求，两者已出现一定的融合趋势，部分在电子制造领域领先的大型企业逐渐开始向太阳能等新能源领域拓展，如发行人传统客户伟创力、捷普、比亚迪等均已纷纷进军太阳能光伏产业。因此两大类产品在客户群体方面也存在一定的交叉。

综上，高温烧结炉等太阳能电池生产设备是发行人在长期的技术沉淀和业务实践基础上发展起来的，是自然而然形成的；太阳能电池生产设备的研发生产是基于发行人在焊接设备领域所拥有的热工学技术拓展而来，源于同一核心技术，两类设备是同一核心技术在不同领域的应用，且两者在原材料、生产制造工艺及客户群体方面存在着较多的相通之处。因此发行人从事的是相关联及相类似的业务，符合主要经营一种业务的规定。

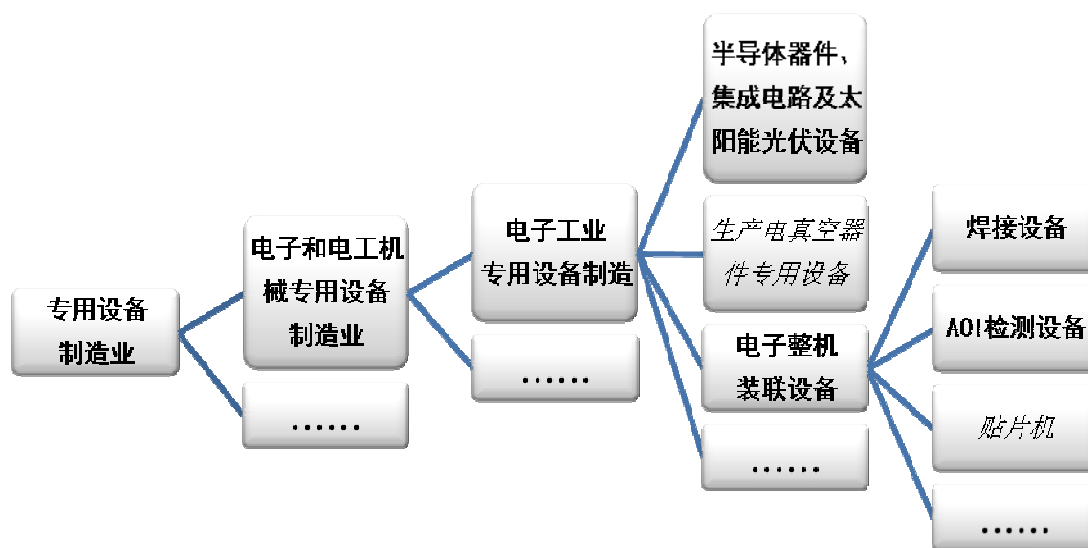
二、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)，公司生产的回流焊、波峰焊、AOI 检测设备、高温烧结炉等产品属于专用设备制造大类，电子和电工机械专用设备制造中类，电子工业专用设备制造小类，行业类别代码为 C3662。

根据中国证监会 2005 年 3 月 25 日发布的《上市公司分类与代码》(JR/T 0020-2004)，公司生产的产品属于制造业大类，机械、设备、仪表次类，专用设备制造业中类，电子、电工机械专用设备制造业小类，代码为 C7325。

下图为公司产品从属细分行业情况（黑体加粗显示的为公司产品所涉及的具体行业）：



电子工业专用设备是指在研究、开发和生产各种电子信息产品过程中专门用于材料制备、元器件制造加工、整机装调、工艺环境保证、生产过程监控和产品质量控制的设备。

电子工业专用设备制造业是装备制造业的重要分支，也是电子信息产品生产技术和工艺技术的高度融合，处于电子信息产业链最前端和最高端，基础性强、关联度高，是技术难度最大，复杂度、附加值和进入门槛最高的领域，决定着一个国家或地区电子信息产品制造业的整体水平，是电子信息产业综合实力的重要标志。随着国家对电子工业专用设备行业的各项支持政策的落实，同时行业内企业技术水平的不断积累和创新，电子工业专用设备行业的发展将会保持平稳快速增长。

（二）行业主管部门和监管体制

工业和信息化部是电子工业专用设备制造业的主管部门，负责行业的管理工作和产业政策的制定。

中国电子专用设备工业协会（CEPEA）是电子工业专用设备制造业的自律组织，由在国内从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成。该协会成立于1987年7月，是经中华人民共和国民政部批准登记注册（社证字第3613号）取得社团法人资格的全国性工业行业协会。中国电子专用设备工业协会的上级业务主管部门是工业和信息化部。协会在政府和行业内的企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，推动了我国电子专用设备行业的发展。

（三）行业相关的法律法规、政策

1、主要行业法律法规

行业相关的主要法律法规文件名称、发布单位和实施日期等如下表所示：

序	法律法规名称	发布单位	实施日期
1	《中华人民共和国产品质量法》	全国人大委员会	1993年9月
2	《中华人民共和国标准化法》	全国人大委员会	1989年4月
3	《工业产品质量责任条例》	国务院	1986年7月
4	《电子信息产品污染控制管理办法》	信息产业部等七部委	2006年2月
5	《关于报废电子电气设备指令》Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	欧洲议会和欧盟理事会	2003年1月
6	《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》Restriction of Hazardous Substances (RoHS)	欧盟议会及欧盟委员会	2006年7月

各有关法律法规的相关解释如下：

（1）《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国产品质量法》是国家为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序而制定的，该法是我国规范经过加工、制作，用于销售产品的基本法律。

（2）《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法》是国家为了发展社会主义商品经济，促进技术进步，改进产品质量，提高社会经济效益，维护国家和人民的利益，使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要而制定的。该法规定工业产品的品种、规格、质量、等级或者安全、卫生要求。工业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输、使用的方法或者生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求等都需要由国务院标准化行政主管部门来制定全国范围内统一的技术要求和国家标准。

（3）《工业产品质量责任条例》

本条例是国家为了明确工业产品质量责任，维护用户和消费者的合法权益，保证有计划的商品经济健康发展，促进社会主义现代化建设而制定的，该条例分别对产品生产企业、产品储运企业、产品经销企业的质量责任和产品质量的监督管理作了详细的规定。

(4) 《电子信息产品污染控制管理办法》

本标准是为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康而制定的，适用于在中华人民共和国境内从事电子信息产品的生产、销售和进口的行为。

(5) 《关于报废电子电气设备指令》 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

本指令旨在减少废弃电子产品中的有害物质含量以及促进电子电气设备的回收利用。

(6) 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》 Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

本指令主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共 6 项物质，并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%。

2、主要行业政策

主要与行业相关的行业政策规划如下表所示：

序号	行业政策名称	发布单位	发布日期
1	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	2009年5月
2	《2006-2020年国家信息化发展战略》	中共中央办公厅、 国务院办公厅	2006年5月
3	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	国家发展改革委员会	2011年4月
4	《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）	国家发展改革委员会	2006年6月
5	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2010》（征求意见稿）	国家发展改革委员会、 科学技术部、商务部、国家 知识产权局联合修订	2010年7月
6	《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》	信息产业部	2008年1月
7	《信息产业“十一五”规划》	信息产业部	2007年3月
8	《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2009年修订）》	深圳市政府	2009年3月

各有关行业政策的相关解释如下：

(1) 《装备制造业调整和振兴规划》

2009年5月12日发布的《装备制造业调整和振兴规划》对电子信息产业的规划是：“结合实施电子信息产业调整和振兴规划，以集成电路关键设备、平板显示器件生产设备、新型元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺整机装联设备、电子专用设备仪器及工模具等为重点，推进电子信息装备自主化”。该规划还“鼓励使用国产首台（套）装备，建立使用国产首台（套）装备的风险补偿机制”。该规划表明国家对我国装备制造业，特别是对自主装备制造业的支持和鼓励。

（2）《2006-2020年国家信息化发展战略》

该项国家中长期国家发展战略明确指出：将突破集成电路、软件、关键元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，培育有核心竞争力的信息产业作为我国信息化发展的战略重点之一。

（3）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

该指导目录将“半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）等”列为鼓励类。

（4）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）

将集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备、无铅工艺的整机装联设备等电子专用设备列入“十一五”重点突破的关键领域。

（5）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2010》（征求意见稿）

该指南列明：“电子专用设备、仪器和工模具”行业优先发展的产业为“8-12寸硅片生产设备，化合物半导体生产设备，碳化硅单晶材料生长设备，片式元件生产设备，敏感元器件/传感器件生产设备，高频率器件生产设备，电力电子器件生产设备，超净设备，环境试验设备，高精度电子专用模具，终测仪、路测仪等电子专用测试仪器。”

（6）《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》

《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》明确“电子整机装联设备”的发展重点是：“突破全自动精密贴片机、大尺寸全自动精密印刷机、全自动插装机、自动光学检测设备（AOI）等关键设备的研发及产业化，扩大市场占有率。大力支持适应无铅工艺的贴装设备（如无铅再流焊机（即回流焊）、无铅波峰焊机等）的研发和产业化。”同时也明确“半导体和集成电路专用设备”发展重点是：“发

展 8-12 英寸集成电路关键生产设备，包括光刻设备、刻蚀设备、平坦化设备、薄膜生长设备、掺杂设备、匀胶显影设备、快速热处理设备、清洗设备等芯片制造设备。”其中太阳能电池片生产设备的高温烧结炉就属于“快速热处理设备”，是国家重点发展目标。

（7）《信息产业“十一五”规划》

《信息产业“十一五”规划》提出：“加快电子专用设备仪器发展。加强国际合作，推动产用结合，突破部分关键技术，缩小电子专用设备仪器、工模具与国外先进水平的差距。大力发展集成电路、平板显示器件等重大技术装备；增强新型元器件生产设备、表面贴装以及支持无铅工艺整机装联设备的产业化能力；围绕数字视听、新一代通信产品，加大高性能测试仪器的开发力度。”

（8）《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2009 年修订）》

该目录列明了“电子专用设备及关键零部件、仪器、工模具制造”为“鼓励类”产业，国家的政策指引有“关于继续组织实施电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业化专项有关问题的通知（发改办高技[2007]3036 号）”。

此外，《高端装备制造业“十二五”发展规划》等诸多规划正在陆续出台，高端装备制造产业被确定为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业，到 2020 年将发展成为国民经济的支柱产业。

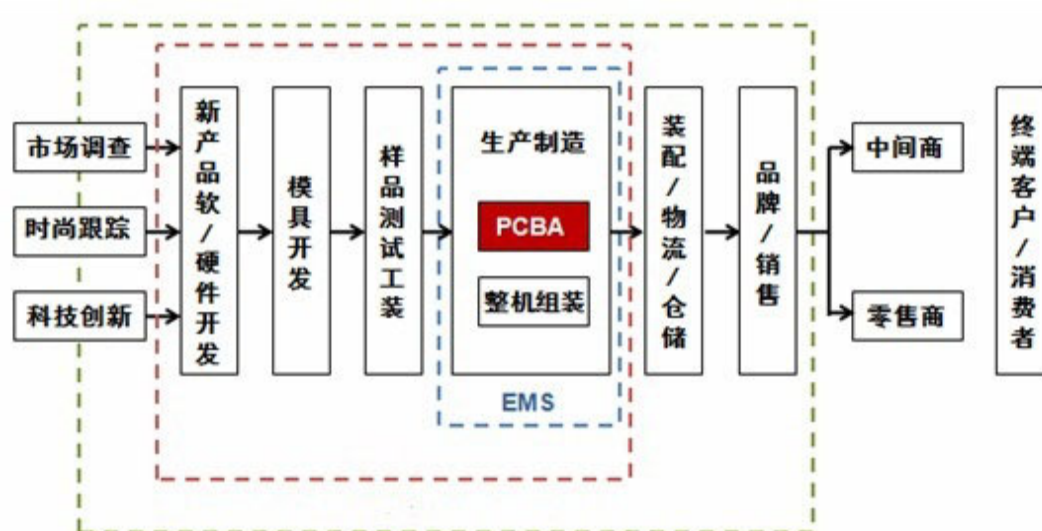
三、电子整机装联设备行业发展概况

（一）电子整机装联设备行业基本概况

1、电子整机装联在电子产品制造中的重要性

电子整机装联又称电子整机组装，是电子或电器产品在制造中所采用的电气连接和装配的工艺过程，即根据设计要求（装焊图或电原理图）将电子元器件（无源器件、有源器件或接插件等）准确无误装焊到基板（PCB）上焊盘表面的工艺过程，同时保证各焊点符合标准规定的物理特性和电子特性的要求。

电子整机装联是电子产品生产过程中的关键环节，最终决定电子产品能否正常使用和质量水平。电子整机装联在电子制造行业供应链的位置如下图所示：



2、电子整机装联技术的发展

电子整机装联技术是现代电子产品先进制造技术的重要组成部分，是衡量一个国家综合实力和科技发展水平的重要标志之一，也是电子产品实现小型化、轻量化、多功能化和高可靠性的关键技术。根据电子整机装联技术的发展历程，可分成以下两大类技术：

(1) THT 技术（Through Hole Technology），即穿孔技术，属于传统的电子装联技术。这种技术是指需要对焊盘进行钻插装孔，再将电子元器件的引线插入印制板的焊盘孔内并加以焊接，最终与导电图形进行电气连接的电子装联技术。主要适用于大功率器件的组装工艺，如雷达、汽车电子、UPS、驱动器、功率放大器、开关电源等；

(2) SMT 技术（Surface Mounting Technology），即表面贴装技术，SMT 技术是一种无需对焊盘进行钻插装孔，直接将表面贴装元器件平贴并焊接于印制板的焊盘表面，最终与导电图形进行电气连接的电子装联技术。该技术适用于高密度、高集成化的微器件焊接组装工艺，如通讯设备、嵌入式控制器、程控交换机等。

从组装工艺技术的角度分析，SMT 技术和 THT 技术的根本区别是“贴”和“插”。两者的差别还体现在基板、元器件、组件形态、焊点形态和组装工艺各个方面，SMT 技术和 THT 技术的主要区别如下所示：







主要区别	SMT 技术	THT 技术
组装基板	树脂基板 陶瓷基板	必须钻通孔 树脂基板

无源元件	片式元件 	有引线元件 
有源器件	BGA、QFP 等 	DIP 等 
元器件组装	用粘接剂或焊膏，把 SMC/SMD 贴装在基板表面	有引线元件插入通孔，引线弯曲加工
焊接	回流焊、波峰焊	波峰焊
组装方式	双面表面组装	通孔插装

SMT 技术具有组装密度高、可靠性高、抗振能力强、焊点缺陷率低等优点。但由于其涉及多学科领域，使其在发展初期较为缓慢。近年来随着各学科领域的协调发展，SMT 得到了迅速的发展和普及，目前已成为主流的电子装联技术。

3、电子整机装联组装方式

以主流的 SMT 组装方式为例，SMT 的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装器件（SMA）的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。大体上可将 SMA 分成单面组装、双面组装和全表面组装 3 种类型共 6 种组装方式，具体如下所示：

组装方式	示意图	电路板	焊接方式	特征
全表面组装	单面表面组装 	单面 PCB 陶瓷基板	单面回流焊	工艺简单，适用于小型、薄型简单电路
	双面表面组装 	双面 PCB 陶瓷基板	双面回流焊	高密度组装、薄型化
单面混装	SMD 和 THC 都在 A 面 	双面 PCB	先 A 面回流焊，后 B 面波峰焊	一般采用先贴后插，工艺简单
	THC 在 A 面，SMD 在 B 面 	单面 PCB	B 面波峰焊	PCB 成本低，工艺简单，先贴后插。
双面混装	THC 在 A 面，A、B 两面都有 SMD 	双面 PCB	先 A 面回流焊，后 B 面波峰焊	适合高密度组装
	A、B 两面都有 SMD 和 THC 	双面 PCB	先 A 面回流焊，后 B 面波峰焊，B 面插装件后附	工艺复杂，很少采用

4、电子整机装联设备

电子整机装联设备是指电子产品整机装配过程中零部件准备工序用的专用设备，这些设备包括：表面贴装印刷设备、插件（片）机、贴片机、波峰焊设备、回流焊设备、AOI 检测设备、编带设备、屏蔽设备等。以主流的 SMT 技术为例，一条完整的 SMT 生产线如下图所示：



（二）下游电子制造业的市场发展情况

电子整机装联设备的下游行业包括消费电子制造业、汽车电子制造业、通信设备制造业、航空航天制造业、国防电子制造业等。电子整机装联设备是这些下游制造行业的必需设备和基础设施，下游行业各企业新建生产线和更新原有生产线都会对本行业产生很大的需求。因此，下游行业的发展状况将对本行业的发展产生直接而密切的影响：下游行业的增长将会带动本行业的增长；反之，如果下游行业出现萎缩，本行业的发展将会受到制约。

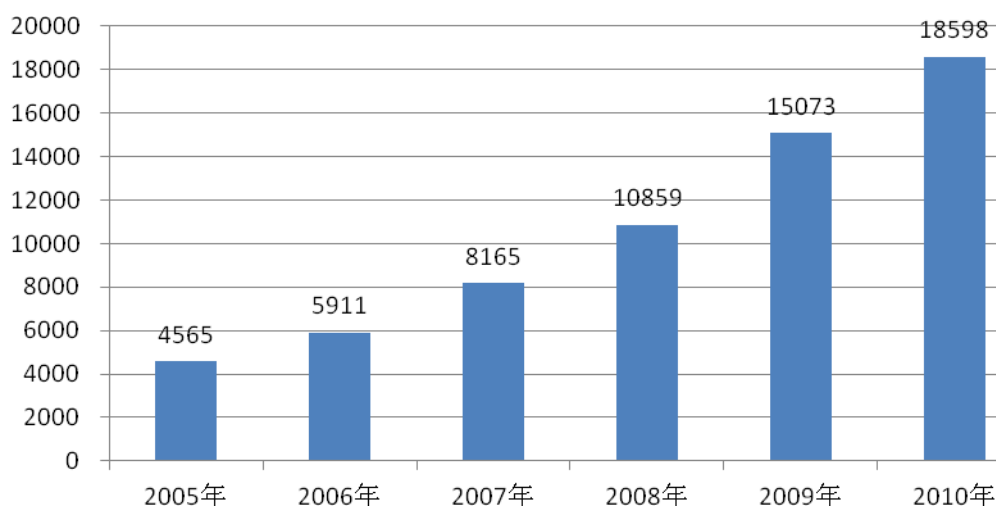
目前我国已经成为世界的电子产品制造中心，在未来数年内我国与电子相关的制造业仍将保持良好的发展趋势，为电子整机装联设备行业的发展提供了良好的市场基础。

1、消费电子制造业

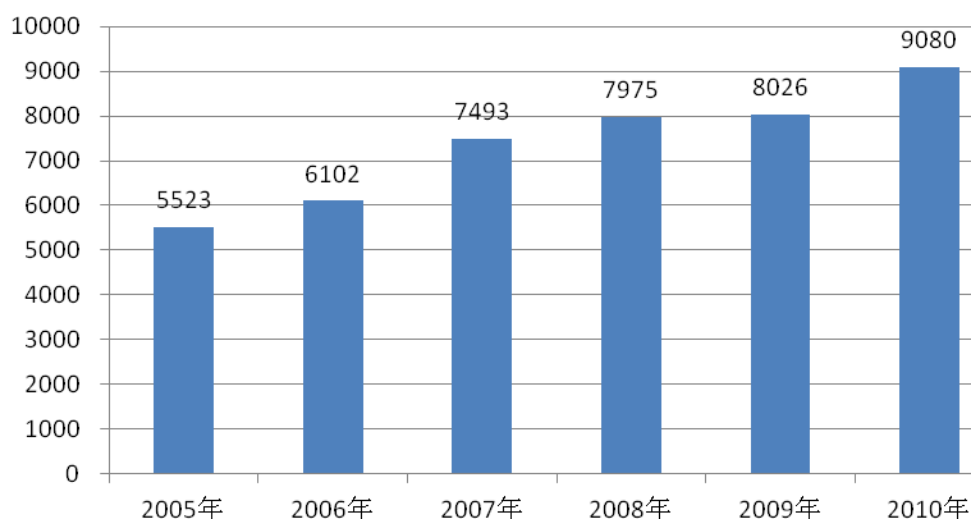
消费电子涉及的范围非常广泛，传统的消费电子包括电视机、组合音箱、MP3 等，随着技术发展和新产品新应用的出现，笔记本电脑、数码相机、信息家电等产品为代表的消费电子产业逐步发展壮大，近年来以 IPAD 为代表的新型平板显示产业，已成为消费电子的新生力量。根据美国消费电子协会发布的最新数据，2010 年，全球消费电子行业销售额达到 8,730 亿美元，比前一年增长 13%。该协会还表示，2011 年全球消费电子行业销售收入预计将达到 9,640 亿美元，比 2010 年增长约 10%。

我国是全球电子制造业布局的关键地区，全球前 10 大电子制造商都已经在我国投资建厂，我国在全球电子制造业发展的过程中扮演重要的角色。近几年，我国主要的消费类电子制造业均得到了快速发展。根据相关数据的统计，我国笔记本电脑产量由 2005 年的 4,565 万台增长到 2010 年的 18,598 万台，增长了 307.16%；数码相机的产量由 2005 年的 5,523 万台增长到了 2010 年的 9,080 万台，增长了 64.40%；彩电、冰箱、空调、洗衣机等家用电器近几年均有不同程度的增长。我国消费电子制造业的持续增长，为电子整机装联设备行业的发展提供了稳定的推动力。

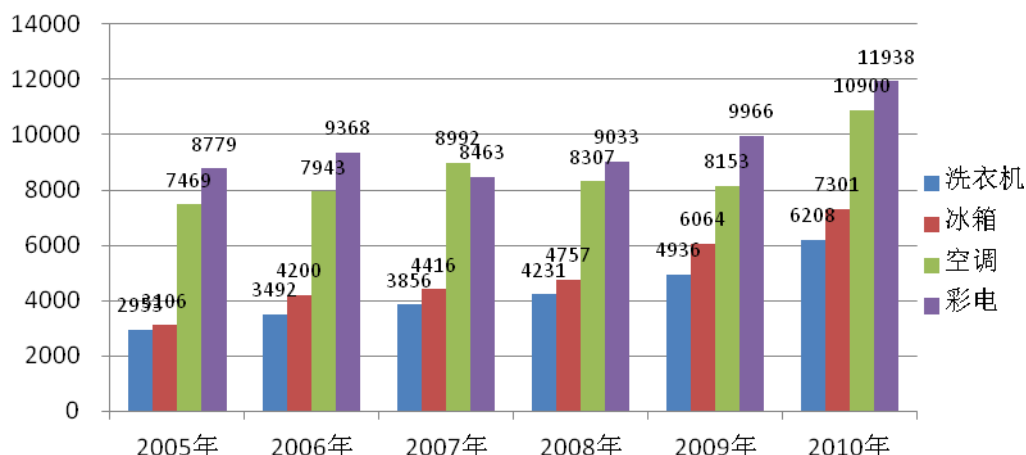
我国 2005-2010 年笔记本电脑产量 (单位：万台)



我国 2005-2010 年数码照相机产量(单位：万部)



我国 2005-2010 年家用电器产量(单位：万台)



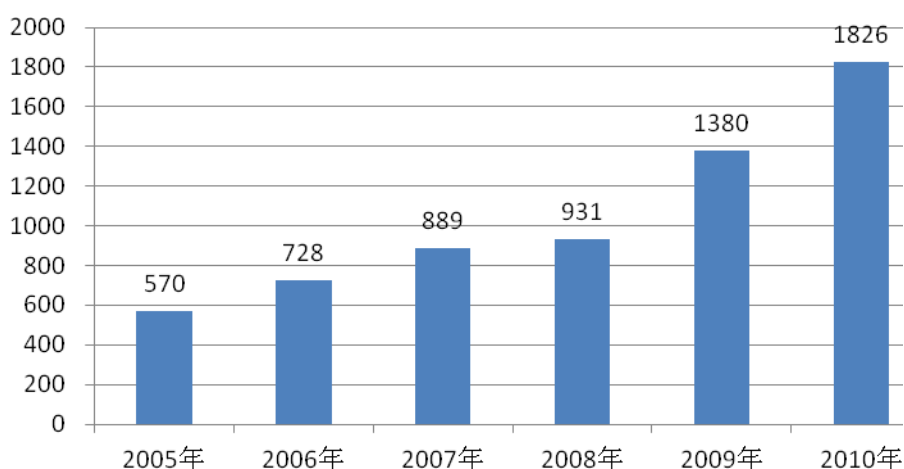
资料来源：工业和信息化部、中国经济信息网、Wind

2、汽车电子制造业

汽车电子包括汽车信息系统、导航系统、汽车音响及娱乐系统、车载通信系统等。在汽车制造领域，电子控制技术已经广泛应用于发动机、底盘和悬架、车身控制、安防系统等方面，根据中国汽车工业协会调查显示，有的车型电子产品占整车的价值超过了 30%。随着消费者和社会对汽车节能、安全、环保、舒适等的要求越来越高，汽车电子产品和技术在新车型中应用还将越来越多。

我国的汽车产量在相关政策的推动下近几年呈现出快速增长的势头。根据中国汽车工业协会的统计，2010 年我国汽车行业产量突破 1800 万辆，比 2009 年增长了 32%，不仅蝉联世界第一，且创全球历史新高。

我国 2005-2010 年汽车产量(单位：万辆)



资料来源：中国统计年鉴 2006-2010，中国汽车工业协会

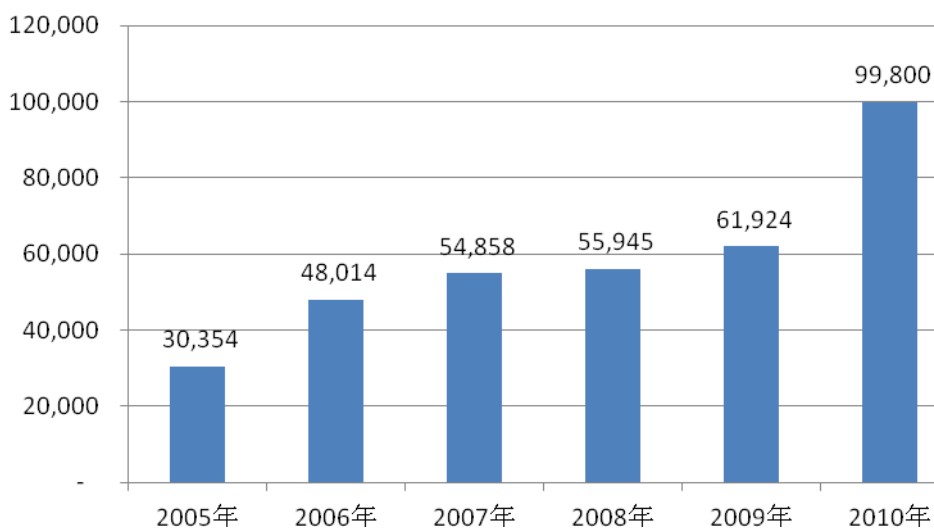
汽车产业的高速发展也带动了汽车电子产量的快速增长。随着国际汽车电子制造能力持续向我国转移，未来几年我国汽车电子市场仍将保持快速平稳增长的良好态势。同时，随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。显然，汽车电子已成为未来电子制造业新的增长点，为我国电子整机装联设备厂商提供新的发展机遇。

3、通信设备制造业

经过多年的发展，我国通信设备制造业已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，涌现出了华为、中兴等一批具有国际竞争力的企业，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。

2008年以后，由于受国际上金融危机的影响，通信设备制造业产品出口受挫，各项经济指标增幅下滑。但2009年以来，国家宏观调控政策和大规模建设3G以及内需市场的扩张，刺激着通信设备制造业以较快的速度走出低迷，降幅逐年收窄，通信设备制造业得以快速回暖。

我国 2005-2010 年移动通信手机产量(单位：万部)



资料来源：中国统计年鉴，工业和信息化部

十二五规划明确了对三网融合、工业信息化、物联网、电子政务等领域的支持，而上述领域顺利推行的网络基础都是通信行业投资范畴，对于通信设备行业是一个比较大的利好，未来几年通信设备行业需求空间得到放大。2011年作为十二五规划第一年即国家战略转型第一年，信息化基础—通信网络建设必将成为

投资重点。

4、 航空航天制造业

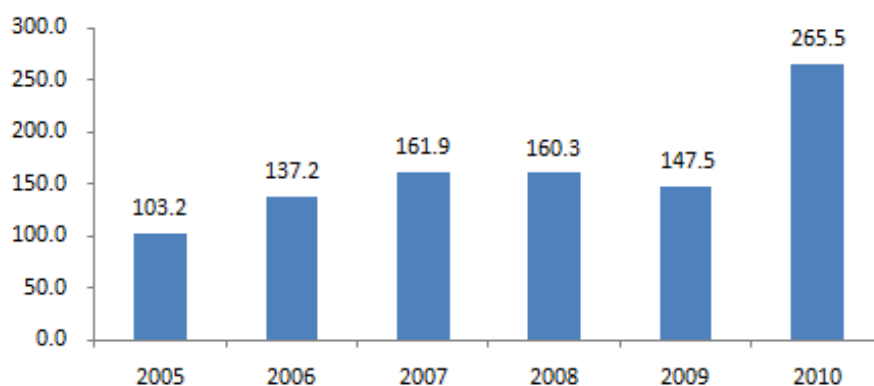
航空航天制造业是高端装备业的先锋，其技术水平和生产能力更能体现国家制造业实力。随着中国经济的高速发展，我国航空航天产业也稳步增长。如在航空领域，随着民航业需求日益增长，我国的民航飞机数量也随之增长，从 2001 年到 2008 年，我国民航飞机架数将近翻番。虽然 2009 年全球航空制造业经营景气大幅下滑时，我国航空转包业务也曾受到短暂影响。不过，从更长的时间纬度来看，在下游整机厂商压缩成本、增加业务外包比重的推动下，国内厂商凭借雄厚的航空工业基础、完善的工业配套体系、相对低廉的人力和原材料成本等国际比较优势将更有可能从行业此轮景气波动中长期受益。

航空装备产业的未来发展机会有大飞机项目、发展支线飞机、低空开放等，前景十分广阔。根据中国商飞在珠海航展发布的《2010年-2029年市场预测年报》，到 2029 年，全球共需要 30,230 架干线和支线飞机，总价值近 3.4 万亿美元。中国航空运输市场对民用飞机的需求价值高达 4,568 亿美元，中国客机机队占全球机队的比例将从现在的 8% 上升至 14%。

（三）电子整机装联设备行业市场容量及发展前景

根据中国电子专用设备工业协会统计数据，我国电子整机装联设备制造行业的市场规模从 2005 年的 103.2 亿元增长到 2010 年的 265.5 亿元，年复合增长率为 20.8%。下图为我国电子整机装联设备制造行业近 5 年市场规模情况：

单位：亿元



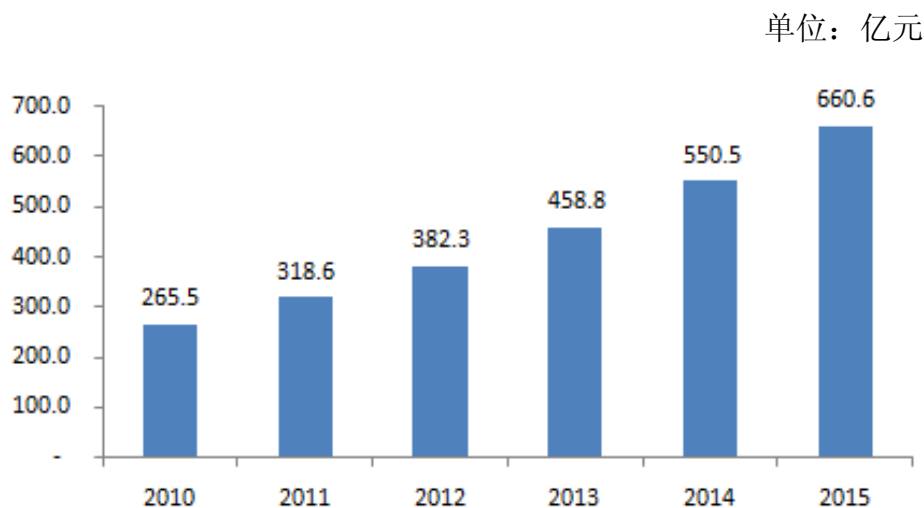
数据来源：中国电子专用设备工业协会

电子整机装联设备行业不可避免受到下游电子制造业景气周期的影响，2008

年以来由于金融危机影响，世界经济和电子信息产业发展放缓，电子整机装联设备行业增速亦随之趋缓。据工信部发布的 2009 年电子信息产业经济运行公报显示，随着国内政策效应不断显现和世界经济回暖，从 2009 年下半年起，中国整个电子信息产业开始呈现企稳向好的迹象，生产增速低位回升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄，总体回升态势基本明朗，整个电子整机装联设备行业亦随之回暖。

2009 年国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》，提出今后几年的发展重点为：“结合实施电子信息产业调整和振兴规划，以集成电路关键设备、平板显示器件生产设备、新型元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺整机装联设备、电子专用设备仪器及工模具等为重点，推进电子信息装备自主化”，从而确保了电子整机装联设备制造业的政策支持的持续性。

中国已经成为世界第一的 SMT 工业大国，预计这一地位 10 年内不会改变。经过金融危机的洗礼，目前我国电子整机装联设备产业将进入盘整转型期，这将是中国由电子整机装联设备大国向强国转型升级的关键时期。据中国电子专用设备工业协会预计，2010-2014 年中国电子整机装联设备行业的市场规模年复合增长率为 20%，在 2015 年将达到 660.6 亿元。下图为我国未来 5 年电子整机装联设备制造业市场规模预测：



数据来源：中国电子专用设备工业协会

（四）发行人产品所属细分行业的市场情况

1、焊接设备市场情况

（1）焊接工艺在电子整机装联中的作用

焊接（Soldering）是实现电子元器件与 PCB 电气及机械连接的必要工艺过程，焊接工艺是电子整机装联技术中唯一的不可逆工艺过程，这就意味着如果焊接设备的技术性能及工艺稳定性达不到设定要求，将直接导致产成品出现质量缺陷甚至报废，而这种质量缺陷很多时候是无法返修的，所以焊接设备的质量和稳定性是保障电子产品安全、提升生产制程良率、控制制造成本的关键核心。

（2）焊接设备产品概况

焊接设备主要用来焊接固定 PCB 上的元器件，目前市场上焊接设备主要分为波峰焊和回流焊两种：

波峰焊，是将熔化的软钎焊料，经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰，使预先装有元器件的 PCB 通过焊料波峰，实现元器件引脚与 PCB 焊盘之间机械与电气连接的软钎焊，波峰焊主要用于通孔插装组件和采用混合组装方式的表面组装组件的焊接。

传统的波峰焊采用电机驱动熔融的锡料，机件磨损大、焊料氧化浪费严重，而采用电磁泵（MHD）以电磁场驱动，则无任何活动部件、焊料氧化少，流动平稳，是最前沿的驱动技术。

选择焊是波峰焊的一个分支，又称为焊接机器人，主要针对高精度、高制程重复性、高可靠性的电子产品焊接，应用于如程控交换机、汽车电子、航空航天等领域，通过对每个焊点的所有工艺参数（如座标，速度、温度、流量、角度、时间等）的可编程精确控制，实现高价值电子产品的精密焊接。

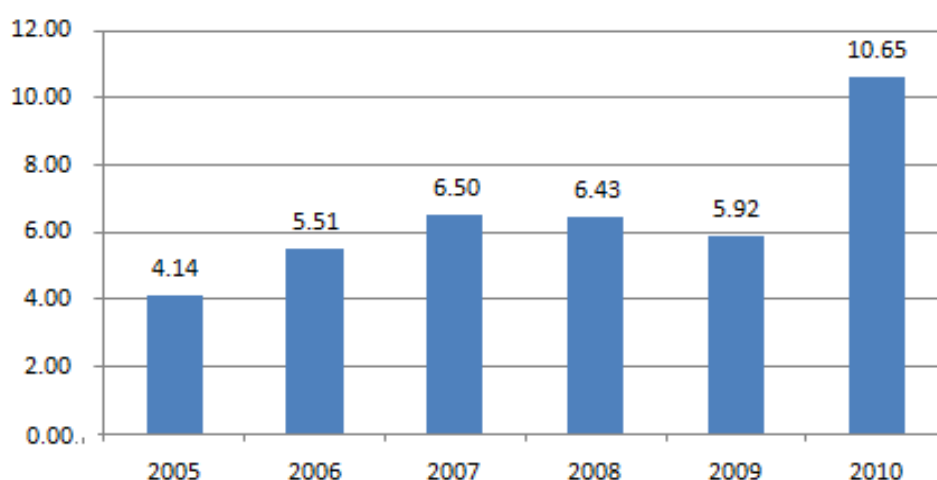
回流焊，也叫再流焊，是伴随微型化电子产品的出现而发展起来的焊接产品，主要应用于各类表面组装元器件的焊接。这种焊接技术使用的焊料是焊锡膏。首先预先在 PCB 焊盘上涂上适量和适当形式的焊锡膏，把 SMT 元器件贴放到相应位置（由于焊锡膏具有一定粘性，可以使元器件固定）；然后让贴装好元器件的 PCB 进入回流焊设备，依靠传送系统将 PCB 通过设备炉腔里各个设定的温度区域；最后焊锡膏经过干燥、预热、熔化、浸润、冷却，从而将元器件焊接到 PCB 上。

现代电子焊接技术的发展历程中，正经历从有铅焊接技术向无铅焊接技术的转变。焊接技术的这项演变趋势直接带来了两个结果：一是对 SMT 技术来说，无铅化要求的焊接工艺更加苛刻，工艺窗口急剧缩小，并且元器件的集成度越来越高，要求焊接工艺参数越来越精确。一般来讲，无铅工艺允许的误差范围比有铅工艺要小一半；二是对 THT 技术来说，通孔元器件（尤其是大热容量或细间距元器件）的焊接难度越来越大，特别是对无铅和高可靠性要求的产品。上述挑战都自然地反映在生产工艺和设备的选择上，由于选择焊具有符合上述高精度、高可靠性要求的特征，所以近年来其发展很快。

（3）焊接设备市场规模

根据中国电子专用设备工业协会的数据，我国电子整机装联焊接设备市场容量从 2005 年的 4.14 亿元增长到 2010 年的 10.65 亿元。同整个电子整机装联设备市场的发展相类似，焊接设备市场规模受全球金融危机影响，近几年市场增幅不大，但从 2009 年下半年开始，随着我国经济的快速复苏和金融危机时被压抑的固定资产设备投资需求的大量释放，国内开启了新一轮的 PCBA 生产线新建和扩建热潮，2010 年焊接设备市场出现爆发式增长，相比上年同期增长率达到 80%。2005-2010 年我国电子整机装联焊接设备市场规模如下图所示：

单位：亿元



数据来源：中国电子专用设备工业协会

（4）焊接设备市场发展前景

未来电子整机装联焊接设备市场的发展主要受益于以下几个因素：

① 全面无铅化带来新的市场需求

随着人类对自身健康意识的提高和全球范围内环保意识的增强，为了尽可能减少铅等重金属对环境的污染和对人类的侵害，欧盟 RoHS 和 WEEE 指令规定，欧美国家及日本在 2006 年 7 月 1 日起全面实行电子产品无铅化，同时，中国政府要求投放市场的国家重点监管目录内的电子产品不能含有铅的成分，因此，电子焊接中所有的焊料将逐步摒弃传统的锡铅合金而采用无铅焊料来代替。

由于无铅焊接工艺与传统含铅焊接工艺区别很大，工艺窗口急剧缩小一半，对焊接设备的精度和材料要求大幅度提高，使得电子厂商必须考虑更新原有的设备。尽管全面无铅化对电子整机装联中的其他设备如贴片机等影响较小，但是却为焊接设备带来重大的机遇和挑战。

② 新型封装的快速发展促进了工艺及设备更新

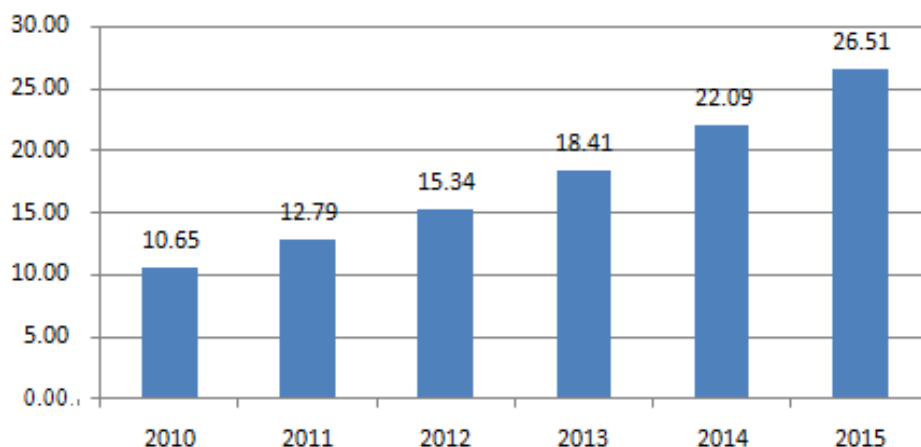
随着元器件集成度越来越高，先进的封装方式，如芯片级封装 CSP（Chip-Scale Package）、塑料片式芯片 PLCC（Plastic Leaded Chip Carrier）、层叠芯片 PoP（Package on Package）、PiP（Package in Package）、模块化芯片、电阻网络化芯片、系统级 SIP（System In a Package）封装等层出不穷，这些先进的封装技术给焊接设备带来新的挑战：一方面要求更高的传热效率和热穿透性；另一方面，要求对温度场的控制由原来的二维提升为三维，但现有很多焊接设备达不到上述要求，需进行工艺更新。未来在新材料、新技术不断涌现的情况下，必将会出现性能更优、组装密度更高的新的封装工艺，这对焊接设备要求也将进一步提高。

③ 应用范围日趋扩大，覆盖行业不断扩充

焊接设备尤其是回流焊这种隧道式连续加热技术，不仅可用于 PCBA 的生产线，还可应用于太阳能电池生产线的烘干及烧结工艺，如高温烧结炉设备。国外专业回流焊制造商（如美国 BTU 和德国 REHM）已先后将应用领域成功扩展到太阳能电池生产线。另外，由于新型晶圆级封装的出现，也使得传统的回流焊技术可扩展应用于晶圆植球焊接（Wafer Bumping），从而将应用领域扩展到半导体行业，美国 BTU 公司就已在普通回流焊的基础上发展了晶圆植球焊接回流焊。

综上因素，中国电子专用设备工业协会预测，我国电子整机装联焊接设备制造行业未来 5 年的复合增长率将达到 20%，2015 年市场规模可达到 26.51 亿元，未来几年我国焊接设备市场规模如下图所示：

单位：亿元



数据来源：中国电子专用设备工业协会

（5）焊接设备市场竞争情况

① 市场份额情况

据统计，目前国内从事电子产品焊接设备的制造企业多达 40 余家，大多中小企业主要集中在该领域的低端市场；在中高端市场，部分优秀的国内企业已经打破国外品牌的垄断，占据了较大的市场份额。电子整机装联焊接设备中高端市场比较活跃的国外厂商有 BTU、HELLER、VIRTRONIC、REHM、ERSA 等；国内知名厂商包括劲拓股份、日东电子、科隆威等。根据中国电子专用设备工业协会的统计，在 2010 年的国内焊接设备市场份额中，处于市场前列的企业为：劲拓股份、毕梯优、朗士电子、维多利绍德机械、日东电子和科隆威。

中国电子专用设备工业协会（CEPEA）成立于 1987 年，是经中华人民共和国民政部批准登记注册（社证字第 3613 号）取得社团法人资格的全国性工业行业协会，其上级业务主管部门为工业和信息化部。截止 2011 年 2 月底，协会共有 108 个会员单位（目前不设个人会员），涉及太阳能电池生产设备、电子整机装联和表面贴装（SMT）设备在内的八大类产品。目前公司为该协会理事单位。

公司在招股说明书中的相关行业数据引自中国电子专用设备工业协会发布的《中国电子整机装联设备行业研究及未来发展趋势》报告，该份报告的数据引用中国电子专用设备工业协会自身的数据库。该报告数据来源于协会会员单位申报，对于没有自行申报的企业，协会通过市场摸底调查（包括实地拜访、电话采访、电邮等方式），同时对数据进行逻辑检查及上下游企业数据的交互验证，保证数据的准确性。协会并根据每年的调查情况定期对数据进行更新。

② 主要竞争企业简要介绍

主要竞争对手	所在地	主要经营范围
毕梯优电子（上海）有限公司	上海	电子加热设备的开发、制造和组装
上海朗仕电子设备有限公司	上海	电子元器件、电子设备及其零部件
维多利绍德机械科技（苏州）有限公司	苏州	精密电子专用设备、系统设备、工业机械设备及相关产品
日东电子科技（深圳）有限公司	深圳	SMT 表面贴装设备、波峰焊、AOI、X-Ray, BGA 返修工作站、COB、COG, 物流装备、自动化生产线、汽车自动化装备、环保清洗设备以及精密钣金为主的 ODM 加工业务
东莞市科隆威自动化设备有限公司	东莞	全自动视觉钢网印刷机、全自动光学检测机（AOI）、无铅（氮气）热风回流焊、无铅（氮气）波峰焊以及其他 SMT 专用设备

● 毕梯优电子（上海）有限公司

毕梯优电子（上海）有限公司成立于 2003 年，是 BTU International 在上海投资建立的全资子公司，公司经营范围为电子加热设备的开发、制造和组装。

BTU International 成立于 1950 年，于 1989 年在 NASDAQ 上市，股票代码是 BTUI，总部位于美国马萨诸塞州北比尔里卡，在美国、亚洲和欧洲设有直接销售和服务代表处。主要为电子制造市场和替代能源生成市场提供热量处理设备。BTU 制造印刷电路板使用的回流焊炉及半导体晶圆级和模具级封装设备，同时还为太阳能电池、燃料电池和核燃料行业提供热量处理设备。根据 BTU International 的年报，其 2009 年的销售收入为 4,508 万美元，2010 年的销售收入为 8,161 万美元。

● 上海朗仕电子设备有限公司

上海朗仕电子设备成立于 2002 年 12 月，是 Heller Industries 在全球建立的继美国、加拿大和韩国之后的第四个工厂。公司经营范围为开发、生产电子元器件、电子设备及其零部件，销售自产产品并提供相关售后服务及技术咨询。

Heller Industries 总部位于美国新泽西州，至今已有 50 年的发展历史，致力于热风对流回流炉的研制，是全球知名的专业焊接设备制造企业，为全球的电子制造和组装生产企业提供全套解决方案，1987 年首先推出全热风回流焊，是焊接设备行业的领导企业。

● 维多利绍德机械科技（苏州）有限公司

维多利绍德机械科技（苏州）有限公司成立于 2003 年 5 月，是 Vitronics-soltec

在国内设立的全资子公司。经营范围为研发、生产精密电子专用设备、系统设备、工业机械设备及相关产品，销售自产产品，并提供相应售后服务。

Vitronics-soltec 成立于 1916 年，是工业焊接设备领域的领军者，拥有包括世界上第一只电烙铁在内的一系列创新发明。提供的产品包括回流焊，波峰焊和选择性焊接设备。维多利绍德在中国，荷兰和美国设有产品研发和制造中心，在美国、荷兰、德国、新加坡、马来西亚、韩国、上海、日本和印度设有销售和服务机构。

- 日东电子科技（深圳）有限公司

日东电子科技（深圳）有限公司成立于 2003 年，生产经营波峰焊机、回流焊机、丝印机、贴片生产设备、工业自动化生产设备、PCB 检查系统、材料搬运自动化设备、上下料机、点胶机、焊线机、固晶机、半导体检测设备、液晶模组 IC 封装设备（COG）及 FPC 热压设备。其母公司日东集团于 2000 年 10 月在香港主板上市，总部设在香港。日东集团除经营自主生产的波峰焊机、回流焊机等生产线及生产设备外，还代理销售贴片机等品牌生产设备。

- 东莞市科隆威自动化设备有限公司

东莞市科隆威自动化设备有限公司成立于 2003 年，经营范围为生产和销售自动化设备及其配件、光伏太阳能设备及其配件。公司主要产品为全自动视觉钢网印刷机、全自动光学检测机（AOI）、无铅（氮气）热风回流焊、无铅（氮气）波峰焊以及其他 SMT 专用设备。

2、AOI 检测设备行业概况

（1）机器视觉技术介绍

机器视觉技术是采用计算机来进行视觉测量和判断的技术，是一门涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域的交叉学科。

机器视觉技术主要采用适合被测物体的多角度光源（可见光，红外光，X 射线等）及传感器（摄像机）获取检测对象的图像，通过计算机从图像中提取信息，进行分析、处理，最终用于实际检测和控制。

机器视觉技术最大的特点是速度快、信息量大、重复性较好。利用机器视觉进行检测不仅可以排除人的主观因素的干扰，而且还能够对这些指标进行定量描

述，还可以用于危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合对象的检测。机器视觉技术如今被广泛应用于工业生产品质检测、宇宙探测、生物医学成像检测、军警指纹对比及字形辨认、机械人控制、军工应用等领域。在工业生产品质检测领域，机器视觉检测技术主要应用于集成电路板、印刷电路板及 LCD 屏幕等生产过程的品质检测。随着计算机硬件、软件算法、光学系统、感光器件等呈几何级数的发展，机器视觉技术在各个领域的发展前景不可估量。

（2）机器视觉技术在电子装配生产中的应用（AOI 检测设备）

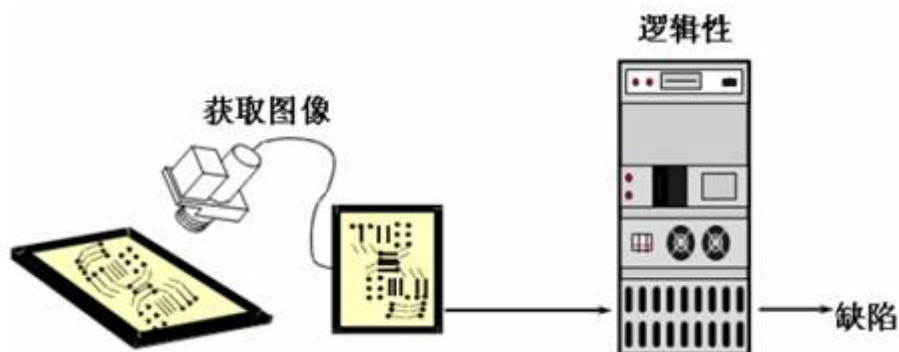
机器视觉技术应用于电子装配生产中就产生了 AOI 检测设备，AOI（Automatic Optic Inspection）的全称是自动光学检测，是基于光学原理及图像识别等机器视觉技术对电子装配生产中遇到的装配及焊接缺陷进行检测的设备。

① AOI 检测设备的产生背景

在激烈的市场竞争中，电子产品制造厂商必须确保产品的质量，因此在产品制造过程中对各个生产环节半成品或成品进行质量监测尤为重要。随着电子元件微型化及 SMT 组件向高密度组装的发展趋势，采用人工检测的方式已难以适应，AOI 检测技术是能够实时反映 SMT 工艺品质变化情况的技术手段，因此，近年来 AOI 检测设备发展较为迅速。

② AOI 检测设备的检测原理和优势

AOI 检测设备主要用于电子产品生产中 PCB 上元件的装配品质检测及工艺品质控制。设备通过摄像头自动采集 PCB 图像，通过图像处理与识别，与数据库中合格的参数进行比较，检测出 PCB 上元件的装配缺陷，并通过显示器或自动标志把缺陷显示或标示出来，供维修人员修整。



通过使用 AOI 检测设备作为减少缺陷的工具，可以在装配工艺过程的早期查找和消除错误，从而实现良好的过程控制。早期发现缺陷可避免将坏板送到随

后的装配阶段，AOI 检测设备的应用可减少修理成本、提高产品良率。

③ AOI 检测设备的分类

AOI 检测设备按上板作业方式不同可分为在线式和离线式两种：

离线式 AOI 检测设备：不连接在 SMT 生产线中，由人工作业放板，成本低，目前市场应用较多。

在线式 AOI 检测设备：主要用于 SMT 生产线在线全自动检测，不需要人工作业，而且可以实现整条 SMT 生产线的品质数据共享及自动工艺优化，全面提升 SMT 生产线的生产品质，在线式 AOI 检测设备的需求将会呈现逐年上升趋势。

（3）AOI 检测设备市场发展前景

在国内，AOI 检测技术是近几年才兴起的一种新型测试技术，目前尚未有相关统计机构发布其市场容量的研究数据，但从近年来 AOI 检测设备的发展来看，其增长潜力巨大。AOI 检测设备未来的发展主要受益于以下几方面因素：

① AOI 检测设备替代人工将成为必然趋势

一方面，电子元器件向小型化发展，AOI 检测设备替代人工将成为必然趋势。目前大多数工厂还在采用人工目视的检测方式，但是随着电子产品小型化及低能耗化的市场需求越来越旺盛，电子元器件向小型化发展步伐也越来越快。目前市场最常见的较小片式元件尺寸（英制）是 0603（1.6mm 长 x0.8mm 宽）及 0402（1.0mm 长 x0.5mm 宽）元件尺寸，这样的元件在装配过程中借助于放大镜尚可以目视，但是越来越多的客户已经采用了 0201（0.6mm 长 x0.3mm 宽）及 01005（0.4mm 长 x0.2mm 宽）的元件，这样的元件在装配过程中不可能采用人工目视的方式，必须采用 AOI 检测设备。此外，人容易疲劳和受情绪影响，相对于人工目检而言，AOI 检测设备具有更高的稳定性、可重复性和更高的精准度。因此，AOI 检测设备取代人工的必然趋势也将会越来越明显，这将产生很大的市场空间。

另一方面，人工成本越来越高，将加速 AOI 检测设备替代的进程。随着我国人工成本逐年增长，一条 SMT 生产线配备 3-10 个人采用目视检测产品的人海战术势必会增加生产线的运营成本，未来电子制造企业出于对产品品质和成本控制的需求，将加速 AOI 检测设备替代人工的进程。

② 国内 AOI 检测设备普及率较低，未来发展空间巨大

AOI 检测设备市场在国内处于刚起步阶段，目前市场上只有 20%-30% 的 SMT 生产线装配了 AOI 检测设备，而国际领先电子制造企业的 SMT 生产线基本都配置了 AOI 检测设备。即便目前配备了 AOI 检测设备的电子制造企业绝大多数也只在炉后配备一台进行全检，而按照国际经验，每条生产线至少要配置三台 AOI 检测设备放置在生产线不同测试工位。因此随着行业的发展及 AOI 检测设备自身具备的优势，未来 AOI 检测设备的装备率会越来越高，国内 AOI 检测设备潜在的机会和发展前景相当巨大。

③ AOI 技术可扩展性强，应用领域广泛

虽然当前 AOI 技术主要用在 SMT 生产线上，但随着设备应用范围的不断拓宽，将来会越来越多用于其它生产线检测产品，凡是需要人眼目检的生产环节都可以用机器视觉来取代，比如用于太阳能光伏生产线检测太阳能电池、用于 LCD 生产线检测面板产品。这些新的应用领域将进一步促进对 AOI 相关设备的需求。

（4）AOI 市场竞争情况

2005 年之前，国内 AOI 检测设备市场几乎全部由国外品牌的设备所独占。近年来，随着越来越多的电子制造企业把生产转移到中国以及集成技术的高速发展，AOI 检测设备在国内生产线显得越来越重要，其市场需求也将越来越大。国内部分具备一定研发实力的生产厂商，抓住这一市场机会，研发出国产 AOI 检测设备，在市场上占据了一定的地位。

总体而言，现阶段国内的 AOI 检测设备市场尚处于快速成长阶段，现有国内的 AOI 检测设备生产厂家规模都相对较小，而且以中低端设备为主，高端的 AOI 检测设备市场仍被日本和欧美厂商所垄断。但部分行业排名靠前的国内厂商，在抢占中低端市场的同时，也在积极开拓高端市场，并取得了一定的成绩。目前 AOI 检测设备市场表现比较好的企业有：欧姆龙（OMRON）、台湾德律（TRI）、劲拓股份、神州视觉及深圳振华兴等。

主要竞争对手如下所示：

① 德律科技股份有限公司（TRI）

德律科技股份有限公司成立于 1989 年 4 月，2002 年在台湾上市，主营业务生产销售电子基板检测及 IC 半导体的自动测试设备，目前德律在全球已有超过 550 个员工，并在中国大陆、美国、新加坡、日本、韩国、德国等地设立子公司，

在超过十多个国家设立代理商。

② 欧姆龙株式会社（OMRON）

欧姆龙株式会社是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。自 1933 年创业至今的七十余年中，通过不断创造新的社会需求，公司全球业务遍及 35 个国家和地区，拥有超过 27,000 名员工；产品品种达几十万种，涉及工业自动化控制系统、电子元器件、社会公共系统以及健康医疗设备等广泛领域。

③ 东莞市神州视觉科技有限公司

东莞市神州视觉科技有限公司成立于 2005 年，经营范围为自动光学检测设备软、硬件研发、销售及维护，电子设备修理、修配维护，自动光学检测设备硬件制造。

④ 深圳市振华兴科技有限公司

深圳市振华兴科技有限公司成立于 2007 年，主要经营范围为：电子机箱、机柜的生产和销售；光学检测设备、臭氧消毒设备的生产及销售；软件开发；货物及技术进出口。

（五）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

自 2003 年以来，国家已将发展我国装备制造业列入《国家中长期科学和技术发展规划》、《“十一五”振兴我国装备制造业的途径与对策》以及《国务院关于加强振兴装备业的若干意见》等政策文件中，属重点发展行业。2006 年以后，国家又先后颁布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》、《装备制造业调整和振兴规划》等相关规划。国家对于电子工业专用设备行业及细分电子整机装联设备子行业的支持达到了前所未有的高度，有利于全行业的快速发展。

（2）电子产品制造业仍将保持持续增长

虽然 2008 年以来金融危机对我国的电子产品制造产业造成了一定的影响，但我国电子产品制造产业在全球的领先地位短期内仍无法撼动，未来消费电子、汽车电子等将引领电子产品制造产业新一轮市场增长。

随着新产品和新技术的层出不穷，消费者未来对高清电视、平板电脑等一系列的产品需求将成为消费电子市场继续发展的新动力。国家在金融危机后出台的一些重大经济刺激政策，如家电下乡等，也对消费电子产业具有非常重要的意义。因此，基于政策和内需的双重推动之下，未来几年国内消费电子市场仍将保持稳定增长的势头。

汽车电子产业是电子产品制造产业向前推进的另一个重要驱动因素，电子产品在汽车导航和娱乐、障碍检测、集成无线通讯、智能安全系统，以及更精密的汽车操作传感装置中的应用都仅仅是个开始，未来电子产品在汽车价值中的比例仍将继续提高。据 iSuppli 预测，在政府持续刺激汽车消费和轿车功能不断推出新等因素的推动下，中国汽车电子市场预计将在 2012 年超过美国。届时中国汽车电子销售额将从 2009 年的 160 亿美元增长到 206 亿美元。

未来电子产品制造产业的持续向好将对上游的电子整机装联设备行业需求起到极大的拉动作用。

（3）生产设备升级换代

全球电子元器件行业的迅猛发展，以及各种新技术和新工艺的不断涌现，也促使 PCBA 生产线上的设备不断进行升级和换代。比如近年来无铅技术和新型封装元件的出现，迫使电子制造企业不得不淘汰大量未达到更新年限的焊接设备。因此，未来由于新技术出现所导致的产品功能性贬值，也将对本行业设备的需求产生较大的推动作用。

中国正面临从制造大国向制造强国的转变，所有的企业也将越来越重视产品品质，对产品生产设备的要求也越来越高，因此促进了生产设备的升级换代。

（4）国内电子产业区域转移

随着我国珠三角和长三角等主要电子产业聚集地开始往中西部转移，许多企业已经或正在考虑搬到成都、郑州等中西部城市，这些企业往往需要在异地新建生产线，或者对搬迁后的生产线进行更新升级，这都会对上游的设备供应产生很大的需求。

（5）生产自动化发展趋势

随着我国人口红利进入下降通道，人工成本在逐年增长，这将不断推高生产线的运营成本。为了满足生产的需要和成本控制的要求，工厂对自动化机器设备

的需要也越来越迫切，而自动化设备的成本相对人工成本也将越来越有优势，这将极大推动相关自动化设备的需求。另外，人工生产、检测有其固有的缺陷，可能导致产品的质量和一致性相对较差。因此未来企业的生产自动化升级也将带动对本行业的产品需求。

2、不利因素

（1）受宏观经济波动影响较为明显

近年来国内电子制造企业对设备的持续投入和技改升级相应推动了上游电子整机装联设备行业的快速发展。但从历史上来看，宏观经济周期的波动有可能会影响电子产品制造企业自身的经营状况和扩产计划，进而影响到本公司客户在电子整机装联设备方面的固定资产投资节奏。

（2）高端精密器件的配套环境较差

由于专用设备行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关配套行业的协调发展。虽然我国的基础材料等产业近年来已取得了一些进步，但限于国内相关产业起步较晚、高技术人才缺乏、产业自主创新能力较弱等因素，国内相关产业与国际同行相比仍有一定差距，尤其是部分高端精密零配件的配套能力较弱，对本行业的发展产生一定的制约作用。

（3）专业人才短缺

与装备制造同业的高速发展相比，装备制造业的人才发展脚步就慢许多。由于我国的整个装备制造教育培训滞后，加上行业发展时间不长，人才培育和积累不足，致使相关专业人才的严重匮乏；而装备制造业对人才的综合素质和技术水平要求都较高，因此专业人才短缺对企业的快速发展存在一定制约。

（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因

总体而言，行业内企业利润水平差异较大。2008 年金融危机以来，不少中小企业由于规模小、品牌差、议价能力弱等原因，无法获取充足的订单，也不能及时将产品价格调整的压力进行转移，导致效益下滑甚至亏损。而对于类似本公司具有规模优势、研发优势、客户优势和品牌优势的企业而言，虽然也受到金融危机的影响，但近年来的利润水平可以保持相对稳定。主要理由如下：一是优势企业凭借自身研发能力和较强的制造能力，不断研究开发新的技术，推出新的机型，提高产品附加值，提高盈利水平；二是优势企业长期以来树立

的品牌形象和客户关系，使优势企业拥有较强的议价能力，可以将产品价格下降的风险部分转移。

可以预见，随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，其未来的利润将较低；而拥有雄厚研发实力、品牌和客户优势明显、产品附加值高的生产企业，由于对上下游拥有较强的议价能力，其未来盈利稳定，利润将保持较高水平。

（七）行业技术水平及技术特点、行业特有经营模式、周期性、区域性和季节性

1、行业技术水平及技术特点

（1）行业技术水平

在行业发展的初期，主要的技术都由国外设备厂家掌握，国内市场的电子整机装联设备，从丝印机、贴片机、波峰焊/回流焊、ICT/ATE，一直到X-Ray/AOI，完全依赖国外进口。经过多年的发展，我国已成为全球最重要的电子信息产品生产基地，产业规模位居世界前列，庞大的加工制造能力为国内电子整机装联设备行业的发展创造了有利的市场环境。国内电子整机装联设备供应商依托国内市场和已有产业基础，通过自主创新，引进、消化吸收再创新等多种方式，在相关的技术方面取得了长足的发展。

虽然我国在该领域的整体技术水平与国外先进水平仍有一定差距（主要是贴片机），但在多个细分领域已有技术上的突破，比如在焊接技术方面，国内部分优秀的企业已经很好地掌握了生产焊接设备所需的核心技术（高效热传导技术、高纯度动态气氛控制技术），并能将这些技术加以应用和产业化。国内焊接设备已完全能实现进口替代。

（2）行业技术特点

① 技术集成度高

电子整机装联设备制造技术是一门新兴的、综合性的先进制造技术，涵盖半导体物理学、热学、自动控制学和机械设计学等多门学科，涉及温度控制技术、加热技术、精密传动技术、真空技术和计算机控制技术等多方面前沿技术。这对设备生产厂家的技术整合能力提出了极高的要求。

② 工艺要求高

电子整机装联设备生产工艺比较复杂，且各个生产企业均有不同的工艺要求。为配合 SMT 生产线的高效率运转，电子整机装联设备提供商必须深刻了解和熟悉设备的生产工艺，以满足下游客户对专用设备的要求。

（3）行业技术发展趋势

未来，电子整机装联设备还将呈现出以下发展趋势：

① 向高效、灵活、智能、环保等方向发展

电子整机装联设备已从过去的单台设备工作，向多台设备组合连线的方向发展；从多台分步控制方式向集中在线控制方向发展；从单路连线生产向双路组合连线生产方向发展。电子整机装联设备向智能、灵活方向发展，主要是指利用远程网络控制及人工智能技术，实现生产工艺的实时监控及自动优化。电子整机装联设备向环保方向发展，主要是指生产无铅化和低能耗、低排放。

② 向高精度、高速度、多功能的方向发展

由于电子元器件的小型化及其封装方式的不断变化，例如 01005 元件、BGA，FC，COB，CSP，MCM 在生产中不断更新和推广应用，对设备的技术要求也逐渐提高，因此该行业的技术正向高精度、高速度、多功能的方向发展。

2、行业特有经营模式

电子整机装联设备需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。从产品安装调试以及后期的运行维护，都需要专业的技术支持和服务，存在着较高的技术壁垒。同时专用设备种类繁多，工艺复杂、专业性强。因此，本行业大部分企业都实行按订单生产的模式。另外，市场信誉和完善的服务体系在本行业中极为重要，往往也是客户采购时必须考虑的重要因素。国内具有一定规模的电子整机装联设备企业都建立了相对完善的销售和售后服务体系，为客户提供售前、售中到售后的全面技术支持和服务。企业间的竞争更多体现在技术、服务、解决方案设计等一系列综合实力上，因此企业在产品设计、制造、安装调试、操作培训、维修服务等方案上的综合整合能力对企业来说至关重要。

3、行业周期性

公司所处行业为装备制造大行业，在一定程度上会受宏观经济环境影响，会随着宏观经济周期的波动而波动。但由于中国的电子整机装联设备产业仍处于快

速发展阶段，加上电子整机装联设备广泛应用于军工电子、航空航天电子、汽车电子以及日常的消费电子等一系列领域，因此单独受某个领域周期性波动的影响较小，一定程度上降低了行业的周期性。

4、行业区域性

中国 SMT/EMS 产业主要集中在东部沿海地区，其中广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京以及辽宁等省市 SMT/EMS 的总量占全国 80% 以上。按地区分，以珠三角及周边地区最强，长三角地区次之，环渤海地区第三。环渤海地区 SMT/EMS 总量虽与珠三角和长三角相比有较大差距，但增长潜力巨大，发展势头更强。不久的将来，我国 SMT/EMS 产业必然形成珠三角、长三角、环渤海地区三足鼎立之势¹。与此相对应，国内电子整机装联设备企业也主要集中在这三个区域。

5、行业季节性

公司所处行业无明显季节性特征。

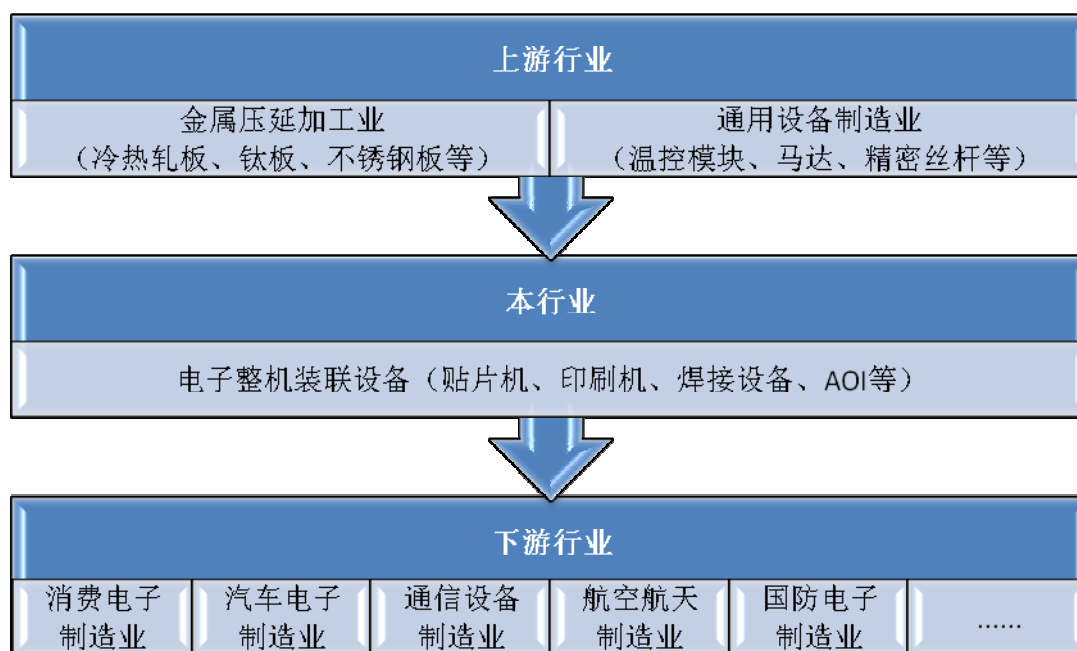
（八）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性

电子整机装联设备产品采购的主要原材料有两类，一类是冷、热轧板、钛板、不锈钢板、合金铝板等金属压延加工产品；另一类是温控模块、马达、链条等通用设备产品，所以上游行业就是金属压延加工业和通用设备制造业。

电子整机装联设备的主要用户为所有需要进行 PCB 板组装的电子产品制造行业，包括消费电子制造业、汽车电子制造业、通信设备制造业、航空航天制造业、国防电子制造业等相关行业。

下图为行业的上下游行业情况：

¹ 胡金荣，中国 SMT25 年发展历史进程概要，《中国 SMT25 周年纪念特刊》，2010 年 12 月



1、上游行业

上游行业为金属压延加工业和通用设备制造业精密机械部件，涉及的具体产品比较多，包括：冷、热轧板、温控模块、热风马达、钛板、精密丝杆、导轨、3CCD 相机、XY-TABLE、不锈钢板、合金铝板、电脑、链条、马达等。这些产品大都属于工业的基础材料或零配件，产品技术相对成熟，产业处于良好发展阶段，供应商数量众多，市场供应充足，能够保障本行业产品的正常生产。

2、下游行业

下游行业包括消费电子制造业、汽车电子制造业、通信设备制造业、航空航天制造业、国防电子制造业等相关行业。这些行业的发展与整机装联设备行业有着重要的关联，因为电子整机装联设备是这些电子制造行业的必需装备和基础设施。电子制造行业内的企业新建生产线和对原有生产线更新都会对本行业产生很大的需求。当前及未来数年内，我国仍是世界电子产品的制造中心，与电子产品相关的制造业发展情况良好，这种市场地位决定了电子制造企业对本行业设备采购的稳定需求，为本行业的发展提供了良好的市场基础。

（九）发行人在行业中的竞争地位

公司自成立以来，专注于电子整机装联焊接设备的研发和制造，积累了深厚的技术储备和丰富的市场经验。目前，公司已经发展成为我国电子整机装联焊接设备领域内的龙头企业，据中国电子专用设备工业协会的统计，公司在 2010 年

国内电子整机装联焊接设备市场占有率位居行业前列。公司利用在焊接设备行业积累的丰富行业经验和丰富的客户资源，于 2009 年进军 AOI 检测设备市场，不久就打开市场，获得用户的认可，市场占有率位居行业前列。

（十）进入行业的主要障碍

1、技术壁垒

电子整机装联设备制造是一个多学科交叉的行业，包括精密机械、电子、电气、软件、光学、热学、流体、化学、材料等众多知识体系，对进入该行业的企业技术整合能力要求很高。因此，技术壁垒是新竞争者和潜在竞争者进入该行业最主要的壁垒。

2、工艺壁垒

一个优秀的装备制造业企业，除了众人所知的设计技术、加工技术和精密装备以外，生产过程中还存在大量的制造工艺，而了解和掌握这些制造工艺诀窍，需要长时间的专注和经验积累。因此工匠般的技术传承性是本行业的独特之处，这对新进入者构成较高的工艺壁垒。

3、人才壁垒

由于电子整机装联设备行业技术的复杂性，对从业人员的知识结构和综合能力要求要远远高于传统产业。一般情况下，专业人才（工程技术人员、一线技能型人才）的培养至少需要 5-8 年的行业经验积累。企业能够很好地发展，必须拥有相当数量的专业人才和人才储备，所以专业人才是进入该行业的壁垒。

4、品牌壁垒

焊接设备的质量和稳定性是保障电子产品安全、控制制造成本的关键。因此焊接设备的品牌是工业客户选购的重要因素，用户及经销商都希望设备厂商提供的产品能保持高可靠性、高稳定性，同时能够提供良好的售后服务及技术支持。焊接设备的用户，尤其是高端客户，具有强烈的品牌意识，对品牌产品有较高的依赖性，因此品牌厂商拥有相对稳定的客户群体，而新进入者在相当长时期内处于小规模生产状态，经验积累不足，难以解决产品可靠性问题，产品品质及售后服务都无法保证，从而难以获得客户的认同。

（十一）发行人在行业中的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）技术与研发优势

① 先进的研发理念、优秀的研发团队和良好的研发体系

公司以市场需求为导向，在充分调研的基础上，选择具有前瞻性和良好拓展性的技术进行储备，坚持量产一代、开发一代、预研一代的技术创新思路，始终保持行业的技术领先优势。

技术的延续性和积累对于装备制造业至关重要，公司始终把建设稳定的研发技术团队放在首要位置，建立了选拔、实习、培训、考核、晋升、淘汰等一整套公开、公平的以业绩为导向的管理方法，打造了一支专业化、富有激情的研发团队。公司设立专门的研发中心，下设焊接设备、机器视觉设备及光伏设备三个研发部门。截至 2011 年 12 月底，公司拥有研发人员 95 人，占员工总数的 14.80%，汇集了电气、机械、软件等各个领域的专业人才。公司核心研发人员多数拥有较强的专业知识背景和多年以上的研发工作经验，对相关技术和工艺均有深刻的理解。

公司建立了较为完善的研发体系：成立了以营销、财务、技术专家组成的跨部门项目评审小组，对项目的立项、实施、验收等环节进行监督管理；实行公司指定战略项目和员工自荐项目相结合的研发管理体制；根据研发项目的技术深度和预期的经济效益以及项目开发的效果、进度及成果对项目开发人员进行绩效考核和奖励，提高研发人员的积极性。

② 持续不断的研发投入

为了保障技术的先进性，公司常年保持较高的研发投入，2009 年、2010 年和 2011 年，发行人在研发方面的投入分别为 607.30 万元、1,192.27 万元和 1,192.77 万元。公司在未来将持续加大研发费用的投入，为公司进一步提升研发创新能力奠定了坚实的基础。

③ 领先的技术优势

经过多年的技术沉淀积累，公司已形成较强的技术与产品创新能力。公司目前是电子整机装联焊接设备子行业的龙头企业，在热工学温度控制方面取得了多项创新成果。公司已取得包括电磁推进（MHD 电磁泵）技术在内的 38 项专利技

术，软件著作权 15 项。同时拥有高效热传导、液态金属的泵送技术、矢量图像识别和等离子控制技术 17 项非专利技术。

公司研发的 SM 无铅波峰焊锡机上的电磁推动式波峰炉胆在 2008 年获得欧盟的专利荣誉，公司完全自主研发的新一代“全节能环保型双曲线回流焊”技术及“全模组化的选择性波峰焊”技术达到了国际先进水平。其中，双曲线回流焊（Multi-Profiles）是具有创新概念的产品，即在一台回流焊设备中同时运行两种完全不同的工艺制程，通过软件对每件产品进行工艺监控及优化，不仅具有优秀的技术指标，而且在比传统产品产量大一倍的情况下能耗低 30%。而模组化的选择性波峰焊则是业内率先标配视觉定位及自动误差补偿的选择焊，采用多轴、多平台实时伺服控制系统，智能无缝扫描数据输入等独创技术。

近年来，发行人利用热传导方面的传统优势，自主研发并掌握了可用于太阳能光伏设备领域的高温快速热处理技术，该技术采用高温、高速、高精度、陡升、陡降的尖峰工艺曲线，能够保证剧烈温度变化下的温度均匀性，从而实现高温条件下的高效热传递。

④ 推陈出新的产品创新

发行人在技术领先的基础上，在专业化和精品化的经营理念指导下，秉承一贯专注和持续改进的创新精神，在产品的研发制造上也不断地推陈出新，体现了发行人以技术创新引领产品结构升级的策略和思路。下表为公司历年推出的产品和技术的先进程度情况：

时间	推出产品情况	技术的先进程度
2007 年 6 月	VS-800, VS-1000 系列无铅热风回流焊机投向市场；并推出 SM 系列无铅波峰焊	VS 无铅热风回流焊机通过了深圳市高新技术产业协会专家鉴定，结论为“该产品的综合技术性能指标达到国内领先、国际先进水平”，同时上述产品还被评为 2007 年“广东省重点新产品”并通过了 CE 及 RoHS 认证。
2008 年 4 月	推出 II 代高效无铅全热风回流焊机 VS-800 II -N 和无铅电磁波峰焊机 NSM-450-N	该型号回流焊采用的“电磁推进式波峰焊接锡炉”及“热风循环加热装置”两项专利获国家知识产权局、辽宁省人民政府、中国贸促会主办的中国国际专利技术与产品交易会金奖荣誉称号；NSM 无铅波峰焊机上的“电磁推动式波峰炉胆”获得了欧盟及墨西哥的专利荣誉。
2009 年 4 月	推出 SELEIT 高端品牌 SAV-450 等多功能全自动选择性波峰焊机	SELEIT 产品应客户生产产能及工艺的要求，业内率先标配视觉系统，可快速导入数据，图形编程简易、高效。为客户提高产量和质量提

		供保障。
2009年7月	推出离线式AOI机 JTA-300系列	该型号AOI采用两项实用新型技术，及国际先进的特征矢量分析算法，拥有最底层的图像识别算法及完全自主知识产权。
2010年5月	推出R系列回流焊 RAD-1040	RAD-1040是SELEIT品牌的产品之一，在回流焊工业标准中提供了更高的生产率和工艺精度控制；非常全面的功能选择以满足不同客户的需求，是行业中功能最全、能耗最低、性能最优的产品之一。
2010年7月	推出高温烧结炉 ADF-600	ADF-600是一款凭借公司多年积累的控温技术完全自主开发的太阳能电池生产设备，具有快速升温/降温的强大温控功能，其能耗大大低于其他品牌的同类产品，并且经客户验证，其温控技术已经达到世界先进水平。随后推出升级版FF-600及双列DDF-600系列烧结炉产品。
2010年11月	推出在线AOI机 JTA-200系列 JTA-400系列	可用于SMT生产线的任何一个位置，既可以检测锡膏印刷质量，也可以检测贴片之后贴片质量，还可以用于回流焊后的焊接品质的检测。检测速度及软件的可靠性能适应目前几乎所有生产线的要求。国内独创远程在线调试及维修站功能。
2011年2月	推出TAB 台式选择性波峰焊	台式选择焊是一款小型化、高性能、经济适用型半自动化选择性波峰焊，具有结构简单，操作方便，稳定性高，易维护等优良特点。其模块化的设计可根据产能需要以1+N的形式加入生产线，最大化利用机器的生产能力。
2011年4月	推出AS系列 热风回流焊	AS系列无铅回流焊中新的设计减少了热量损失的同时使助焊剂回收的更彻底，具有超低的耗电量，传动可靠性高，系统稳定性好，热传递效率高和易于维护保养等优良特点，能更好应对更复杂更大型的焊接产品的无铅工艺。
2011年5月	推出SPI-200	可用于炉前的锡膏检测，国内首台具飞行照相技术的SPI，速度达到国内最快，主要技术指标与国际相当。
2011年12月	推出AOI在线SPI-400	可用于炉前的锡膏检测，国内首台具飞行照相技术的SPI，速度达到国内最快，主要技术指标与国际相当。JTA-200的改进版，三段式传输，具备3D测试功能。
2012年1月	推出AOI离线设备 JTA-500系列	JTA-500系列比JTA-300系列更稳定，结构更合理，测试速度提升30%。

公司利用技术优势，不断推出性价比更高的新产品，这些新产品的推出一方

面打破了国际主要厂商的垄断，使公司在中、高端无铅焊接设备领域占据了较高的市场份额。另一方面也在一定程度上降低了国内电子生产企业的设备采购成本，提升了国内电子产品的国际竞争力。

（2）产品品质优势

公司通过深入理解客户需求，制定详细供应链，从产品设计，研发到量产及售后都有完善的审核、评估及改善的机制。截止本招股说明书签署日，公司已通过了 SGS 的 ISO9001（2008 版）质量管理体系认证，并引入 ERP 系统实现了内部信息化管理，提升了内部控制与财务分析水平。公司设置有专职的工艺部门，制定合理、可靠、先进的制造工艺，推动产品质量的不断提高。近年来公司一直组织品质圈（QCC）和改善提案活动，充分调动了全体员工参与改善的积极性，使工作场所充满生机和活力，产品质量处于同行领先水平。另外，在回流焊、波峰焊缺乏国家及行业标准的情况下，公司积极探索并建立了企业标准，该标准已于 2007 年通过了深圳市质量技术监督局的备案审核。

公司通过推动全员质量管理，严格执行产品的全程质量控制。在设备的制造过程中，“原材料输入—制造工艺设定—生产制造过程”三个环节直接决定了产品的品质。在原材料输入方面，公司有严格的供应商优选流程，通过与上游供应商保持良好关系，严格控制购入的材料质量，确保输入的严格把关；在生产制造过程中，公司执行严格的内部管理流程，详细记录产品的生产履历，每个产品的履历都可以追溯到直接负责人，确保生产过程的严谨制造；公司产品的一次生产合格率（不需要进行第二遍工序）高达 97%。

由于对生产质量的严格管控，公司的产品屡获殊荣。公司的回流焊、波峰焊产品获“中国国际专利技术与产品交易会金奖”和“第七届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖”等奖项。2007 年 6 月，公司产品中的 VS 无铅热风回流焊机、SM 全自动无铅电磁波峰焊锡机，通过了深圳市高新技术产业协会专家鉴定，结论为“该产品的综合技术性能指标达到国内领先、国际先进水平”，同时上述产品还被评为 2007 年广东省重点新产品并通过了产品 CE 与 ROHS 认证。

（3）生产制造优势

在生产制造型企业中，企业的生产制造体系直接决定了生产效率，从而决定了该企业的成本控制、产品质量、市场响应速度等环节，最终影响到企业绩效目

标的实现。公司追求精益生产，注重生产制造的每一个环节。

① 自主生产模式的优势

公司拥有钣金、机加、装配等完整的生产工序链，坚持采取自主生产模式，只有在产能不能满足订单需求时才进行少量外协生产。公司这种自主生产模式的优势主要体现在如下几个方面：

一是，生产环节可以更好地与市场及研发相衔接，根据市场及客户的需求，研发设计的新产品可以更快地在生产环节中得以实现，从而确保新产品的推出速度及交货周期；二是，在具体的生产环节中，有利于公司严格监控设备制造过程中整条生产线的运行状态，并对生产线进行优化配置，从而保证产品品质；三是，自主生产还可以避免因外协而产生的核心技术泄密风险；四是，由于对生产工艺的深入掌控，可以组织出比外协更高的生产效率，从而使得制造成本相对更低。

② 生产组织上的创新

在生产方式上，公司借鉴国外企业的一些管理精髓（如 JIT 准时化生产方法和 TOC 约束理论生产模式等），结合行业特征和自身特点进行创新，将代工厂的快速、灵活、弹性化的生产方式引入到日常生产管理过程中。每天根据订单情况进行生产线调整，合理地进行产品的生产排单，将计划的推动生产与各车间各工序的拉动生产进行对接。生产计划不只是做一个简单的下达，各车间、各工序还对计划进行优化、完善，充分配置资源，快速响应各种的变化，提高生产效率，缩短交货期。在生产的标准化上，公司设立专门的工艺小组，细化生产工艺并推广标准化和模块化生产，降低对员工个人技能的依赖，同时提高生产效率；在生产布置上，布局合理，用较少的占地面积实现产量最大化。公司在仅有 2 万平方米厂房面积的条件下，实现了单月产量最高达到 140 台焊接设备的业绩，大大高于同行业平均水平。

通过上述优化和创新后，公司在与行业内其他企业相比时，市场反应速度更快、交货期更短、产品的单位生产成本更具优势，这也是公司近年来销售持续增长和产品利润率先于行业平均水平的重要因素。

（4）品牌及客户资源优势

公司自成立以来，以“JT/劲拓”品牌营销海内外市场，植根于长期在焊接设备领域的耕耘，凭借优良的产品性能及专业的服务优势，公司已建立起良好的品

牌形象，品牌在行业内具有较高的知名度。公司的“JT/劲拓”商标荣获 2010 年广东省著名商标荣誉，同时公司也是 2010 年“深圳知名品牌”企业。

正是由于良好市场品牌形象，公司积累了一批成熟的客户群体。目前，公司的产品已经成功进入国内外众多知名电子制造企业（包括 EMS 和终端用户），本公司与其中的大部分厂家都建立了长期稳定的合作关系，如公司是全球第二大 EMS 厂商 Flextronics（伟创力）在全球范围内的焊接设备指定供应商。丰富的客户资源和强大的销售网络为公司业绩的持续增长和市场份额的不断扩大提供了保障。公司部分客户名单如下表所示：

客户类型	部分客户名称
EMS	伟创力制造（新加坡）有限公司、捷普电子有限公司（美国）、SMT 新进、Integrated Micro-Electronics Inc.、Sanmina-sci Corporation（美国）、东莞爱高电子厂、富士康科技集团（北京）、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、比亚迪股份有限公司
终端客户	爱默生网络能源公司、北京西门子电器有限责任公司、佳能（中国）有限公司、东芝（中国）有限公司、SanDisk 闪迪公司、卡西欧股份有限公司、先锋电子科技（上海）有限公司、上海爱立信电子有限公司、Creative Technology Ltd.、格力电器股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、青岛海信电器股份有限公司、深圳创维数字技术股份有限公司、广东美的制冷设备有限公司

（5）营销团队优势

① 公司的营销人员主要从公司内部的技术、生产、售后服务等部门抽调，经过专业营销知识培训转型而来。这样的团队，对本行业的专业技术理解透彻，能快速了解客户的技术要求，甚至能协助客户解决生产中的疑难问题，客户认同度高。同时由于这些营销人员对本公司组织架构及人员非常熟悉，使得行业的最新动态和客户的需求，能以最快速度传达到本公司设计及生产部门，客户满意度高。

② 营销人员忠诚度高，对公司有较强的归宿感，加之公司良好的激励机制和企业文化，营销人员流失率较低，保障了客户服务的持续性、连贯性。

（6）服务能力优势

装备制造业的特点是注重设备在生产线上的运行情况，尤其关注技术水平。公司在服务上的特点是：

在产品的售前和售中阶段，公司销售人员会根据客户的个性化需求，会同研

发、技术支持人员介入到用户的工艺研发环节，和用户一起研究下一代工艺和产品的解决方案。通过和用户的深入交流和沟通，把用户的工艺优化理念融入到公司新产品的研发过程中去，同时与用户一起改进和优化设备和工艺，直到用户获得满意的结果为止。公司是国内焊接设备企业中首家协助客户引入 PWI（Process Window Index，工艺窗口情况指标）工艺管理模式的厂商，这种工艺管理模式可以将生产过程中的工艺参数不稳定范围以量化的指标表现出来，从而协助电子制造企业更快速和更准确的调整工艺，降低生产成本。通过为用户提供高效率和高附加值的增值服务，极大地促进了产品的销售和客户对公司的信赖。因此与国外设备提供商纯粹提供设备的方式相比，公司有着十分明显的优势。

在产品的售后方面，公司拥有一支规模约 90 人的技术支持团队，同时在主要客户所在地设立办事处，并在重点客户的工厂附近常驻相应的技术支持人员，实现 24 小时技术支持服务。

2、竞争劣势

与国内许多装备制造企业类似，公司成立时间还不算长，企业综合积累还不够。与国外拥有多年设备制造经验的企业相比，存在资金实力偏弱、融资渠道单一等劣势。随着国内装备制造业的振兴和发展，市场需求的进一步扩大和释放，用户对设备生产企业的规模实力将会越来越看重，如果企业规模偏小，将很大程度上制约企业的市场竞争力。

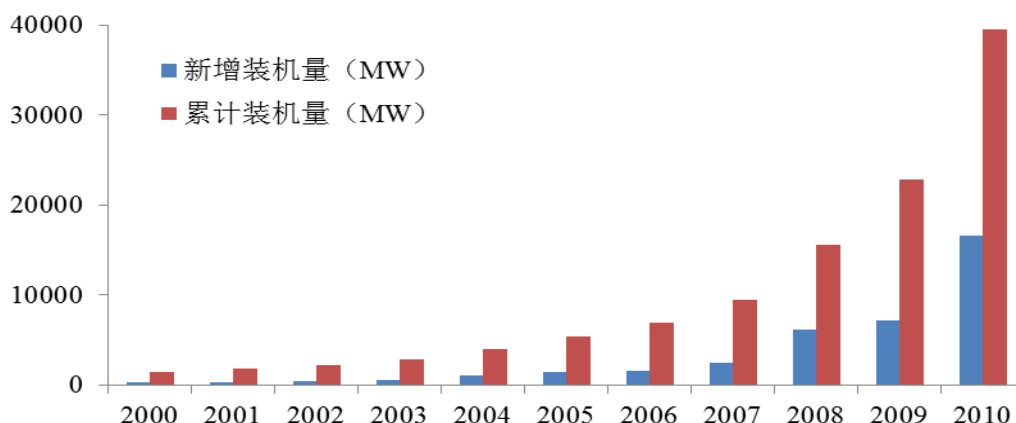
四、太阳能光伏设备行业发展概况

（一）太阳能光伏行业基本概况

1、太阳能光伏产业现状

太阳能资源丰富、分布广泛，是最具发展潜力的可再生资源。随着全球能源短缺和环境污染等问题日益突出，太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。在各国政府对光伏产业的政策扶持和价格补贴下，近十年来光伏产业赢来了行业发展的高峰期。据欧洲光伏工业协会统计，2010 年全球光伏发电的装机容量达到 16.63GW，比 2009 年增长了 129%，近 10 年的复合增长率超过 50%，具体情况见下图：

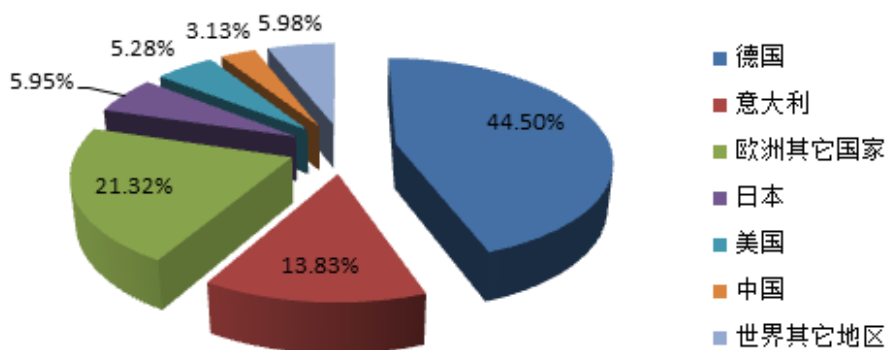
2000-2010 年全球太阳能光伏行业年新增装机量及累计装机量规模



数据来源：欧洲光伏工业协会(EPIA)

从光伏装机量的市场结构看，欧洲保持着绝对领先的优势，其中德国和意大利是欧洲最大光伏产品消费市场，2010年其新增装机容量分别为7.4GW和2.3GW，二者占全球的比例接近60%。此外，日本和美国市场也表现显著，2010年新增容量分别为990MW和878MW，同比增幅分别达到105%和84%；相对以上国家，我国的太阳能光伏系统新增装机量较小，但近年来发展非常迅猛，近三年来均已超过100%的速度增长，2010年新增装机量达到了520MW。

2010 年全球太阳能光伏装机量地区分布



数据来源：欧洲光伏产业协会（EPIA）

整体而言，欧盟各国光伏产业政策近年来推动了市场的快速发展，全球各地的光伏电池组件和系统超过一半销往欧洲地区，欧盟各国发展新能源的技术与政策扶持路径也给其他国家和地区提供了良好的经验。

2010年全球光伏产业呈现繁荣的景象，给光伏产业带来大量资金，整个行业产能大幅扩张。然而相对于火电等传统发电方式，光伏发电目前成本仍较高，

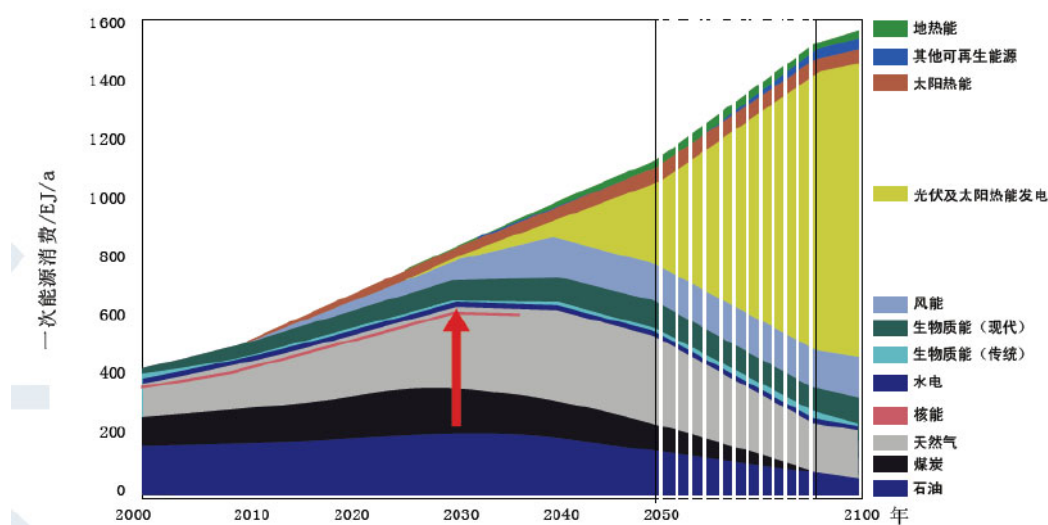
产业的发展主要依靠政府的补贴政策，由于欧洲债务危机使得欧洲各国政府削减了光伏产业的财政补贴，导致 2011 年光伏产业整体需求放缓，光伏企业产能过剩，产品价格全线下跌，全球光伏市场陷入低迷。

2、全球太阳能光伏产业发展趋势及前景

当前的光伏行业萧条景象与 2008 年底较为相似，当时受次贷危机的负面影响，光伏需求骤减，光伏企业普遍产能过剩。从长远看，随着传统能源的枯竭，在核电危机的推动下，太阳能凭借其独特的优势必将在未来会占据世界能源消费的重要席位，不仅要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。据欧洲光伏产业协会(EPIA)预计，尽管未来一段时间欧洲市场可能持续低迷，但美国和亚洲等新兴市场的快速增长将能够保证未来太阳能光伏市场的持续增长，2011 年全球光伏组件新增装机量将会达到 21.15GW，较 2010 年增长 27%，全球 2015 年光伏装机容量单年可突破 43.9GW。

此外，随着技术提升和成本的不断下降，太阳能对传统能源的替代效应和优势会逐步体现，届时太阳能装机将彻底摆脱政府补贴的模式，进入爆发式的良性增长轨道。根据欧盟委员会联合研究中心（JRC）的预测，到 2030 年可再生能源在总能源结构中占到 30% 以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到 10% 以上；2040 年可再生能源占总能耗 50% 以上，太阳能光伏发电将占总电力的 20% 以上；到 21 世纪末可再生能源在能源结构中占到 80% 以上，太阳能发电占到 60% 以上，显示出极其重要的战略地位。

2000-2100 年全球一次能源消费趋势



资料来源：欧盟联合研究中心

3、中国光伏产业发展现状

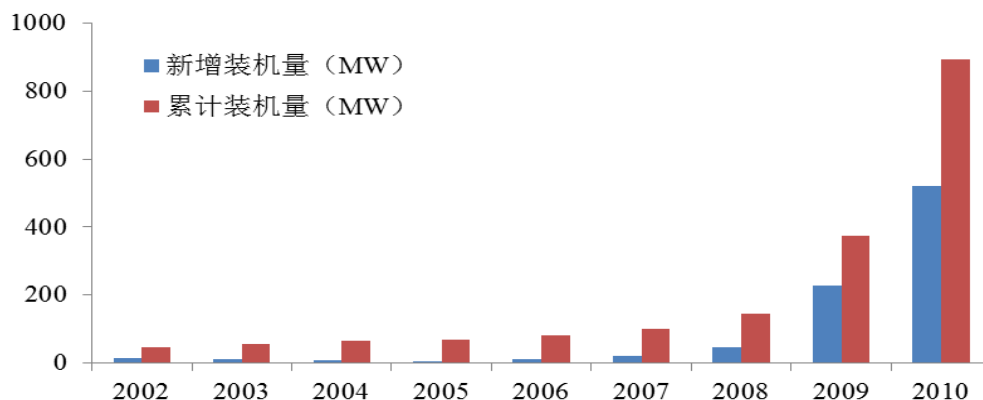
2004年1月1日，德国新修订的《可再生能源法》正式实施，极大地推动了德国光伏产品的市场需求，在此背景下，中国光伏企业凭借其低廉的成本迅速打开了国际市场，获得了良好的发展机遇，从晶体硅制造到生产太阳能电池芯片、电池组件以及太阳能终端应用产品，技术水平不断提升，产品结构不断完善，市场规模不断扩大，中国光伏产业进入全面、快速的发展阶段。

2000-2010年，中国太阳能光伏电池年产量从2.8MW增长到9GW，十年间增长3,000倍，已成为全球太阳能第一生产大国，然而，中国太阳能发电市场发展却极为缓慢，2010年累计装机容量仅占全球的2.26%。主要由于国内缺乏具体的产业政策细则鼓励居民和企业使用太阳能发电，目前光伏产业90%左右的产品均出口海外。

由于中国光伏产业对国外市场的过度依赖，因此2011年欧洲光伏市场的低迷对国内的光伏产业产生了较强的冲击。但随着国内光伏政策的陆续出台，这一局面可能将得以改变。根据即将出台的《太阳能光伏产业十二五规划（征求意见稿）》，到2015年我国的光伏装机量将至少达到10GW，平均每年新增约2.5GW的装机量，是目前的5倍以上。

2011年8月1日国家发改委颁布了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，将国内建设的太阳能光伏项目的上网电价统一核定为1.15元/千瓦时，未来降低到1元/千瓦以促进成本的下降。该政策的具体细则仍有待继续完善，但可以预见，上网电价政策的实行将带来我国的光伏装机量实现德国、意大利式的快速增长。

2002-2010年中国光伏行业年新增装机量及累计装机量规模

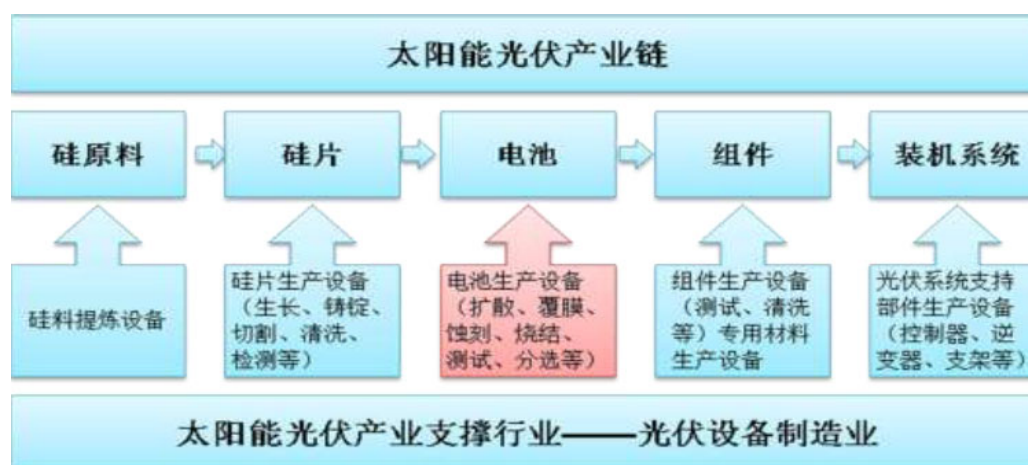


数据来源：欧洲光伏工业协会(EPIA)

（二）太阳能光伏设备市场发展概况

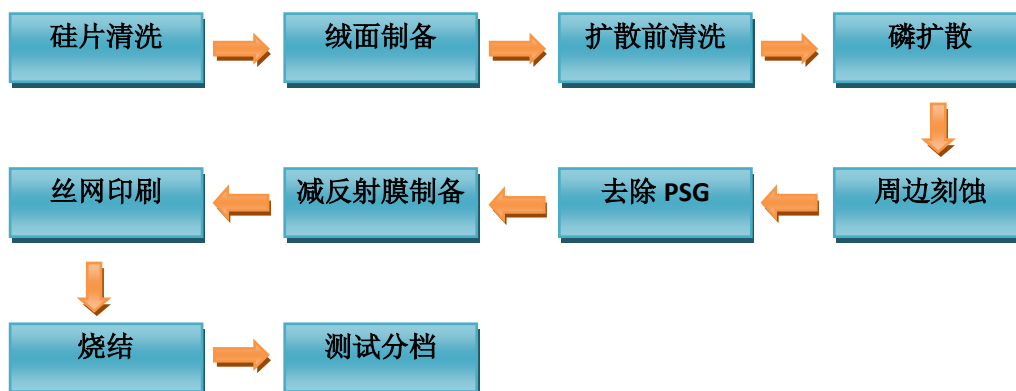
1、太阳能光伏设备简介

太阳能光伏设备，是指太阳能光伏制造业中所需的各类专用设备，包括硅料提炼制备、硅片生产（生产、铸锭、切割、清洗、检测等）、电池生产设备（扩散、覆膜、刻蚀、烧结、测试、分选等）、组件生产设备（清洗、测试等）、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备（控制器、逆变器、支架等）。本公司生产的设备为太阳能电池生产设备，主要用于太阳能电池生产线中。



光伏设备制造业是光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链。而其中太阳能电池制造则是光伏产业重要的产业链工序，也是整个产业的产量衡量标准。根据 Photon International 的统计数据，2010 年全球光伏太阳能电池产量达到了 27.2GW，增长了 118%，是过去 12 年以来最高的一年。光伏产业已成为世界发展最快的高新技术产业之一，而太阳能电池生产设备作为制造电池片的基础支撑，对光伏产业的发展具有至关重要的作用。

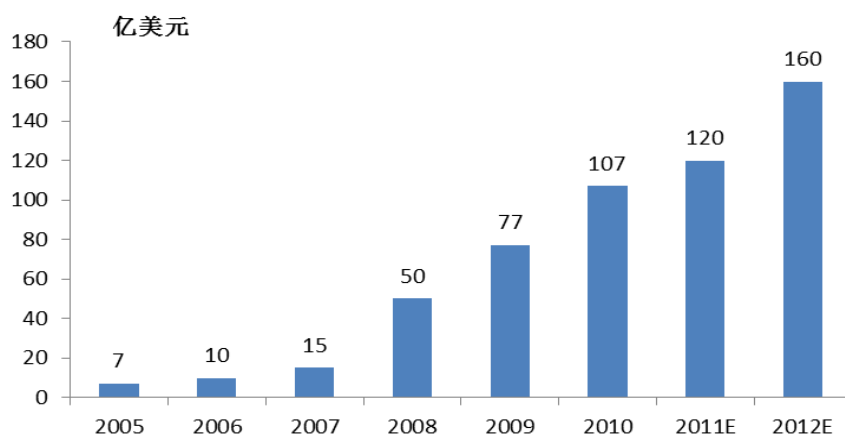
目前太阳能电池主要有两种类型：分别是晶体硅太阳能电池片和薄膜太阳能电池片，其中晶体硅电池为目前世界光伏市场的主力，占 90% 以上的市场比重。与薄膜电池相比，晶体硅电池具有转换率相对较高、使用寿命较长、原料资源较多等优势。晶体硅电池生产工序主要包括清洗、制绒、扩散、刻蚀、减反射膜制备、电极印刷、低温烘干、高温烧结、自动测试分捡等，下图为晶体硅太阳能电池的制造工艺流程图：



2、全球太阳能光伏设备市场情况

以市场最大、用量最多也是最关键的晶体硅太阳能电池制造设备为例，以德国、意大利为代表的欧洲设备制造商和日本、美国设备制造商代表了当今世界相关设备的最高技术水平，其技术特征为产能高、自动化程度高并且适合越来越大、越来越薄的硅片工艺。尤其是德国，已成功地推出了代表国际最先进水平的、几乎不需要人工干预的适合 210mm*210mm 方硅片生产的全自动生产线设备。现今国际典型的大生产线，其产能已从以前的每条线几兆瓦发展到了 25 兆瓦（MW）甚至单台设备产能达到了 50MW。

2010 年，全球光伏设备市场总销售收入为 107 亿美元，连续六年保持 30% 以上的年增长率。据 SEMI 预测，全球太阳能光伏设备市场将在 2012 年增长至 160 亿美元以上。SEMI 统计出的全球近 200 家光伏设备制造商有接近 100 家总部位于欧洲，其中有许多以前是半导体设备供应商，其余的主要是美国、日本和部分亚洲的厂商。下图为 2005-2012 年全球光伏设备市场规模及预测：

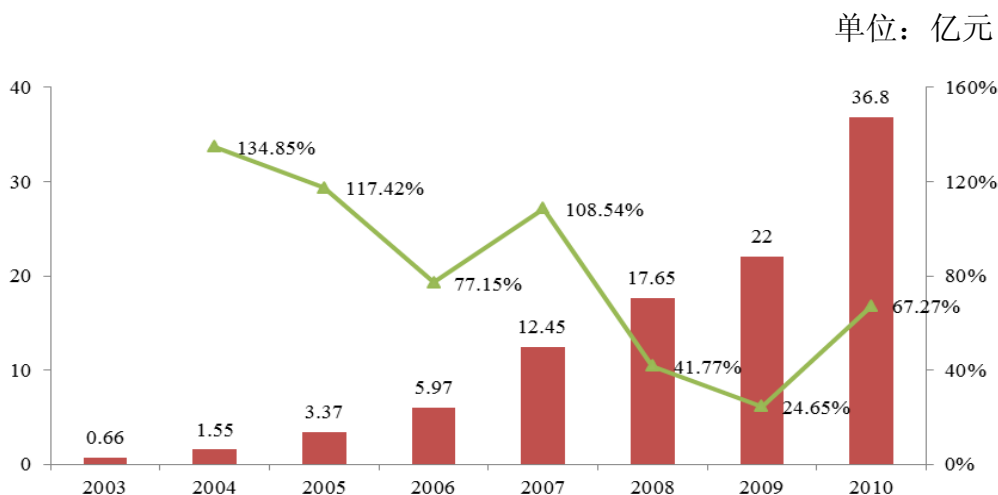


数据来源：SEMI，Solarbuzz，赛迪顾问，2011

3、中国太阳能光伏设备市场情况

在光伏产业发展的推动下，2010年我国的太阳能设备（主要是晶硅太阳能电池生产设备）在2009年下半年迅速复苏的基础上得到了大幅度增长。2011年在一批关键设备国产化和高效、低能耗新设备投放市场的推动下，我国太阳能设备将继续保持快速增长的态势。据中国电子专用设备工业协会统计，2010年我国主要光伏设备企业销售收入比2009年增长了67.30%，达到36.8亿元。其中：其中晶硅材料生长加工设备销售收入达到26.4亿元，同比增长81.2%，占太阳能光伏设备销售收入的71.74%；晶硅太阳能电池芯片制造设备销售收入达到10.4亿元，同比增长40%，占太阳能光伏设备销售收入的28.26%。2003年至2010年，中国光伏设备产业规模复合增长率达到65.31%。

2003-2010年中国太阳能光伏设备企业销售规模



数据来源：中国电子专用设备工业协会，2011

依靠我国半导体设备行业数十年来的技术积累，通过和国内优秀光伏电池企业的合作，经过连续多年的不懈努力，我国光伏设备企业目前已初步具备太阳能电池制造设备的整线装备能力。我国光伏设备制造的生产规模已逐渐形成，并在北京、西安和长三角地区形成了产业集群，市场化程度相对较高，太阳能光伏设备中的单晶炉、多晶硅铸锭炉、扩散炉、等离子刻蚀机、清洗/制绒机等已接近国际水平，在国内占据了一定的市场份额，性价比优势明显。但在一些核心设备上，如PECVD（设备投资比重约占整条生产线投资的1/3以上）、全自动丝网印刷机和自动分捡机由于核心技术无法绕开国外公司的技术专利封锁，尚未取得实质性突破，整体水平和国外差距较大，国际领先水平的设备主要由美、日、德、

英等西方发达国家制造，某些设备甚至仅有 3-4 家生产商提供，行业集中度非常高。国内主要大生产线几乎全部采用了价格高昂的进口设备。

伴随着国内上游光伏设备企业技术的突破，凭借其成本优势，国内太阳能光伏设备企业将逐步实现进口替代，未来发展前景良好。根据《太阳能光伏产业十二五规划（征求意见稿）》：我国政府将集中支持骨干光伏企业，提供资金、贷款等方面扶持，将在 2015 年形成 3-4 家年销售收入过 10 亿元的光伏专用设备企业；支持全自动平板式 PECVD、激光刻蚀机、干法刻蚀机、离子注入机、全自动印刷机、快速烧结炉等晶硅太阳能电池片生产线设备。促进光伏生产装备的低能耗、高效率、自动化和生产工艺一体化。

（三）高温烧结炉细分市场概况

1、高温烧结炉简要介绍

经过丝网印刷后的硅片，不能直接使用，需经烧结炉快速烧结，将有机树脂粘合剂燃烧掉，剩下几乎纯粹的、由于玻璃质作用而密合在硅片上的银电极。当银电极和晶体硅在温度达到共晶温度时，晶体硅原子以一定的比例融入到熔融的银电极材料中去，从而形成上下电极的欧姆接触，提高电池片的开路电压和填充因子两个关键参数，使其具有电阻特性，以提高电池片的转换效率。烧结炉分为预烧结、烧结、降温冷却三个阶段。预烧结阶段目的是使浆料中的高分子粘合剂分解、燃烧掉，此阶段温度慢慢上升；烧结阶段中烧结体内完成各种物理化学反应，形成电阻膜结构，使其真正具有电阻特性，该阶段温度达到峰值；降温冷却阶段，玻璃冷却硬化并凝固，使电阻膜结构固定地粘附于基片上。

2、高温烧结炉行业竞争格局

目前国内的高温烧结炉绝大多数通过进口，少部分来自国内的一些研究机构和企业。中国电子工业专用设备协会预计，国外企业中美国的 Despatch 公司目前占据整个国内市场的 80% 市场份额，其次美国 BTU 占据 10%、国内企业占据剩余的 10% 的市场份额。以上企业中，美国的 Despatch、BTU 以及中国电子科技集团 48 所将成为公司在太阳能高温烧结炉设备制造领域的主要竞争对手。

主要竞争对手简介：

（1）Despatch Industries

Despatch 是一家有百年历史的提供热处理，各种加热、固化系统及环境测

试解决方案的美国公司。产品广泛应用于电子，半导体，机械，制药，材料，交通以及各种实验室。主要产品有工业、实验室用烘箱，洁净室用烘箱，量产烘炉，环境模拟及老化实验设备，烧结和扩散炉等。

（2）BTU

BTU 公司简介详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所属行业的基本情况”之“（四）发行人所属细分行业的市场情况”之“1、焊接设备市场情况”。

（3）中国电子科技集团 48 所

中国电子科技集团 48 所坐落于长沙市天心区，成立于 1964 年，是国内主要以集成电路、半导体照明、太阳能光伏、磁性材料、新型储能材料、特种传感器和 SOI 材料等技术为主的科研生产机构，在太阳能光伏设备领域，主要生产扩散炉、刻蚀机、烧结炉、PECVD 等产品。

（四）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策对国内装备制造业及光伏产业的大力支持

我国前期由于政策支持力度不够，国内发电市场需求不够，导致国内光伏产业整体上仍以出口为主。近年来，国家出台了一系列的政策和规划来支持装备制造业和太阳能光伏设备行业的发展，包括《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2010》、《产业结构调整指导目录（2011）》等国家政策文件也分别将太阳能光伏设备列为鼓励类或作为重点优先发展的行业之一。

（2）太阳能光伏的可持续性和良好前景为光伏设备市场需求提供良好保障

① 能源危机和环境保护将为光伏产业发展提供良好契机

传统的燃料能源正在逐渐减少，对环境造成的危害日益突出。据世界能源权威机构的分析，按照目前已经探明的化石能源储量以及开采速度来计算，全球石油剩余可采年限仅有 45 年，国内剩余可开采年限为 15 年；天然气剩余可采年限 61.9 年，国内剩余可开采年限 30 年；煤炭剩余可采年限 216 年，国内剩余可开采年限 105 年。2011 年 3 月日本发生的核泄漏危机，进一步将核电推向了风口浪尖，许多国家纷纷关闭或暂缓了本国的核能计划。而太阳能由于是世界上能量

最大也是最为清洁的能源，被公认为是 21 世纪重要的新能源。因此，光伏发电被公认是解决能源与环境问题的最佳途径之一。

② 光伏发电市场正由欧洲向亚洲和美国转移

2011年10月美国太阳能产业协会（SEIA）报告显示，美国2011年上半年安装的太阳能光伏发电装置比上年同期高出69%。奥巴马政府2012年财年预算80亿美元用于支持风能、太阳能及新式电池等清洁能源领域的研究，比2011财年增加三分之一，同时取消石油、天然气和煤炭生产商未来十年共计46亿美元的税收补贴，以帮助弥补清洁能源技术研发上的创新支出。在良好的政府补贴和资金投入下，2011年美国的光伏新增装机将超过100%增长，有望接近2GW。

2011年8月26日，日本参议院通过可再生能源法案。该法案旨在促进太阳能及气体可再生能源投资、切断日本对核能的依赖。基于对可再生能源立法的乐观，三井化学、东芝和三井物产先后宣布建设50MW光伏电站的建设计划。

截止2010年底，印度太阳能装机容量不足300MW，按照2009年提出的“国家太阳能计划”，印度将在2013年实现1.3GW的太阳能装机容量，2017年再增加10G，这将带动全球太阳能市场快速增长。

可以预见，随着美国和亚洲光伏发电市场的启动，全球光伏产业将克服欧洲补贴下降的负面影响，保持快速发展的态势。

（3）国内太阳能电池设备制造水平不断提升，太阳能光伏企业开始选用国产设备

在二十世纪八十年代中期以前我国大多数生产企业的设备都依赖国外进口，八十年代后期我国开始加大了对光伏设备制造的研发力度和规模化生产。随着我国可再生能源观念的深入和太阳能光伏发电在我国各领域应用的日益广泛，我国光伏设备制造行业取得了一定的成绩。进入二十一世纪以来，我国光伏设备制造行业步入了快速发展阶段。目前，国内不少企业加大了对先进机械设备的研发力度，逐渐掌握了相关核心技术，并取得了试验阶段的成功。今后，无论是技术水平，还是自主创新能力，我国光伏设备制造行业的整体竞争力都将大幅提升，基本能够满足光伏产业链的生产装配需求，考虑到性价比方面优势，国内太阳能电池生产企业已经开始选购国产设备，这一趋势将促进国内太阳能电池设备行业的高速发展。

2、不利因素

（1）我国光伏产业受全球光伏产业政策影响

一直以来，我国的光伏产业始终受到“两头在外”的双重制约，即原料依靠进口，产品以出口为主。目前我国的光伏产品主要出口欧美市场，外向度高达 90% 以上，这种现象造成的直接后果之一就是我国的光伏企业严重依赖国际市场的需求和海外国家光伏产业政策的变化。

随着国内光伏市场的启动，将逐步抵消海外市场波动的影响，2009 年以来，我国开始推行“太阳能屋顶计划”和“金太阳工程”，并从财政和建设领域上进行政策扶持。2011 年 8 月国家发改委的《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，更是被业界视为光伏产业内需进程的启动信号。

（2）光伏发电成本尚待降低

国内光伏发电市场迟迟不能启动的主要原因是光伏发电的成本还是太高，影响了大规模推广。目前，我国光伏发电成本为 1.3 元/度-2.0 元/度，远高于普通火电平均不到 0.30 元/度左右的发电成本。如此高昂的成本，一直以来都是制约我国乃至世界光伏产业发展的瓶颈。不过未来电池转化效率的提高、设备技术的改进、原材料价格的降低以及政府鼓励政策的推动，都将有力促进太阳能发电成本的下降，预计未来 5-10 年内将逐步接近常规电力的上网电价。

五、发行人主营业务的具体情况

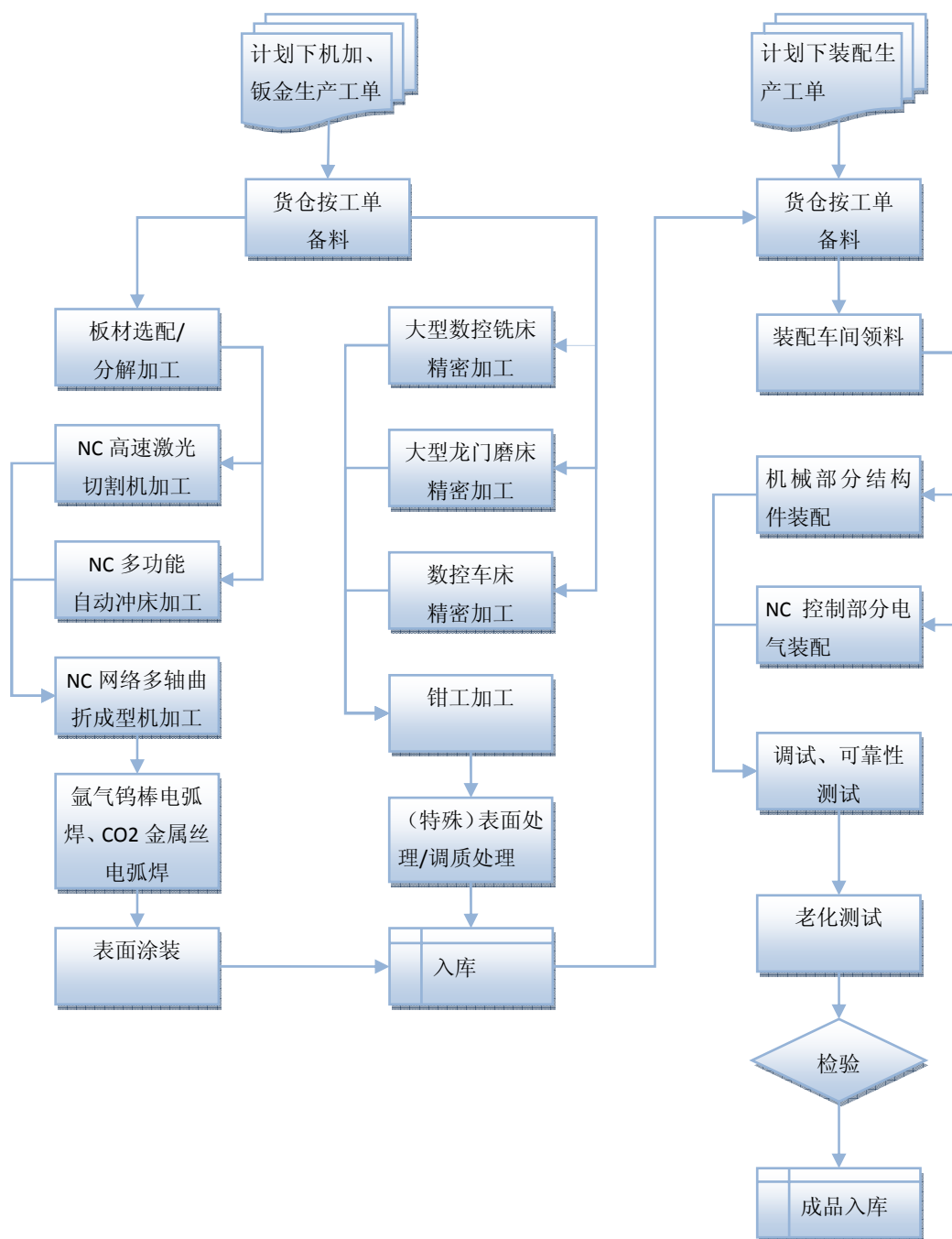
（一）主要产品及其用途

公司主要从事电子专用设备的研发、生产和销售，主要产品有波峰焊、回流焊、AOI 及高温烧结炉等。

公司主要产品的性能及用途，具体请参见本节“一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况”之“（二）主要产品”。

（二）主要业务和产品工艺流程图

公司主要产品均为电子专用设备，在产品工艺流程上有一致性，具体生产流程图如下：



其中，各产品的装配流程有所不同，分别为：

1、回流焊装配过程包括发热管装配，马达装配，内胆装配，整流装配，上/下炉膛装配，空气/氮气炉独立冷却区装配，机头、机尾装配，顶盖装配，导轨系统组装，紊流箱装配，抽风箱装配，顶盖装配，助焊剂回收系统装配，最后是总机装配。

2、波峰焊装配过程包括传动部分装配，玻璃门柜、门板装配，预热部分装配，冷却喷雾部分装配，锡炉部分装配，电气布线及电箱底板对接，机械调试，

电气调试，总装。

3、AOI 装配过程主要包括以下几个部分，机械系统装配；电气控制系统（马达、运动控制、周边控制、计算机）装配；光学系统（光源、相机、镜头）装配；软件系统装配。

4、高温烧结炉装配过程包括：机架整合，打水平，超声波装置，升降器，烘干炉胆，石英棒，烧结/水冷炉胆，风冷炉胆，路线/管路，装电箱/流量计，外壳/风机组装，安装网带，水路、气路，门板。

（三）主要业务模式

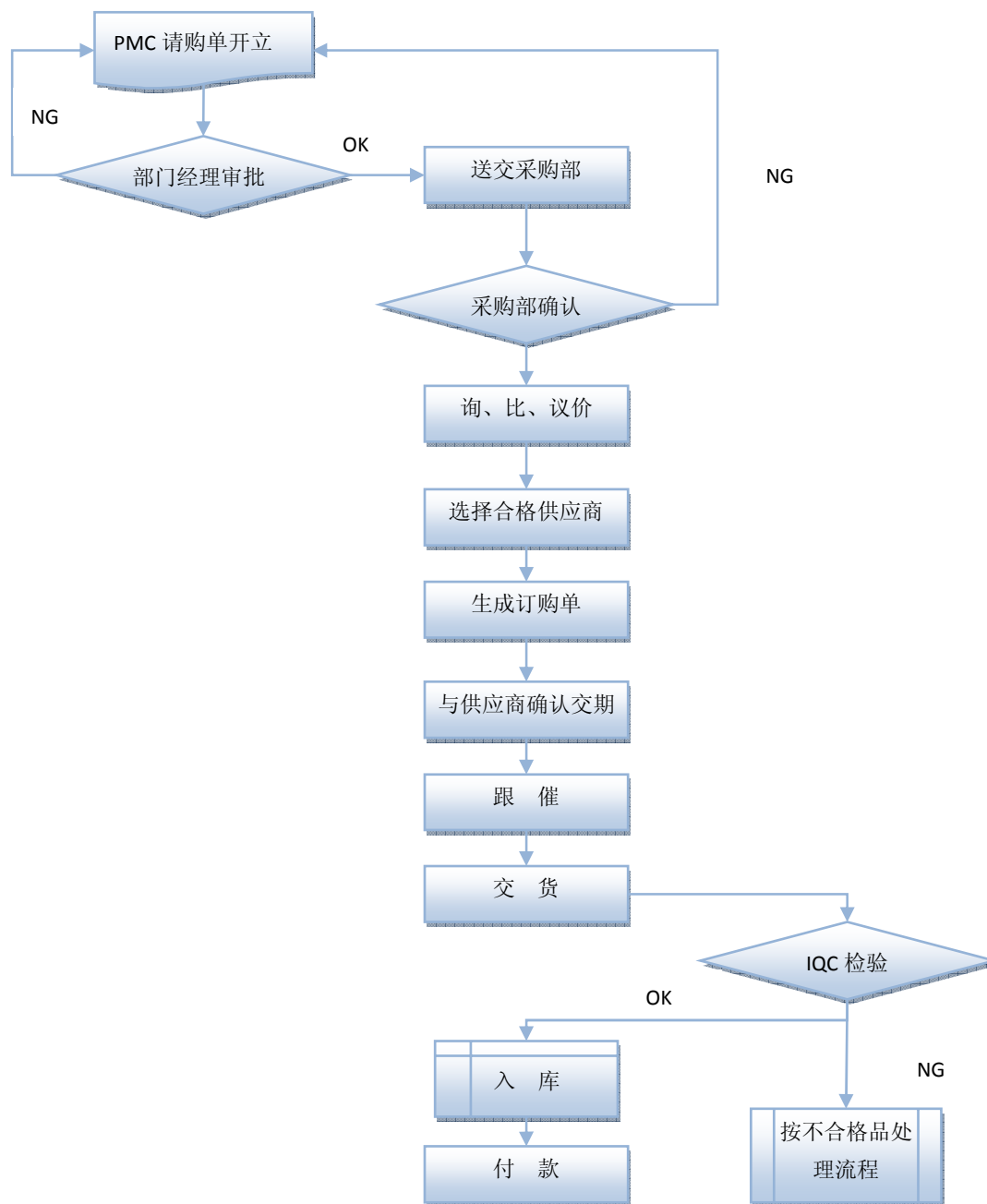
1、采购模式

公司下设采购部，负责采购的实施和管理，根据公司 PMC 部门下发的请购单进行采购。

公司在采购方面，严格遵循“同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务”的三比采购法原则。在供应商选择方面，公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审，通过评审的供应商才能成为合格供应商，公司所有材料采购只能向合格供应商采购。

对于电器、机械关键部品，主要采用国际知名品牌的产品，与供应商建立长期合作关系，供货渠道来源有国内代理商、经销商、国际知名品牌供应商驻国内办事处等，不存在供货不稳定的问题。重要部品至少有两家合格供应商，通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品。

对于常规产品，在保证产品品质及交期的前提下，选择有价格优势的供应商。在采购交货管理方面，基本与生产计划衔接。公司采购流程如下图所示：



2、生产模式

公司按客户定单组织生产，建立了以销定产的生产模式。公司的产品属于专用设备类，产品种类、型号较多。在长期的生产实践中，公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式。公司下设 PMC 部全面负责协调管理生产系统的工作。

在具体的生产过程中，公司立足于自主生产，只有在产能不能满足订单需求时才进行部分外协生产。公司拥有钣金、机加、装配等完整的工序链，PMC 部

按销售部下发的订单指令组织安排钣金车间、机加工车间、装配车间进行生产，并和品管部共同配合，负责原材料入库、产品生产、产品测试、质量控制和产品发运的全过程。

结合多年的生产经验，公司摸索出了一套先进的生产工艺，形成了稳定的生产技术，公司完工产品一次检验合格率在 97% 以上，居行业领先水平。

3、营销模式

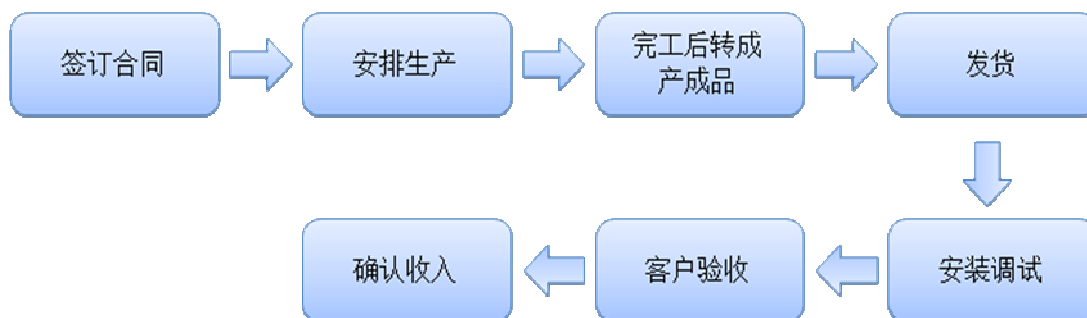
公司在国内的销售模式主要采用订单直销模式，由于公司所生产的电子整机装联设备及太阳能电池设备等属于制造业工作母机，专业性强，客户根据自身生产的需求，订单的获得方式主要为客户来公司进行洽谈订货或资深客户经理利用丰富的客户资源和信息主动与客户进行接洽。另外，公司还积极通过举办行业的技术及工艺交流会、产品推介会以及参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得订单。

目前公司营业网点覆盖全国主要电子制造企业所在地，公司在天津、大连、上海、苏州、杭州、重庆、成都、武汉、厦门等地长期有人员出差。

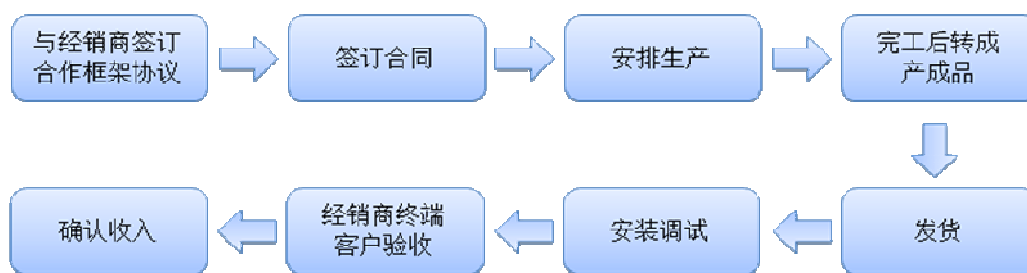
公司在国际市场上则主要采用经销商销售的模式，公司国外经销商遍布亚洲、欧洲、美洲等地区。在国际市场拓展方面，公司通过在国外参加展会、拜访优质经销商和客户、邀请经销商和客户代表及相关专家参观等方式，积极宣传、展示公司产品质量，树立品牌形象，使公司的出口业务不断发展提升。

① 直销和经销模式下的销售流程

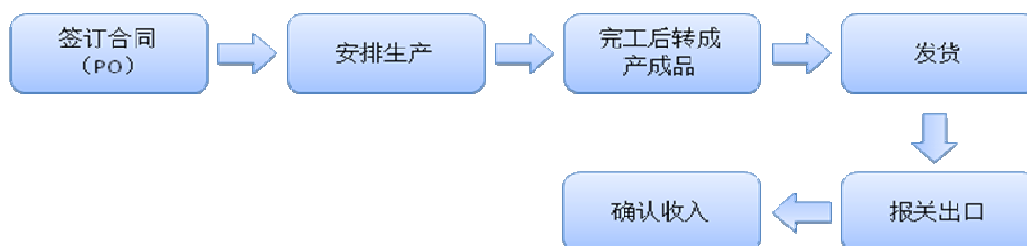
i、发行人内销直销模式下的销售流程如下：



ii、发行人内销经销模式下的销售流程如下：



iii 出口直销、经销模式下的销售流程如下：



② 各地区主要经销商情况

报告期内，除海外销售主要采用经销模式外，公司国内销售仍主要立足于直销的模式。目前公司在国内有两个经销商，分别为厦门市恒达裕商贸有限公司和东莞市金日机电设备有限公司；在海外有十一个经销商，主要分布在东南亚、北美、南美及欧洲等国家或地区。

③ 公司对经销商的选择及管理

公司对经销商的选择分为经销商的地域选择与资格选择。

经销商的地域选择原则是：该地区对公司产品有一定的需求而公司在该地区又没有直销点。尽管经过多年的发展，公司已建立了相对完善的销售体系和服务网点，但在海外及国内部分地区仍无法完全覆盖。基于上述地域选择原则，公司在海外主要采用经销商模式；而在国内对经销商的选择主要是公司服务网点无法覆盖的区域。

经销商的资格选择原则是：备选中的经销商需有公司产品所在行业销售的丰富经验或有销售公司某一特定产品的独特渠道，同时需信用良好及一定的资金实力。由于公司销售的设备为定制专用设备，根据最终用户的特点，在需求及配置方面存在一定差异，因此在经销商的选择上，要求无论是国内还是国外的经销商，都必须能够为客户提供必要的技术和咨询服务。

公司对经销商的管理主要体现在其是否按合同约定上及其开拓市场能力的考核上，包括按时付款率、年度销售目标完成率等方面。本公司销售的所有

产品在产品表面均印有公司的注册商标或标识，包括通过经销商销售的产品。经销商在收到本公司产品后，仍沿用本公司原产品包装，并不撤换包装。此外，经销商会不定期与最终用户来本公司进行质量审核，以使最终用户对本公司有更深刻了解。通过这些方式可以最大限度的保持本公司产品及品牌的独立性。

④ 经销商销售数量分配和销售价格确定机制

在销售的数量分配方面，一般根据行业发展情况、经销商所处地区的市场容量、上年度销售情况，综合制定各个经销商的数量分配政策。

在销售价格的确定方面，由于公司焊接设备一般为定制产品，设备配置分为标准模块与选配模块两大类，客户可以根据自身产品的生产技术要求来配置合适的焊接设备功能模块。因此公司产品定价一般采用成本加成法，同时结合自身的品牌、产品市场接受度及市场同类产品的售价综合制定。而销售给经销商的设备价格一般在公司制定的直销客户产品售价的基础上乘以一定的折扣系数确定，折扣系数一般依据经销商所在销售区域、新客户的开发情况及历史业绩综合确定。对于 AOI 产品，公司一般采用在双方协商一致的基础上于经销框架协议中直接约定产品结算价格的办法确定。同时公司在代理合同中约定，公司可以根据产品价格的变动情况调整给经销商的价格。

⑤ 各地区销售情况

报告期内各地区各类销售模式下销售金额与占主营业务收入的比例情况如下表所示：

2011 年各地区销售情况

单位：万元

地区	直销金额	经销金额	合计	经销占比
东北	343.28	-	343.28	-
华北	1,295.15	-	1295.15	-
华东	7,068.31	457.91	7,526.22	1.81%
华中	632.08	-	632.08	-
华南	13,118.53	78.63	13,197.16	0.31%
西北	73.97	-	73.97	-
西南	734.55	-	734.55	-
内销合计	23,265.87	536.54	23,802.41	2.12%
外销合计	306.04	1,185.95	1,491.99	4.69%
主营合计	23,571.91	1,722.49	25,294.40	6.81%

2010 年各地区销售情况

单位：万元

地区	直销金额	经销金额	合计	经销占比
东北	252.21	-	252.21	-
华北	348.33	-	348.33	-
华东	4,702.13	157.78	4,859.91	0.76%
华中	210.77	-	210.77	-
华南	12,554.27	172.51	12,726.78	0.83%
西北	-	-	-	-
西南	304.89	-	304.89	-
内销合计	18,372.60	330.29	18,702.89	1.59%
外销合计	982.25	1,204.80	2,187.05	5.77%
主营合计	19,354.85	1,535.09	20,889.94	7.35%

2009 年各地区销售情况

单位：万元

地区	直销金额	经销金额	合计	经销占比
东北	82.56	-	82.56	-
华北	289.76	-	289.76	-
华东	1,891.89	274.03	2,165.92	2.99%
华中	44.87	-	44.87	-
华南	5,291.80	-	5,291.80	-
西北	19.23	-	19.23	-
西南	144.27	-	144.27	-
内销合计	7,764.38	274.03	8,038.41	2.99%
外销合计	508.37	625.18	1,133.55	6.82%
主营合计	8,272.75	899.21	9,171.96	9.80%

公司与经销商之间不存在关联关系，最近三年，公司对所有经销商（国内和国外）的销售收入分别为 899.21 万元、1,535.09 万元和 1,722.49 万元，占公司当期主营业务收入的比重分别 9.80%、7.35%和 6.81%，由于公司通过经销商实现的销售占公司全部销售收入的比重都在 10% 以下，报告期内单个经销商销售收入占公司全部销售收入的比重最高不超过 4%。因此公司不存在对经销商的重大依赖情况。

（四）主要产品的生产和销售情况

1、公司产能、产量和销售情况

2011 年产销情况

单位：台

产品名称	产能	产量	销量	订单量	销量/产量	订单量/产量
焊接设备	1280	1268	1390	1233	109.62%	97.08%
AOI	255	243	240	259	98.77%	106.58%
高温烧结炉	20	7	3	4	42.86%	57.14%

注：公司产品实行以销定产的生产模式，产品经过客户验收合格后确认收入，因此产销比率较低是由于发货与验收之间的时间差异所致。若以订单量为统计口径，公司主要产品供求基本平衡。

2010 年产销情况

单位：台

产品名称	产能	产量	销量	订单量	销量/产量	订单量/产量
焊接设备	1250	1361	1137	1374	83.54%	100.96%
AOI	250	325	211	290	64.92%	89.23%
高温烧结炉	5	5	1	1	20.00%	20.00%

2009 年产销情况

单位：台

产品名称	产能	产量	销量	订单量	销量/产量	订单量/产量
焊接设备	750	630	504	665	80.00%	105.56%
AOI	60	90	27	54	30.00%	60.00%

最近三年发行人主要产品的产量和销售随着发行人经营规模的扩大持续增长，2008 年由于受金融危机的影响，产量和销售处于最低谷，2009 年下半年以来，全球电子制造业快速复苏，发行人主要产品的产量和销售也随之大幅度增长。由于发行人采用的是以销定产的生产模式，按照订单安排生产，基本不存在积压库存，最近三年按照订单量统计口径，发行人主要产品基本保持供求平衡。2009 年 AOI 检测设备出货量较低，主要是因为发行人 2009 年下半年才通过兼并收购开始研发生产 AOI 检测设备，销售规模尚小，而且公司为加大 AOI 检测设备的市场推广力度做了部分库存储备，从而导致产销率等指标相对较低。

2、公司主要产品销售价格的变动情况

单位：万元

年份	焊接设备	AOI
2011年	15.53	10.94
2010年	15.85	9.76
2009年	16.34	9.94

注：以上产品价格不含税

3、公司前五名客户销售情况

单位：万元

年份	客户名称	销售额	占总销售额的比例
2011年	杰特环球私人有限公司	754.45	2.84%
	东莞技研新阳电子有限公司	559.72	2.11%
	天津钜宝电子有限公司	519.66	1.96%
	厦门恒达裕商贸有限公司	458.6	1.73%
	深圳市普联技术有限公司	459.14	1.73%
	合计	2751.57	10.36%
2010年	杰特环球私人有限公司	772.43	3.53%
	四海电子（昆山）有限公司	603.27	2.76%
	深圳市普联技术有限公司	502.09	2.29%
	伟创力制造（珠海）有限公司	475.13	2.17%
	东莞高效电子有限公司	446.96	2.04%
	合计	2,799.87	12.79%
2009年	厦门恒达裕商贸有限公司	277.93	2.88%
	杰特环球私人有限公司	269.94	2.80%
	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	225.91	2.34%
	惠州市西文思电子科技股份有限公司	180.88	1.87%
	惠州大亚湾光弘科技电子有限公司	171.78	1.78%
	合计	1,126.44	11.67%

从上表可以看出，报告期内，发行人的客户比较分散，报告期内向前五大客户的销售额占全部销售收入的比重分别为 11.67%、12.79%和 10.36%，不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%或严重依赖于少数客户的情况。

发行人及发行人董事、监事、高级管理人员、核心人员、主要关联方及持有本公司 5%以上股份的股东未在发行人前五名客户中占有任何权益。

（五）主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、主要原材料和能源供应情况和价格变动趋势

公司采购的原材料主要有两大类：一类是冷、热轧板、钛板、不锈钢板、合金铝板等金属压延加工产品，另一类是温控模块、马达、链条等通用设备产品，报告期内主要原材料的价格变动情况如下表：

序号	原材料名称	价格变动情况		
		2011年	2010年	2009年
1	冷板	5.16	5.19	4.34
2	不锈钢板	11.03	11.23	10.25
3	铝材	22.87	21.37	21.99
4	钢材	7.17	7.07	7.67
5	钛材	145.76	122.18	114.93
6	镀锌花板	6.47	6.08	5.97
7	铜材	43.10	40.23	37.38
8	自动控制件	72.14	67.73	72.9
9	传动外购件	47.99	44.69	52.54
10	PLC 及温控模块	869.22	789.63	883.1
11	变频器	782.85	785.02	777.71
12	电箱配件	1.47	1.16	1.19
13	开关类	47.57	42.22	46.71
14	电脑、工控机	2,112.04	1,877.64	1,778.47
15	KIC 测温、超声波及氧气分析仪	15,055.81	15,328.70	15,948.79
16	显示器、触摸屏	924.93	891.86	907.95
17	XY-Table	17,521.47	16,152.23	15,253.72
18	基座及外壳	-	7,306.49	7,642.45
19	相机	7,137.21	7,062.74	5,975.61
20	光源	5,425.16	5,553.11	6,038.37

注：表中各类金属材料单价位均为元/公斤，各类非金属材料单价均为元/个

2、主要原材料占直接材料成本比重及能源耗用情况

序号	主要原材料名称	2011年		2010年		2009年	
		金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
1	冷板	882.97	7.10	894.99	6.49	360.96	5.72
2	不锈钢板	605.42	4.87	697.10	5.06	299.29	4.75
3	铝材	633.89	5.10	680.00	4.93	377.28	5.98
4	钢材	644.93	5.19	612.13	4.44	294.86	4.67

5	钛材	346.91	2.79	323.32	2.35	198.01	3.14
6	镀锌花板	218.88	1.76	173.09	1.26	73.41	1.16
7	铜材	54.93	0.44	66.39	0.48	38.21	0.61
8	自动控制件	1131.4	9.10	1,262.24	9.16	676.33	10.72
9	传动外购件	852.27	6.85	907.25	6.58	411.68	6.53
10	PLC 及温控模块	732.69	5.89	885.50	6.43	354.18	5.62
11	变频器	361.41	2.91	413.19	3.00	212.77	3.37
12	电箱配件	372.23	2.99	395.36	2.87	181.48	2.88
13	开关类	377.3	3.03	350.19	2.54	197.74	3.14
14	电脑、工控机	301.02	2.42	347.72	2.52	153.37	2.43
15	KIC 测温、超声波及氧气分析仪	179.06	1.44	230.80	1.67	52.67	0.84
16	显示器、触摸屏	148.39	1.19	202.74	1.47	81.07	1.29
17	XY-Table	5.81	0.05	340.81	2.47	169.32	2.68
18	基座及外壳	-	-	78.18	0.57	42.80	0.68
19	相机	200.3	1.61	191.40	1.39	97.40	1.54
20	光源	113.62	0.91	193.25	1.40	50.12	0.79
	合计	8,163.43	65.66	9,245.66	67.09	4,322.93	68.54

公司生产经营用电、水等能源数量不大，由当地供电、供水部门供应，价格比较稳定。

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	均价 (元)	金额 (万元)	均价 (元)	金额 (万元)	均价 (元)
水费	5.76	2.17	5.33	2.17	2.76	2.17
电费	158.41	0.76	136.09	0.74	91.47	0.80

3、公司前十名供应商采购情况

单位：万元

年份	客户名称	采购内容	采购额 (万元)	占总采购额 的比例
2011 年	上海硅力电子科技有限公司	高温马达	423.73	3.29%
	深圳市伟凯达电气设备有限公司	变频器	421.66	3.27%
	深圳市佳平钛业有限公司	钛材	405.69	3.15%
	大连理工计算机控制工程有限公司	模块	384.38	2.98%

	深圳市利友贸易有限公司	冷板	361.05	2.80%
	超汇链条（深圳）有限公司	链条	327.24	2.54%
	佛山市顺德区舜成贸易有限公司	冷板	297.16	2.31%
	深圳市华安精工五金模具有限公司	银钢枝、爪	289.04	2.24%
	东莞市科大贸易有限公司	冷板	285.13	2.21%
	深圳市锦发铜铝有限公司	合金铝板	262.46	2.04%
	合计		3,457.54	26.83%
2010年	大连理工计算机控制工程有限公司	模块	588.31	4.27%
	上海硅力电子科技有限公司	高温马达	519.32	3.77%
	东莞市科大贸易有限公司	冷板	460.26	3.34%
	深圳市伟凯达电气设备有限公司	变频器	428.66	3.11%
	深圳市佳平钛业有限公司	钛材	424.73	3.08%
	超汇链条（深圳）有限公司	链条	414.37	3.01%
	深圳市华安精工五金模具有限公司	银钢枝、爪	388.68	2.82%
	深圳市百川滚珠丝杆有限公司	工作平台	338.62	2.46%
	深圳市锦发铜铝有限公司	合金铝板	323.99	2.35%
	佛山市鸿远祥不锈钢有限公司	不锈钢板	269.01	1.95%
		合计		4,155.95
2009年	大连理工计算机控制工程有限公司	模块	325.56	5.16%
	上海硅力电子科技有限公司	高温马达	207.72	3.29%
	佛山市鸿远祥不锈钢有限公司	不锈钢板	206.83	3.28%
	佛山市顺德区舜成贸易有限公司	冷板	196.11	3.11%
	深圳市百川滚珠丝杆有限公司	平台	163.15	2.59%
	超汇链条（深圳）有限公司	链条	161	2.55%
	深圳市鼎阳机电设备有限公司	继电器、开关	153.25	2.43%
	深圳市佳平钛业有限公司	钛材	150.23	2.38%
	深圳市新动源电机有限公司	牙箱	147.69	2.34%
	深圳市力豪电脑有限公司	电脑	146.32	2.32%
		合计		1,857.86

本公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。报告期内公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有本公司 5%以上的股东在上述供应商或客户中占有权益的情形。根据发行人及实际控制人、供应商出具的无关联声明函及工商登记公开信息的核查，发行人及实际控制人、董事、监事和高级管理人员与报告期内前十大供应商及其实际控制人之间不存在关联关系。

（六）主要产品的质量控制情况

1、质量控制标准

公司根据产品的生产和服务方式，参照国际先进水平，在采购、生产、销售

等各环节上制定了一系列的企业质量控制制度、工作流程和操作规程，并通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，领取了《质量管理体系认证证书》，证书注册编号为 SGS: HK07/01401，有效期至 2013 年 6 月 26 日。

公司本着“品质至上，积极领先，持续改善，客户满意”的为总方针，为每个部门制定有具体可量化的年度质量目标。公司，追求产品零缺陷，秉持实现以客户至上、持续改进的理念为尊，获取客户高度满意和追求产品零缺陷持续改进的承诺。

2、质量控制措施

（1）质量控制过程

公司根据 ISO9001:2008《质量管理体系——要求》，从资源管理、产品实现、检测和监控等方面制定了严格的质量控制总纲、程序执行过程和操作规程等多个层次的文件。

在资源管理方面，公司根据实际业务运作需要确定所必需的资源，如人力资源、信息、设备、工作环境等，以保证质量体系得以建立、保持和改进。

在产品实现方面，公司对客户需求的识别、产品设计和开发、供应商选择、采购程序、生产和服务运作等过程分别制定了控制要求，同时制定了合同评审及客户投诉处理程序、顾客满意测量分析和改进程序、生产运作及产品测量控制程序、供应商控制程序、采购及进货控制程序、仓库收发控制程序等一系列程序文件来指导控制的过程和标准，以达到控制要求。

在检测和监控方面，公司对所有在用的检验和检测设备进行控制、校准和维护，以保证其检测产品时所需的测试精度。该项工作包括检验和检测设备的验收、入库、建账、检定、标示、贮存、维修和报废等。

（2）质量控制反馈

公司每年至少进行一次质量管理评审。质量评审对管理体系、业务运作、产品质量、顾客满意度等各方面进行规定、策划、测量、监视、分析，并对质量控制审核结果、客户反馈意见、预防和纠正措施的实施状况、以往管理评审的跟踪措施等进行综合评审，并依据评审结果，公司对质量控制体系及其程序、产品和服务的质量控制目标等进行改进。

3、质量纠纷情况

公司一直以来严格执行国家有关质量、计量法律法规，产品符合国家有关产品质量和技术监督的要求，没有受到任何质量、计量方面的行政处罚。截至本招股说明书签署之日，公司未发生因产品质量问题而导致的纠纷。

2012年1月9日，深圳市市场监督管理局出具了证明（深市监信证[2012]14号），证明公司报告期内不存在违反市场监督管理有关法律法规的记录。

（七）安全生产和环境保护情况

1、公司安全生产情况

在安全生产方面，本公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规执行。

搞好安全生产是公司的重要职责，为了保证生产人员在生产过程中的安全和健康，公司本着“安全第一、预防为主”、“全程控制、持续发展”的管理理念，对操作人员进行教育和培训，做到各尽其责，各负其责，以防止和减少安全事故的发生。

公司合理地制定安全生产管理制度，并有效地贯彻执行各项规章制度。在做好安全宣传（如宣传标语、安全挂图）的同时，坚持定期和不定期的安全检查，维修保养好各种设备和消防器材，对不符合标准的设备和消防器材，下达整改通知书及时进行整改，从而保持良好的安全环境。

公司目前安全方面运作良好，至今无重大生产安全事故记录。

深圳市宝安区安全生产监督管理局于2012年1月10日出具了报告期内公司安全生产方面无违法违规情况的证明。

2、公司环境保护情况

公司主要生产波峰焊、回流焊、AOI检测设备等产品，不存在高危险、重污染的情况。本公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规，重视环保的投入，报告期内没有发生污染事故，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。现阶段生产中的主要污染物排放均达到国家规定的排放标准。

深圳市人居环境委员会于2012年1月10日出具了证明（深人环法证字[2012]第12号），证明公司报告期内未发生环境污染事故和环境违法行为，现阶段未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保要求。

六、发行人的主要固定资产及无形资产

（一）固定资产

1、固定资产基本情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下表所示：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	3,687.53	467.09	3,220.44	87.33%
机械设备	1,557.25	422.88	1,134.37	72.84%
运输设备	614.13	224.26	389.87	63.48%
电子及其他设备	1,281.49	410.68	870.81	67.95%
总计	7,140.40	1,524.91	5,615.49	78.64%

2、主要生产设备

截至 2011 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	账面价值 (万元)	净值 (万元)	成新率	剩余折旧时间 (月)
1	数控转塔冲床	153.85	135.58	88.12%	105
2	激光切割机	148.63	102.74	69.12%	81
3	数控转塔冲床	109.41	76.17	69.62%	81
4	强动力设备	93.50	57.97	62%	72
5	数控折弯机	70.09	57.32	81.78%	97
6	网络数控折弯机	53.96	37.30	69.13%	81
7	数控冲床	50.51	34.52	68.34%	80
8	立式加工中心	42.96	29.70	69.13%	81
9	立式加工中心	36.75	34.13	92.87%	111
10	数控钻床	35.47	29.01	81.79%	97
11	立式加工中心	35.05	24.23	69.13%	81
12	液压式折弯机	35.00	13.11	37.46%	41
13	磨床	33.33	26.47	79.42%	94
14	立式加工中心	29.92	20.68	69.12%	81
15	涂装设备	28.00	17.36	62%	72
16	液压式折弯机	26.18	17.89	68.33%	80
17	立式加工中心	26.04	18.00	69.12%	81
18	数控铣床	25.21	21.22	84.17%	100
19	立式加工中心	23.93	21.28	88.93%	106
20	立式加工中心	22.91	21.09	92.06%	110
21	立式加工中心	22.91	21.27	92.84%	111

22	立式加工中心	22.91	22.91	100%	120
23	立式加工中心	22.91	21.27	92.84%	111
24	数控车床	15.30	14.69	96.01%	115
25	铣床	16.24	12.90	79.43%	94
合计		1,180.97	888.81	-	-

3、自有房产情况

截至本招股说明书签署之日，本公司拥有自有产权房屋一处，建筑面积总计 21,063.68 平方米。自有产权房屋情况见下表：

序号	房屋位置	房产证号	建筑面积 (m ²)	用途	他项权利
1	宝安区西乡街道鹤洲工业区	深房地字第 5000469662 号	21,063.68	厂房、宿舍、食堂等	抵押

2010 年 12 月 13 日，发行人与招商银行股份有限公司深圳宝安支行（授信人）签订了《授信协议》（合同编号：2010 年宝字第 0010408337 号），授信人为发行人提供了人民币 5,000 万元的授信额度，授信期间为 2 年，即从 2010 年 12 月 17 日起到 2012 年 12 月 17 日止。同日，发行人与授信人签订了《最高额抵押合同》（合同编号：2010 年宝字第 0010408337 号），发行人同意将其持有的房地产（深房地字第 5000469662 号《房地产证》）作为抵押担保，抵押期间从合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满之日。

4、主要租赁房产情况

由于近两年公司产品线的不断丰富及产能规模的扩大，原有劲拓工业园已不能提供足够多的场地供公司用于研发及生产，鉴于此，2010 年 12 月 24 日，劲拓股份与深圳市天富安物业管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，承租天富安物业位于深圳宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角旧村合海工业园二栋一楼厂房及配套宿舍，厂房面积 2,450m²，期限为三年，该厂房主要用于公司的研发实验室。该房产因历史遗留问题，尚未办理报建手续而未取得产权证书，存在被拆迁的风险，但该产权瑕疵不会对公司生产经营产生重大影响，具体情况如下：

① 该租赁的厂房主要用于公司研发实验，厂房主要用于放置试验设备、样机及部分研发人员办公，对厂房无特殊要求，易找到可替代场地。截止本反馈答复日，该研发实验室内部已基本装修完毕。

② 天富安物业于 2011 年 3 月 12 日向公司出具声明“如该房产因被政府拆迁或声明人单方原因，无法履行合同，将提前通知深圳市劲拓自动化设备股份有限公司，并给予合理的搬迁时间，承担因其搬迁而受到的损失”。

③ 深圳市宝安区西乡街道办事处已经出具证明，确认该房产在 2013 年 12 月 31 日前没有被列入拆迁范围，不存在被强制拆迁的情形。

（二）无形资产

1、商标

（1）截至本招股说明书签署发行人持有国家商标局核发的如下注册商标：

序号	商标名称	类别	注册号	有效期限	取得方式
1	劲拓	第 35 类	3192675	2003/12/28-2013/12/27	转让取得
2	劲拓	第 7 类	3192676	2004/01/07-2014/01/06	转让取得
3		第 7 类	3211319	2004/01/28-2014/01/27	转让取得
4	劲拓	第 9 类	4202636	2006/11/28-2016/11/27	转让取得
5	劲拓	第 7 类	4202637	2006/11/28-2016/11/27	转让取得
6	劲拓	第 40 类	4202653	2007/11/28-2017/11/27	转让取得
7	劲拓	第 37 类	4202654	2007/11/28-2017/11/27	转让取得
8	劲拓	第 11 类	4202655	2006/11/28-2016/11/27	转让取得
9	劲拓	第 42 类	4369676	2008/09/21-2018/09/20	转让取得
10		第 42 类	4236783	2008/02/07-2018/02/06	申请取得
11	深圳市劲拓自动化设备有限公司	第 42 类	4236784	2008/01/28-2018/01/27	申请取得
12		第 42 类	4280568	2008/03/14-2018/03/13	申请取得
13	雪山	第 7 类	4330097	2007/05/14-2017/05/13	申请取得
14		第 37 类	4369670	2008/09/21-2018/09/20	申请取得
15		第 11 类	4369671	2007/06/07-2017/06/06	申请取得
16		第 7 类	4369673	2007/07/14-2017/07/13	申请取得


17		第 9 类	4369674	2007/08/07-2017/08/06	申请取得
18		第 40 类	4369675	2008/05/14-2018/05/13	申请取得
19	劲拓	第 1 类	4740611	2008/11/21-2018/11/20	申请取得
20		第 6 类	4740612	2008/05/28-2018/05/27	申请取得
21		第 1 类	4740629	2008/11/21-2018/11/20	申请取得
22	劲拓	第 6 类	4740630	2008/05/14-2018/05/13	申请取得
23	WINNING	第 7 类	6254450	2010/02/07-2020/02/06	转让取得
24	劲拓	第 36 类	7452918	2010/10/28-2020/10/27	申请取得
25		第 6 类	7750479	2010/12/14-2020/12/13	申请取得
26		第 7 类	7457326	2011/01/14-2021/01/13	申请取得
27		第 9 类	7457336	2011/01/21-2021/01/20	申请取得
28		第 1 类	7750465	2011/03/14-2021/03/13	申请取得
29		第 7 类	7750491	2011/04/14-2021/04/13	申请取得
30		第 11 类	7750526	2011/04/28-2021/04/27	申请取得
31		第 37 类	7750547	2011/02/07-2021/02/06	申请取得
32		第 40 类	7750564	2011/02/07-2021/02/06	申请取得
33	劲拓	第 9 类	8186767	2011/04/14-2021/04/13	申请取得
34		第 9 类	8186770	2011/04/14-2021/04/13	申请取得
35		第 42 类	7750587	2011/09/07-2021/09/06	申请取得
36		第 9 类	8186768	2011/06/21-2021/06/20	申请取得
37		第 1 类	8449075	2011/07/14-2021/07/13	申请取得
38		第 9 类	8449127	2011/08/28-2021/08/27	申请取得

39		第 11 类	8449144	2011/07/21-2021/07/20	申请取得
40		第 9 类	8451038	2011/07/21-2021/07/20	申请取得
41		第 40 类	8452110	2011/08/07-2021/08/06	申请取得
42		第 9 类	8509652	2011/08/07-2021/08/06	申请取得
43		第 7 类	8509653	2011/08/07-2021/08/06	申请取得

注：上述第 1 至 9 项商标系从劲拓实业受让而来，第 23 项商标系从运英软件受让而来。

（2）发行人境外取得的注册商标

根据发行人提供的商标注册文件，并向发行人及其聘请的知识产品代理机构核查，发行人境外取得的注册商标如下：

序号	商标名称	注册号	注册类别	国别（地区）	有效期至
1	 劲拓	T0906867B	7	新加坡	2019-06-24

（3）发行人商标变更情况

截至招股说明书签署日，发行人持有的国家商标局核发的 43 项商标和境外注册的 1 项商标均已变更至股份公司名下。

2、专利技术与非专利技术

（1）本公司目前拥有的专利情况

截至本招股说明书签署日，公司已拥有 33 项实用新型专利和 5 项外观设计，具体情况如下表所示：

序号	专利类型	名称	专利号	申请日	取得方式
1	外观设计	波峰焊机	ZL02332933.5	2002/08/02	转让取得
2	实用新型	防氧化套	ZL02244386.X	2002/08/08	转让取得
3	实用新型	一种改进的泵送无铅钎料的液态金属电磁泵	ZL02289236.2	2002/11/22	转让取得
4	实用新型	波峰焊机喷嘴	ZL03240152.3	2003/03/06	转让取得
5	实用新型	线路板夹持输送结构	ZL03209433.7	2003/09/11	转让取得
6	外观设计	波峰焊机	ZL03358782.5	2003/09/15	转让取得
7	实用新型	线路板夹持输送结构的导电报警装置	ZL03282518.8	2003/09/19	转让取得
8	实用新型	电磁推进式波峰焊接锡炉	ZL200520019014.4	2005/05/17	申请取得

9	外观设计	回流焊机	ZL200630002118.4	2006/02/22	申请取得
10	实用新型	热风循环加热装置	ZL200620123303.3	2006/08/01	申请取得
11	实用新型	爪钩式印刷电路板输送装置	ZL200720150390.6	2007/06/28	申请取得
12	实用新型	一种控制器支撑台旋转转轴	ZL200920001243.1	2009/01/16	申请取得
13	实用新型	一种回流焊机抽风装置	ZL200920001242.7	2009/01/16	申请取得
14	实用新型	回流焊机运输导轨平行度检测装置	ZL200920006433.2	2009/03/03	申请取得
15	实用新型	一种工业相机调整架	ZL200920135394.6	2009/03/10	转让取得
16	实用新型	一种 PCB 板夹持装置	ZL200920135393.1	2009/03/10	转让取得
17	外观设计	焊锡光学检测机	ZL200930163988.3	2009/03/13	转让取得
18	实用新型	一种 PCB 线路板波峰焊调整装置	ZL200920151477.4	2009/04/24	申请取得
19	实用新型	波峰焊机的焊锡炉炉体及焊锡炉	ZL200920150984.6	2009/06/05	申请取得
20	实用新型	波峰焊机焊锡炉密封装置	ZL200920160758.6	2009/06/25	申请取得
21	实用新型	波峰焊机点焊加锡装置	ZL200920160760.3	2009/06/25	申请取得
22	实用新型	波峰焊机焊锡炉	ZL200920160759.0	2009/06/25	申请取得
23	实用新型	波峰焊机自动加锡装置	ZL200920160757.1	2009/06/25	申请取得
24	实用新型	点焊焊锡炉氮气加热保护装置	ZL200920160756.7	2009/06/25	申请取得
25	实用新型	具有旋转功能的锡炉导出架	ZL200920156838.4	2009/06/26	申请取得
26	实用新型	喷嘴高度调节模板	ZL200920156840.1	2009/06/26	申请取得
27	实用新型	具有隔热保护的锡炉波峰电机皮带传送装置	ZL200920156839.9	2009/06/26	申请取得
28	实用新型	一种波峰焊料回流装置	ZL200920218411.2	2009/10/10	申请取得
29	实用新型	一种选择性波峰焊的推板装置	ZL201020181508.3	2010/04/29	申请取得
30	实用新型	回流焊的发热丝固定结构及回流焊设备	ZL201020626977.1	2010/11/26	申请取得
31	实用新型	回流焊的入口进板防呆装置	ZL201020626992.6	2010/11/26	申请取得
32	实用新型	一种过滤器结构	ZL201020626993.0	2010/11/26	申请取得
33	实用新型	回流焊的助焊剂回收箱结构	ZL201020627046.3	2010/11/26	申请取得
34	实用新型	回流焊的热风马达密封结构	ZL201020627050.X	2010/11/26	申请取得
35	实用新型	用于回流焊的助焊剂回收装置及回流焊机	ZL201020627062.2	2010/11/26	申请取得

36	实用新型	用于回流焊的双导轨传输结构及双导轨式回流焊机	ZL201020627898.2	2010/11/26	申请取得
37	实用新型	一种新型回流焊机	ZL201020631079.5	2010/11/26	申请取得
38	外观设计	回流焊机	ZL201030620166.6	2010/11/16	申请取得

注：上述第 1 至 7 项专利系从劲拓实业受让而来，第 15 至 17 项专利系从运英软件受让而来。

公司已获得 2 项国际专利，具体情况如下表所示：

序号	名称	优先权日	有效期至	专利公开号	备注
1	电磁推进式波峰焊接锡炉	2005-5-17	2025/08/16	EP1724047	授权欧洲专利在德国生效
2	电磁推进式波峰焊接锡炉	2005-5-17	2015/08/24	1744	墨西哥

注：在墨西哥授权的专利目前正办理权利人更名手续，权利人由有限公司变更为股份公司。

公司已申请并由国家知识产权局受理的专利具体如下表所示：

序号	类型	名称	申请日	申请号	受理状态
1	发明	回流焊的发热丝固定结构及回流焊设备	2010/11/26	201010560982.1	申请受理
2	发明	用于回流焊的双导轨传输结构及双导轨式回流焊机	2010/11/26	201010560971.3	申请受理
3	发明	一种回流焊炉内存板指示方法及装置	2011/08/17	201110236338.3	申请受理
4	发明	一种宽度调节装置及表面贴装周边设备	2011/08/31	201110254603.0	申请受理
5	发明	一种表面贴装设备	2011/08/31	201110254626.1	申请受理
6	实用新型	一种回流焊炉内存板指示器	2011/08/17	201120299534.0	申请受理
7	实用新型	一种宽度调节装置及表面贴装周边设备	2011/08/31	201120323420.5	申请受理
8	实用新型	一种表面贴装设备	2011/08/31	201120323575.9	申请受理
9	实用新型	网带结构和由其构成的太阳能电池片生产设备	2011/09/02	201120327951.1	申请受理
10	实用新型	内循环冷却装置和内循环热交换系统	2011/09/02	201120327954.5	申请受理
11	实用新型	具有高温热补偿的加热装置和隧道炉	2011/09/14	201120343372.6	申请受理
12	实用新型	一种气冷式红外发热装置和加热设备	2011/09/14	201120343375.X	申请受理

13	实用新型	转角机及其构成的接驳装置	2011/04/29	201120133185.5	申请受理
14	实用新型	一种印刷电路板的夹板装置	2011/07/11	201120242762.4	申请受理
15	实用新型	一种印刷电路板的夹板装置	2011/07/11	201120242761.x	申请受理
16	外观设计	烘干烧结一体炉（FF-600）	2011/08/05	201130259959.4	申请受理
17	外观设计	红外链式烘干炉(DA-700)	2011/08/05	201130259961.1	申请受理
18	实用新型	一种选择性波峰焊的平台运动装置	2011/07/11	201120242744.6	申请受理
19	实用新型	一种选择性喷雾机的平台装置	2011/07/11	201120242910.2	申请受理
20	实用新型	一种接驳机构	2011/08/17	201120299633.9	申请受理
21	实用新型	一种冷水机通风结构	2011/08/17	201120299636.2	申请受理
22	实用新型	一种加油系统	2011/08/17	201120299639.6	申请受理

注：第 13 至 22 项专利中华人民共和国国家知识产权局已授予专利权通知书，但尚未取得专利证书。

（2）发行人专利变更情况

截至招股说明书签署日，发行人除一项国外专利正在办理变更股份公司的手续外，其余专利均已全部变更至股份公司名下。

（3）本公司拥有的非专利技术

本公司拥有的非专利技术主要包括以下 17 项，具体情况如下：

序号	技术名称	序号	技术名称
1	高效热传导技术	10	等离子控制技术
2	高纯度动态气氛控制技术	11	真空技术
3	液态金属的泵送技术	12	高速高精 X-Y 工作平台的设计与制造技术
4	金属流体控制技术	13	高亮度 LED 光源的精确控制技术
5	粘性半流体控制技术	14	矢量图像识别原创核心技术
6	视觉扫描无缝拼接技术	15	多路多通道工业实时控制技术
7	视觉快速定位技术	16	智能一维二维码识别技术
8	微隙间距局部焊接技术	17	高亮度 LED 对于 SMT 板的照明技术

9	高温快速热处理技术		
---	-----------	--	--

3、软件著作权

公司已申请软件著作权登记 15 项，并获得软件著作权登记证书。

序号	名称	证书号	首次发表日期	登记号
1	NS 系列回流焊控制软件【简称：NS Series 操作系统】V2.15	软著登字第 0240805 号	2007/01/31	2010SR052532
2	NSM 系列波峰焊控制软件【简称：NSM 系列操作系统】V1.37	软著登字第 0240866 号	2007/02/01	2010SR052593
3	KK 系列波峰焊控制软件【简称：KK Series】V1.08	软著登字第 0240807 号	2007/10/10	2010SR052534
4	VS 系列回流焊控制软件【简称：VS Series 操作系统】V2.15	软著登字第 0240865 号	2008/01/10	2010SR052592
5	MS 系列波峰焊控制软件【简称：MS 系列操作系统】V2.12	软著登字第 0240698 号	2008/02/01	2010SR052425
6	劲拓 AOI 在线测试软件【简称：WIN-AOI-TEST】V1.0	软著登字第 0190942 号	2008/11/01	2010SR002669
7	劲拓 AOI 离线编程软件【简称：WIN-AOI-EDIT】V1.0	软著登字第 0190944 号	2008/11/01	2010SR002671
8	劲拓 AOI 错误查看软件【简称：WIN-AOI-LOGVIEW】V1.0	软著登字第 0190945 号	2008/11/01	2010SR002672
9	SAV 系列选择波峰焊控制软件【简称：Select Wave Solder Series】V1.00	软著登字第 0240733 号	2009/03/10	2010SR052460
10	ES 系列回流焊控制软件【简称：ES Series 操作系统】V1.02	软著登字第 0240806 号	2009/12/10	2010SR052533
11	R 系列回流焊控制软件 V1.00	软著登字第 0240206 号	2010/01/10	2010SR051933
12	CELL 系列选择波峰焊控制软件 V1.00	软著登字第 0242505 号	2010/03/01	2010SR054232
13	ADF-600 烧结炉控制软件【简称：ADF-600】V1.0.0.0	软著登字第 0275760 号	2010/06/28	2011SR012086
14	RS 系列回流焊控制软件【简称：RS Series】V1.00	软著登字第 0265181 号	2010/09/15	2011SR001507
15	AS 系列回流焊控制软件【简称：AS Series 操作系统】V1.00	软著登字第 0265192 号	2010/12/10	2011SR001518

注：第六至第八项软件著作权系从运英软件受让而来

2002 年 1 月 1 日起施行的《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止

于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

4、软件产品登记证书

发行人持有深圳市科技工贸和信息化委员会核发的如下软件产品登记证书：

序号	软件产品名称	证书编号	发证时间	有效期
1	劲拓 KK 系列波峰焊控制软件 V1.07	深 DGY-2010-0654	2010 年 5 月 20 日	五年
2	劲拓 NSM 系列波峰焊控制软件 V1.35	深 DGY-2010-0655	2010 年 5 月 20 日	五年
3	劲拓 VS 系列回流焊控制软件 V2.14	深 DGY-2010-0653	2010 年 5 月 20 日	五年
4	劲拓 NS 系列回流焊控制软件 V2.14	深 DGY-2010-0652	2010 年 5 月 20 日	五年
5	劲拓 MS 系列波峰焊控制软件 V2.10	深 DGY-2010-0651	2010 年 5 月 20 日	五年
6	劲拓 ES 系列回流焊控制软件 V1.00	深 DGY-2010-0656	2010 年 5 月 20 日	五年
7	劲拓 AOI 在线测试软件 V2.0	深 DGY-2010-0148	2010 年 6 月 29 日	五年
8	劲拓 AOI 离线编程软件 V2.0	深 DGY-2010-0147	2010 年 6 月 29 日	五年
9	劲拓 AOI 错误查看软件 V2.0	深 DGY-2010-0146	2010 年 6 月 29 日	五年
10	劲拓 SAV 系列选择波峰焊控制软件 V1.00	深 DGY-2010-1329	2010 年 8 月 30 日	五年
11	劲拓 CELL 系列选择波峰焊控制软件 V1.00	深 DGY-2010-1330	2010 年 8 月 30 日	五年
12	劲拓 R 系列回流焊控制软件 V1.00	深 DGY-2010-1331	2010 年 8 月 30 日	五年
13	劲拓 RS 系列回流焊控制软件 V1.00	深 DGY-2011-0072	2011 年 1 月 28 日	五年
14	劲拓 AS 系列回流焊控制软件 V1.00	深 DGY-2011-0064	2011 年 1 月 28 日	五年
15	劲拓 ADF-600 烧结炉控制软件 V1.0.0.0	深 DGY-2011-0495	2011 年 4 月 29 日	五年

5、土地使用权

序号	土地使用权证号	面积 (m ²)	取得方式	用途	终止日期	他项权利
1	深房地字第 5000469662 号	14,290.40	出让	工业用地	2054/1/18	抵押
2	惠湾国用 (2011) 第 13210100786 号	3,1948.00	出让	工业用地	2061/4/15	-

为了解决公司场地不足的问题，2011年3月14日，公司通过公开挂牌出让的方式竞拍取得位于广东省惠州市原西区第一工业园的土地使用权。该地块总面积为31,948平方米的土地使用权，使用年限为50年，土地使用权出让总地价款为8,945,440元，土地用途为工业用地。2011年11月22日，劲拓精密取得“惠湾国用（2011）第13210100786号”的国有土地使用证。

七、特许经营权

截至本招股说明书签署之日，公司未拥有特许经营权。

八、发行人生产研发和技术情况

（一）主要产品的核心技术情况

1、核心技术情况

公司核心技术的基本情况简要介绍如下：

序号	核心技术名称	简要介绍
1	高效热传导技术	应用在回流焊中的该技术，实现三维体系的温度均匀性，对扰动的快速恢复能力强，动态的快速稳定，传热快等目标。
2	高纯度动态气氛控制技术	该技术应用于回流焊产品中，设备内部设有高纯度动态气体的控制的装置，得到可控的高温高纯气体吹向已经贴好元件的线路板进行焊接。
3	液态金属的泵送技术	该技术应用在PCB钎焊接设备中，用来泵送无铅钎料的液态金属电磁泵，补偿了无铅钎料抗氧化能力弱和润湿性差等缺陷，提高了钎焊产品的可靠性和合格率。
4	金属流体控制技术	该技术应用于波峰焊系列产品中，通过电磁场作用，推动金属流体实现无摩擦无磨损工作模式的高效精确的驱动技术。
5	粘性半流体控制技术	该技术应用于选择焊系列产品中，通过对半流体物质的可控技术达到对焊接进行实时精确控制的目的。
6	视觉扫描无缝拼接技术	该技术应用于选择焊系列产品中，是通过工业相机对PCB板进行扫描，生成若干图像后经视觉算法计算无缝整图技术。
7	视觉快速定位技术	该技术应用于选择焊系列产品及AOI产品，通过工业相机采集Mark点图像，经视觉算法计算Mark点上的偏差，有效的补偿了工作环境对PCB板的影响，使定位更加精确。
8	微隙间距局部焊接技术	该技术应用于选择焊系列产品中，根据不同焊点设

		定所需的焊接参数，大大提高了焊点的可靠性，完全满足高品质线路板的焊接要求。
9	高温快速热处理技术	应用在高温烧结炉中的本技术特色主要体现为高温、高速、高精度、陡升、陡降的尖峰工艺曲线，能够保证此剧烈温度变化下的温度均匀性，从而实现高温条件下的高效热传递。与传统产品相比，能耗降低 30%。
10	等离子控制技术	应用在平板 PECVD 中的本技术无需采用其他间接式系统的外加磁场导向，而采用独特结构设计，将等离子体的发生范围控制在某一特定区域，该等离子体控制技术的使用，能够有效增加所沉积的膜层质量，提高电池片抗反射以及表面钝化能力，从而增加光电效率。
11	真空技术	应用平板式 PECVD 中的该技术，实现了真空条件下 SiNx 高效高质量的生成、沉积等一系列工艺过程。
12	高速高精 X-Y 工作平台的设计与制造技术	采用高精密的丝杠、导轨与高速电机，配合运动基座精密铸造及热处理，以及装配中的高技巧及耐心。可以批量稳定生产综合运动精度为 0.018mm，运动最高速度为 1200mm/秒的 X-Y 工作平台。
13	高亮度 LED 光源的精确控制技术	通过自主设计的彩色高亮度 LED 灯的筛查装置，保证 LED 光源灯性能的稳定；同时采用自主设计的高亮度 LED 光源和高精度大电流的智能恒流源控制电路，保证 LED 光源亮度的稳定与精准；另外，可以根据需要编程控制 LED 亮度。
14	矢量图像识别原创核心技术	分析 PCB 装配中，各种装配错误的特征，再依据 IPC 标准来精确量化各种情况下各种装配缺陷的特征，再规划出客户一定的客户化选择范围，使用一些快速的数学算法。此核心技术已成熟运用在上百台 AOI 检测设备上。
15	多路多通道工业实时控制技术	采用工业集散控制系统的软硬件控制方式。上位机是一台工业控制电脑，负责整套系统的协调与决策：控制协调电机驱动卡、光源的驱动及控制卡、CCD 等独立系统；收集多个外接感应传感器信号；进行图像采集，图像识别的运算及结果输出；控制 PCB 轨道与夹持机构作业；与网络中的其它电脑的网络信息交换等。下位机是独立的单片机控制系统，具体实现及驱动相应的执行机构，如工业实时运动规划及电机的驱动，光源恒流源的电流控制，照相机的内部控制系统等
16	智能一维二维码识别技术	使用普通相机，采集一维及二维码的照片，通过对图像识别以及图像无缝拼接。由电脑自动识别出对应的条码编码。采用此技术图像识别设备可以不需要专门的条码识别装置。由本来图像识别中的相机自动完成了一维及二维码的识别。此技术也可以广泛推广到很多的应用场合。
17	高亮度 LED 对于 SMT 板的	采用能耗低，光线强的 LED，根据元件的焊接锡

照明技术	面角度设计,能准确对元件的焊接锡面、PCB 上的焊盘、元件的本体、PCB 的材质以不同的颜色作正确区分。
------	--

2、核心技术产品收入占营业收入的比例

公司的焊接设备、AOI 检测设备等产品均拥有自主研发的核心技术，核心技术产品收入占营业收入的比例如下：

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	收入金额 (万元)	比例(%)	收入金额 (万元)	比例 (%)	收入金额 (万元)	比例 (%)
核心技术产品收入	24,497.75	92.25	20,150.49	92.15	8,506.11	88.17

3、公司主要产品的技术特点

产品名称	产品简介	技术创新点
波峰焊	波峰焊是指将熔化的软钎焊料，经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰，亦可通过向焊料池注入氮气来形成，使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰，实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。	(1) 产品采用模块化、数字化及人性化设计，在功能、性能、稳定性及可靠性、安全性、可维护性、易操作性及人性化方面具有良好的优越性；(2) 获欧盟专利的最先进的电磁流体驱动技术，可完全取代传统的机械泵，波峰稳定性好，无氧化黑粉，焊接质量得到更好的保障。
回流焊	设备的内部有一个加热电路，将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。	(1) 热传导技术水平世界前列；(2) 电能消耗比其他同类产品降低 20~30%；(3) 双轨机能同时生产两种不同规格的产品；(4) 制冷机由非环保升级为内置环保型；(5) 大幅度的提高助焊剂回收率。
选择焊	通过设备编程装置，助焊剂喷涂模块可对每个焊点依次完成助焊剂选择性喷涂，经预热模块预热后，再由焊接模块对每个焊点逐点完成焊接。	(1) 业内率先标配视觉系统；无需任何 PCB 数据，依旧可快速导入数据，且图形编程简易、高效；(2) 无浪费，通过高精度的焊接进一步提高生产效率和品质的可靠性。
AOI	是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。	采用自主创新“特征矢量分析”方法，可以检测几乎所有的电子产品生产中的外观缺陷。配套的远程监控调试功能，不仅可以让客户远程进行的编程、调试，而且可以汇总分析生产线所有的品质数据来全面优化生产线工艺。
高温烧结炉	公司生产的烘干/烧结一体炉，应用于光伏太阳能电池片的快烧工艺。	(1) 高效热传递技术及高精温度控制技术，升温速率：>150℃/S，冷却速率：>130℃/S，最高温度 1000℃，控温精度：±0.5℃； (2) 低能耗优势，与传统同类技术相比能耗降低 30%；(3) 高设备稳定性和产品重复性。

（二）发行人的技术储备情况

1、正在从事的研发项目及进展情况、拟达到的目标

序号	项目名称	项目内容	进展情况	拟达到目标
1	模组式选择焊 CELL-450	世界首创的应用于高价值的电子产品的通孔焊接的视觉可编程数控选择焊	中试验收	焊点自动适应的优化及学习功能，焊接线路自动模拟功能，远程调试功能，实时多任务多平台控制系统，达到国内领先、世界先进的水平。
2	高速高温烧结炉	用于晶硅太阳能电池片的烧结过程的设备	中试验收	产能是传统产品的两倍；且能耗是国外同类产品的 60%；主要技术性能指标与国外相当。
3	平板式 PECVD	用于真空环境中通过激发等离子体形成沉积膜的过程的设备	设计完成	打破技术国外垄断的现状；优秀的成膜均匀性；出色的钝化效果；高效的生产能力；低消耗成本；完善的软件安全设施。
4	在线式炉前炉后 JTA-400	在线式可以适用于炉前及炉后的大型 AOI 检测设备	中试验收	精度，平稳性在大平台上达到与小平台同样的要求。
5	AOI 自动锡膏 3D 在线检测机 SPI-400	锡膏印刷机后在线式自动锡膏印刷质量光学检测设备	中试验收	激光 3D 测试，可以检测元件锡膏的高度数据，高度方向检测精度达到 5um 左右；具有自主知识产权的飞行照相技术，可以做到高速全板在线检测，最高速度达到 8000mm ² /秒，在正常工艺情况下，直通率>90%，该技术已达国内先进水平。
6	AS-回流焊	是具有超低能耗表面贴装焊接设备	中试验收	具有超低能耗，超低碳排放标准。
7	红外链式烘干炉	用于晶硅太阳能电池片的电极印刷后烘干过程的设备	中试验收	具有高温控制精度以及运动稳定性；各项性能指标与国外进口产品相当
8	链式扩散炉	用于晶硅太阳能电池片制备中的磷扩散工艺	样机测试	具有高自动化、高产能等优点，能够得到电池片高均匀性的扩散方阻，批次间电池参数一致性高，生产连续性好以及环境友好型设备。
9	高性能 氮气回流焊	适合 IPHONE 等新一代电子产品生产所需要的全程氮气回流	样机测试	在尽可能低的氮气消耗的前提下，做到炉内全程低氧含量，确保助焊剂回收的效果，

		焊。		提高整机的稳定可靠程度。
10	NK 无铅波峰焊	是针对 KK 系列波峰焊的升级产品。	样机设计	在 KK 系列波峰焊基础之上的整体结构及性能的优化，具有高稳定性，低成本的优势。
11	TAB 台式选择性波峰焊	低成本台式选择焊	中试验收	具有结构简单，操作方便，稳定性高，易维护等优良特点；各项指标与日本进口产品相当

2、最近三年研发费用情况

根据国家科学技术部《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》，以及《高新技术企业认定管理工作指引调查测评工作手册》中的相关研究开发费用口径，公司最近三年研发投入共计 2,992.34 万元，全部于当期费用化。

单位：万元

年度	营业收入	研发投入	研发投入/ 营业收入	计入营业 成本金额	计入管理费用金额 (研发支出费用)
2011 年	26,555.42	1,192.77	4.49%	-	1,192.77
2010 年	21,866.29	1,192.27	5.45%	-	1,192.27
2009 年	9,647.55	607.30	6.30%	-	607.30

公司最近三年研发投入构成情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1、人员工资	635.64	541.17	270.61
2、直接材料投入	280.76	382.62	274.77
3、折旧与长期待摊费用	91.60	48.15	26.52
4、设计及工艺制定费	-	153.63	1.00
5、装备调试费	-	2.41	6.36
6、无形资产摊销	12.23	8.51	4.75
7、其他费用	172.54	55.78	23.29
合 计	1,192.77	1,192.27	607.30

3、合作研发情况

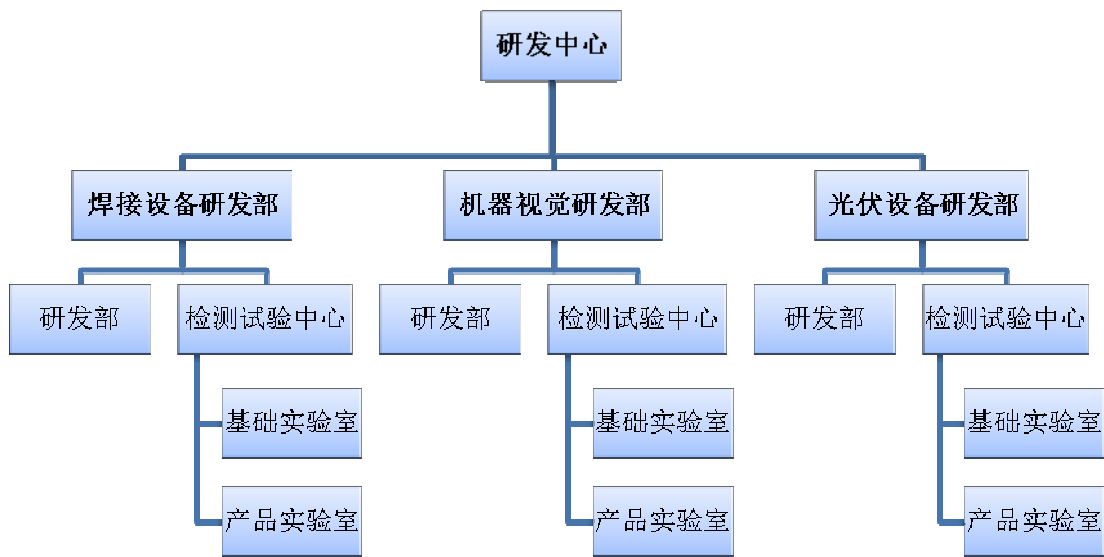
公司与大连理工大学保持长期的技术合作关系，共同开发新项目，公司提供实验场地及仪器，为对方提供研究生实习基地；对方利用技术开发力量，提

供相应的技术咨询和技术支持。双方依据具体项目确定合作范围，在立项之前协商确定专利权归属事项。

4、技术创新机制和安排

公司颁布了《项目管理控制程序》、《研发中心绩效考核方案》、《研发中心科研经费管理试行办法》等制度，激励研发人员进行项目开发。公司为加快自身的发展，保持在国内外同行的技术优势，自设立以来就形成了一套符合公司实际情况的技术创新机制：

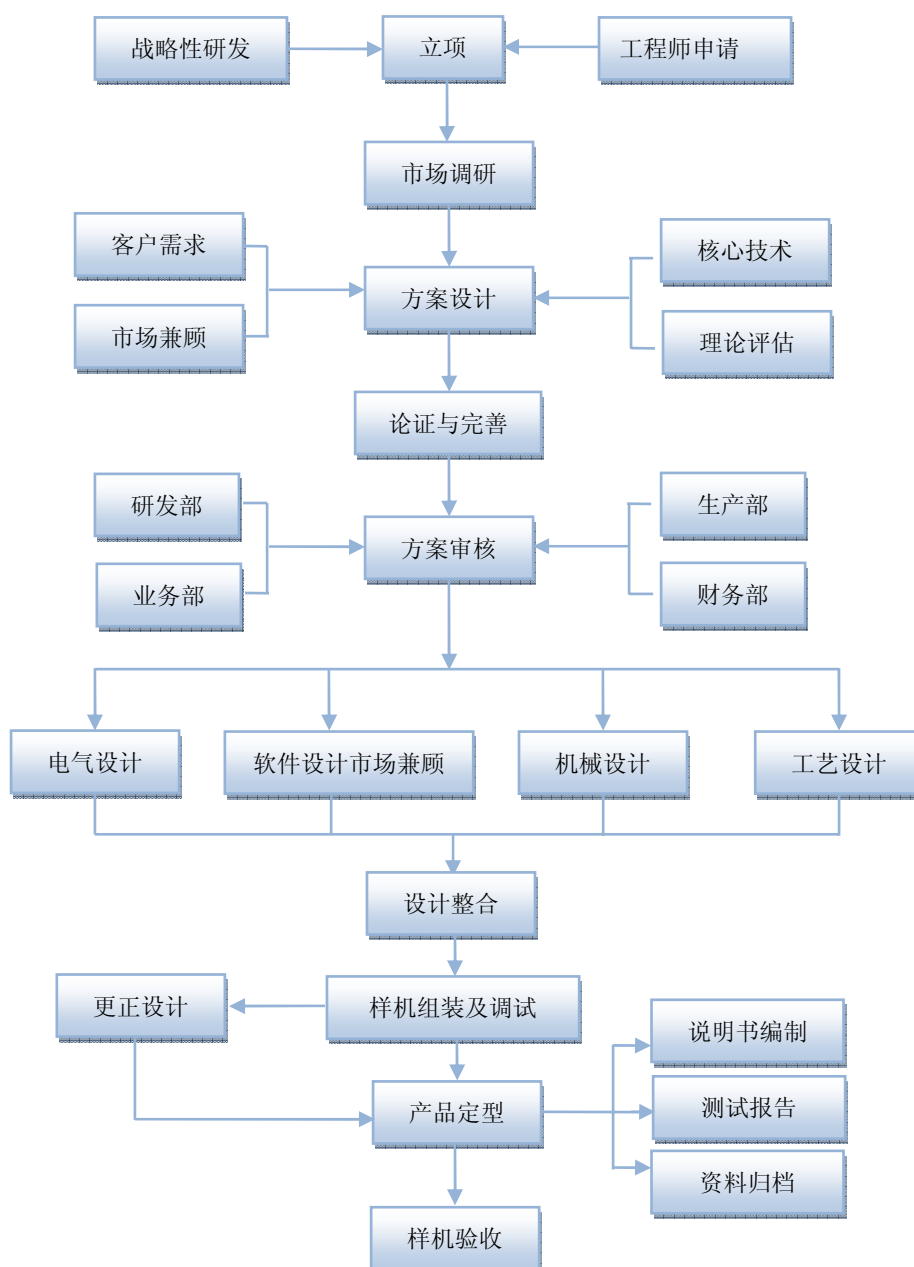
（1）公司研发机构设置情况



（2）公司研发工作流程

项目从立项开始主要经过以下几个阶段进行验收评估：样机验收，中试验收，量产验收。

项目从立项到样机验收详细工作流程如下图所示：



项目通过样机验收后进入小批量生产，根据客户使用反馈进行进一步跟踪改善。须有三个客户签字验收设备合格并出具《使用报告》，才能视为中试验收通过。项目研发小组填写《中试验收申请表》、《安装验收单复印件》，交由项目评审小组批准后在财务存档，即告中试验收合格。中试验收半年后，如无重大质量问题或业务投诉问题遗留，项目研发小组填写《量产验收申请表》，交由项目评审小组批准后在财务存档，即告量产验收合格，并关闭项目。

（3）技术创新机制的原则和制度

① 以市场为导向的研发机制

公司研发项目首先遵循市场需求原则，前瞻性的选择技术储备项目；坚持不

断创新，为顾客提供更加先进、可靠的技术装备；遵循完善产品功能，提高产品自动化水平，确保产品运行稳定可靠。除公司指定的战略性开发项目，其他由工程师申请的项目立项的准则为：具有一定创新性，能够为公司带来市场竞争优势。

② 实行项目负责制

公司实施以项目为导向的项目负责人制度，即按项目竞选项目负责人，提交《自荐书》，由公司评估决定，并且项目负责人以自愿组合的原则召集合适的技术人员组成项目团队，项目完成后即告团队解散，项目负责人对项目的进度及预定目标负责。项目负责人对项目内的组员具有管理权、奖金分配权、预算内开支审批权和供应商选择权。关键项目可两个项目组同时进行，择优竞标，确保项目的成功。

③ 建立长效激励机制

公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对研发人员的再培养，提倡进修，积极提供出国考察、培训、参加国际学术会议的机会。并相应制订了项目奖金制度，根据研发项目的技术深度和预期的经济效益以及项目开发的效果、进度及成果对项目开发人员进行绩效考核和奖励，提高了研发人员的积极性，为公司技术更新、创新提供了保障。

（4）技术创新的安排

公司以研发中心为主要技术研发平台，为保持持续创新能力，公司进行了严密、周详的安排。主要体现在以下方面：

① 强大的研发团队

公司是以技术为核心的国家高新技术企业，截至2011年12月末，拥有研发人员共95人，公司多年来逐渐培养了一批年轻的技术带头人和技术骨干，逐步形成了一支素质高、专业结构合理的技术创新型人才队伍。

② 良好的研发平台

研发中心为公司的核心研发平台，近年来公司不断地为研发工作提供有效的研发手段，加大软硬件的投入力度，建立了研发实验室，改善了研发环境，创造了良好的开发平台，保证公司研发中心在研发实力上始终处于行业的领先地位，始终保持与国际技术水平同步，保持公司持续的市场竞争能力。

③ 规范化的管理

公司建立了规范化的研发组织机构，科学严谨的研发组织制度，先进的创新管理机制，制订了完善的研发程序和管理系统。

④ 持续的研发经费投入

为保证技术开发活动的正常进行，设立专门的研究开发经费，持续增加对研发成本的投入，逐年提高科研开发费用总额投入，报告期内每年投入的研发经费总额均超过当年销售收入的5%；并且为鼓励技术人员进行新产品、新技术的开发研制，对取得各种专利设立了不同等级的奖励，为持续的研发创新提供了充足的资金支持。

⑤ 顺畅的信息渠道

公司为国内电子工业专用设备行业的高新技术企业，经过多年的技术积累，拥有一批具有自主知识产权的专有技术产品，掌握了相关核心技术，技术实力、产品竞争力一直处于国内龙头地位，在技术与产品发展工艺方面交流频繁，在把握先进技术发展方向上具有强大的先发优势。

⑥ 技术保密制度

公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施，与所有的涉密员工均签订了《保密协议书》。同时在产品开发项目管理流程中设置了完善的文档数据管理流程，并在组织上设置专职的技术文档数据管理部门，防止核心技术文档和数据流失。定期对各研发人员的开发文档、数据进行总结存档，最大程度地以书面和电子文档形式保留技术人员的研究成果，保持公司技术和产品开发的延续性。

（三）核心技术人员及成果情况

截至2011年12月31日，公司研发技术人员共95人，占公司员工总数的14.80%，其中核心技术人员5人，分别为：陈洁欣、余云辉、邹英、张卫华、徐志明。各自所取得的专业资质及重要科研成果和获得的奖项如下：

1、陈洁欣

高级工程师，曾负责航空喷气发动机压气机强度及流体分析；主持开发成功国内首台视觉SMT丝印机，获香港工业设计奖及多项专利；主持高速COB帮定机开发；负责贴片机设计及生产；主持开发电磁推进锡炉，获中国及欧盟专利；主持开发NS/VS系列回流焊，获多项专利，并通过科技成果鉴定；主持开发Seleit全视觉选择性波峰焊，获得多项专利，填补国内空白。参与发明的专利及项目有：

(1) 热风循环加热装置；(2) 爪钩式印刷电路板输送装置；(3) 波峰焊机焊锡炉；(4) 点焊焊锡炉氮气加热保护装置；(5) 波峰焊机点焊加锡装置；(6) 波峰焊机焊锡炉密封装置；(7) 具有旋转功能的锡炉导出架；(8) 喷嘴高度调节板；(9) 波峰焊机自动加锡装置；(10) 具有隔热保护的锡炉波峰电机皮带传送装置；(11) 一种波峰焊料回流装置。

2、余云辉

机械工程师，回流焊研发主管，主要负责回流焊的项目管理，搜集客户的需求信息及最新的生产工艺，制定回流焊的研发方向与设计方案，预算项目成本，制定与管理开发进度，安排及协调项目的开发工作，并实际参与其中传动模块、机架模块的开发。参与发明的专利及项目有：

(1) 一种回流焊机抽风装置；(2) 一种控制器支撑台旋转转轴；(3) 回流焊机运输导轨平行度检测装置；(4) 回流焊机；(5) 回流焊多段式传输方法及装置（发明专利，已进入实质审查阶段）。

3、邹英

工学硕士，主持研发运英通用AI&SMT编程软件（MPS），填补了国内电子装联行业CAM软件空白，其中的AI&SMT程序优化算法达到国际先进水平，使用此软件的客户包含中兴通讯、富士康、伟创力等大型企业。参与了自动光学检测系列设备研发的研发工作。参与发明的专利及项目有：

(1) 运英通用AI&SMT编程软件；(2) 一种用于检测SMT焊接质量的照明光源和检测系统。

4、张卫华

工学硕士，参加国家八五项目设计，独立设计92吨钢水包的国产化设计以及工艺，填补国内制造空白；主持设计远程网络办公系统主持设计大流量信息交换系统，被多个国内外大型公司应用底层采用；参与设计MPS软件；主持光学识别设备的设计研发，研发出独特的图像底层算法。参与发明的专利及项目有：

(1) 92吨钢水包的设计；(2) 电极自动夹持装置；(3) 远程网络办公系统大流量信息交换系统；(4) 运英通用AI&SMT编程软件（MPS）；(5) 一种用于检测SMT焊接质量的照明光源和检测系统；(6) 一种PCB板夹持装置；(7) 一种工业相机调整架；(8) 焊锡光学检测机。

5、徐志明

工学硕士，软件工程师，主要负责ADF-600高温烧结炉程序开发，以及PECVD研发中的软件和射频技术。曾参与多项产品的软件研发或改进工作，独立完成的项目主要有：（1）六自由度工业机器人控制软件、（2）SCARA机器人控制软件；（3）嵌入式一级倒立摆；（4）复杂机器人控制系统。

近年来，公司为拓展新产品和新业务，加大引进优秀人才的力度。邹英、张卫华和徐志明于2009年进入公司。除此之外，发行人最近两年核心技术人员没有发生变动，近两年核心人员变动未对公司造成重大影响。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况

自公司成立以来，公司控股股东和实际控制人均为自然人吴限，未发生过变化。

公司实际控制人吴限控制的企业包括深圳劲拓实业有限公司、贵州劲同矿业有限公司、贵州劲同投资有限公司、贵州劲同耐火材料有限公司与贵州劲同机械设备有限公司。其中劲拓实业有限公司成立于 1996 年 7 月 1 日，鉴于其经营期限将于 2009 年 7 月 1 日到期，且出于避免同业竞争的考虑，2008 年 12 月 31 日劲拓实业召开股东会，全体股东一致同意对劲拓实业解散、清算。2010 年 11 月 30 日，深圳市市场监督管理局核发了《企业注销通知书》，劲拓实业注销完毕。截至本招股说明书签署之日，除持有本公司股份外，吴限控制的其他企业包括贵州劲同矿业有限公司、贵州劲同投资有限公司以及劲同矿业持有 100% 股权的贵州劲同耐火材料有限公司、贵州劲同机械设备有限公司，此四家公司具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、（三）控股股东、实际控制人及其所控制其他企业的情况”。

公司的主营业务为焊接设备、AOI 检测设备和高温烧结炉等电子专用设备的研发、生产和销售；贵州劲同矿业有限公司的主营业务为铝矾土、铁矿开采；铝矾土熟料、保温材料、建筑材料、黑色金属、有色金属、铁合金、五金机电销售等；贵州劲同投资有限公司的主营业务为耐火材料、金属和非金属矿、有色金属材料、铁合金产品销售等；贵州劲同耐火材料有限公司的主营业务为耐火材料生产、销售；贵州劲同机械设备有限公司的主营业务为铝矾土、铁矿开采；铝矾土熟料、耐火材料、保温材料、建筑材料、黑色金属、有色金属、铁合金、五金机电销售；机械加工、模具制造、生产加工、销售。因此，截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业所从事的主营业务与公司明显不同，不存在同业竞争关系。

（二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人及控股股东吴限已于 2011 年 3 月出具《不竞争承诺函》，向公司作出如下承诺：

“一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。

二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。

三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。”

二、关联方及关联关系

根据《中华人民共和国公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规对于关联方的披露要求，并遵循关联交易从严披露原则，本公司报告期内的关联方及关联关系情况披露如下表：

（一）控股股东、实际控制人及其控制的除公司及发行人控股子公司以外的关联方

序号	关联方名称	与发行人关系
1	吴限	控股股东及实际控制人
2	劲同矿业	同一实际控制人
3	劲同投资	同一实际控制人
4	劲拓实业	原同一实际控制人
5	劲同机械	同一实际控制人
6	劲同耐火材料	同一实际控制人

注：2010 年 11 月 30 日，深圳市市场监督管理局核发了企业注销通知书，劲拓实业注销完毕。

（二）发行人控股、参股的企业

关联方名称	与发行人关系
劲拓精密	控股子公司

（三）持有发行人 5%以上股份的其他股东

序号	关联方名称	与发行人关系
1	劲通电子	发起人、持有发行人 9.55% 股份
2	孔旭	发起人、持有发行人 7.52% 股份
3	朱武陵	发起人、持有发行人 7.19% 股份
4	主逵	发起人、持有发行人 6.66% 股份
5	张纪龙	发起人、持有发行人 5.88% 股份

（四）公司董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与发行人关系
吴限、主逵、朱武陵、张汉斌、廖晔、罗昌昌、高凯、朱玺、陈洁欣、罗习雄、邹英、谢加云	本公司现任董事、监事及高管人员

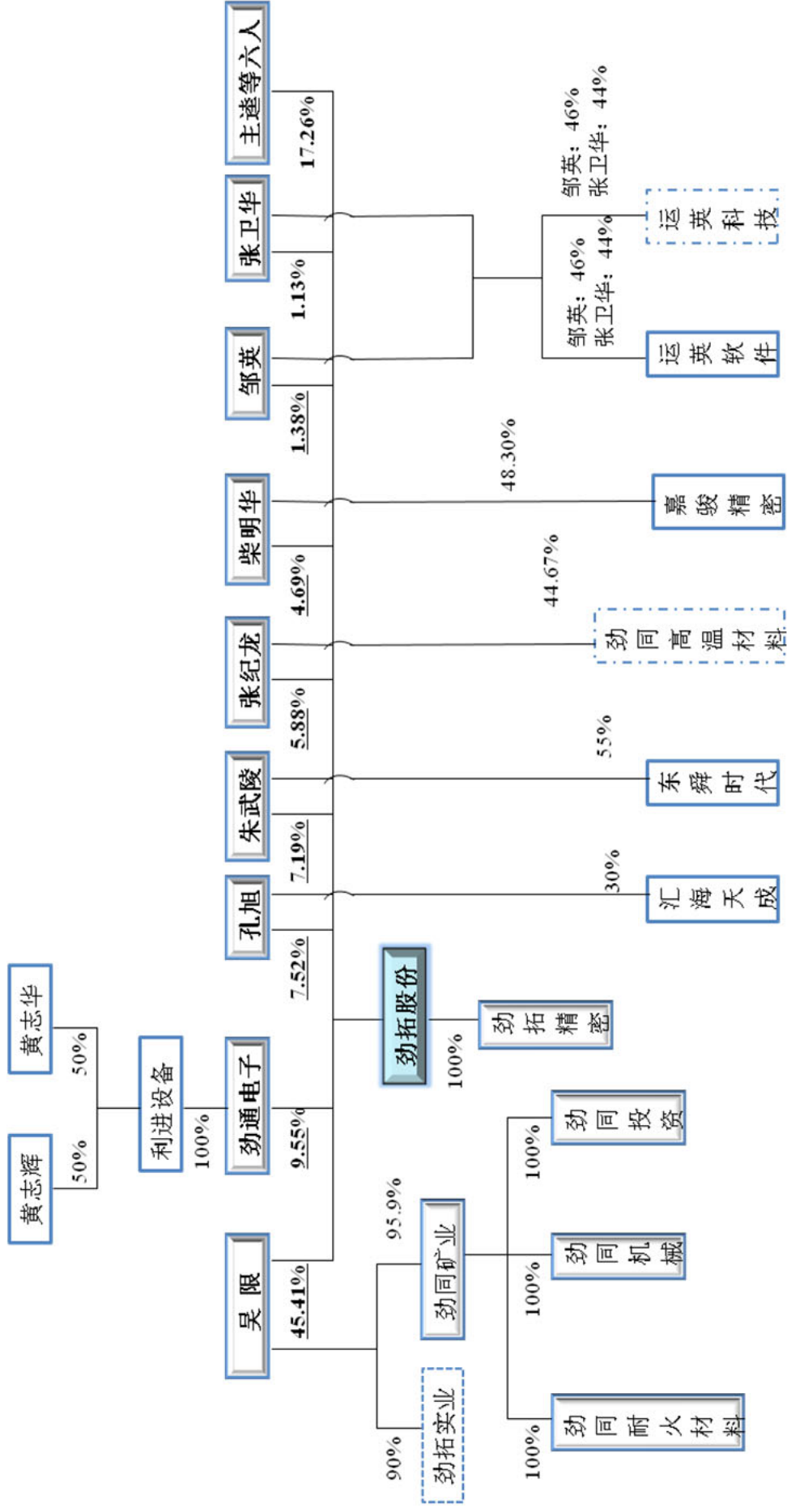
（五）其他关联方

关联方名称	与发行人关系
运英软件	本公司副总经理邹英实际控制的公司
运英科技	本公司副总经理邹英实际控制的公司
深圳市东舜时代科技有限公司	本公司董事朱武陵实际控制的公司
北京东方步步高电子科技有限公司	本公司独立董事廖晔实际控制的公司
北京华信诚达电器有限责任公司	本公司独立董事廖晔参股的公司
深圳铭鼎会计师事务所	本公司独立董事张汉斌实际控制
深圳市汇海天成投资有限公司	本公司持股 5% 以上股东孔旭实际控制的公司
劲同高温材料	本公司持股 5% 以上股东张纪龙实际控制的公司
惠州市国鹏置业有限公司	本公司持股 5% 以上股东张纪龙担任董事的公司

注：截至本招股说明书签署日，运英科技、劲同高温材料均已完成工商注销登记。

除上述关联自然人与关联企业外，发行人不存在其他关联方。

报告期内公司关联方及关联关系如下图所示：



注 1：图中虚线表示截至报告期末该公司已注销

注 2：报告期内公司仅与上表中列示的劲拓实业、劲通电子、运英软件发生关联交易，与除此之外的其他企业无任何往来

三、报告期的关联交易

（一）经常性关联交易

公司报告期内无经常性关联交易发生。

（二）偶发性关联交易

1、与劲通电子的关联采购

（1）关联采购内容

鉴于劲通电子与公司双方都从事无铅波峰焊、无铅回流焊设备的生产与销售，且公司在成立初期产能不足，部分产品结构件需要外协完成，而劲通电子拥有数量较多的机械加工设备，产能存在部分富余。基于此，公司与劲通电子于2007年3月签订《合作框架协议》，根据该协议约定，公司按照15%的成本加成率向劲通电子采购与生产无铅回流焊、无铅波峰焊设备相关的机架、传动装置氮气装置等结构件半成品以及少量无铅回流焊、无铅波峰焊设备产成品。鉴于2008年劲通电子已将其与焊接设备业务相关的固定资产、存货基本均转让给公司，2009年初其将剩余的积压时间较长、单价较低的零配件等存货一次性均按照劲通电子账面价值70%左右定价处理给公司。故报告期内公司仅2009年与劲通电子发生关联采购，采购总金额为140.52万元，占同期同类交易比例分别为2.23%。

报告期内公司向劲通电子采购产品的明细情况如下表所示：

单位： 万元

交易时间	交易货物	数量	交易价格 (不含税)	该资产劲通电子 账面价值
2009.01.06	PLC 模块	403.00	24.61	35.15
2009.01.06	UPS	40.00	1.81	3.12
2009.01.06	XP 密码	6.00	0.23	0.33
2009.01.06	变频器	329.00	13.60	19.43
2009.01.06	变压器	49.00	1.81	2.59
2009.01.06	不锈钢板	96.00	3.65	5.21
2009.01.06	步进马达	35.00	2.40	3.44
2009.01.06	触摸屏	58.00	3.23	4.61
2009.01.06	串口扩展卡	8.00	0.30	0.42
2009.01.06	纯铝板	2.00	0.07	0.10
2009.01.06	电木板	1.00	0.05	0.07

2009.01.06	电脑	90.00	15.88	16.47
2009.01.06	调速板	234.00	9.69	13.85
2009.01.06	镀锌风轮	50.00	0.43	0.60
2009.01.06	多路温度巡检仪	30.00	1.02	1.46
2009.01.06	多翼式风机	14.00	0.49	0.70
2009.01.06	发热管	300.00	0.32	0.44
2009.01.06	风机	17.00	0.80	1.15
2009.01.06	滚珠丝杆	42.00	2.19	3.14
2009.01.06	黄铜棒	2.00	0.08	0.12
2009.01.06	计数板	66.00	2.34	3.35
2009.01.06	快换双钩爪主导轨	186.00	8.78	13.85
2009.01.06	离心风机	34.00	1.41	2.01
2009.01.06	滤波器	12.00	0.74	1.05
2009.01.06	螺杆升降机	26.00	1.88	2.69
2009.01.06	米速表	1.00	0.04	0.06
2009.01.06	喷嘴	59.00	3.12	4.46
2009.01.06	气动隔膜泵	112.00	4.13	5.90
2009.01.06	气缸	27.00	1.31	1.87
2009.01.06	驱动器	51.00	1.95	2.79
2009.01.06	热板	33.00	1.18	1.69
2009.01.06	双排链条	68.00	3.55	5.06
2009.01.06	丝印网板	3.00	0.02	0.02
2009.01.06	温控模块	229.00	13.17	18.92
2009.01.06	无杆气缸	12.00	0.54	0.77
2009.01.06	巡检仪	2.00	0.09	0.12
2009.01.06	压缩机	35.00	2.59	3.71
2009.01.06	液晶显示器	76.00	4.81	7.70
2009.01.06	硬盘	2.00	0.04	0.07
2009.01.06	有灯按钮	101.00	0.31	0.47
2009.01.06	针式打印纸	50.00	0.31	0.32
2009.01.06	直线传动器	69.00	2.67	3.81
2009.01.06	直线导轨	6.00	0.25	0.36
2009.01.06	致动器	12.00	0.86	1.23
2009.01.06	中文 XP 系统	17.00	0.61	0.89
2009.01.06	中央支撑链条	12.00	1.15	1.64
	总计	-	140.52	197.19

公司与劲通电子间的关联采购均遵循双方 2007 年 3 月签署的《合作框架协议》，同期公司章程中未针对关联交易情况规定内部审批程序，故公司上述交易发生时并未召开董事会。2011 年 2 月 18 日公司召开的第一届董事会第九次会议通过了《关于公司 2008 年-2010 年关联交易事项的议案》，对上述关联交易进行

了追溯确认。此外，2011年3月公司独立董事出具《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事关于2008年-2010年关联交易事项的独立意见》亦对上述关联交易的合法合规性发表了肯定意见。

（2）报告期内与劲通电子的其他往来情况

① 业务及客户关系

在劲通电子成为劲拓有限股东之前，双方均从事焊接设备的生产与销售，劲通电子的焊接设备市场主要集中在海外市场，劲拓有限的焊接设备市场主要集中在国内市场，不存在向同一客户同时销售焊接设备的情形。但由于劲拓有限在此期间的机械加工能力有限，劲拓有限与劲通电子之间存在半成品采购往来。2008年劲拓有限收购劲通电子固定资产之后即具备了全工序的生产加工能力，双方也由业务合作关系转变为股权合作关系，劲通电子在将全部固定资产转让给劲拓有限后，其经营业务变更为无铅锡膏的生产与销售，2009年初劲通电子将剩余的少量焊接设备零配件存货及其他积压存货处理给劲拓有限后双方不再发生关联交易。

② 技术研发与使用关系

在劲拓实业将与焊接设备相关的技术、专利转让给劲拓有限之前，劲拓有限、劲通电子同时共享劲拓实业所拥有的技术及专利开展生产与销售活动。劲拓实业将相关技术、专利转让给劲拓有限之后，劲通电子也已将其固定资产全部转让给劲拓有限不再从事焊接设备业务，故报告期内劲拓有限与劲通电子之间不存在技术共享的现象。

③ 资金往来情况

报告期内公司与劲通电子之间除采购款外无其他资金往来款项。

④ 原材料采购与产品销售关系

劲拓有限2008年收购劲通电子固定资产前，劲通电子为劲拓有限主要供应商之一，向公司提供焊接设备半成品及少量产成品，此阶段内双方属于紧密合作关系，但由于劲通电子焊接设备销售业务集中在海外而劲拓有限业务集中在国内，2008年8月劲拓有限承接了劲通电子海外业务，劲通电子自身不再对外销售焊接设备产品，因此报告期内公司与劲通电子不存在向相同客户销售焊接设备产品的现象。

鉴于劲通电子变更经营范围前劲拓有限与劲通电子都从事焊接设备业务的生产与销售，因此，公司与劲通电子在 2008 年 8 月前存在向相同供应商采购原材料的现象。劲拓有限收购劲通电子固定资产后，劲通电子业务转为无铅锡膏的生产与销售，业务领域与公司差别较大，双方不再存在向相同供应商采购的现象。

⑤ 经营场地与人员关系

劲通电子设立时经营场所为深圳市宝安区西乡镇黄田村甜口工业区第五栋，2008 年 10 月 15 日住所变更为深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 C6 栋 1802A，报告期内劲通电子与劲拓有限不存在共用经营场地的现象，亦不存在代为支付房屋租赁费用的现象。

2008 年，随着劲通电子将其全部固定资产转让给劲拓有限后，除部分自愿自谋工作的员工外，其余从事焊接设备生产、销售行政人员合计 218 人转移到劲拓有限，并与劲拓有限重新签订了劳动合同。故报告期内劲通电子与劲拓有限拥有各自独立的生产、销售、行政与管理人员。

2、收购运英软件与生产 AOI 检测设备相关资产

（1）运英软件简要历史沿革

运英软件成立于 2001 年 2 月 20 日，注册资本 10 万元，设立时股权结构为邹英持有 70% 股权、梁栋持有 20% 股权、邹雄持有 10% 股权。

2004 年 7 月 28 日，运英软件股东会决议，同意增加注册资本至 50 万元，本次增资后，运英软件的股权结构为邹英持有 94% 股权，梁栋持有 4% 股权，邹雄持有 2% 股权。

2009 年 7 月，运英软件股东会决议，同意梁栋、邹雄将持有的全部股权转让给刘玲玲，邹英将持有的 4% 股权转让给刘玲玲、44% 股权转让给张卫华。同月，上述股权转让方签订了《股权转让协议书》，并经深圳市公证处公证。本次股权转让后，运英软件股权结构为：邹英持有 46% 股权，张卫华持有 44% 股权，刘玲玲持有 10% 股权。

截至本招股说明书签署日，运英软件法定代表人为刘玲玲；注册资本为人民币 100 万元，其中邹英持有 46% 股权，张卫华持有 44% 股权，刘玲玲持有 10% 股权。

2009年11月，邹英入股劲拓有限并成为劲拓有限董事，2010年6月邹英辞去董事职务，2010年11月邹英担任发行人副总经理。除邹英在发行人担任董事、副总经理，张卫华为发行人核心技术人员外，报告期内运英软件及其股东与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他未为披露的关联关系。

（2）运英软件所从事业务情况、最近三年的主要财务数据及最近三年经营合规性

在将 AOI 相关的无形资产转让给公司之前，运英软件的主要业务是 AOI 相关软件的研发。运英软件将与 AOI 相关的无形资产转让给公司后即不再从事与 AOI 相关的业务，目前主营业务为 AI&SMT 编程软件的研发与销售。

运英软件最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表			
	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
资产总额	662.76	777.28	849.98
总负债	44.96	140.30	43.77
所有者权益	617.80	636.98	806.21
利润表			
	2009年	2010年	2011年
营业收入	568.22	184.67	112.33
净利润	370.72	23.15	120.11

注：以上数据均未经审计

根据深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市南山区人力管理局出具的证明，证明 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，运英软件不存在重大违法违规行。

（3）运英软件拥有的与 AOI 检测设备相关资产的形成过程及转让原因

运英软件是一家以专长于 AOI 检测设备研发与生产的公司，尤其在 AOI 技术研发及相关软件开发上具有较强的优势，其所拥有的与 AOI 检测设备相关的专利技术均为自主研发、申请取得。运英软件虽然在 AOI 技术方面形成较强的优势，但在销售渠道和市场开拓方面的不足明显制约了相关业务的发展。劲拓有限的焊接设备与 AOI 检测设备的客户群体相同，通过购买运英软件相关无形资产并接收其核心技术人员邹英与张卫华后，公司快速掌握了 AOI 检测设备的核

心生产技术，辅以公司本身具有的强大的销售网络平台，公司实现了向 SMT 生产线设备中另一主要设备领域——AOI 检测设备领域的快速渗透，进一步丰富了公司的产品线。

（4）该等资产转让的具体过程

2009 年 8 月 8 日，经劲拓有限董事会决议，一致同意购买运英软件的 AOI 相关无形资产，包括四项专利技术、三项软件著作权及一项商标权。劲拓有限与运英软件于 2009 年 8 月 18 日签订了《无形资产转让协议》，该协议的主要内容

包括：

i、交易标的物及交易价格：公司收购运英软件与生产 AOI 检测设备相关的三项软件著作权、四项专利技术以及一项注册商标，根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深天健国众联评报字（2009）第 2-20712 号《评估报告》，公司本次收购运英软件的所有无形资产评估价值为人民币 1,308.99 万元，转让双方同意以 1,308 万元作为无形资产转让的交易价格，具体专利技术及软件著作权明细如下：

项目	名称	证书/申请号	评估值（万元）
发明专利	一种用于检测 SMT 焊接质量的照明光源及检测系统	200910105957.1	458.15
实用新型	一种工业相机调整架	200920135394.6	261.8
	一种 PCB 板夹持装置	200920135393.1	
外观专利	焊锡光学检测机	200930163988.3	130.9
软件著作权登记	AOI 在线测试软件	2009SR07813	392.7
	AOI 离线编程软件	2009SR07814	
	AOI 错误查看软件	2009SR07808	
产品设备的商标权	“WINNING”	6254450	65.45
合计	-	-	1,308.99

ii、付款方式：公司应于协议签订之日起十日内向运英软件预付 228 万元，余款 1,080 万元自 2009 年起分 5 年支付，各年度需支付金额以在该会计年度内经双方确认的 AOI 销售数量为基准，每销售 1 台离线 AOI 支付人民币 1 万元，每销售 1 台在线 AOI 支付人民币 2 万元。公司按上述计算方法计算的应付款项

达到 228 万元之前无需再支付款项，如截至 2014 年 6 月 30 日前的任何时点公司 AOI 销售数量所对应支付款项累计达到 1,308 万元，公司将提前完成所有收购价款的支付，如自本协议签署之日起超过 5 年（即截至 2014 年 6 月 30 日），公司 AOI 销售数量所对应支付款项累计未达到 1,308 万元，公司也不再支付余款。

iii、资产交割方式：运英软件应在收到公司支付的首期款 228 万元后的二十个工作日内，将其已取得权利证书的软件及商标权利人变更为公司，将正在办理权利证书的专利技术申请人变更为公司，办理权利人或申请人变更的相关费用由运英软件承担。

iv、竞业禁止：由于公司收购运英软件相关无形资产之目的在于开展 AOI 生产经营，因此自转让协议生效之日起运英软件不再开展与 AOI 相同或相似的业务，且不向任何第三方泄露其知悉的与 AOI 软件相关的商业秘密或信息。

v、保证和承诺：公司保证有能力支付全部转让价款并执行协议规定的义务，运英软件保证对所转让的无形资产拥有完整的权利，不存在任何纠纷或潜在争议的情形，并已就该无形资产向公司作了准确、充分的陈述或说明。

根据该协议的约定，公司于 2009 年 11 月向运英软件预付 228 万元受让价款，运英软件已于 2009 年当年申请将三项软件著作权、四项专利技术以及一项注册商标中已取得权利证书的软件及商标权利人变更为公司，将正在办理权利证书的专利技术申请人变更为公司，变更的相关费用均由运英软件承担。截止 2010 年 12 月 31 日上述无形财产权利人均已变更为公司。2009 年、2010 年及 2011 年公司按照当期实际销售的 AOI 检测设备数量应向运英软件支付转让价款 27 万元、217 万元、264 万元。

为进一步保护劲拓有限的利益，运英软件及其主要股东邹英、张卫华及其控制的运英科技出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，承诺自上述资产收购协议签署日起，不以任何方式开展与公司相同或相似的业务，也不从事其他任何可能损害公司利益的活动，且同时承诺于 2010 年 12 月 31 日前注销运英科技。

（5）该等资产转让前账面价值、评估增值情况及其原因

运英软件所转让的与生产 AOI 检测设备相关的无形资产均为自主研发形成，其为研发该等无形资产所发生的各项费用均在当期计入损益，并未在资产负债表中形成无形资产，故该等无形资产转让前无账面价值。深圳市天健国众联资产评

估土地房地产估价有限公司在深天健国众联评报字（2009）第 2-20712 号《评估报告》中根据收益法的评估方法得出该等无形资产价值为 1,308.99 万元的评估结论，其评估增值的主要依据为：

i、考虑到国内市场目前多为进口 AOI 检测设备，随着国内技术的成熟加上国内设备材料价格的优势，国产 AOI 检测设备市场份额将逐年提升，且运英软件具有自主专利技术，近几年发展势头较好，故预计未来年度 AOI 销售数量第一年增长 35%，第二年增长 40%，第三年增长 45%，以后各年销量趋于稳定，设备的销售价格则随着产品的成熟与市场竞争的加剧必然有所下调，运英软件以该等无形资产为基础实现 AOI 销售情况及未来销售预测具体如下表所示：

单位： 万元

	实际数据		评估预测数据				
	2008 年	2009 年 1-6 月	2009 年 7-12 月	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年及 以后
销量（套）	50.00	28.00	70.00	135.00	189.00	274.05	397.37
销售金额	646.64	333.70	1,190.00	2,160.00	2,835.00	3,562.65	4,768.47

ii、销售成本率、期间费用占收入比例以运英软件销售 AOI 检测设备的历史平均水平为依据，所得税率按 25% 计算，净利润中该等无形资产的收益分成率按 18% 计算。

iii、以孰短法为原则，按照该等无形资产中剩余有限年限最短的 9.75 年为标准确定无形资产收益的测算年限，折现率则按照加权平均资本成本法计算确定为 10.51%。

该等无形资产按照以上评估依据测算评估价值的具体过程如下表所示：

单位： 万元

	2009 年 7-12 月	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年至 2019 年 3 月
产品销售收入	1,190.00	2,160.00	2,835.00	3,562.65	4,768.47
减：产品销售成本	499.80	907.20	1,190.70	1,496.31	2,002.76
产品销售税金及	1.43	2.59	3.40	4.28	5.72

附加					
产品销售利润	688.77	1,250.21	1,640.90	2,062.06	2,759.99
减：期间费用	201.70	363.80	485.30	616.28	833.32
利润总额	487.07	886.41	1,155.60	1,445.78	1,926.67
减：所得税	121.77	221.60	288.90	361.45	481.67
净利润	365.30	664.81	866.70	1,084.34	1,445.00
净利润的技术分成额	65.75	119.67	156.01	195.18	260.10
折现值	0.95	0.86	0.78	0.70	3.40
评估值 (i=10.51%)	1,308.99				

（6）转让资产与发行人的关系

公司受让运英软件与 AOI 相关的无形资产前对机器视觉方面的知识储备及相关产品涉足不深，受让的该等无形资产构成了公司开展 AOI 业务的技术基础。公司利用该等无形资产生产的 AOI 检测产品与公司主要产品同属于电子装联生产线设备，其既可以用来检查回流焊炉后元件的焊接品质及回流焊前元件的贴装品质，也可以用来检查波峰焊之后元件的焊接状况，因此公司受让该等无形资产是对公司产品线的扩展和完善。

AOI 检测设备相应的图像识别技术与数控技术提高了发行人选择性波峰焊的技术水平，此外 AOI 检测设备与焊接设备在加工工艺、原材料方面大多数是一致的，在市场应用、客户群体方面完全一致，因此，公司收购 AOI 无形资产后形成的 AOI 检测设备业务与公司焊接设备业务属于相关业务。

（7）转让前后运英软件的主要财务数据及资产明细

公司于 2009 年年底将运英软件转让的商标、专利、软件著作权在账面追溯确认无形资产，该等无形资产于 2010 年 8 月完成权利所有人变更，运英软件转让该等无形资产前后的财务数据对比如下：

单位： 万元

资产负债表			
	2009 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	差异数
资产总额	662.76	777.28	114.52
总负债	44.96	140.30	95.34
所有者权益	617.80	636.98	19.18

利润表			
	2009年	2010年	差异数
营业收入	568.22	184.67	-383.55
净利润	370.72	23.15	-347.57

注：以上数据均未经审计

运英软件未将所出让的商标、专利、软件著作权在账面确认为无形资产。

本次资产转让完成前后运英软件主要固定资产清单如下：

单位： 万元

资产明细	入账日期	2009.12.31			2010.12.31		
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
电脑一批	2006.08.29	11.40	7.22	4.18	11.40	9.39	2.01
笔记本	2002.03.24	1.28	1.22	0.06	1.28	1.22	0.06
笔记本	2002.12.24	1.49	1.42	0.07	1.49	1.42	0.07
台式电脑	2002.12.24	0.69	0.65	0.03	0.69	0.65	0.03
小汽车	2002.12.24	23.98	15.95	8.03	23.98	18.22	5.76
电脑及显示器	2006.07.29	3.20	2.08	1.12	3.20	2.69	0.52
办公家具	2003.01.24	0.46	0.44	0.02	0.46	0.44	0.02
手提电脑	2003.10.24	1.30	1.24	0.07	1.30	1.24	0.07
手提二台	2003.09.24	2.50	2.38	0.13	2.50	2.38	0.13
数码相机	2006.07.29	0.38	0.25	0.13	0.38	0.32	0.05
电脑、打印机	2005.02.24	0.93	0.86	0.08	0.93	0.89	0.05
办公桌椅	2004.03.24	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00
冰箱	2004.03.24	0.09	0.08	0.00	0.09	0.08	0.00
海尔空调	2010.12.28	-	-	-	0.35	0.00	0.35
防伪税控机	2006.06.29	0.14	0.09	0.05	0.14	0.12	0.02
地毯	2005.02.24	0.59	0.54	0.05	0.59	0.56	0.03
笔记本电脑	2005.06.24	1.28	1.09	0.19	1.28	1.21	0.06
笔记本电脑	2005.07.24	1.00	0.84	0.16	1.00	0.95	0.05
沙发	2005.10.24	0.09	0.07	0.02	0.09	0.09	0.00
扫描仪	2005.11.24	0.10	0.08	0.02	0.10	0.10	0.01
笔记本电脑	2005.12.24	1.51	1.15	0.36	1.51	1.43	0.08
仪器	2006.02.24	1.12	0.82	0.31	1.12	1.03	0.09
IBM 笔记本电脑	2007.05.31	1.46	0.72	0.74	1.46	0.99	0.47
办公家具	2007.12.27	0.23	0.09	0.14	0.23	0.13	0.10
联想笔记本电脑	2008.02.25	0.45	0.16	0.29	0.45	0.24	0.21
设备	2008.05.31	12.97	4.09	8.88	12.97	6.67	6.30
笔记本电脑	2009.09.28	0.70	0.06	0.64	0.70	0.28	0.42
笔记本电脑	2009.10.14	5.38	0.28	5.10	5.38	1.99	3.40
手提电脑	2010.12.28	-	-	-	0.49	-	0.49
奥迪车	2010.09.26	-	-	-	45.95	2.73	43.23

奥迪车	2010.09.30	-	-	-	45.95	2.73	43.23
奥迪车	2010.11.30	-	-	-	45.96	0.96	45.00
手提电脑	2010.11.30	-	-	-	0.47	0.02	0.45
合 计		74.81	43.92	30.88	213.98	61.23	152.75

（8）该项资产转让对发行人生产经营、经营业绩的具体影响、是否存在纠纷或潜在纠纷

本次收购运英软件的相关资产主要是为了延伸公司产品线，进一步增强和扩展发行人在电子整机装联设备制造领域的领先优势。公司购买运英软件资产总额为 1,481.71 万元，占发行人 2009 年底相应资产总额的比例仅为 8.77%，比重较小，不构成重大影响。报告期各期内公司 AOI 检测设备业务收入占比情况如下表所示：

	2011 年	2010 年	2009 年
AOI 检测设备收入（万元）	2,624.76	2,059.16	268.48
主营业务收入（万元）	25,294.40	20,889.94	9,171.97
占 比	10.38%	9.86%	2.93%

在双方签署的《无形资产转让协议》中，运英软件保证与承诺其对于所转让的无形资产拥有完整的权利，不存在任何纠纷或潜在争议的情形。截至 2010 年 8 月，运英软件所转让的无形财产权利人或申请权利人均已变更为公司。因此，截至招股说明书签署日，公司与运英软件的上述无形资产转让行为不存在纠纷或潜在纠纷。

（9）发行人副总经理邹英及核心人员张卫华合计持有运英软件 90% 股权是否影响两人在发行人任职的独立性

2010 年 2 月邹英辞去运英软件总经理职务，2011 年 7 月邹英辞去运英软件执行董事职务，张卫华自 2010 年 2 月起至招股说明书签署日担任运英软件监事。因此，截至招股说明书签署日，邹英与张卫华均不再参与运英软件的经营管理。此外，运英软件将其与 AOI 相关资产转让给公司后与公司不存在同业竞争，公司除按照《无形资产转让协议约定》向运英软件支付无形资产受让款外双方不再发生任何关联交易，因此邹英、张卫华持有运英软件股份并不影响两人在公司任职的独立性。

（10）报告期内运英软件与发行人业务、人员、资金等往来情况

① 业务与资金往来

鉴于运英软件将上述与 AOI 相关的无形资产转让给公司后即不再从事与 AOI 相关业务，其于 2009 年 8 月将部分存货及少量管理用固定资产按照账面价值转让给公司，转让价款共计 173.71 万元，公司验收完毕后于 2009 年 10 月实际承接上述资产。

报告期内运英软件与公司资金往来明细如下：

单位： 万元

时间	付款金额	付款事由
2009 年 7 月 13 日	100.00	预付物料、固定资产采购款
2009 年 11 月 18 日	300.00	付采购款、预付无形资产受让款
2009 年 12 月 1 日	1.71	付采购尾款

报告期内运英软件与公司所有资金往来均因购买运英软件与 AOI 检测设备相关资产而产生，双方不存在其他资金借贷行为。

② 人员往来

资产转让后运英软件的部分客户和内部人员也相应转移至公司，其中原管理层邹英和技术核心人员张卫华于 2009 年 9 月至公司任职，其他销售、生产、售后服务等共计 14 名人员于 2009 年 7 月起陆续转至公司。

3、因劲拓实业拟注销而与其发生的关联交易

鉴于劲拓实业与公司同属同一实际控制人控制，且 2008 年初公司上市计划已定，为避免同业竞争，劲拓实业于 2008 年 12 月 31 日召开股东会，全体股东一致同意对劲拓实业解散、清算。2010 年 11 月 30 日，深圳市市场监督管理局核发了企业注销通知书，劲拓实业注销完毕。

2008 年 7 月 31 日，劲拓实业与公司签订《关联交易协议》，根据该协议安排，报告期内公司与劲拓实业所发生的关联交易包括：

（1）购买存货

基于避免同业竞争的考虑，劲拓实业于 2008 年 7 月起已不再对外承接业务，而截止 2008 年 7 月底劲拓实业仍存在一定金额的存货。因此，劲拓实业自当月起逐步将其闲置的存货按照账面价值出售给公司。2009 年公司按照账面价值收购劲拓实业存货总计金额分别为 45.03 万元，占同期同类交易比例分别为 0.71%，采购明细如下表所示：

单位： 万元

年份	类别	数量	未税金额
----	----	----	------

2009年	回流焊设备	3.00	43.16
	原材料	-	1.86
合 计		-	45.02

（2）转让无形资产

自2008年2月起，劲拓实业逐步将其所拥有的与生产焊接设备相关的专利、商标等无形资产无偿转让给公司，报告期内完成转让的无形资产清单如下：

商标：			
商标注册号	类别	商标样式	转让证明出具日
3192675	第 35 类	劲拓	2009.12.06
3192676	第 7 类	劲拓	2009.12.06
3211319	第 7 类		2009.12.06
4202636	第 9 类	劲拓	2009.12.06
4202637	第 7 类	劲拓	2009.12.06
4202653	第 40 类	劲拓	2009.12.06
4202654	第 37 类	劲拓	2009.12.06
4202655	第 11 类	劲拓	2009.12.06
4369676	第 42 类	劲拓	2009.12.06

（3）上述交易对公司经营业绩的影响及劲拓实业是否存在为发行人承担成本费用情形

报告期内公司与劲拓实业之间的所有关联交易如上所述主要因实际控制人吴限焊接设备业务的转移而发生，故两者关联交易按照劲拓实业相关资产账面价值定价较为合理。除上述关联交易之外，报告期内公司与劲拓实业不存在任何场地、设备借用或共用现象；劲拓实业与劲拓有限拥有各自独立的生产、销售与行政人员，2008、2009年虽因实业注销或者客户混淆等原因双方存在代收销售货款的情况，但代收货款结清较为及时。因此，报告期内劲拓实业并不存在为发行人承担成本费用的情形。

（4）其他往来情况

① 业务及客户关系

2007年劲拓自动化工业园投产后，基于实际控制人吴限对劲拓有限相关股东的承诺，其于2008年起开始将劲拓实业焊接设备业务转移至劲拓有限。2009年初劲拓实业开始清算，报告期内其不存在经营性销售收入，报告期内公司与劲拓实业不存在向相同客户销售的情形。

② 技术研发与使用关系

实际控制人吴限与焊接设备业务相关的技术均为劲拓实业在多年生产经营过程中、通过自主研发形成。基于上述业务转移的原因，实际控制人吴限于 2008 年内将劲拓实业拥有的与焊接设备业务相关的技术、无形资产无偿转让给劲拓有限。因此，在受让劲拓实业相关技术、无形资产前，劲拓有限主要通过共享劲拓实业拥有的商标、专利及非专利技术组织生产与销售，2008 年相关技术、无形资产转让完成后劲拓有限即独立拥有实际控制人所有与焊接设备生产、销售相关的技术与无形资产产权。

③ 原材料采购与产品销售关系

鉴于劲拓有限与劲拓实业经营业务相同且同属同一实际控制人控制，故两者销售客户群体与供应商群体存在一定重叠。但 2008 年内劲拓实业开始将焊接设备业务逐步转移给劲拓有限，报告期内其基本未再签订新的原材料采购与设备销售合同，仅将前期签订的合同履行完毕。因此，报告期内双方不存在向同一供应商采购以及同年度内与同一客户签订设备销售合同的情形。

④ 经营场地关系

1999 年 10 月，劲拓实业住所由深圳市宝安区 79 区宝民路荣华楼地下一楼变更为深圳市宝安区黄田甜口工业区轻工厂房第二栋，自此之后其生产经营场地未再发生变更。劲拓有限新厂房建成投产前其生产经营场所为深圳宝安区西乡街道黄田甜口工业区四栋第一层，劲拓工业园区落成后劲拓有限住所于 2008 年 2 月变更为深圳市宝安区西乡街道鹤州工业区劲拓自动化工业厂区。报告期内劲拓实业与劲拓有限不存在共用经营场地的现象，亦不存在代为支付房屋租赁费用的现象。

（5）公司与劲拓实业向相同客户销售及代收货款的具体情况

公司成立于 2004 年，2007 年内劲拓自动化工业园建造完毕并开始投产。因此，在新厂房建成投产以前实际控制人主要通过劲拓实业开展焊接设备业务。2008 年，基于实际控制人对劲拓有限相关股东的口头承诺，实际控制人吴限逐渐将焊接设备业务整体纳入公司，相关业务、资产、人员均在 2008 年内逐步转移到公司。2007 年-2008 年，由于公司与劲拓实业同属吴限实际控制且经营相同业务从而发生了向相同客户销售的现象，向相同客户销售的主要产品为焊接设备配件产品并包含少部分设备产品，2009 年起公司与劲拓实业不再存在向相同客

户销售产品的情形。

此外，鉴于上述业务转移的原因，部分原与劲拓实业有业务往来的客户在报告期内与公司发生交易时将货款仍支付给了劲拓实业，而公司与原劲拓实业客户建立业务往来之后部分客户又会将劲拓实业之前销售的尾款直接支付给公司，从而导致了报告期内公司与劲拓实业之间互为代收款的情形。2009 年货款部分或全部由另一方代为收回的销售收入总金额为 142.17 万元，其中劲拓有限代劲拓实业收款金额为 60.03 万元，劲拓实业代劲拓有限收款金额为 36.83 万元，其余部分均为各自独立收取货款。截至 2009 年 12 月 31 日，双方所有往来款均已结清，2010 年起双方不再发生代收货款的情形。

为防止双方互为代收款情形的持续发生，公司所采取的措施主要包括：

① 在合同专用章中明确标明收款银行账户的详细信息；

② 合同约定的收款期到期时若未收到货款及时与客户沟通，若客户已误将货款支付给劲拓实业，在与劲拓实业对账确认后向劲拓实业催收相关款项，并由负责该客户的业务员提醒客户在日后付款时注意区分账户信息；

③ 在收到劲拓实业货款时及时与劲拓实业对账确认，并于当期内在与劲拓实业结算采购等款项时一同结算双方的代收货款。

2009 年底公司与劲拓实业之间将代收的货款全部结清，自 2010 年起公司与劲拓实业不再发生任何往来。因此，公司与劲拓实业向相同客户销售产品、代收货款是实际控制人将焊接设备业务整体转移至公司过程中发生的短期现象，2009 年起双方即不再存在向相同客户销售的现象，因客户混淆账户而代收货款现象也于 2009 年底彻底纠正。

报告期内公司因上述关联交易与劲拓实业发生的资金往来明细如下：

单位：万元

年度	期初应付 余额	当期采购额	当时代实业 收款金额	当期实业代公 司收款金额	实际支付 金额	应付余额
2009 年	-547.56	-52.68	-63.03	36.83	626.44	-

注：负号表示公司对劲拓实业债务增加，正号表示公司对劲拓实业债务减少

由上表可以看出，报告期初公司共计尚欠劲拓实业 547.56 万元的采购货款，公司于 2009 年 4 月全额支付了该笔货款，公司占用劲拓实业款项的时间未超过一年，属于正常商业信用行为，故未向其支付资金占用费。

4、关联方为公司提供担保

2010年12月13日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2010年宝字第0010408337号”的《授信协议》，协议规定循环额度为人民币1,500万元，一次性额度为人民币3,500万元，授信期间自2010年12月17日至2012年12月17日。同时，公司与该行签订编号“2010年宝字第0010408337号”的最高额抵押合同，以公司所有的“深房地字第5000469662号”位于深圳市宝安区西乡街道鹤洲工业区的厂房（一）【含宿舍（一）、宿舍（二）、门卫（一）、水泵房】为上述授信协议提供抵押担保。

2010年12月，公司实际控制人吴限与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为2010年宝字第0010408337号的《最高额不可撤销担保书》，为公司与该行签订的《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任。

2011年9月15日，发行人与中国民生银行股份有限公司深圳分行（贷款方）签订编号为“2011年深宝安金融综额字010号”《综合授信合同》，协议约定的授信期间为2011年9月15日至2012年9月15日，约定的授信额度为8,000万元人民币，最高授信额度可用于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证及进口代付，在授信期限内，发行人对已清偿的授信额度可再次申请使用。同时，发行人控股股东吴限与贷款方签订编号为“2011年深宝安金融综额字010号”的《最高额担保合同》，约定为“2011年深宝安金融综额字010号”《综合授信合同》下发行人的债务提供最高债权额为8,000万元的连带保证担保。

（三）关联方应收应付款余额情况

单位：万元

科目名称	关联方名称	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
长期应付款	运英软件	1,030.41	999.43	969.38

（四）公司章程及关联交易管理制度对关联交易决策与程序的规定

1、现行有效的《公司章程》中关于关联交易的规定

（1）“第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十五）审议批准公司与关联人发生的金额在1,000万元以上，且占公司最

近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。”

（2）“第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

如果关联交易事项拟提交股东大会审议，则公司董事会应当在股东大会会议通知中明确告知公司全体股东；如果关联交易金额较大，则该等通知中应当简要说明进行该等关联交易的事由；在股东大会就关联交易事项进行表决时，公司董事会应当将关联交易的详细情况，向股东大会逐一说明并回答公司股东提出的问题；公司可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。”

（3）“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。

（二）审议公司与关联自然人发生的在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；审议与关联法人发生的在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易。”

2、《关联交易管理制度》中对于关联交易决策程序的规定

（1）“第十六条 除另有规定外，符合下列标准的关联交易事项由股东大会审议批准：

（一）公司与关联人在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。

（二）相关交易协议没有规定具体金额的关联交易事项。

（三）法律、法规、规范性文件、公司章程规定应由股东大会审议的其他关联交易事项。

公司在涉及前款第（一）项关联交易事项的，应当聘请具有相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。但本制度第二十条所述之与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。”

（2）“第十七条 除另有规定外，符合下列标准的关联交易事项由董事会审议批准：

（一）公司与关联自然人在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易事项；

（二）公司与关联法人在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的交易总额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易事项；

（三）法律、法规、规范性文件、公司章程规定可由董事会审议的其他关联交易事项。”

（3）“第十八条 除另有规定外，符合下列标准的关联交易事项由董事会授权公司总经理审议批准：

（一）公司与关联自然人在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的交易金额在 50 万元以下的关联交易事项；

（二）公司与关联法人在连续 12 个月内单笔或累计金额发生的交易总额在 300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以下的关联交易事项；

（三）法律、法规、规范性文件、公司章程规定可由公司总经理审议的其他关联交易事项。”

（4）“第十九条 公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会会议审议通过后，提交股东大会审议。”

（5）“第二十条 公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项，应当按照以下规定履行相应审议审批程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，根据公司与关联人订立的书面协议中确定的交易金额分别适用本制度第十六条、第十七条、第十八条的规定提交审议。

（二）已经公司股东大会、董事会或公司总经理批准且正在执行的日常关联交易协议，在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用本制度第十六条、第十七条、第十八条的规定提交审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交审议的，公司应在公布上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用本制度第十六条、第十七条、第十八条的规定提交审议；如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用本制度第十六条、第十七条、第十八条的规定提交审议。

前款所称‘日常关联交易’系指：购买产品或商品、销售产品或商品、提供或

接受服务、提供或接受委托、委托或受托销售以及与日常经营密切相关的其它事项。”

（6）“第二十一条 公司建立独立董事制度后，独立董事对公司拟与关联人达成的金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 3% 以上的关联交易发表独立意见。

公司审议需由独立董事事前发表意见的关联交易事项时，公司应及时通过董事会秘书将相关材料提交独立董事。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。”

（7）“第二十二条 监事会对需由董事会或股东大会审议决定的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。”

（8）“第二十三条 公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。”

（9）“第二十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出说明。

关联股东在股东大会表决关联交易事项时，应当主动回避，并放弃表决权，同时，会议主持人应当要求关联股东回避。如会议主持人需要回避，到会董事或股东应当要求会议主持人及关联股东回避并推选临时会议主持人（临时会议主持人应当经到会非关联股东所持表决权半数以上通过）。”

（10）“第二十七条 董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。”

（11）“第三十一条 需由董事会或股东大会审议决定的关联交易原则上应获得董事会或股东大会的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或股东大会事前批准既已开始执行，公司应在获知有关事实之日起 60 日内履行相应的审批程序，对该等关联交易予以确认。”

（五）本公司报告期内关联交易决策程序的执行情况

1、本公司报告期内关联交易决策程序的执行情况

2011年3月11日，公司年度股东大会审议通过《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于公司2008年-2010年关联交易事项的议案》。经核查，确认“公司于2008、2009年度与关联方发生的关联交易，是为了发展公司业务，扩大公司在电子整机装联行业中的影响，避免同业竞争，剥离与公司主营业务无关的资产。该等关联交易签订了相关协议书，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司长远规划和利益。”

2、独立董事意见

2011年3月，公司独立董事出具《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事关于2008年-2010年关联交易事项的独立意见》，对公司报告期内发生的关联交易进行了确认：

“公司2008、2009年度与深圳市劲拓实业有限公司、劲通电子设备（深圳）有限公司、深圳市运英软件开发有限公司、公司股东之间发生的关联交易，是为了发展公司业务，扩大公司在电子整机装联行业中的影响，避免同业竞争，剥离与公司主营业务无关的资产。该等关联交易均签订了相关协议书，交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司利益。该等关联交易符合相关法律、法规和《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》等有关规定。

2010年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。”

（六）发行人规范和减少关联交易的措施

截至招股说明书签署日，本公司已经不存在关联交易的情形。未来若出现难以避免的关联交易，本公司将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，确保关联交易的公平。

第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介

（一）董事会成员

公司现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名，其基本情况如下：

1、吴限：董事长、总经理，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于贵州铁合金厂、日东电子，1996 年创办深圳市劲拓实业有限公司；2005 年起担任深圳市劲拓自动化设备有限公司董事长；2010 年 1 月起任本公司董事长、总经理至今。

2、主逵：董事、副总经理，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于贵州铁合金厂、爱高电子厂；2004 年起历任深圳市劲拓自动化设备有限公司担任董事、总经理；2010 年 1 月起任本公司董事、副总经理至今。

3、朱武陵：董事，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖南湘潭市酒厂、东莞长安爱高集团，2003 年创办深圳市东舜时代科技有限公司并任执行董事至今；2005 年起担任深圳市劲拓自动化设备有限公司董事；2010 年 1 月起任本公司董事至今。

4、张汉斌：独立董事，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。1987 年至 2000 年，历任天勤会计师事务所审计员、项目经理、经理助理、经理及授薪合伙人；2000 年至 2004 年 7 月，任深圳市注册会计师协会主任干事；2004 年 8 月至今，任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人；2011 年 3 月至今，任深圳兆日科技股份有限公司独立董事；2011 年 10 月至今任深圳汇洁集团股份有限公司独立董事；2010 年 7 月起任本公司独立董事至今。

5、廖晔：独立董事，男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 年至 2002 年任东莞市金正通讯设备有限公司副总经理；2002 年-2008 年任步步高通讯设备有限公司事业部总经理；2008 年-2011 年任东莞市奥珀电子有限公司总经理；2011 年 7 月至今任北京东方步步高电子科技有限公司任总经理；

2011年11月至今任北京华信诚达电器有限责任公司监事；2010年7月起任本公司独立董事至今。

（二）监事会成员

本公司监事会由3人组成，基本情况如下：

1、罗昌昌：监事会主席，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004起担任深圳市劲拓自动化设备有限公司监事；2010年1月起任本公司监事会主席至今。

2、高凯：职工监事，男，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任职于永华无线电仪器厂，先后担任车间主任与设计所副所长。2007起担任深圳市劲拓自动化设备有限公司技术顾问；2010年1月起任本公司监事至今。

3、朱玺：监事，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于贵州都匀久达机械厂、深圳市劲拓实业有限公司，2004年起任职于深圳市劲拓自动化设备有限公司；2010年1月起任本公司监事至今。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员共6名，包括总经理、副总经理、财务总监，其基本情况如下：

1、吴限：其基本情况请见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历”之“（一）董事会成员”。

2、主逢：其基本情况请见本节之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历”之“（一）董事会成员”。

3、陈洁欣：副总经理，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，全国高技术产业化在册专家。曾任职于日东电子、美国环球仪器公司，主持开发国内首台视觉丝印机，获香港工业设计奖；2004年起历任深圳市劲拓自动化设备有限公司研发部经理、技术中心总监、副总经理；2010年11月起任本公司副总经理至今。

4、罗习雄：财务总监、董事会秘书，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业注册会计师、中国注册

税务师协会非执业注册税务师。1996年至2004曾先后任职于江南机器厂财务处、高时石材集团审计部、深圳市科陆电子科技股份有限公司财务部；2004起历任深圳市劲拓自动化设备有限公司财务经理、财务总监；2010年11月起任本公司财务总监、董事会秘书至今。

5、邹英：副总经理，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任职于深圳康佳集团股份有限公司、松下电器机电（深圳）有限公司；2000年-2009年，创办深圳市运英软件开发有限公司并任执行董事、总经理；2009年起历任深圳市劲拓自动化设备有限公司研发中心副总监、董事；2010年11月起任本公司副总经理至今。

6、谢加云：副总经理，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于广东韶关曲仁机械厂、广州嘉林电子厂和东莞新进电子集团；2005年起历任深圳市劲拓自动化设备有限公司生产经理、制造中心总监；2010年11月起任本公司副总经理至今。

（四）其他核心人员

张卫华：研发中心机器视觉研发部技术总监，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任职于成都无缝钢管厂设备设计研究所，参与国家八五项目中的机电一体化设计，成功完成92吨大电炉钢水包设计（主设计师）。2001年至2003年就职于永泰（深圳）软件有限公司，完成美国国家信息交换技术底层架构。2003年至2009年就职于深圳市运英软件开发有限公司，担任运英自动光学检测设备的主设计师。2009年起担任深圳市劲拓自动化设备有限公司研发中心机器视觉研发部技术总监。

（五）董事、监事和高级管理人员的提名和选聘情况

1、董事提名和选聘情况

2010年1月31日，公司召开股份公司创立大会，大会审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事成员的议案》，同意选举吴限、主逵、朱武陵、张纪龙、邹英为公司董事，任期三年，自股份公司首次领取营业执照之日起；同日第一届董事会召开第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举吴限为第一届董事会董事长。

2010年6月30日，第一届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意张纪龙、邹英辞去公司董事职务，拟选聘廖晔、张汉斌出任公司独立董事，任期自经股东大会批准日起，到期时间与公司第一届董事任期到期时间相同。该议案经公司于2010年7月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。

具体董事提名和选聘情况如下表所示：

姓名	提名人	选聘情况	任期
吴限	朱武陵	由公司创立大会暨第一次股东大会选聘	2010.1.31-2013.1.30
朱武陵	张纪龙	由公司创立大会暨第一次股东大会选聘	2010.1.31-2013.1.30
主逵	吴限	由公司创立大会暨第一次股东大会选聘	2010.1.31-2013.1.30
张汉斌	董事会	由公司2010年第二次临时股东大会选聘	2010.7.20-2013.1.30
廖晔	董事会	由公司2010年第二次临时股东大会选聘	2010.7.20-2013.1.30

2、监事提名和选聘情况

2010年1月31日，公司召开股份公司创立大会，大会审议通过了《关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案》，同意选举罗昌昌、朱玺为公司第一届监事会股东代表监事；同日公司召开职工代表大会，一致同意选举公司员工高凯为公司第一届监事会职工代表监事，与公司创立大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任期三年，自股份公司首次领取营业执照之日起；同日公司召开第一届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举罗昌昌为监事会主席。

具体监事提名和选聘情况如下表所示：

姓名	提名人	选聘情况	任期
罗昌昌	吴限	由公司创立大会暨第一次股东大会选聘	2010.1.31-2013.1.30
朱玺	主逵	由公司创立大会暨第一次股东大会选聘	2010.1.31-2013.1.30
高凯	职工监事	由职工代表大会选举产生	2010.1.31-2013.1.30

3、高级管理人员选聘情况

2010年1月31日，公司第一届董事会召开第一次会议，一致同意聘任吴限担任公司总经理；2010年11月8日，公司第一届董事会召开第六次会议，一致同意聘任主逵、陈洁欣、邹英、谢加云担任公司副总经理，聘任罗习雄担任财务

总监兼董事会秘书。

经本保荐机构及律师核查，公司董事、监事、高级管理人员的提名和选聘程序符合《公司法》及其他相关法律法规的要求。

二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属的持股情况

（一）直接及间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持股情况如下所示：

股东姓名	持股数量	持股比例	在本公司任职
吴 限	27,243,000	45.41%	董事长、总经理
朱武陵	4,315,100	7.19%	董事
主 逵	3,997,200	6.66%	董事、副总经理
罗昌昌	1,420,600	2.37%	监事会主席
陈洁欣	1,008,200	1.68%	副总经理
罗习雄	988,600	1.65%	董事会秘书、财务总监
邹 英	825,000	1.38%	副总经理
朱 玺	1,350,000	2.25%	监事

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未有间接持股的情形。

公司董事、监事、高级管理人及其核心人员的近亲属未以任何方式直接或间接持有发行人股份。

公司董事、监事、高级管理人及其他核心人员出具声明函，确认其近亲属（配偶、父母、子女）未直接或间接持有本公司股票及其衍生品种。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的持股情况变动

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年持股情况变动如下所示：

姓名	在本公司任职	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
		股份 (股)	比例 (%)	出资额(元)	比例 (%)	出资额 (元)	比例 (%)
吴限	董事长 总经理	27,243,000	45.41	27,243,000	45.41	27,243,000	45.41

朱武陵	董事	4,315,100	7.19	4,315,100	7.19	4,315,100	7.19
主遼	董事、 副总经理	3,997,200	6.66	3,997,200	6.66	3,997,200	6.66
罗昌昌	监事会主席	1,420,600	2.37	1,420,600	2.37	1,420,600	2.37
陈洁欣	副总经理	1,008,200	1.68	1,008,200	1.68	1,008,200	1.68
罗习雄	董事会秘书 财务总监	988,600	1.65	988,600	1.65	988,600	1.65
邹英	副总经理	825,000	1.38	825,000	1.38	825,000	1.38
朱玺	监事	1,350,000	2.25	1,350,000	2.25	1,350,000	2.25

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押或冻结情况

经本保荐机构及律师核查，至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持发行人股份未有质押或冻结的情况。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人及其他核心人员对外投资的情况如下表：

姓名	对外投资企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例
吴限	贵州劲同矿业有限公司	矿产开发	7,032.71	95.90%
	贵州劲同投资有限公司	矿产开发	2,660.00	95.90%
	贵州劲同机械设备有限公司	矿产、机械制造	350.00	95.90%
	贵州劲同耐火材料有限公司	耐火材料生产	900.00	95.90%
朱武陵	深圳市东舜时代科技有限公司	安防监控器材	300.00	55.00%
廖晔	北京东方步步高电子科技有限公司	家电、通讯产品销售	1,000.00	53.00%
	北京华信诚达电器有限责任公司	家电、五金交电	200.00	40.00%
张汉斌	深圳铭鼎会计师事务所	审计、验资、会计服务	30.00	90.00%
邹英	深圳市运英软件开发有限公司	计算机软硬件	100.00	46.00%
张卫华	深圳市运英软件开发有限公司	计算机软硬件	100.00	44.00%
	深圳市兴华炜科技有限公司	计算机软硬件	10.00	97.00%

注：吴限通过持有劲同矿业 95.90% 股权而间接控制劲同耐火材料、劲同机械

上述对外投资与本公司不存在利益冲突。

除上述列明的投资情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无其他的对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬安排

1、本公司的总经理、财务总监和董事会秘书不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬的情况。

2、本公司没有与任何董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订借款、担保协议的情况。

3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2011 年度从本公司及关联企业领取收入的情况如下：

姓名	任职情况	2011 年度薪酬 (万元)	是否在本公司及关联企业专职领薪
吴限	董事长、总经理	52.05	仅在本公司领薪
主遼	董事、副总经理	35.52	仅在本公司领薪
朱武陵	董事	-	否
张汉斌	独立董事	6.00	否
廖晔	独立董事	6.00	否
罗昌昌	监事会主席	41.30	仅在本公司领薪
高凯	职工监事	12.26	仅在本公司领薪
朱玺	监事	13.40	仅在本公司领薪
陈洁欣	副总经理	35.83	仅在本公司领薪
罗习雄	董事会秘书、财务总监	34.60	仅在本公司领薪
邹英	副总经理	18.48	仅在本公司领薪
谢加云	副总经理	29.77	仅在本公司领薪
张卫华	AOI 研发部工程总监	23.37	仅在本公司领薪

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他待遇及退休金计划情况

为加强对公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的激励与监督，公司制定了相关晋级、加薪、福利、奖金分配、提高福利待遇等激励措施。根据公司效益及上述人员的绩效考核情况，公司按年度发放奖金并逐步提高标准。同时，

公司实施收入与业绩、效益挂钩政策，使员工价值得到充分体现。公司对有特殊贡献的高级管理人员和核心技术人员，还将加大奖励的力度。

（三）独立董事津贴政策

2010年11月29日，本公司2010年第三次临时股东大会决议通过的本公司独立董事津贴标准为：每人每年6万元（含税）。此外，独立董事出席本公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

（一）于本公司关联企业任职情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有在本公司关联企业任职的情况。

（二）于本公司非关联企业任职情况

姓名	本公司职务	任职法人企业	任职情况
朱武陵	董事	深圳市东舜时代科技有限公司	执行董事、总经理
张汉斌	独立董事	深圳铭鼎会计师事务所	执行合伙人
		深圳兆日科技股份有限公司	独立董事
		深圳汇洁集团股份有限公司	独立董事
廖晔	独立董事	北京东方步步高电子科技有限公司	总经理
		北京华信诚达电器有限责任公司	监事

除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有在其他本公司非关联企业任职的情况。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系情况

除高凯为吴限的舅舅外，公司所有董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署协议及承诺情况

（一）协议签署情况

在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司均签有《劳动合同》，其中核心技术人员与公司签有《保密协议书》，对勤勉尽责、保守商业机密、重大知识产权等方面作了规定。

（二）承诺情况

就发行上市后股权锁定、避免同业竞争等事项签署了相关承诺。详见“第五节 发行人基本情况”之“十、实际控制人、持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况”。

截至本招股说明书签署之日，上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

八、董事、监事及高级管理人员任职资格情况

经本保荐结构及律师核查，本公司全体董事、监事、高级管理人员的提名及选聘程序符合国家相关法律法规及公司章程的要求，且所有人员均具备担任相应职务的资格。

九、近两年董事、监事及高级管理人员变动情况

（一）董事变动

2010 年 1 月 31 日，公司召开创立大会，选举产生的董事与原董事相同。

2010 年 7 月 20 日，为完善公司治理结构，建立独立董事制度，在保荐机构和律师的帮助下，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，同意张纪龙、邹英辞去公司董事职务，选聘廖晔、张汉斌出任公司独立董事，任期自本次临时股东大会批准日起，到期时间与公司第一届董事任期到期时间相同。

（二）监事变动

1、在劲拓有限整体变更为股份有限公司之前，劲拓有限未设监事会，只设 1 名监事。自劲拓有限 2004 年 7 月首次设立以来，一直由罗昌昌担任监事一职。

2、2010 年 1 月 31 日，公司召开股份公司创立大会，同意选举罗昌昌、朱玺为公司第一届监事会股东代表监事；同日公司召开职工代表大会，一致同意选举公司员工高凯为公司第一届监事会职工代表监事，与公司创立大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第一届监事会。

截至目前，本公司第一届监事会成员未发生变更。

（三）高级管理人员变动

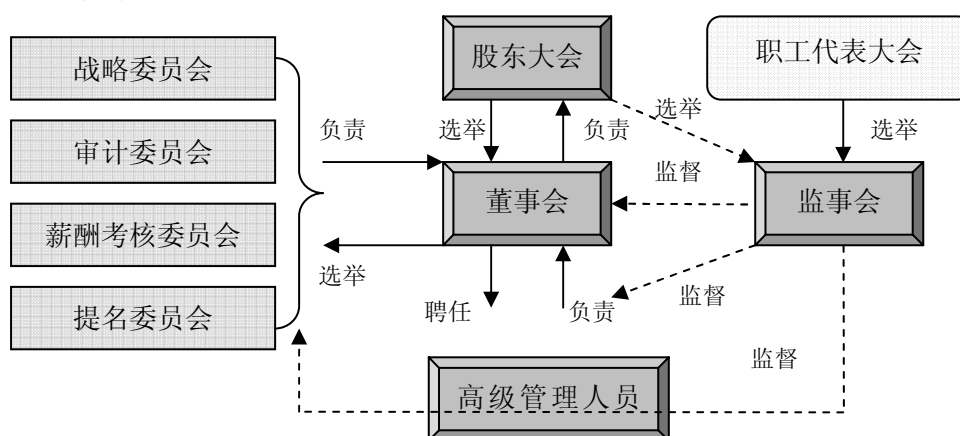
劲拓有限自 2004 年 7 月首次设立以来，主逵一直担任总经理一职；2010 年 1 月 31 日，第一届董事会举行第一次会议，一致同意聘任吴限担任公司总经理；2010 年 11 月 8 日，第一届董事会召开第六次会议，一致同意聘任主逵、陈洁欣、邹英、谢加云担任公司副总经理，聘任罗习雄担任财务总监兼董事会秘书。

发行人最近两年内董事、高级管理人员未发生重大变化，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定。

第九节 公司治理

本公司自整体变更设立以来，建立健全了职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；并相应制订了股东大会、董事会、监事会的职权和议事规则，对独立董事产生办法及发挥作用的制度进行了具体规定。

本公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，并明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。本公司治理结构的关系如下图所示：



目前，本公司各项制度基本完备，制订了：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等一系列的规章制度。

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书的依法运作情况

（一）本公司股东大会

1、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准第四十一条规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (14) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会的工作情况

本公司自整体变更设立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，共召开了 8 次股东大会，股东均依法履行股东义务，行使股东权利。

(1) 2010 年 1 月 31 日，本公司召开创立大会。会议审议通过《关于发起设立深圳市劲拓自动化设备股份有限公司的议案》、《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司筹备工作报告的议案》、《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司设立费用审核报告的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程（草案）及附件〉的议案》、《关于授权董事会全权处理有关公司设立、登记相关事项，并委托、授权毛一静负责办理公司设立登记事宜的议案》；

(2) 2010 年 5 月 28 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于 2010 年财务预算的议案》、《关于聘请 2010 年外部审计机构的议

案》；

（3）2010年7月20日，本公司召开2010年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于授权办理工商登记的议案》；

（4）2010年11月29日，本公司召开2010年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于完善公司组织架构的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于建立独立董事工作制度的议案》、《关于建立对外担保管理制度的议案》；

（5）2010年12月30日，本公司召开2010年第四次临时股东大会。会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权办理工商变更登记的议案》；

（6）2011年3月11日，本公司召开2010年年度股东大会。会议审议通过了《2010年董事会工作报告的议案》、《独立董事工作报告的议案》、《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告的议案》、《关于2010年利润分配方案的议案》、《关于聘请公司2011年外部审计机构的议案》、《关于2008年-2010年关联交易的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金项目及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程（草案）的议案》、《募集资金管理制度的议案》、《信息披露管理制度的议案》；

（7）2011年12月23日，本公司召开2011年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》、《关于修改〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

（8）2011年12月30日，本公司召开2011年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》。

（二）本公司董事会

公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人。

1、董事会的职权

董事会行使下列职权：

- （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；
- （3）决定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （9）决定公司内部管理机构的设置；
- （10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （11）制订公司的基本管理制度；
- （12）制订公司章程的修改方案；
- （13）管理公司信息披露事项；
- （14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- （15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

2、董事会的工作情况

本公司自整体变更设立以来，董事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了 14 次董事会，董事均依法履行董事义务，行使董事权利。

（1）2010 年 1 月 31 日，本公司召开第一届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选择公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》；

（2）2010 年 5 月 10 日，本公司召开第一届董事会第二次会议。会议审议

通过了《关于2010年财务预算的议案》、《关于聘请2010年外部审计机构的议案》、《关于2009年年度财务报告的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；

(3) 2010年6月30日，本公司召开第一届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于授权办理工商登记的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；

(4) 2010年9月28日，本公司召开第一届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于公司向美国西南设备服务公司购买氮化物沉积系统技术的议案》；

(5) 2010年10月25日，本公司召开第一届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司向招商银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币5,000万元事宜的议案》；

(6) 2010年11月8日，本公司召开第一届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于完善公司组织架构的议案》、《关于建立<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于建立<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于建立<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于建立<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于建立<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于建立<总经理工作细则>的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于建立<独立董事工作制度>的议案》、《关于建立<对外担保管理制度>的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》；

(7) 2010年12月14日，本公司召开第一届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权办理工商变更登记的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》；

(8) 2011年1月15日召开的发行人第一届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于设立惠州市劲拓精密设备有限公司的议案》、《关于建立公司<内部审计制度>的议案》；

(9) 2011年2月18日召开的发行人第一届董事会第九次会议。会议审议通过《2010年总经理工作报告的议案》、《2010年董事会工作报告的议案》、《独立董事工作报告的议案》、《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告的议

案》、《关于 2010 年利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2011 年外部审计机构的议案》、《关于公司 2008 年-2010 年审计报告的议案》、《关于公司 2008 年-2010 年关联交易事项的议案》、《关于公司内部控制的评估说明的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金项目及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程〉（草案）的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于公司召开 2010 年年度股东大会的议案》；

（10）2011 年 8 月 8 日，召开发行人第一届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于公司审计报告报出日的议案》；

（11）2011 年 8 月 22 日，召开发行人第一届董事会第十一次会议。会议审议通过了《《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 8000 万元事宜的议案》》；

（12）2011 年 12 月 7 日，召开发行人第一届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》、《关于修改〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

（13）2011 年 12 月 14 日，召开发行人第一届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》、《关于公司召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

（14）2012 年 1 月 17 日，召开发行人第一届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于审议公司 2009-2011 年度财务报告的议案》。

3、董事会专门委员会

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，专门委员会成员如下表：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	吴限	吴限、廖晔、主遼
审计委员会	张汉斌	张汉斌、主遼、廖晔

提名委员会	廖晔	廖晔、吴限、张汉斌
薪酬与考核委员会	张汉斌	张汉斌、廖晔、主逢

（1）战略委员会职权

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议、方案。主要行使以下职权：①对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；②对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；③对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；⑤对以上事项的实施进行检查；⑥董事会授权的其他事宜。

（2）审计委员会职权

审计委员会负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。主要行使下列职权：①提议聘请或更换外部审计机构；②监督公司的内部审计制度及其实施；③促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通；④审阅公司的财务信息及其披露；⑤审查公司内控制度的设计和执行情况；⑥审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活动；⑦董事会授权的其他事宜。

（3）提名委员会职权

提名委员会主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，并对董事会负责。主要行使下列职权：①根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；②对被提名的董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；③对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；④董事会授权的其他事宜。

（4）薪酬与考核委员会职权

薪酬委员会主要负责拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。主要行使下列职权：①研究董事、经理及其他高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；②根据董事、经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚

的主要方案和制度；③审查公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；④对公司薪酬制度执行情况进行监督；⑤董事会授权的其它事宜。

（三）本公司监事会

本公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名，监事会设主席 1 人。

1、监事会的职权

- （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （2）检查公司财务；
- （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （6）向股东大会提出提案；
- （7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

2、监事会工作情况

本公司自整体变更设立以来，监事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了 4 次监事会，监事均依法履行监事义务，行使监事权利。

（1）2010 年 1 月 31 日，召开发行人第一届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

（2）2010 年 7 月 30 日，召开发行人第一届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于公司 2010 年 1-6 月财务运行状况的报告》；

（3）2011 年 4 月 11 日，召开发行人第一届监事会第三次会议。会议审议

通过了《关于 2010 年监事会年度工作报告》；

(4) 2011 年 12 月 7 日，召开发行人第一届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》、《关于修改〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

（四）本公司独立董事制度

本公司独立董事 2 名，占董事会人数的比例超过三分之一。

1、独立董事的职权

独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

(1) 公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人达成的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(2) 向董事会提请聘用或解聘会计师事务所；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2、独立董事实际发挥作用的情况

公司引进独立董事后，独立董事积极参与公司决策，公司治理结构有较大改善，在关联交易及重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

公司建立独立董事制度以来召开 8 次董事会，独立董事均参加了会议。

公司的独立董事张汉斌与廖晔在任职期间，向本公司出具了《独立董事关于聘任高管的独立意见》、《独立董事工作报告》及《关于 2008 年-2010 年关联交易事项的独立意见》。

（五）本公司董事会秘书制度

董事会秘书的主要职责是：

- 1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- 2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
- 3、组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
- 4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
- 5、关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
- 6、组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深交所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
- 7、督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；
- 8、《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。

二、公司最近三年违法违规行为情况

最近三年，公司不存在因违法违规而被行政处罚的情况。

发行人保荐机构认为：自成立至今，公司严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，均不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关、社保、外汇管理、技术监督以及其他法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形，也未有受到司法制裁的记录；公司董事、监事以及高级管理人员均不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。

三、公司最近三年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用

报告期内不存在公司占用控股股东资金，亦不存在本公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的

情形。

（二）对外担保

本公司最近三年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

四、公司重大经营投资决策程序与投资者权益保护

为确保重大经营及投资决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》，本公司制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，主要内容如下：

（一）对外投资

《公司章程》规定，公司股东大会决定公司的投资计划；董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

1、以下投资事项由公司董事会审批：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 100 万元；

2、以下投资事项由公司股东大会审批：

《公司章程》第三十九条规定：公司对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）对外担保

2010 年 11 月 29 日，公司 2010 年第三次临时股东大会通过了发行人制定的《对外担保管理制度》，对担保审查和决议权限作出了明确规定。

1、《对外担保管理制度》审批权限

公司对外担保事项必须经董事会或股东大会审议。董事会审议权限范围内的担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议董事三分之二以上同意。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（1）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

- (3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- (4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- (5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；
- (6) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- (7) 本章程规定的其他担保情形。

股东大会审议前款第（4）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由其他股东所持表决权的半数以上通过。

2、审批程序

公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据公司章程及其细则有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过规定权限的，董事会应当提出议案，报股东大会批准。

公司在决定担保前，公司有关部门认真调查被担保人的经营情况、财务状况和资信情况，对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，形成有关担保事项的报告，提交公司经理审核，并按本制度规定履行相应的审议批准程序。

公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

最近三年内，公司未发生对外担保行为。

（三）公司对外投资、对外担保制度的执行情况

公司自设立以来，能够有效的执行公司指定的对外投资、对外担保制度，股东大会、董事会及管理层在其职权范围内决定对外投资、对外担保的事项，并履行相应的决策程序，不存在已经或可能对股东利益造成损害的对外投资，不存在违规对外担保及可能影响公司持续经营的重大对外担保事项。

2011年2月公司投资设立惠州市劲拓精密装备有限公司，投资额人民币1,000

万元。该项决策业经公司第一届董事会第八次会议审核通过。

（四）投资者权益保护

2010年1月31日公司的创立大会审议通过了《关联交易管理制度》；2010年11月29日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》；2011年3月11日公司2010年年度股东大会审议通过了发行人制定的《信息披露管理制度》及《募集资金管理制度》。通过建立科学、完善的法人治理结构来保障股东行使权力，参与公司重大事项的决策。

《公司章程》中已明确规定了股东享有的权力、承担的义务、参与公司重大决策及选择管理者的权利，其他对投资者权益保护的相关制度具体如下：

1、信息披露管理

公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露信息。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

2、募集资金管理

公司将实行募集资金专户存储，并严格按照募集资金投资计划使用募集资金。公司将在每个会计年度结束后核查募集资金投资项目的进展情况，如因市场变化需改变募集资金投向的，公司将履行相应的法律程序。

3、关联交易管理

公司明确了董事会、股东大会对于关联交易的决策权限，规定公司关联交易的内部控制建设应当遵循公平、公开、公允的原则，确保公司的管理交易行为不损害公司和全体股东利益。董事会、股东大会在作出决议时，关联方应回避表决，并不得代理他人行使表决权。

4、独立董事

公司明确规定独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

五、公司内部控制制度情况

（一）公司内部控制制度的建设情况

本公司在多年生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的管理制度。公司在运作过程中力争做到有制度可循，有制度必循，违反制度必究。

公司现已明确建立了以下内部控制制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等。

上述制度的建立，使公司经营过程中的各项业务，有了规范的内部控制制度或管理办法，这不仅使公司的各项业务有规可循，而且也将使公司得以沿着健康有序的运营轨道，持续高效发展。

（二）公司管理层对公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司管理层认为：据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范的控制标准建立了比较合理的内部控制制度，在所有重大方面保持了对截至 2011 年 12 月 31 日的财务报表有效的内部控制。

（三）注册会计师对公司内部控制制度的评价

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具的“深鹏所股专字【2012】0015 号”《内部控制鉴证报告》认为：根据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范的控制标准建立了比较合理的内部控制制度，在所有重大方面保持了对截至 2011 年 12 月 31 日的财务报表有效的内部控制。

第十节 财务会计信息与管理层分析

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的深鹏所股审字【2012】0003号《审计报告》或依据该报告计算而得，单位为人民币元。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：			
货币资金	48,005,627.70	50,305,779.68	20,634,447.54
交易性金融资产	-	-	8,000,000.00
应收票据	2,862,822.81	171,250.01	260,679.99
应收账款	72,724,683.97	49,850,623.20	26,987,515.19
预付款项	9,456,675.31	4,660,681.03	2,656,256.26
其他应收款	996,678.30	7,174,513.96	943,922.99
存货	68,933,832.81	75,830,011.06	44,423,784.81
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	202,980,320.90	187,992,858.94	103,906,606.78
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	-
固定资产	56,154,895.61	52,533,466.17	47,874,237.25
在建工程	63,025.00	-	-
无形资产	20,823,615.92	14,477,023.41	16,616,954.83
长期待摊费用	3,801,717.44	1,254,687.50	280,059.14
递延所得税资产	754,702.66	447,352.71	222,452.09
非流动资产合计	81,597,956.63	68,712,529.79	64,993,703.31
资产总计	284,578,277.53	256,705,388.73	168,900,310.09

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：			
短期借款	-	-	10,000,000.00
应付票据	9,578,818.66	-	-
应付账款	48,853,607.80	54,462,688.70	34,182,127.02
预收款项	11,714,063.39	33,195,142.51	14,503,489.51
应付职工薪酬	2,551,607.00	2,650,381.00	1,518,840.80
应交税费	4,993,294.67	1,870,508.46	1,129,957.64
应付利息	-	-	-
其他应付款	3,376,250.52	3,011,450.82	2,064,999.77
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	6,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	101,067,642.04	101,190,171.49	63,399,414.74
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00
长期应付款	10,304,162.45	9,994,337.93	9,693,829.22
预计负债	1,032,107.43	918,635.93	471,286.02
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	3,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	29,836,269.88	33,612,973.86	18,865,115.24
负债合计	130,903,911.92	134,803,145.35	82,264,529.98
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	24,503,760.08	24,503,760.08	-
盈余公积	9,126,149.05	5,040,299.09	2,663,578.02
未分配利润	60,044,456.48	32,358,184.21	23,972,202.09
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	153,674,365.61	121,902,243.38	86,635,780.11
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	153,674,365.61	121,902,243.38	86,635,780.11
负债和所有者总计	284,578,277.53	256,705,388.73	168,900,310.09

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	265,554,180.78	218,662,928.46	96,475,535.02
二、营业总成本	221,040,863.64	179,395,281.80	80,318,372.07
减：营业成本	155,580,054.46	125,894,152.00	56,927,572.34
营业税金及附加	2,147,746.16	694,420.63	278,915.94
销售费用	32,348,279.13	26,686,295.21	9,738,377.55
管理费用	27,092,577.56	23,640,048.53	11,530,763.19
财务费用	2,536,419.81	1,088,213.03	1,231,050.25
资产减值损失	1,335,786.52	1,392,152.40	611,692.80
加：投资收益	-	3,397.26	-
三、营业利润	44,513,317.14	39,271,043.92	16,157,162.95
加：营业外收入	3,915,338.00	1,002,261.63	509,020.00
减：营业外支出	608,168.00	787,615.12	8,499.20
其中：非流动资产处置损益	-	-	-
四、利润总额	47,820,487.14	39,485,690.43	16,657,683.75
减：所得税费用	7,048,364.91	4,219,227.16	1,521,156.22
五、净利润	40,772,122.23	35,266,463.27	15,136,527.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	40,772,122.23	35,266,463.27	15,136,527.53
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.68	0.59	0.25
（二）稀释每股收益	0.68	0.59	0.25
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	40,772,122.23	35,266,463.27	15,136,527.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,772,122.23	35,266,463.27	15,136,527.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	257,860,690.64	249,473,390.30	106,061,300.33
收到的税费返还	260,724.00	624,053.57	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,807,672.83	1,258,049.11	1,814,399.21
经营活动现金流入小计	262,929,087.47	251,355,492.98	107,875,699.54
购买商品、接受劳务支付的现金	154,435,905.52	150,237,838.23	71,010,878.57
支付给职工以及为职工支付的现金	43,841,414.18	32,798,273.67	13,281,592.45
支付的各项税费	22,639,298.32	16,406,666.94	5,837,985.74
支付其他与经营活动有关的现金	22,756,450.95	21,462,110.59	7,559,291.06
经营活动现金流出小计	243,673,068.97	220,904,889.43	97,689,747.82
经营活动产生的现金流量净额	19,256,018.50	30,450,603.55	10,185,951.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,534,829.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	7,567,071.73
收到的其他与投资活动有关的现金	-	3,397.26	-
投资活动现金流入小计	-	3,397.26	10,101,901.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,059,238.33	10,770,609.92	7,976,995.56
投资支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	23,059,238.33	10,770,609.92	7,976,995.56
投资活动产生的现金流量净额	-23,059,238.33	-10,767,212.66	2,124,905.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,003,660.00	-	-
筹资活动现金流入小计	21,003,660.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	20,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,097,402.50	705,050.00	1,079,215.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	6,950,000.00	-
筹资活动现金流出小计	19,647,402.50	27,655,050.00	35,079,215.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,257.50	2,344,950.00	-5,079,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,249.51	-357,008.75	-10,215.18
五、现金及现金等价物净增加额	-2,840,211.84	21,671,332.14	7,221,427.27
加：期初现金及现金等价物余额	50,305,779.68	28,634,447.54	21,413,020.27
六、期末现金及现金等价物余额	47,465,567.84	50,305,779.68	28,634,447.54

（四）母公司资产负债表

单位：元

资 产	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：			
货币资金	47,345,415.67	50,305,779.68	20,634,447.54
交易性金融资产	-	-	8,000,000.00
应收票据	2,862,822.81	171,250.01	260,679.99
应收账款	72,724,683.97	49,850,623.20	26,987,515.19
预付款项	9,453,475.31	4,660,681.03	2,656,256.26
其他应收款	996,678.30	7,174,513.96	943,922.99
存货	68,933,832.81	75,830,011.06	44,423,784.81
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	202,316,908.87	187,992,858.94	103,906,606.78
非流动资产：			
长期股权投资	10,000,000.00	-	-
固定资产	56,154,895.61	52,533,466.17	47,874,237.25
在建工程	-	-	-
无形资产	11,636,430.32	14,477,023.41	16,616,954.83
长期待摊费用	3,801,717.44	1,254,687.50	280,059.14
递延所得税资产	754,702.66	447,352.71	222,452.09
非流动资产合计	82,347,746.03	68,712,529.79	64,993,703.31
资产总计	284,664,654.90	256,705,388.73	168,900,310.09

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：			
短期借款	-	-	10,000,000.00
应付票据	9,578,818.66	-	-
应付账款	48,853,607.80	54,462,688.70	34,182,127.02
预收款项	11,714,063.39	33,195,142.51	14,503,489.51
应付职工薪酬	2,551,607.00	2,650,381.00	1,518,840.80
应交税费	4,993,294.67	1,870,508.46	1,129,957.64
应付利息	-	-	-
其他应付款	3,376,250.52	3,011,450.82	2,064,999.77
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	6,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	101,067,642.04	101,190,171.49	63,399,414.74
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00
长期应付款	10,304,162.45	9,994,337.93	9,693,829.22
预计负债	1,032,107.43	918,635.93	471,286.02
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	3,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	29,836,269.88	33,612,973.86	18,865,115.24
负债合计	130,903,911.92	134,803,145.35	82,264,529.98
所有者权益：			
实收股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	24,503,760.08	24,503,760.08	-
盈余公积	9,126,149.05	5,040,299.09	2,663,578.02
未分配利润	60,130,833.85	32,358,184.21	23,972,202.09
所有者权益合计	153,760,742.98	121,902,243.38	86,635,780.11
负债和所有者总计	284,664,654.90	256,705,388.73	168,900,310.09

（五）母公司利润表

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	265,554,180.78	218,662,928.46	96,475,535.02
减：营业成本	155,580,054.46	125,894,152.00	56,927,572.34
营业税金及附加	2,147,746.16	694,420.63	278,915.94
销售费用	32,348,279.13	26,686,295.21	9,738,377.55
管理费用	26,955,817.81	23,640,048.53	11,530,763.19
财务费用	2,586,802.19	1,088,213.03	1,231,050.25
资产减值损失	1,335,786.52	1,392,152.40	611,692.80
加：投资收益	-	3,397.26	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	44,599,694.51	39,271,043.92	16,157,162.95
加：营业外收入	3,915,338.00	1,002,261.63	509,020.00
减：营业外支出	608,168.00	787,615.12	8,499.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	47,906,864.51	39,485,690.43	16,657,683.75
减：所得税费用	7,048,364.91	4,219,227.16	1,521,156.22
四、净利润	40,858,499.60	35,266,463.27	15,136,527.53

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	257,860,690.64	249,473,390.30	106,061,300.33
收到的税费返还	260,724.00	624,053.57	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,756,191.04	1,258,049.11	1,814,399.21
经营活动现金流入小计	262,877,605.68	251,355,492.98	107,875,699.54
购买商品、接受劳务支付的现金	154,435,905.52	150,237,838.23	71,010,878.57
支付给职工以及为职工支付的现金	43,841,414.18	32,798,273.67	13,281,592.45
支付的各项税费	22,612,673.32	16,406,666.94	5,837,985.74
支付其他与经营活动有关的现金	22,673,107.09	21,462,110.59	7,559,291.06
经营活动现金流出小计	243,563,100.11	220,904,889.43	97,689,747.82
经营活动产生的现金流量净额	19,314,505.57	30,450,603.55	10,185,951.72
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,534,829.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	7,567,071.73
收到的其他与投资活动有关的现金	-	3,397.26	-
投资活动现金流入小计	-	3,397.26	10,101,901.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,777,937.43	10,770,609.92	7,976,995.56
投资支付的现金	10,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	23,777,937.43	10,770,609.92	7,976,995.56
投资活动产生的现金流量净额	-23,777,937.43	-10,767,212.66	2,124,905.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,003,660.00	-	-
筹资活动现金流入小计	21,003,660.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	20,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,097,402.50	705,050.00	1,079,215.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	6,950,000.00	-
筹资活动现金流出小计	19,647,402.50	27,655,050.00	35,079,215.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,257.50	2,344,950.00	-5,079,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,249.51	-357,008.75	-10,215.18
五、现金及现金等价物净增加额	-3,500,423.87	21,671,332.14	7,221,427.27
加：期初现金及现金等价物余额	50,305,779.68	28,634,447.54	21,413,020.27
六、期末现金及现金等价物余额	46,805,355.81	50,305,779.68	28,634,447.54

二、 审计意见

本次发行委托的深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度、2010年度、2011年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（深鹏所股审字【2012】0003号），发表意见如下：

“我们认为，劲拓自动化财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了劲拓自动化2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日的财务状况以及2009年度、2010年度、2011年度的经营成果和现金流量。”

三、 财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一） 财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。重组属于同一控制下的企业合并事项，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示；重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计

年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

1、纳入合并报表子公司的基本情况

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例	表决权比例
惠州市劲拓精密装备有限公司	惠州大亚湾澳头安惠大厦 2 栋 802 号	1,000	机械设备、电子设备及其零配件的购销；无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、接驳台、AOI产品、太阳能设备的研发、设计和销售（不含商场、仓库经营）。	100%	100%

2、报告期内合并范围发生变更的情况说明

劲拓精密成立于2011年2月23日，注册资本1,000万元，为公司全资子公司，法定代表人为吴限。自2011年起惠州市劲拓精密装备有限公司纳入合并范围。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的方法

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司经销与直销两种销售模式下收入确认的具体方式如下：

（1）内销直销与经销收入确认具体方法

①装备产品：产品已经发出、最终客户已调试完成并验收后，作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入；

②配件产品：产品发出后作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

（2）出口直销与经销收入

根据出口销售合同约定，在所有权的风险和报酬转移的时点确认产品销售收

入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入。

2、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，公司于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于会计期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

报告期各期末公司营业收入中不含按照完工百分比法确认的劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

与交易相关度的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠计量时确认让渡资产使用权的收入。让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，其中利息收入金额按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定，使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具的核算方法

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款）等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(三) 应收账款坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额超过或等于 100 万元的应收款项认定为单项金额重大的应收款项，对其单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项按照同类型债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力，同类型债权历年实际坏账损失比例确定坏账准备的计提比例。

3、单独测试未发生减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大的应收账款），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

此外，本公司对各项其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

公司坏账准备计提政策是根据公司自身信用政策并结合行业平均信用水平综合确定。从公司自身信用政策角度来说，平均来看，公司设备货款除预收部分外其余货款于设备经客户验收合格后 60-90 天内支付，且根据产品类别不同以及客户信用情况不同预留订单金额 5%左右作为产品销售质保金，质保期平均约为

1年。因此，公司较大部分应收账款账龄集中在1年以内，且该部分应收账款无法全额收回的风险较低，故坏账计提比例定为3%。本公司坏账准备计提比例与可比上市公司对比如下：

账龄	天龙光电	七星电子	佳士科技	瑞凌股份	京运通	行业平均	本公司
1年以内	5%	5%	5%	5%	5%	5%	3%
1-2年	10%	10%	10%	10%	15%	11%	10%
2-3年	30%	20%	20%	20%	30%	24%	30%
3-4年	50%	30%	50%	30%	50%	42%	50%
4-5年	100%	30%	80%	50%	80%	68%	100%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

注：毛利率对比中的可比公司BTU、Applied Materials及日东科技由于适用的会计准则不同故未在本表中进行应收账款坏账计提比例的对比

上表中可比公司的选择标准为与发行人所处细分行业相同或产品属性与发行人产品相近。公司所处细分行业为电子工业专用设备制造业大行业下的电子整机装联设备制造行业以及太阳能光伏设备行业，天龙光电与京运通均为已上市太阳能光伏设备企业，七星电子核心业务同属电子设备制造行业，且其部分产品亦为太阳能光伏设备。上述三家企业，在技术原理上，均属于热工学领域中的温度控制和传热技术；制造工艺包括了钣金、机加、喷涂和装配；原材料包括了冷、热轧板、电热丝、马达和温控模块。而佳士科技与瑞凌股份均生产焊割设备，属于装备制造行业，其技术原理类似电子整机装联设备中的焊接工艺，即通过加热的方法将不同工件熔合在一起。

通过上表对比可以看出，公司各账龄应收账款的坏账准备计提比例基本均高于或与行业平均水平持平，仅1年以内应收账款坏账准备计提比例略低于行业平均水平。此外，报告期内公司账龄结构较好，各期末1年以内应收账款占比始终保持在90%以上，坏账风险较低。因此，公司坏账准备计提充分，符合谨慎性原则。

（四）存货的核算方法

1、存货的分类

公司存货分为原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品等五大类

2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

4、存货的盘存制度

公司存货的盘存制度为永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品与包装物均于领用时一次性摊销。

（五）长期股权投资的核算

1、初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

C、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资

产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（六）固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30年	5	3.17
机器设备及工具	5-10年	5	9.5-19
运输设备	5年	5	19
电子及其他设备	5年	5	19

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

（七）无形资产的核算方法

1、无形资产确认条件

无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

2、无形资产的计价与摊销

无形资产在取得时按照实际成本计价。对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用合理方法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

公司各类别无形资产具体摊销年限如下：土地使用权按使用权年限平均摊销，外购 AOI 无形资产按销量摊销，已授权专利、商标权均按 10 年平均摊销，软件按 5 年平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，则估计该无形资产的可收回金额，若该无形资产的可收回金额低于其账面价值，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（八）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（九）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

（十）政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（十一）递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：① 该项交易不是企业合并；② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；② 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

五、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响

- 1、报告期内公司会计政策未发生变更。
- 2、报告期内公司会计估计未发生变更。
- 3、报告期内公司未发生前期会计差错更正。

六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销产品销售收入	17%
	外销产品销售收入	实行“免、抵、退”
营业税	提供服务	5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

注：根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发【2010】35号）的有关规定，自2010年12月1日起，深圳市城市维护建设税率由1%调整为7%。

报告期内，公司及子公司执行的所得税税率如下：

本部	所得税税率		
	2011年	2010年	2009年
	15%	11%	10%

劲拓精密	25%	-	-
------	-----	---	---

（二）税收优惠

1、增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十五条 纳税人出口适用税率为零的货物，向海关办理出口手续后，凭出口报关单等有关凭证，可以按月向税务机关申报办理该项出口货物的退税。报告期内，发行人焊接设备、周边产品以及AOI产品出口均享受出口退税优惠。公司焊接设备报告期内各期出口退税率分别为13%、17%与17%，周边设备中上、下料机与出、入板机各期出口退税率均为17%，喷雾机各期出口退税率均为15%，AOI产品报告期内出口退税率均为15%。报告期内公司仅2010年实际收到出口退税57.04万元。

此外，财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》第一条规定“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”，且财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起延续了上述优惠政策。根据上述增值税优惠政策，报告期内2010年、2011年公司与焊接设备、AOI检测设备配套销售的软件分别收到增值税即征即退5.37万元、20.42万元。

2、企业所得税

2011年公司根据深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局深国税宝西减免备案【2011】134号税收优惠登记备案通知书，按高新技术企业15%的税率申报缴纳企业所得税。

根据深府【1998】第232号《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》第六条规定，“特区企业从事生产、经营所得和其他所得，均按15%的税率征收企业所得税”，且根据国发【2007】39号规定，“自2008年1月1日起，原享受税率优惠政策的企业，在新税法实施后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行”。

此外，根据深府【1998】第 232 号《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》第八条规定，“对从事工业、农业、交通运输等生产性行业的特区，经营期在 10 年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税”，且根据国发【2007】39 号规定，“2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税‘两免三减半’、‘五免五减半’等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止”。

公司自 2007 年开始获利，经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局下发的《减、免税批准通知书》（深国税宝西减免【2007】0115 号）核准，公司减免税期限为：2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征企业所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减半征收。

2011 年 7 月 28 日，深圳市国家税务局出具深国税函【2011】261 号《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司企业所得税税率问题的复函》对公司所得税税率实缴比例核实如下“该企业 2008 年实征税率为 0%，2009 年实征税率为 10%，2010 年实征税率为 11%，2011 年实征税率为 12%”。因此公司根据上述税收征管部门的批复文件在报告期内享受税收减免并不构成重大违法行为，公司的税务主管部门也出具了报告期内公司不存在重大税务违法违规的证明文件。

2010 年 9 月，公司取得由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准颁发的编号为 GR201044200081 的高新技术企业证书。根据《高新技术企业认定管理办法》第十二条规定“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年”，且根据新《企业所得税法》第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税”，2011 年公司根据深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局深国税宝西减免备案【2011】134 号税收优惠登记备案通知书，按高新技术企业 15% 的税率申报缴纳企业所得税。2012 年公司仍可享受 15% 的高新技术企业优惠税率。若 2013 年公司无法通过国家高新技术企业复核，则将面临所得税税率上升的风险。

报告期内公司根据上述税收优惠政策所享受的所得税优惠详细情况如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011年
公司实际缴纳税率	10%	11%	15%
适用税率	20%	22%	24%
优惠税率	10%	11%	9%
应税利润总额	1,613.20	4,040.12	4,903.81
所得税税收优惠金额	161.32	444.41	441.34

报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,307.28 万元、3,067.61 万元、3,813.46 万元，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第十条中关于拟上市公司盈利能力的要求。除此之外，2011 年 3 月，发行人控股股东及实际控制人吴限出具《承诺函》：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失。”因此，此所得税补缴风险不会对公司业绩造成重大不良影响。

综上所述，报告期内公司享受的主要税收优惠总金额及占比情况如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011年
所得税税收优惠	161.32	444.41	441.34
增值税税收优惠	-	62.41	20.42
合计	161.32	506.82	461.76
当期净利润	1,513.65	3,526.65	4,077.21
占比	10.66%	14.37%	11.33%

3、其他

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条的规定，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50% 加计扣除。

（2）根据深圳市宝安区地方税务局深地税宝西减备告【2008】053008 号告知书，公司申报的位于深圳市宝安区西乡街道鹤洲工业区的房产（宗地号：A122-0259；宗地面积：14,290.4 平方米；房产名称：厂房一、宿舍一至二、门卫一、水泵房）自 2007 年 10 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日免征房产税。

（三）发行人律师对公司享受的税收优惠发表的意见

发行人律师认为，发行人按照深圳市有关规定享受的企业所得税税收优惠没有相关国家法律或行政法规作为依据，但属深圳市依据地方规章给予深圳市企业普遍适用的优惠待遇，且经发行人税务主管部门批准。对于发行人享受的企业所得税优惠可能存在被追缴的风险，发行人实际控制人吴限承诺：“如果发行人因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担发行人因此受到的相关损失”。因此，发行人享受的地方税收优惠政策并不构成本次发行上市的障碍，发行人控股股东所作承诺真实、合法、有效，上述税收优惠到期对发行人业绩不会造成重大影响，亦不会因税收优惠可能被追缴而遭受损失。

七、分部信息

详细情况见本节“十六、盈利能力分析”之“（一）营业收入构成及其变化原因”。

八、最近一年收购兼并情况

公司最近一年无被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目20%（含）的情况。

九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内 2009 年、2010 年及 2011 年归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 13.63%、13.02%和 6.47%。非经常性损益发生的主要内容是可能被追缴的所得税，发行人已在风险因素章节披露。

报告期内公司各期非经常性损益净额占净利润的比例均较低，对公司的经营成果、财务状况不构成重大影响。具体非经常性损益明细如下表所示：

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减	-7,168.00	-187,615.12	-3,499.20

值准备的冲销部分			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	4,444,127.78	1,613,214.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,654,614.00	948,583.00	509,020.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	3,397.26	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-544,514.46	-600,000.00	-5,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益合计	3,102,931.54	4,608,492.92	2,113,735.60
减：所得税影响额	465,439.73	18,080.17	50,052.08

少数股东损益		-	-
扣除所得税、少数股东损益后非经常性损益净额	2,637,491.81	4,590,412.75	2,063,683.52

十、主要财务指标

发行人最近三年的主要财务指标如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31	
流动比率（倍）	2.01	1.86	1.64	
速动比率（倍）	1.33	1.11	0.94	
资产负债率（母公司）	45.99%	52.51%	48.71%	
归属母公司股东每股净资产（元）	2.56	2.03	1.44	
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	4.72%	8.19%	13.87%	
项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	
应收账款周转率（次）	4.33	5.69	4.38	
存货周转率（次）	2.15	2.09	1.53	
息税折旧摊销前利润（万元）	5,806.20	4,672.85	2,138.56	
利息保障倍数（倍）	23.35	56.32	16.88	
归属母公司股东净利润（万元）	4,077.21	3,526.65	1,513.65	
归属母公司股东扣除非经常损益后净利润（万元）	3,813.46	3,067.61	1,307.28	
每股经营活动现金净流量（元）	0.32	0.51	0.17	
每股净现金流量（元）	-0.05	0.36	0.12	
基本每股收益（元）	扣除前	0.68	0.59	0.25
	扣除后	0.64	0.51	0.22
稀释每股收益（元）	扣除前	0.68	0.59	0.25
	扣除后	0.64	0.51	0.22
加权平均净资产收益率	扣除前	30.08%	33.82%	19.14%
	扣除后	28.14%	29.42%	16.53%

上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。主要财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率 = 期末流动资产 / 期末流动负债
- 2、速动比率 = (期末流动资产 - 期末存货) / 流动负债
- 3、资产负债率 = 期末总负债 / 期末总资产
- 4、归属母公司股东每股净资产 = 归属于母公司所有者权益 / 期末股份总数（以股份公司成立后的最新股本 60,000,000 股计算）
- 5、无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例 = 无形资产（扣除土地使用权等

后) / 净资产

6、应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均净额

平均应收账款净额 = (期初应收账款净额 + 期末应收账款净额) / 2

7、存货周转率 = 营业成本 / 平均存货

平均存货 = (期初存货 + 期末存货) / 2

8、息税折旧摊销前利润 = 净利润 + 所得税 + 折旧 + 摊销 + 利息费用

9、利息保障倍数 = (税前利润 + 利息费用 + 资本化利息支出) / (利息费用 + 资本化利息支出)

10、每股经营活动现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股份总数 (以股份公司成立后的最新股本 60,000,000 股计算)

11、每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股份总数 (以股份公司成立后的最新股本 60,000,000 股计算)

12、加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于本公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润；NP 为归属于本公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于本公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于本公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于本公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

13、基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于本公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

14、稀释每股收益 = $【P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) * (1 - 所得税率)】 / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

十一、发行人盈利预测情况

本公司未制作盈利预测报告。

十二、发行人设立时及报告期内资产评估情况

2010年1月20日，深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2009年11月30日为评估基准日按照资产基础法对深圳市劲拓自动化设备有限公司的整体资产进行了评估，并出具深国众联评字（2010）第2-042号的《深圳市劲拓自动化设备有限公司拟股份制改造项目整体资产评估报告书》。经评估，深圳市劲拓自动化设备有限公司于评估基准日的全部资产评估价值为人民币17,127.22万元，相应的负债为人民币6,636.67万元，全部股东权益的评估价值为人民币10,490.55万元，评估增值2,040.12万元。

本次评估结果仅为满足公司整体改制需要，因此公司并未因此次评估而调整账目或财务报表。

十三、发行人设立时及报告期内历次验资情况

1、公司设立时的验资

2004年7月22日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深鹏所验字【2004】120号），对深圳市劲拓自动化设备有限公司截至2004年7月22日注册资本的实收情况进行了审验，确认公司前身劲拓有限全体股东已足额认缴注册资本人民币500万元。

2、2004年11月合口味入资时的验资

2004年8月2日，劲拓有限召开股东会，全体股东一致同意深圳市合口味食品有限公司以其所有的宗地号A122-0259的土地使用权（房产证号：深房地字第5000116886号）参股公司，并同时增加公司注册资本金额。深圳市合口味食品有限公司用以出资的土地使用权经深圳市国资源房地产评估有限公司深国资评字第200409188号《土地估价报告》评估，并经深圳市房地产估计中心深房字

247186号审定报告认可，评估价为人民币4,320,160元，双方协议入股作价为人民币4,245,121元。2004年11月5日，深圳枫桦会计师事务所出具深枫桦验字（2004）第424号《验资报告》，确认深圳市合口味食品有限公司实物资产已办完过户手续，截止2004年11月5日，劲拓有限累计注册资本实收金额为人民币9,245,121元。

3、2005年7月增资至2,300万元时的验资

2005年6月16日，劲拓有限召开股东会，一致同意将公司注册资本金由人民币9,245,121元增加至23,000,000元。2005年6月29日，深圳衡大会计师事务所出具深衡（内）验字【2005】031号《验资报告》确认，截止2005年6月22日劲拓有限累计注册资本实收金额为人民币23,000,000元

4、2005年11月增资至3,000万元时的验资

2005年11月2日，劲拓有限召开股东会，一致同意将公司注册资本金由人民币23,000,000元增加至30,000,000元。2005年11月11日，深圳衡大会计师事务所出具深衡大（内）验字【2005】097号《验资报告》确认截止2005年11月10日劲拓有限累计注册资本实收金额为人民币30,000,000元。

5、2006年11月增资至4,000万元时的验资

2006年9月19日，劲拓有限召开股东会，一致同意将公司注册资本金由人民币30,000,000元增加至40,000,000元。2006年9月30日，深圳衡大会计师事务所出具深衡大（内）验字【2006】137号《验资报告》确认截止2006年9月30日劲拓有限累计注册资本实收金额为人民币40,000,000元。

6、2007年5月增资至5,000万元时的验资

2007年5月15日，劲拓有限召开股东会，一致同意将公司注册资本金由人民币40,000,000元增加至50,000,000元。2007年5月18日，深圳衡大会计师事务所出具深衡大（内）验字【2007】061号《验资报告》确认截止2007年5月18日劲拓有限累计注册资本实收金额为人民币50,000,000元。

7、2008年9月增资至6,000万元时的验资

2008年9月16日，劲拓有限召开股东会，一致同意将公司注册资本金由人民币50,000,000元增加至60,000,000元。2008年9月24日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字【2008】160号《验资报告》确认截止2008年9

月 24 日劲拓有限累计注册资本实收金额为人民币 60,000,000 元。

8、2010 年 2 月股份有限公司成立时的验资

2010 年 1 月 8 日，劲拓有限召开股东会会议，一致同意以 2009 年 11 月 30 日作为股份公司改制基准日，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所审字【2010】034 号”审计报告审定的截至 2009 年 11 月 30 日的净资产 84,503,760.08 元按照 1: 0.710028 比例折股，折股后公司注册资本为 60,000,000 股，每股面值一元，全部为普通股。2010 年 1 月 31 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字【2010】041 号《验资报告》，确认截止 2010 年 1 月 12 日，公司注册资本人民币 60,000,000 元已由全体股东缴足。

十四、备考利润表

本公司未制作备考利润表。

十五、财务状况分析

（一）资产结构

1、资产规模和结构

报告期内，公司资产结构如下表所示：

项目	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产	20,298.03	71.33	18,799.29	73.23	10,390.66	61.52
货币资金	4,800.56	16.87	5,030.58	19.60	2,063.44	12.22
应收账款	7,272.47	25.56	4,985.06	19.42	2,698.75	15.98
存货	6,893.38	24.22	7,583.00	29.54	4,442.38	26.30
非流动资产	8,159.80	28.67	6,871.25	26.77	6,499.37	38.48
固定资产	5,615.49	19.73	5,253.35	20.46	4,787.42	28.34
无形资产	2,082.36	7.32	1,447.70	5.64	1,661.70	9.84
总资产	28,457.83	100.00	25,670.54	100.00	16,890.03	100.00

公司资产结构中流动资产所占比例高于非流动资产，报告期内该比例分别为 61.52%、73.23%和 71.33%，流动资产占总资产比重呈逐渐上升趋势，这主要是由于报告期内随着公司经营业绩快速的增长导致应收账款与存货各期末余额出现较大幅度增长。公司非流动资产以固定资产为主，非流动资产各期末余额较为

稳定，占总资产比重则随着流动资产规模的扩大而逐年下降。

2、流动资产构成

报告期内，公司流动资产构成情况列示如下：

流动资产	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	4,800.56	23.65	5,030.58	26.76	2,063.44	19.86
交易性金融资产	-	-	-	-	800.00	7.70
应收票据	286.28	1.41	17.13	0.09	26.07	0.25
应收账款	7,272.47	35.83	4,985.06	26.52	2,698.75	25.97
预付款项	945.67	4.66	466.07	2.48	265.63	2.56
其他应收款	99.67	0.49	717.45	3.82	94.39	0.91
存货	6,893.38	33.96	7,583.00	40.34	4,442.38	42.75
合计	20,298.03	100.00	18,799.29	100.00	10,390.66	100.00

报告期内，公司流动资产主要由存货、应收账款与货币资金构成。2009 年末、2010 年末及 2011 年末，三项流动资产合计占流动资产的比重分别为 88.59%、93.61%和 93.44%。

(1) 货币资金

报告期内，公司货币资金余额情况如下：

单位：万元

类别	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
现金			
其中：人民币	1.69	2.40	1.95
银行存款			
其中：人民币	4,256.61	4,869.31	1,894.20
美元	146.34	145.08	167.07
港币	13.13	13.78	0.22
其他货币资金	382.78	-	-
合计	4,800.56	5,030.58	2,063.44

2010 年末公司货币资金余额水平在当年度销售收入规模大幅度增长以及银行贷款增长的条件之下出现较大比例上涨。2011 年公司为购入固定资产与无形资产所支付现金两千多万元从而导致货币资金水平相比 2010 年同期小幅下降。此外，上表中披露的 2011 年末其他货币资金余额为公司应付票据银行保证金。

(2) 交易性金融资产

报告期内，公司交易性金融资产明细情况如下：

单位：万元

名 称	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
对公理财产品-岁月流金	-	-	800.00

公司于 2009 年 12 月 25 日向招商银行深圳宝安支行申购了岁月流金 0070 号理财产品，起息日为 2009 年 12 月 25 日，到期日 2010 年 1 月 4 日，到期年收益率 0.0155，获利总计 0.34 万元于 2010 年确认为投资收益。

（3）应收票据

公司销售合同中未明确约定支付方式，但通常情况下客户可以直接通过银行汇款支付货款，而其若要通过票据支付货款必须取得相关主管的认可。公司主管出于风险控制的考虑，基本只接受银行承兑汇票与出票人信誉度高的商业汇票。

报告期内公司应收票据各类、发生额、背书转让、贴现、期末余额等详细情况如下表所示：

单位：万元

票据种类	报告期间	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
				背书	贴现	到期收现	
银行承兑	2009 年	28.40	995.94	278.89	-	720.45	25.00
	2010 年	25.00	918.94	662.68	-	265.26	16.00
	2011 年	16.00	1,888.07	1,332.49	-	288.61	282.97
商业承兑	2009 年	-	3.28	-	-	2.21	1.07
	2010 年	1.07	1.13	-	-	1.07	1.13
	2011 年	1.13	36.72	33.41	-	1.13	3.31

由上表可以看出，公司应收票据发生额主要以银行承兑汇票为主，由于银行承兑汇票基于银行信用，因此公司期末持有的汇票以及已经背书转让的汇票均不存在重大无法收回款项的风险。截至 2011 年 12 月 31 日公司背书转出的商业承兑汇票均已到期，且公司也未收到任何持票人要求公司履行背书人义务、支付票据的请求。

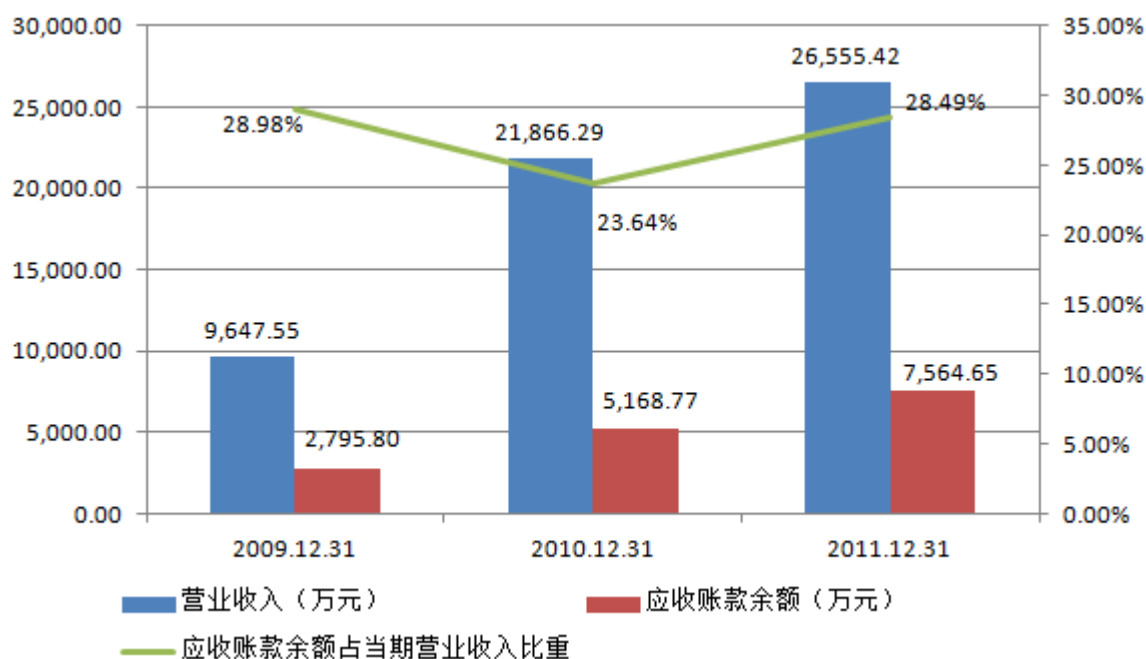
公司已制定了相关的应收票据管理制度：由总经理负责销售回款以商业汇票结算政策的审批；财务总监负责票据纠纷和因票据灭失而主张权利的法律关系的处理；公司财务部负责商业汇票的接收、登记、保管、背书、贴现、托收，并负责账务处理、定期盘点，负责大额商业汇票的查询及异常信息的反馈；营销中心负责商业汇票的接收与审核、传递、交接，负责与市场人员的信息沟通与处理，并对业务真实性负责。

(4) 应收账款

①应收账款变动情况分析

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
应收账款余额（万元）	7,564.65	5,168.77	2,795.80
应收账款余额增长比例	46.35%	84.88%	58.84%
营业收入（万元）	26,555.42	21,866.29	9,647.55
营业收入增长比例	21.44%	126.65%	33.74%
应收账款余额占当期营业收入比重	28.49%	23.64%	28.98%

报告期内公司应收账款增长与公司营业收入增长情况的对比如下图所示：



公司销售模式主要包括直销与经销两种，在此两种销售模式下公司确认收入的方式相同，收款政策也基本相同，因此报告期内公司应收账款变动情况与公司销售模式无关。此外，报告期内公司结算方式基本通过货币资金结算，票据结算比例在各期均较低，不会对公司各期末应收账款水平变动产生较大影响。因此，公司的应收账款各期末水平及其变化情况主要取决于公司的信用账期与销售收入变动情况。

公司收款一般政策为：合同签订后预付一定比例货款，其余部分货款则于设备经客户验收合格后 60-90 天内支付，根据产品类别不同以及客户信用情况不同预留订单金额 5%左右作为产品销售质保金，质保期平均约为 1 年。上述销售政策属于公司内部掌握的平均销售信用政策，针对每个客户的不同情况，公司所签订的各个销售合同中所规定的预付比例、信用期长短以及质量保证金比例、最后

收款期限等条款均不尽相同。

根据以上公司一般销售政策，以公司各期实现销售收入为基础测算公司各期末应有的应收账款余额水平过程如下表所示：

单位： 万元

	当期最后一季度收入金额	当期总收入	当期质保金金额	当期末测算应收账款金额	当期末实际应收账款余额
2009年	4,251.54	11,094.93	342.17	3,318.25	2,795.80
2010年	7,176.55	25,211.76	901.76	5,925.34	5,168.77
2011年	7,008.40	30,816.20	1,190.39	6,096.27	7,564.65

注 1：本表中列示的收入金额已还原为含税金额，其中内销收入乘以 1.17 还原，外销收入则以原值还原

注 2：2009 年-2011 年当期质保金金额=（当期总收入-当期最后一季度收入金额）*5%，

注 3：当期末测算应收账款金额=当期质保金额+当期最后一季度收入金额*（1-预收比例），预收比例按 30% 测算。

通过以上测算可以看出，报告期内除 2011 年度以外公司实际应收账款余额水平均低于按照当期最后一季度收入及质保金平均水平测算的应收账款余额水平，亦即说明除 2011 年度以外公司实际销售情况基本符合公司平均信用销售政策。

2011 年公司实际应收账款水平较高主要是由两方面原因所导致，一方面是 2011 年实际预收比例下降，另一方面是当年货款实际信用账期有所延长。预收方面，2010 年末未出货合同中 75% 左右已预收货款，与 2010 年相比，2011 年末受宏观经济环境影响该比例下降至 50% 左右，从而导致 2011 年预收比例相比 2010 年出现一定幅度下降；货款回收信用账期方面对比如下表所示：

单位： 万元

年度	项目	金额	占比
2010/12/31	期末账龄在一年以内应收余额	4,842.23	
	其中账龄超过 6 个月部分	825.51	17.05%
2011/12/31	期末账龄在一年以内应收余额	6,801.47	
	其中账龄超过 6 个月部分	1,841.56	27.08%

从上表的对比中可以看出，与 2010 年期末相比，2011 年末应收账款结构中账龄超过 6 个月部分占账龄 1 年以内应收账款余额比重有所上升，说明 2011 年在宏观货币政策收紧的外部环境下公司信用账期平均水平有所延长，但应收账款无法回收风险仍较低，2011 年末整体应收账款余额中账龄 1 年以内所占比例仍保持在 89.91% 的较高水平。

报告期各年度公司应收账款回收情况如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011年
应收账款期初余额①	1,760.17	2,795.80	5,168.77
当期含税收入总额②	11,114.93	25,442.19	30,599.21
当期预收确认收入总额③	870.40	1,437.52	3,294.16
当期新增应收总额（②-③=④）	10,244.53	24,004.68	27,305.05
应收期末余额	2,795.80	5,168.77	7,564.65
其中：属于当期新增部分⑤	2,630.98	4,842.23	6,801.47
属于来自前期部分⑥	164.83	326.54	763.18
本期收回前期应收账款总额（①-⑥=⑦）	1,595.34	2,469.26	4,405.59
本期收回本期应收账款总额（④-⑤=⑧）	7,613.55	19,162.45	20,503.58
本期应收回收现金总额（⑦+⑧）	9,208.90	21,631.71	24,909.17

报告期各年度公司应收账款回收情况与现金流量表的匹配关系如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011年
现金流量表中销售商品提供劳务收到的现金（①+②+③-④）	10,606.13	24,947.34	25,786.07
其中：本期应收回收现金①	9,208.90	21,631.71	24,909.17
本期预收收到现金②	1,394.90	3,306.68	1,146.06
期初汇票本期收到现金③	28.40	26.07	17.13
本期客户开具汇票支付应收账款但截至期末该汇票尚未收现④	26.07	17.13	286.28

②报告期各期末应收账款主要客户情况

客户名称	账龄	金额 (万元)	占应收账款 余额的比例
2011年12月31日			
斯比泰电子（深圳）有限公司	1年以内	454.40	6.01%
天津钜宝电子有限公司	1年以内	425.60	5.63%
杰特环球私人有限公司	1年以内	299.43	3.96%
伟创力制造(珠海)有限公司	1年以内	242.93	3.21%
格力电器(重庆)电子科技有限公司	1年以内	242.58	3.21%
合 计		1,664.94	22.01%
2010年12月31日			
Flextronics Computing (SuZhou) CO.,LTD	1年以内	140.00	2.71%
LIKS ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD	1年以内	137.73	2.66%
宁波高新区七鑫旗科技有限公司	1年以内	133.84	2.59%

斯比泰电子（深圳）有限公司	1 年以内	122.25	2.37%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	1 年以内	121.34	2.35%
合 计		655.15	12.68%
2009 年 12 月 31 日			
惠州市西文思电子科技股份有限公司	1 年以内	159.20	5.69%
加贺沢山电子（苏州）有限公司	1 年以内	124.98	4.47%
杰特环球私人有限公司	1 年以内	96.42	3.45%
珠海市运泰利发展有限公司	1 年以内	76.50	2.74%
东莞东坑时信电子厂	1 年以内	52.85	1.89%
合 计		509.96	18.24%

从应收账款的客户来看，报告期内各期末公司应收账款集中度不高。公司各期末应收账款前五大客户均为信誉良好的大型跨国公司或国内大中型企业，且应收账款账龄均在 1 年以内，因此该等应收账款安全性较高。公司的应收账款中不存在持有本公司 5% 以上股权的股东单位的欠款，也不存在关联交易往来款。

③应收账款账龄分析

公司应收账款余额的账龄分布如下表所示：

账龄	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	余额 (万元)	比例 (%)	余额 (万元)	比例 (%)	余额 (万元)	比例 (%)
1 年以内	6,801.47	89.91	4,842.23	93.68	2,630.98	94.10
1 至 2 年	704.08	9.31	305.82	5.92	156.63	5.60
2 至 3 年	59.10	0.78	12.52	0.24	8.20	0.29
3 至 4 年	-	-	8.20	0.16	-	-
合 计	7,564.65	100.00	5,168.77	100.00	2,795.80	100.00

从应收账款的账龄分布来看，公司绝大多数应收账款账龄不超过 1 年，应收账款质量良好。2011 年受宏观经济调控影响，应收账款账龄结构中 1 至 2 年占比同期相比有所上升。

④应收账款坏账计提分析

公司按照应收账款账龄将应收账款划分为 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4 年以上这 5 个层次，分别按照 3%、10%、30%、50%、100% 的比例计提坏账准备，报告期内公司应收账款坏账准备计提充分。

单位：万元

账龄	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	坏账计提	计提比例	坏账计提	计提比例	坏账计提	计提比例
1 年以内	204.04	3.00%	145.27	3.00%	78.93	3.00%

1 至 2 年	70.41	10.00%	30.58	10.00%	15.66	10.00%
2 至 3 年	17.73	30.00%	3.76	30.00%	2.46	30.00%
3 至 4 年	-	-	4.10	50.00%	-	-
合 计	292.18	-	183.70	-	97.05	-

⑤应收账款的管理

公司管理层非常关注应收账款的管理。为降低应收账款的增加对流动资金的占用及发生坏账的风险，公司根据变化的市场情况不断修订完善销售内控制度，并制订了《往来账款管理制度》，健全了责任追究制度，对每笔应收款项都设定明确责任人，负责清收、结账报销；若发生呆账、坏账，视金额大小，情节轻重，追究责任人责任。

(5) 预付账款

报告期内各期末公司预付账款余额分别为 265.63 万元、466.07 万元和 945.67 万元，占流动资产总额比例分别为 2.56%、2.48%、4.66%，各期末年预付款余额与占流动资产比例均不大。公司预付账款主要系预付 PECVD 氮化物沉淀系统技术转让款以及预付材料、固定资产购置款。

2010 年 10 月，公司与美国 SOUTHWEST EQUIPMENT SERVICES（西南设备服务公司）签订《PECVD 氮化物沉淀系统技术转让合同》，按照该合同约定西南设备服务公司其拥有的 PECVD 氮化物沉积系统技术转让给公司。2011 年 3 月，为组建 PECVD 生产测试线，公司与西南设备服务公司签订合同，向其购买价值总计 29.65 万美元的 PECVD 氮化处理测试设备。截至报告期末公司共计向西南设备服务公司预付技术转让和设备采购款合计 430.30 万元。

2011 年 3 月起，公司为生产 PECVD 样机委托深圳科捷物流有限公司进口相关固定资产及部件，截至报告期末公司向深圳科捷物流有限公司预付款余额为 280.63 万元。

剔除上述因素影响，报告期内公司预付账款余额分别为 265.63 万元、212.00 万元和 234.74 万元，其中主要均为公司预付的材料或设备、软件等采购款。公司 2010 年末主要预付款项情况分别如下表所示：

单位：万元

单位名称	年限	预付金额	预付款性质
SOUTHWEST EQUIPMENT SERVICES	1 年以内	254.07	预付技术转让款
上海碧昌实业有限公司	1 年以内	24.74	预付材料款

深圳市鼎泰数控机床有限公司	1 年以内	18.14	预付固定资产采购款
SONO-TEK CORPORATION	1 年以内	17.38	预付材料款
无锡新趋势科技有限公司	1 年以内	17.19	预付技术转让咨询款
合 计	-	331.52	-

公司 2011 年末主要预付款项情况分别如下表所示：

单位：万元

单位名称	年限	预付金额	预付款性质
SOUTHWEST EQUIPMENT SERVICES	2 年以内	430.30	预付技术转让款
深圳科捷物流有限公司	1 年以内	280.63	预付进口设备款
无锡新趋势科技有限公司	2 年以内	27.94	预付技术顾问费
SONO TEK CORPORATION	1 年以内	27.41	预付超声波喷雾装置采购款
上海正帆科技有限公司	1 年以内	20.94	预付 30%PECVD 车间特气输送设备款
合 计	-	787.21	-

(6) 其他应收款

公司其他应收款项构成主要为投标保证金与员工借款等。报告期内，公司其他应收款余额的账龄分布如下：

账龄	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	余额 (万元)	比例 (%)	余额 (万元)	比例 (%)	余额 (万元)	比例 (%)
1 年以内	45.88	33.18	685.81	90.32	31.46	30.66
1 至 2 年	22.07	15.96	3.87	0.51	71.14	69.34
2 至 3 年	0.72	0.52	69.61	9.17	-	-
3 至 4 年	69.61	50.34	-	-	-	-
合 计	138.27	100.00	759.29	100.00	102.59	100.00

公司 2009 年 1 月收到的深圳市宝安区科学技术局、宝安区财政局无息借款 600 万元是由深圳平安银行股份有限公司深圳华强支行综合授信提供担保，而 2010 年 12 月公司银行综合授信转至招商银行，故平安银行要求提供 600 万元保证金作为该行继续提供上述担保的条件。该笔保证金已于 2011 年 1 月收回，从而使得 2011 年末其他应收款余额相比 2010 年末大幅降低。

报告期内，公司历年其他应收款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	坏账计提	计提比例	坏账计提	计提比例	坏账计提	计提比例
1 年以内	1.38	3.00%	20.57	3.00%	0.94	3.00%
1 至 2 年	2.21	10.00%	0.39	10.00%	7.26	10.20%

2至3年	0.22	30.00%	20.88	30.00%	-	-
3至4年	34.80	50.00%	-	-	-	-
合计	38.60	-	41.84	-	8.20	-

2010年末，公司其他应收款前五名合计金额714.79万元，占其他应收款余额的94.15%。其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

欠款单位	金额 (万元)	年限	占其他应收款 余额的比重	款项性质
深圳平安银行股份有限公司车公庙支行	600.37	1年以内	79.07%	担保保证金
深圳市房屋公用设施专用基金管理中心	69.61	2至3年	9.17%	维修基金
深圳市天富安物业管理有限公司	24.22	1年以内	3.19%	租赁费
林界	10.60	1年以内	1.40%	员工借款
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	10.00	1年以内	1.32%	投标保证金
合计	714.79	-	94.15%	-

2011年末其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

欠款单位	金额	年限	占其他应收款 余额的比重	款项性质
深圳市房屋公用设施专用基金管理中心	69.61	3-4年	50.34%	房屋维修基金
深圳市天富安物业管理有限公司	17.90	1-2年	12.95%	租赁押金
邱豊闵	4.86	1年以内	3.52%	备用金
刘丁胜	4.59	1年以内	3.32%	备用金
宁波丰强电器有限公司	4.00	1年以内	2.89%	投标保证金
合计	100.96	-	73.02%	-

截至报告期末，公司其他应收款余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 存货

报告期内，随着公司生产规模和销售规模的增长，公司存货也相应增加，报告期内各期末公司存货账面价值余额分别为4,442.38万元、7,583.00万元与6,893.38万元。报告期内，公司存货明细及变动情况如下表：

项目	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	余额 (万元)	比例 (%)	余额 (万元)	比例 (%)	余额 (万元)	比例 (%)
原材料	1,744.68	25.31	1,672.49	22.06	1,457.64	32.81

半成品	818.33	11.87	524.40	6.92	286.18	6.45
在产品	1,255.46	18.21	896.84	11.83	648.82	14.61
库存商品	1,611.76	23.38	1,471.04	19.40	723.17	16.28
发出商品	1,463.15	21.23	3,018.23	39.80	1,326.56	29.86
合计	6,893.38	100.00	7,583.00	100.00	4,442.38	100.00

报告期内公司各年末存货余额变动的主要原因如下：

（1）就平均水平而言，公司核心产品焊接设备从签订订单到产品发货周期一般为 45 天，如遇订单量集中时期则此交货周期可能会有所延长。公司产成品发往客户后平均需要 2-3 个月的时间进行设备调试与验收，因此公司焊接设备较长的验收周期是公司账面存在较大金额发出商品的一个重要原因。公司 2010 年下半年订单数量相比上一年同期出现较大幅度增长，2010 年年底此部分订单中部分订单虽产品已交付客户但安装验收尚未完成，从而于期末形成较大金额的发出商品；由于公司销售货款 60%左右在设备验收完成后收取，在 2011 年国家宏观货币政策紧缩的大环境下为了缩短公司收款周期，2011 年起公司制定了新的设备验收管理政策，将售后服务部门人员的薪酬水平与其完成验收设备的台数挂钩，从而在一定程度上缩短了从设备发货到完成验收的周期。在这一政策的推动下，公司 2011 年当年新签的订单在 2011 年末形成发出商品的比例下降，加之 2011 年下半年公司订单总金额水平与 2010 年相比亦有所下降，故导致公司 2011 年末尚未确认收入的发出商品金额相比去年年末出现较大幅度下降。

（2）若截至报告期末客户订单产品已完成生产但尚未发货，则会在公司账面形成库存商品。通常情况下，客户预付账款尚未到账、客户 PCBA 生产线各设备上线时间差异等因素都会导致公司产品发货延迟，因此，因不同客户付款进度与其生产线配置进度的差异使得公司库存商品发货时间差异也较大。2010 年末库存商品余额水平相比 2009 年末大幅增长是因为当年内焊接设备与 AOI 检测设备订单数量相比 2009 年水平均大幅增长。2011 年末库存商品较上年同期小幅增长主要系公司在本年加大了对选择性波峰焊与烧结炉的市场推广力度做了少量库存机以方便快速响应客户需求以及部分已签合同客户因资金或生产线配套设备未到位原因推迟交货所致。

（3）公司在产品是指存放在生产线现场的未完工产品，而半成品则是指上道工序已完成并入库等待下一工序领用的产品。2010 年末、2011 年末公司在产品与半成品之和相比上一期末分别增长 52.00%、45.91%。2010 年公司所获订单

数量的大幅上升导致了当期末在产品与半成品余额同比上升，2011 年末在产品与半成品余额同比持续上升主要是由于公司 PECVD 项目开始进入样机组装阶段以及本年度高温烧结炉车间增加在产品等原因所导致。

(4) 报告期内，2010 年末、2011 年末公司账面原材料存货金额分别较上期末上涨 14.76%、4.32%。公司生产所采用的全工序生产模式使得公司生产所需消耗的原材料种类繁多。为了降低采购成本与保障生产顺利进行，公司通常以批量的形式采购原材料，从而使得各期末公司账面存在较大金额的原材料存货。

3、非流动资产构成

报告期内，公司非流动资产主要为固定资产和无形资产，具体构成情况如下表所示：

非流动资产	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
固定资产	5,615.49	68.82	5,253.35	76.45	4,787.42	73.66
无形资产	2,082.36	25.52	1,447.70	21.07	1,661.70	25.57
长期待摊费用	380.17	4.66	125.47	1.83	28.01	0.43
递延所得税资产	75.47	0.92	44.74	0.65	22.25	0.34
合计	8,159.80	100.00	6,871.25	100.00	6,499.37	100.00

(1) 固定资产

报告期内，公司固定资产构成如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
一、原价合计	7,140.40	6,279.18	5,436.08
其中：房屋建筑物	3,687.53	3,687.53	3,687.53
机器设备及工具	1,556.82	1,345.96	991.78
运输设备	614.56	454.73	193.78
电子及其他设备	1,281.49	790.96	562.99
二、累计折旧	1,524.91	1,025.83	648.66
其中：房屋建筑物	467.09	350.32	233.54
机器设备及工具	422.63	276.15	164.26
运输设备	224.27	143.08	81.36
电子及其他设备	410.92	256.28	169.5
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-
四、账面价值合计	5,615.49	5,253.35	4,787.42

2009 年末、2010 年末及 2011 年末公司固定资产原值分别为 5,436.08 万元、6,279.18 万元与 7,140.40 万元，其中 2010 年末、2011 年末分别较上一期期末增

长 843.10 万元、861.22 万元。2010 年公司因生产设备与运输设备采购量增加使得 2010 年末固定资产规模出现小幅上涨，2011 年因 PECVD 研发需要购入较多研发设备及装修净化 PECVD 生产车间导致当期内固定资产规模持续扩大。

截至报告期末，公司固定资产原值为 7,140.40 万元，累计折旧为 1,524.91 万元，固定资产成新率（净值/原值）为 78.64%。截至报告期末，公司固定资产成新率较高，也不存在闲置、报废等固定资产减值情形。

（2）无形资产

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
一、原价合计	2,708.51	1,780.27	1,756.07
其中：外购 AOI 无形资产	1,182.59	1,182.59	1,182.59
土地使用权	1,435.52	513.69	513.69
软件	75.39	68.97	44.77
已授权专利	13.42	13.42	13.42
已授权商标	1.60	1.60	1.60
二、累计摊销	626.15	332.56	94.37
其中：外购 AOI 无形资产	508.00	244	27
土地使用权	77.99	64.43	53.98
软件	30.61	16.08	6.84
已授权专利	8.95	7.6	6.26
已授权商标	0.61	0.45	0.29
三、减值准备累计金额	-	-	-
四、账面价值合计	2,082.36	1,447.70	1,661.70

2011 年公司全资子公司劲拓精密通过公开挂牌出让的方式竞拍取得位于广东省惠州市原西区第一工业园的土地使用权，根据双方出让合同约定向惠州市国土资源局支付土地出让金及相关税费共计 921.83 万元，从而导致 2011 年土地使用权金额同比大幅上升。

此外，根据公司与运英软件签署的《无形资产转让协议》约定的付款条件，公司购买运英软件相关无形资产实际采用的为分期付款支付方式。根据相关会计准则规定，公司购买无形资产的价款超出正常信用条件，实际具有融资性质，购入资产的成本不能以各期付款额之和确定，而应以各期付款额的现值之和确定，故无形资产入账价值应为支付价款的现值。而公司以后各期应支付运英软件的资产受让款取决于各期内 AOI 产品的销售情况，因此必须对公司未来 AOI 产品的销售情况进行合理预测才能较为合理的计量无形资产的入账价值。

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司在深天健国众联评报字（2009）第 2-20712 号《评估报告》中的预测，公司未来 AOI 产品的销售情况为：

	实际数据		评估预测数据				
	2008 年	2009 年 1-6 月	2009 年 7-12 月	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年 及以后
销量(套)	50.00	28.00	70.00	135.00	189.00	274.05	397.37

参考资产评估机构的预测，公司收购自运英软件与 AOI 相关的无形资产入账价值计算过程如下表所示：

单位： 万元

年度	评估预测 销售数量	预计每年支 付转让款	折现 利率	预付款	现值	各年确认融 资费用
2009 年 7-12 月	70.00	70.00	-	228.00	70.00	14.80
2010 年	135.00	135.00	-	-	135.00	30.05
2011 年	189.00	189.00	3.10%	-	176.78	30.98
2012 年	274.00	274.00	3.10%	-	246.20	26.80
2013 年	397.00	397.00	3.10%	-	346.00	19.13
2014 年	243.00	243.00	3.10%	-	208.60	3.65
合计	-	1,308.00	-	228.00	1,182.59	125.41

注 1：折现利率取无形资产评估基准日 5-10 年期国债综合收益率 3.1%

注 2：2009 年预计销售数量 70 台，预计支付转让款 70 万元，因 2009 年 11 月公司已向运英软件预付 228 万元，故 70 万元冲减预付款，现值即 70 万元；2010 年预计销售数量 135 台，预计支付转让款 135 万元冲减预付款，现值即 135 万元；2011 年预计销售数量 189 台，预计支付转让款 189 万元，2011 年支付的转让款中 228 万-70 万-135 万=23 万冲减预付款，189 万-23 万=166 万按照折现利率折现为 153.78 万元，故 2011 年应支付转让款现值之和为 153.78 万元+23 万元 =176.78 万元，2012 年-2014 年预计支付转让款按折现利率折现。

注 3：无形资产的入账价值为 954.59 万元+228 万元=1,182.59 万元

公司采用“工作量法”摊销与 AOI 相关的无形资产，即按当年度 AOI 实际销售量计算出当年度内应支付运英软件的受让款金额，以此金额摊销无形资产并同时计入 AOI 产品成本，直至 AOI 相关无形资产摊销完毕。2009 年，公司实际销售 27 台离线检测设备，故当年内该等无形资产入账价值摊销 27 万元，摊销金额同时计入 AOI 当年销售成本；2010 年，公司实际销售 205 台离线 AOI 与 6 台在线 AOI，故当年内该等无形资产入账价值摊销 205×1+6×2=217 万元，摊销金额同时计入 AOI 当年销售成本；2011 年，公司实际销售 216 台离线 AOI 与 24 台在线 AOI，故 2011 年该无形资产摊销 216×1+24×2=264 万元，摊销金额同时计入 AOI 当年销售成本。

公司未确认融资费用初始入账价值为 $1,308.00 - 1,182.59 = 125.41$ 万元，各年度融资费用按当期末无形资产摊余成本乘以折现率确定，即各年度融资费用 = 当期末无形资产摊余成本 * 3.1%，半年度融资费用 = 年度融资费用 / 2。具体计算过程如下：

未确认融资费用 = $1,308.00 - 1,182.59 = 125.41$ 万元

2009 年 7-12 月应确认的融资费用 = $(1,182.59 - 228.00) \times 3.1\% / 2 = 14.80$ 万元

2010 年应确认的融资费用 = $(1,182.59 - 228.00 + 14.80) \times 3.1\% = 30.05$ 万元

2011 年应确认的融资费用 = $(1,182.59 - 228.00 + 14.80 + 30.05) \times 3.1\% = 30.98$ 万元

2012 年应确认的融资费用

= $(1,182.59 - 228.00 + 14.80 + 30.05 + 30.98 - 166.00) \times 3.1\% = 26.80$ 万元

2013 年应确认的融资费用 = $(1,182.59 -$

$228.00 + 14.80 + 30.05 + 30.98 + 26.80 - 166.00 - 274.00) \times 3.1\% = 19.13$ 万元

2014 年应确认的融资费用

= $125.41 - 14.80 - 30.05 - 30.98 - 26.80 - 19.13 = 3.65$ 万元

公司具体账务处理如下：

i、2009 年度

借：无形资产	11,825,868.26
未确认融资费用	1,254,131.74
贷：长期应付款	10,800,000.00
银行存款	2,280,000.00

ii、2009 年度

借：财务费用	147,960.96
贷：未确认融资费用	147,960.96
借：主营业务成本	270,000.00
贷：无形资产-累计摊销	270,000.00

iii、2010 年度

借：财务费用	300,508.71
贷：未确认融资费用	300,508.71

借：主营业务成本	2,170,000.00
贷：无形资产-累计摊销	2,170,000.00

iv、2011 年度

借：财务费用	309,824.52
贷：未确认融资费用	309,824.52
借：主营业务成本	2,640,000.00
贷：无形资产-累计摊销	2,640,000.00

鉴于公司所购买的该等无形资产不存在外部市场，亦无可供参考的市价，因此从外部信息来源无法判断是否减值。从公司内部信息来源看，2009 年 6 月至 2011 年 12 月底，公司共计销售 448 台离线 AOI 和 30 台在线 AOI，合计应支付转让款 508 万元，在确定无形资产入账价值时预计 2009 年 6 月至 2011 年 12 月底应销售 394 台（70+135+189）离线 AOI，应计转让款 394 万元。因此，公司 AOI 检测设备产品实际销售数量大于预计销售数量，销售状况良好，无减值迹象。

除上述外购 AOI 无形资产之外，报告期内公司各项无形资产均按照实际成本计价。公司土地使用权、专利与商标、软件的摊销期限分别为 50 年、10 年、5 年，软件著作权的摊销期限为 10 年。截至 2011 年末，公司无形资产无抵押、担保情况。

公司拥有的土地使用权详细情况如下表所示：

单位：万元

权证号	获得方式	初始金额	摊销期限	报告期末摊余价值
深房地字第 5000469662 号	股东投入	513.69	50 年	438.81
惠湾国用（2011）第 210100786 号	购入	921.83	50 年	918.72

(3) 长期待摊费用

公司长期待摊费用为车间装修费用与中介机构服务费，其中装修费用于发生次月起开始按月份平均摊销。报告期内公司长期待摊费用明细如下表所示：

单位：万元

项 目	发生日期	初始成本	摊销期限（月）	2009 年末余额	2010 年末余额	2011 年末余额
厂区钢结构成品包装车间屋面装修	2008.02	11.90	36.00	4.63	0.66	-
厂区三楼新车间装修	2009.12	23.38	36.00	23.38	15.58	7.79

仓储棚装修工程	2010.09	16.00	36.00	-	14.24	8.89
PECVD 消音工程	2011.01	6.30	36.00	-	-	4.20
PECVD 消防工程	2011.07	0.24	36.00	-	-	0.20
PECVD 防撞工程	2011.07	3.78	36.00	-	-	3.15
PECVD 洁净车间工程	2011.09	6.68	36.00	-	-	5.94
中介机构费	-	-	-	-	95.00	350.00
合 计	-	35.28	-	28.01	125.47	380.17

（4）递延所得税资产

公司递延所得税资产产生于计提坏账准备与预计负债形成的暂时性差异。报告期内，各期末公司递延所得税资产余额分别为 22.25 万元、44.74 万元与 75.47 万元。公司递延所得税资产在资产总额中占比较低，对公司财务状况影响较小。报告期内公司递延所得税资产具体情况如下：

单位：万元

	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
递延所得税资产	75.47	44.74	22.25
其中：坏账准备	49.62	27.07	11.58
存货跌价准备	10.37	6.65	5.48
预计负债	15.48	11.02	5.18

4、资产减值准备的计提情况

报告期内公司资产质量良好，计提的资产减值准备主要为坏账准备和部分存货跌价准备。主要资产减值准备情况如下：

单位：万元

	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
坏账准备	93.93	11.32	-	-	105.25
存货跌价准备	-	49.85	-	-	49.85
合 计	93.93	61.17	-	-	155.10

单位：万元

	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
坏账准备	105.25	120.29	-	-	225.54
存货跌价准备	49.85	18.92	-	13.39	55.38
合 计	155.10	139.21	-	13.39	280.92

单位：万元

	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	225.55	105.24	-	-	330.78
存货跌价准备	55.38	28.34	-	14.58	69.14
合计	280.93	133.58	-	14.58	399.92

(1) 坏账准备

公司于各期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按个别认定与账龄分析相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。2009 年末、2010 年末与 2011 年末公司的应收款项坏账准备余额分别为 105.25 万元、225.55 万元与 330.78 万元。根据资产减值政策，公司已足额计提了应收款项的减值准备，报告期内公司各项应收账款未发生坏账损失，应收账款坏账准备未发生转回与转销。

(2) 存货跌价准备

公司根据成本与可变现净值孰低法，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

(3) 其他资产减值准备

除提取上述坏账准备和存货跌价准备外，公司固定资产、无形资产等资产未发生需提取减值准备的情形。

(二) 负债结构

1、负债结构分析

报告期内，公司的负债构成如下表：

负 债	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
短期借款	-	-	-	-	1,000.00	12.16
应付票据	957.88	7.32	-	-	-	-
应付账款	4,885.36	37.32	5,446.27	40.40	3,418.21	41.55
预收款项	1,171.41	8.95	3,319.51	24.62	1,450.35	17.63
应付职工薪酬	255.16	1.95	265.04	1.97	151.88	1.85
应交税金	499.33	3.81	187.05	1.39	113.00	1.37
其他应付款	337.63	2.58	301.15	2.23	206.5	2.51
一年内到期的非流动负债	2,000.00	15.28	600.00	4.45	-	-
流动负债合计	10,106.76	77.21	10,119.02	75.07	6,339.94	77.07
长期借款	1,500.00	11.46	2,000.00	14.84	600.00	7.29
长期应付款	1,030.42	7.87	999.43	7.41	969.38	11.78

预计负债	103.21	0.79	91.86	0.68	47.13	0.57
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-
其他非流动负债	350.00	2.67	270.00	2.00	270.00	3.28
非流动负债合计	2,983.63	22.79	3,361.30	24.93	1,886.51	22.93
负债总计	13,090.39	100.00	13,480.31	100.00	8,226.45	100.00

2、主要负债情况

(1) 应付账款

公司应付账款构成主要为原材料采购形成的供应商欠款，报告期各期末公司不存在其他因关联交易产生的应付账款余额。

2009年末、2010年末与2011年末公司应付账款余额分别为3,418.21万元、5,446.27万元、4,885.36万元，其中2010年末、2011年末分别较上一期末增长59.33%、-10.30%。2010年末公司应付账款前五名分别如下表所示：

单位：万元

序号	单位名称	账龄	金额	比例
1	大连理工计算机控制工程有限公司	1年以内	258.87	4.75%
2	深圳市华安精工五金模具有限公司	1年以内	188.64	3.46%
3	超汇链条（深圳）有限公司	1年以内	179.06	3.29%
4	深圳市锦发铜铝有限公司	1年以内	155.15	2.85%
5	深圳市佳平钛业有限公司	1年以内	147.51	2.71%
	合计		929.23	17.06%

2011年末公司应付账款前五名如下表所示：

单位：万元

序号	单位名称	账龄	金额	比例
1	大连理工计算机控制工程有限公司	1年以内	301.84	6.18%
2	深圳市佳平钛业有限公司	1年以内	189.62	3.88%
3	深圳市华安精工五金模具有限公司	1年以内	175.98	3.60%
4	深圳市松茂财五金制品有限公司	1年以内	161.74	3.31%
5	深圳市伟凯达电气设备有限公司	1年以内	132.08	2.70%
	合计		961.27	19.68%

公司的上游行业竞争充分，供应商较多，公司可以通过供应链管理有效控制采购成本，因此公司应付账款前五名供应商占比不大，公司也不存在对单一供应商依赖程度较高的情形。

(2) 预收账款

公司预收账款主要为设备销售预收款。2009年末、2010年末、2011年末公司预收账款余额分别为1,450.35万元、3,319.51万元与1,171.41万元，其中2010

年末、2011 年末分别较上一期末增长 128.88%、-64.71%。公司预收账款余额的波动主要是受预收账款比例调整以及销售订单总金额变化综合影响所引起的。报告期内公司预收账款比例估算过程如下表所示：

单位：万元

指标	算法	2009 年	2010 年	2011 年
①预收账款	①	1,450.35	3,319.51	1,171.41
②发出商品（成本价）	②	1,326.56	3,018.23	1,463.15
③当年销售成本率	③	59.01%	57.57%	58.59%
④发出商品（含税价）	②/③*1.17	2,630.19	6,133.98	2,921.80
⑤已签订合同但未出货	⑤	1,731.60	4,321.39	2,659.65
⑥期末未确认收入的销售金额	④+⑤	4,361.79	10,455.37	5,581.45
⑦预收账款比重	①/⑥	33.25%	31.75%	20.99%

公司各期预收账款余额对应的销售合同主要为截至期末仍未确认收入的销售合同，其中包括商品已发出但尚未验收以及销售合同签订商品仍在产两类。公司 2010 年销售订单总量的大幅上涨导致了期末尚未确认收入合同数量也大幅增长。如上表估算结果，2010 年底公司尚未确认收入的销售金额相比上一期增长 139.70%，与当期预收账款增长比例基本保持一致。

2011 年末公司预收账款余额相比 2010 年末出现较大比例下降主要是因为一方面 2011 年公司对售后服务部门人员的新的激励政策在一定程度上缩短了设备从发货到完成验收的周期，从而也缩短了预收账款结转为销售收入的周期；另一方面 2010 年末未出货合同中 75%左右已预收货款，2011 年末受宏观经济影响该比例下降至 50%左右，从而导致 2011 年预收比例相比 2010 年出现一定幅度下降。

报告期各期末公司预收账款前五名如下表所示：

单位：万元

序号	客户名称	金额	账龄	占比	内容	与公司关系
2009 年 12 月 31 日						
1	深圳市普联技术有限公司	119.84	1 年以内	8.26%	设备款	非关联方
2	深圳市捷来科技有限公司	46.50	1 年以内	3.21%	设备款	非关联方
3	祥森电子（深圳）有限公司	39.60	1 年以内	2.73%	设备款	非关联方
4	深圳市天世星电子有限公司	38.58	1 年以内	2.66%	设备款	非关联方
5	厦门立达信光电有限公司	38.40	1 年以内	2.65%	设备款	非关联方
	合 计	282.92	-	19.51%	-	-
2010 年 12 月 31 日						
1	深圳国威电子有限公司	134.96	1 年以内	4.07%	设备款	非关联方

2	深南电路有限公司	113.92	1年以内	3.43%	设备款	非关联方
3	安徽沃巴弗电子科技有限公司	82.45	1年以内	2.48%	设备款	非关联方
4	青岛汇元海泰电子有限公司	76.64	1年以内	2.31%	设备款	非关联方
5	北京和利时系统工程有限公司	63.25	1年以内	1.91%	设备款	非关联方
	合计	471.21	-	14.20%	-	-
2011年12月31日						
1	上海电子信息职业技术学院	59.83	1年以内	5.11%	设备款	非关联方
2	浙江子午光电科技有限公司	48.60	1年以内	4.15%	设备款	非关联方
3	江苏天宝汽车电子有限公司	47.60	1年以内	4.06%	设备款	非关联方
4	无锡和晶科技股份有限公司	43.07	1年以内	3.68%	设备款	非关联方
5	苏州欧普照明有限公司	41.40	1年以内	3.53%	设备款	非关联方
	合计	240.50	-	20.53%	-	-

报告期内公司主要预收账款客户均与公司不存在关联关系。截至报告期末，公司预收账款中不存在预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

（3）应付职工薪酬

截至报告期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目名称	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
1、工资、奖金、津贴	259.44	3,847.14	3,851.42	255.16
2、职工福利费	-	219.23	219.23	-
3、社会保险费	-	151.21	151.21	-
其中：医疗保险费	-	14.60	14.60	-
养老保险费	-	118.93	118.93	-
失业保险费	-	12.26	12.26	-
工伤保险费	-	4.52	4.52	-
生育保险费	-	0.89	0.89	-
4、住房公积金	5.60	61.63	67.23	-
合计	265.04	4,279.21	4,289.09	255.16

（4）应交税费

报告期内，公司应交税费构成如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
企业所得税	273.08	94.21	79.32
增值税	177.00	59.02	26.55
教育费附加	6.02	4.17	2.75
个人所得税	17.45	12.23	3.32
房产税	7.47	7.47	-

城市维护建设税	14.06	9.74	0.92
堤围防护费	0.23	0.21	0.14
地方教育费附加	4.02	-	-
合 计	499.33	187.05	113

①报告期内发行人缴纳所得税详细情况

报告期内公司应交所得税明细情况如下表所示：

单位： 万元

报告期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2009 年度	-19.85	161.32	62.15	79.32
2010 年度	79.32	444.41	429.53	94.21
2011 年度	94.21	735.57	556.70	273.08

报告期内各年度公司所得税申报数与相应年度原始财务报表、申报财务报表相应项目的勾稽关系如下表所示：

单位： 万元

内 容（2009 年）	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表与原始报表差异	申报报表与原始报表差异
一、利润总额	1,663.76	1,663.76	1,665.77	-	2.01
加：纳税调整增加额	114.06	114.06	112.05	-	-2.01
招待费支出	25.05	25.05	25.05	-	-
坏账准备计提数	11.32	11.32	11.32	-	-
存货跌价准备	66.65	66.65	49.85	-	-16.80
补计提保修期内预计发生的维修费	10.67	10.67	10.67	-	-
营业外支出	0.37	0.37	0.37	-	-
未确认融资费用	-	-	14.80	-	14.80
减：纳税调整减少额	164.61	164.61	164.61	-	-
企业开办费	4.02	4.02	4.02	-	-
加计扣除数	160.59	160.59	160.59	-	-
二、纳税调整后所得	1,613.21	1,613.21	1,613.21	-	-
三、应纳税所得额	1,613.21	1,613.21	1,613.21	-	-
企业实际税率	10%	10%	10%	-	-
四、按税法及相关规定计算的当期所得税	161.32	161.32	161.32	-	-

由上表可以看出 2009 年公司纳税申报数与企业原始财务报表数据之间无差异，原始财务报表与申报报表间的差异原因为：（1）调减存货跌价准备 16.80 万元；（2）未确认融资费用摊销 14.80 万元。

单位： 万元

内 容（2010年）	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表与原始报表差异	申报报表与原始报表差异
一、利润总额	3,948.57	3,948.57	3,948.57	-	-
加：纳税调整增加额	397.57	397.57	397.57	-	-
招待费支出	196.93	196.93	196.93	-	-
坏账准备计提数	120.29	120.29	120.29	-	-
存货跌价准备	5.56	5.56	5.56	-	-
未确认融资费用	30.05	30.05	30.05	-	-
补计提保修期内 预计发生的维修费	44.74	44.74	44.74	-	-
减：纳税调整减少额	306.02	306.02	306.02	-	-
加计扣除数	306.02	306.02	306.02	-	-
二、纳税调整后所得	4,040.12	4,040.12	4,040.12	-	-
三、应纳税所得额	4,040.12	4,040.12	4,040.12	-	-
企业实际税率	11%	11%	11%	-	-
四、按税法及相关规定 计算的当期所得税	444.41	444.41	444.41	-	-

由上表可以看出 2010 年公司纳税申报数与企业原始财务报表数据、原始财务报表数与申报报表数据之间均无差异。

单位： 万元

内 容 (2011年)	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表与原始报表差异	申报报表与纳税申报表差异
一、利润总额	4,790.69	4,790.69	4,790.69	-	-
加：纳税调整增加额	422.40	422.40	422.40	-	-
招待费支出	259.79	259.79	259.79	-	-
坏账准备计提数	105.24	105.24	105.24	-	-
存货跌价准备	13.76	13.76	13.76	-	-
补计提保修期内 预计发生的维修费	11.34	11.34	11.34	-	-
未确认融资费用	30.98	30.98	30.98	-	-
无发票费用	1.19	1.19	1.19	-	-
其他	0.10	0.10	0.10	-	-
减：纳税调整减少额	309.29	309.29	309.29	-	-
加计扣除数	309.29	309.29	309.29	-	-
二、纳税调整后所得	4,903.81	4,903.81	4,903.81	-	-
三、应纳税所得额	4,903.81	4,903.81	4,903.81	-	-
企业实际税率	15%	15%	15%	-	-
四、按税法及相规定 计算的当期所得税	735.57	735.57	735.57	-	-

由上表可以看出 2011 年度公司纳税申报数据与企业原始财务报表数据、原始财务报表数据与申报报表数据之间均无差异。

报告期内由于纳税调整导致公司会计利润总额与应纳税所得额不同，各期纳税调整明细如以上分析各表中所示。此外，报告期各期内应纳所得税额与当期所得税费用之间的差额主要是由于递延所得税所导致，明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应纳税所得额	4,903.81	4,040.12	1,613.21
税率	15%	11%	10%
本期应纳所得税额	735.57	444.41	161.32
当期所得税费用	704.84	421.92	152.12
差额（即递延所得税）	30.73	22.49	9.20

报告期各期递延所得税金额计算过程如下表所示：

单位：万元

递延项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31	2008/12/31
坏账准备	330.78	225.55	105.25	93.93
存货跌价准备	69.14	55.38	49.85	-
预计负债	103.21	91.86	47.13	36.46
合计	503.14	372.79	202.23	130.39
递延税率	15%	12%	11%	10%
各期末递延所得税资产余额	75.47	44.74	22.25	13.04
	2011 年度	2010 年度	2009 年度	-
递延所得税	30.73	22.49	9.20	-

②报告期内发行人缴纳增值税详细情况

报告期内公司应交增值税明细情况如下表所示：

单位：万元

报告期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2009 年度	-51.17	570.71	492.99	26.55
2010 年度	26.55	1,158.65	1,126.19	59.02
2011 年度	59.02	1,570.98	1,453.00	177.00

报告期内公司进项税额、销项税额核算明细情况分析如下：

i、进项税

报告期内公司进项税税目来源与核算情况如下表所示：

（以下各表货币单位均为万元）

申报抵扣的进项税项目	栏次	2009年认证抵扣			2010年认证抵扣			2011年认证抵扣		
		份数	金额	税额	份数	金额	税额	份数	金额	税额
一、认证相符的防伪税控增值税专用发票	1	2,591.00	5,504.25	855.98	5,916.00	15,167.69	2,420.91	6,118.00	14,581.15	2,391.38
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	2,591.00	5,504.25	855.98	5,916.00	15,167.69	2,420.91	6,118.00	14,581.15	2,391.38
前期认证相符且本期申报抵扣	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证	4	41.00	263.88	47.27	76.00	334.45	63.36	111.00	378.64	86.39
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	10.00	168.88	40.62	18.00	80.85	45.61	22.00	-	59.89
农产品收购发票或者销售发票	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
废旧物资专用发票	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
运输费用结算单据	8	31.00	95.00	6.65	58.00	253.60	17.75	89.00	378.64	26.50
6%扣除率	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4%扣除率	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、当期申报抵扣进项税额合计	11	2,632.00	5,768.14	903.25	5,992.00	15,502.14	2,484.27	6,229.00	14,959.79	24,77.77

报告期内公司进项税与存货采购的匹配情况如下表所示：

单位：万元

年度	年度进项税额	进项税类别	各类别进项税额	具体项目	年度	税率种类	税金	税金对应采购金额	暂估净额	非专用发票入账	实际采购
2009	903.25	存货类	775.36		2009年	3%	14.21	473.68	1,339.77	16.84	6,307.29
		固定资产	23.64			761.14	4,476.99				
		无形资产	3.49			775.36	4,950.67				
		其他	100.77			12.65	421.66				
2010	2,484.27	存货类	2,282.20	存货类	2010年	17%	2,269.55	13,350.29	-43.37	53.40	13,781.97
		固定资产	80.95			2,282.20	13,771.95				
		无形资产	3.45			12.89	429.41				
		其他	117.67			2,253.65	13,256.76				
2011	2,477.77	存货类	2,266.54		2011年	17%	2,266.54	13,686.17	-533.61	55.63	13,208.19
		固定资产	102.56			2,266.54	13,686.17				
		无形资产	1.00								
		其他	107.67								

注 1：“实际采购”列示的为报告期各期实际发生的材料采购金额，其与按照“税金对应采购额”、“暂估净额”、“非专用发票入账”之和测算出的各期采购发生额一致；

注 2：进项税类别中“其他”主要是生产经营过程中的水、电费、办公费、维修费、运输费用

ii、销项税

报告期内发行人销项税及与销售收入的配比情况详见下表所示：

单位：万元

	2009	2010	2011
总收入	9,647.55	21,866.29	26,555.42
其中：出口收入	1,133.55	2,187.05	1,495.95
内销收入	8,514.00	19,679.25	25,059.47
内销收入应交销项税	1,447.38	3,345.47	4,260.11
纳税申报销项税	1,467.38	3,575.90	4,043.80
差异金额	20.00	230.43	- 216.31
差异率	1.38%	6.89%	-5.08%

如上表所列示，报告期内各年度公司实际纳税申报销售税额与按照当年内销收入应交的销项税金差异不大，各年度具体的差异原因如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011
内销收入应交销项税	1,447.38	3,345.47	4,260.11
减：上期开票本期确认收入的销项税	-	20.00	241.83
红字发票	-	2.34	10.93
加：当期已开票但当期尚未确认收入的销项税	20.00	252.76	36.45
纳税申报销项税	1,467.38	3,575.90	4,043.80

注：2010年末已开票但尚未确认收入销项税金额为252.76万元，2011年上期开票本期确认收入金额为241.83万元，两者相差10.93万元均为2010年开票、2011年冲红所导致。

（5）其他应付款

公司其他应付款主要由产品销售运费、厂房建设与装修工程款构成，2009年末、2010年末与2011年末其他应付款余额分别为206.50万元、301.15万元与337.63万元，占当期末负债总额比例分别为2.51%、2.23%与2.58%。报告期内各期末公司其他应付款余额占比均较小，且均不存在关联方其他应付账款余额。

（6）长期借款

报告期各期末公司长期借款构成如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
长期借款	1,500.00	2,000.00	-
研发资金无息借款	-	-	600.00

合 计	1,500.00	2,000.00	600.00
-----	----------	----------	--------

据“深宝科联【2008】8号”文，公司“VS系列无铅热风回流焊机研发”和“全自动无铅电磁波峰焊锡机研发”项目获得宝安区科学技术局、财政局无息贷款600万元，期限2年。2008年12月公司与宝安区科学技术局、宝安区财政局签定编号为2008024的《深圳市宝安区科技研发资金无息借款合同书》及《深圳市宝安区科技研发资金无息借款担保合同》，担保方为深圳平安银行华强支行，贷款款项于2009年1月到账。2010年12月公司银行综合授信转至招商银行，故平安银行要求提供600万元保证金作为该行继续为该笔贷款提供担保的条件。2010年底，该笔无息贷款已转入一年内到期的非流动负债。2011年1月，公司已偿还该笔无息借款。

2010年12月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订《借款合同》，借入长期借款2,000万元，期限为两年，利率为1-3年人民币贷款基准利率5.60%，且每三个月按1-3年基准率调整，本金偿还方式为自借款之日起半年后的每季24日偿还本金人民币500万元，余款于贷款期限届满之日一次性还清。2011年4月18日，公司与该行签订《借款合同补充协议》，约定上述借款的本金偿还方式变更为在贷款期限届满之日一次性偿还完毕。2011年10月20日公司与该行签订了《固定资产借款合同（中长期借款合同）补充协议》，约定该笔贷款尚未偿还的本金由在贷款期限届满之日一次性偿还完毕改为最低每半年一次频率分期归还本金及相应利息，本金具体还款计划为：2012年1月1日归还50万元，2012年6月1日归还50万元，2012年12月1日归还50万元，2012年12月24日归还1,850万元。2011年底，该笔贷款已转入一年内到期的非流动负债。

2011年2月28日，公司与该行签订《借款合同》，借入长期借款1,500万元，期限两年，利率为以定价日中国人民银行公布的1-3年人民币贷款基准利率为基准利率，上浮8%，每三个月按1-3年基准率调整。2011年11月公司与该行签订了《固定资产借款合同（中长期借款合同）补充协议》约定该笔贷款尚未偿还的本金由在贷款期限届满之日一次性偿还完毕改为按照最低每半年一次的频率分期归还本金及相应利息，本金具体还款计划为：2012年1月1日归还50万元，2012年6月1日归还50万元，2012年12月1日归还50万元，2013年2月28日归还1,350万元。

以上两笔贷款均为公司在与该行签订的编号为 2010 年宝字第 0010408337 号的《授信协议》授信额度下的借款。

（7）长期应付款

公司于 2009 年 8 月 18 日与深圳市运英软件开发有限公司签署《无形资产转让协议》（合同编号为 2009003），根据该协议约定运英公司转让给公司三项软件著作权、四项专利技术、一项注册商标，转让价格 1,308 万元。付款方式为：① 公司应自本协议签订之日起 10 日内预先支付运英软件 228 万元；② 余款 1,080 万元的支付与公司以受让无形资产为基础所生产的 AOI 检测设备的销售量直接相关，自 2009 年起分 5 年支付，在每个会计年度结束后 2 个月内根据双方确认的销售统计数量支付。

公司因本次无形资产转让应付受让款合计 1,308.00 万元，以交易基准日 5-10 年期国债综合收益率 3.1% 为折现率确定的应付受让款的现值为 1,182.59 万元，二者的差额形成 125.41 万元未确认融资费用。报告期各期末公司该笔长期应付款净值明细情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
长期应付款余额	1,080.00	1,080.00	1,080.00
未确认融资费用	49.59	80.57	110.62
长期应付款账面净值	1,030.41	999.43	969.38

注：会计报表中未确认融资费用列示为长期应付款的减项

（8）预计负债

根据公司销售合同约定，公司主营产品销售后一般均包含免费保修期。按企业会计准则-或有事项的规定，公司根据以往发生的保修费用，在各期末按照当期产品销售收入计提保修费用，具体的计提标准为：波峰焊设备由于正常运作要求的温度更高更易出现故障，因此 2009 年波峰焊产品按收入的 1% 计提而主营业务收入中其他的产品按收入的 0.5% 计提维修费用，2010 年起公司结合往年实际维修费用发生情况综合考虑，将所有主营业务产品统一按照 1% 的比例计提保修费用。

报告期内根据公司产品销售收入应计提的预计负债金额计算如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011年
主营业务收入	9,171.97	20,889.94	25,294.40
其中：波峰焊收入①	2,611.45	5,835.35	6,621.04
预计负债计提比例②	1.00%	1.00%	1.00%
其他主营产品收入③	6,560.52	15,054.59	18,673.36
预计负债计提比例④	0.50%	1.00%	1.00%
应计提预计负债金额（①*②+③*④）	58.92	208.90	252.94

报告期内公司实际预计负债核算情况如下表所示：

单位：万元

	2009年	2010年	2011年
期初余额	36.46	47.13	91.86
当期计提金额	58.92	208.90	252.94
当期发生维修费用	48.26	164.16	241.60
期末余额	47.13	91.86	103.21

（9）其他非流动负债

公司其他非流动负债全部为政府资助专项资金，用于补贴公司新产品、新技术的研发。公司在收到该部分专项资金时计入递延收益科目，待相关产品研发完成并由政府部门验收完成后转入验收当期的营业外收入。

报告期内公司递延收益项目具体情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.10.31	2009.12.31
VS/NS 系列无铅回流焊机的研发及产业化	150.00	150.00	150.00
HS 系列热风回流焊机研发及产业化	120.00	120.00	120.00
太阳能电池烧结炉项目发展专项资金	80.00	-	-
合 计	350.00	270.00	270.00

依据工信部运【2008】97号文《关于下达2008年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》，公司与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订了《电子信息产业发展基金无偿资助项目合同书》，根据该合同，公司“VS/NS系列无铅回流焊机的研发及产业化”项目得到该基金无偿资助资金150万元，款项于2008年10月划入公司账户，该项目需由工信部电子信息产业发展基金管理办公室验收。

根据项目文件号为“深科信【2009】202号”文，公司与深圳市科技和信息局签订了《深圳市科技计划项目合同书》，根据该合同，公司“HS系列热风回流焊

机研发及产业化”项目获得深圳市科技和信息局无偿资助 120 万元，款项已于 2009 年 6 月划入公司专户。根据上述文件及相关合同规定，该资助项目需经深圳市科技和信息局验收。

根据深发改【2011】169 号《深圳市新能源产业发展专项资金项目合同书》，公司太阳能电池烧结炉项目获得深圳市科技工贸和信息化委员会无偿资助资金 80 万元，项目实施年限自合同签订之日起至 2012 年 6 月 30 日，在合同规定期限内公司应完成项目，并主动向科技工贸和信息化委员会提交验收申请与相关验收材料，项目完成后 6 个月内应经深圳市科技工贸和信息化委员会验收。

（三）偿债能力分析

1、偿债能力财务指标

报告期内，公司根据合并资产负债表中相关数据计算的有关偿债能力的财务指标列示如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动比率（倍）	2.01	1.86	1.64
速动比率（倍）	1.33	1.11	0.94
资产负债率（合并）	45.99%	52.51%	48.71%
资产负债率（母公司）	46.00%	52.51%	48.71%
项 目	2011 年	2010 年	2009 年
利息保障倍数（倍）	23.35	56.32	16.88
息税折旧摊销前利润（万元）	5,806.20	4,672.85	2,138.56

报告期内，公司流动比率均高于 1.5 倍，且流动比率与速动比率均逐年上升，资产流动性较好。报告期内由于公司流动资产中存货平均占比较高，从而使得公司速动比率水平相比流动比率较低。报告期内公司流动比率与速动比率均逐年上升。

报告期内，母公司资产负债率分别为 48.71%、52.51%和 45.99%，资产负债率维持在合理水平范围之内。2010 年末资产负债率水平相比 2009 年末出现小幅上涨主要系当年内长期借款大幅增长所致。2011 年公司资产负债率相比 2010 年下降主要源于当年经营业绩增长导致资产规模上升而 2011 年年末预收账款与应付账款均同比出现不同程度下降。

报告期内，公司业务规模发展迅速，经营状况良好，2009 年、2010 年、2011 年度公司息税折旧摊销前利润分别为 2,138.56 万元、4,672.85 万元和 5,806.20 万

元，利息保障倍数分别为 16.88、56.32 和 23.35，2011 年公司银行贷款增长导致利息支出规模大幅增长，从而使得 2011 年度利息保障倍数相比 2010 年出现较大幅度下降，但总体来看公司近年来盈利状况良好，利息保障倍数较高，偿债能力强。

2、银行授信情况

2010 年 12 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2010 年宝字第 0010408337 号”的《授信协议》，协议规定循环额度为人民币 1,500 万元，一次性额度为人民币 3,500 万元，授信期间自 2010 年 12 月 17 日至 2012 年 12 月 17 日。同时，公司与该行签订编号“2010 年宝字第 0010408337 号”的最高额抵押合同，以公司所有的“深房地字第 5000469662 号”位于深圳市宝安区西乡街道鹤洲工业区的厂房（一）【含宿舍（一）、宿舍（二）、门卫（一）、水泵房】为上述授信协议提供抵押担保。此外，公司控股股东吴限与该行签订编号为“2010 年宝字第 0010408337 号”的最高额不可撤销担保书，约定在保证范围内对公司债务承担连带清偿责任。

2011 年 9 月 15 日，发行人与中国民生银行股份有限公司深圳分行（贷款方）签订编号为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”《综合授信合同》，协议约定的授信期间为 2011 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 15 日，约定的授信额度为 8,000 万元人民币，最高授信额度可用于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证及进口代付，在授信期限内，发行人对已清偿的授信额度可再次申请使用。同时，发行人控股股东吴限与贷款方签订编号为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”的《最高额担保合同》，约定为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”《综合授信合同》下发行人的债务提供最高债权额为 8,000 万元的连带保证担保。此外，发行人与贷款方签订编号为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”的《银行承兑协议》，约定贷款方对汇票承兑时按票面金额的万分之五向发行人收取手续费。

（四）资产周转能力分析

1、应收账款周转情况分析

项目	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次）	4.33	5.69	4.38
应收账款周转天数（天）	83.14	63.25	82.15

从上表可以看出，报告期内公司应收账款周转率一直保持在较高水平，与公司订单主要货款于设备经客户验收合格后 60-90 天内收取的信用政策基本相符。2010 年公司应收账款周转率有所回升主要是因为 2009 年公司在焊接设备市场整体增长放缓的条件下为扩大公司的销售量下调了预收比例导致当期应收账款周转天数较长，2010 年预收款比例基本与 2009 年持平，稳定在 30%左右，因此应收账款周转率有所回升。2011 年度因持续的宏观紧缩货币政策导致电子制造企业资金趋紧，公司预收比例进一步下降且信用账期也相对延长，从而导致当期应收账款周转率相比 2010 年出现一定程度下降。

2、存货周转情况分析

项目	2011 年	2010 年	2009 年
存货周转率（次）	2.15	2.09	1.53
存货周转天数（天）	167.44	171.94	234.38

公司主要产品焊接设备生产过程中所需消耗的原材料品类繁多，为了降低采购成本与保障生产顺利进行，公司通常以批量的形式采购原材料，这种原材料采购方式在降低成本、保障生产的同时也在一定程度上降低了公司的存货周转速度。2010 年存货周转率相比 2009 年出现较大幅度上升主要是源于当期焊接设备与 AOI 检测设备产销率的提升，2011 年存货周转率在 2010 年基本上持续小幅提升主要是源于当期内发出商品验收周期的缩短。

3、流动资产与总资产周转情况分析

项目	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次）	4.33	5.69	4.38
应收账款周转天数（天）	83.14	63.25	82.15
存货周转率（次）	2.15	2.09	1.53
存货周转天数（天）	167.44	171.94	234.38
流动资产周转率（次）	1.36	1.50	1.05
总资产周转率（次）	0.98	1.03	0.64

报告期内，公司应收账款与存货占流动资产总额比例较高，因此流动资产周转率水平、变化情况基本与应收账款周转率、存货周转率相匹配。

2010 年，公司营业收入增速较快，而资产构成中除应收账款、存货之外其他资产 2010 年增长速度较慢，从而使得公司 2010 年总资产周转率增长幅度略高于当年度流动资产周转率增长幅度。2011 年应收账款周转率水平的下降导致流动资产周转率与总资产周转率均出现不同程度的下降。

公司管理层认为：公司资产结构相对合理，资产管理效率和盈利能力较高，公司财务状况整体处于良性循环状态。

（五）所有者权益变动分析

报告期内，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
实收资本（或股本）	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	2,450.38	2,450.38	-
盈余公积	912.61	504.03	266.36
未分配利润	6,004.45	3,235.82	2,397.22
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	15,367.44	12,190.22	8,663.58
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	15,367.44	12,190.22	8,663.58

1、股本

单位：万元

股东名称	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	出资额	比例	出资额	比例	出资额	比例
吴限	2,724.30	45.41%	2,724.30	45.41%	2,724.30	45.41%
劲通电子	573.06	9.55%	573.06	9.55%	573.06	9.55%
孔旭	451.26	7.52%	451.26	7.52%	451.26	7.52%
朱武陵	431.51	7.19%	431.51	7.19%	431.51	7.19%
主逵	399.72	6.66%	399.72	6.66%	399.72	6.66%
张纪龙	353.00	5.88%	353.00	5.88%	353.00	5.88%
柴明华	281.55	4.69%	281.55	4.69%	281.55	4.69%
毛一静	158.86	2.65%	158.86	2.65%	158.86	2.65%
罗昌昌	142.06	2.37%	142.06	2.37%	142.06	2.37%
朱玺	135.00	2.25%	135.00	2.25%	135.00	2.25%
陈洁欣	100.82	1.68%	100.82	1.68%	100.82	1.68%
罗习雄	98.86	1.65%	98.86	1.65%	98.86	1.65%
邹英	82.50	1.38%	82.50	1.38%	82.50	1.38%
张卫华	67.50	1.13%	67.50	1.13%	67.50	1.13%
合 计	6,000.00	100.00%	6,000.00	100.00%	6,000.00	100.00%

劲拓有限于 2009 年 11 月 16 日召开股东会，该次股东会决议一致同意股东柴明华将其持有的公司 4%、0.333%、1.7%、1.5%、0.917%、0.633%、1.167%、1.375%、1.125%、2.25% 的股权分别转让给吴限、张纪龙、孔旭、主逵、罗昌

昌、陈洁欣、罗习雄、邹英、张卫华、朱玺。

2010年1月8日，深圳市劲拓自动化设备有限公司召开股东会会议，一致同意以2009年11月30日作为股份公司改制基准日，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所审字【2010】034号”审计报告审定的净资产84,503,760.08元按照1:0.710028比例折股，折股后公司注册资本为60,000,000股，每股面值一元，余额24,503,760.08元列入资本公积。

2、资本公积

报告期内，公司资本公积增减变动情况如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
资本溢价（股本溢价）	2,450.38	2,450.38	-
合 计	2,450.38	2,450.38	-

3、盈余公积

报告期内，公司盈余公积增减变动情况如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
法定盈余公积金	912.61	504.03	266.36
合 计	912.61	504.03	266.36

公司2010年度、2011年度母体实现净利润分别为3,526.65万元、4,085.85万元，按照10%比例提取法定盈余公积金，2010年末与2011年末法定盈余公积金分别相比上一年末增加352.66万元、408.58万元。此外，2010年1月31日，劲拓有限以2009年11月30日的净资产8,450.38万元按照1:0.710028比例折股时，折股后公司注册资本为6,000万股，余额2,450.38万元列入资本公积，其中盈余公积转增资本公积115.00万元，未分配利润转增资本公积2,335.38万元。

4、未分配利润

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
调整前 上年末未分配利润	3,235.82	2,397.22	1,034.93
调整 年初未分配利润合计数	-	-	-
调整后 年初未分配利润	3,235.82	2,397.22	1,034.93
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	4,077.21	3,526.65	1,513.65
减： 提取法定盈余公积	408.58	352.66	151.37

应付普通股股利	900.00	-	-
所有者权益内部结转	-	2,335.38	-
期末未分配利润	6,004.45	3,235.82	2,397.22

2011年2月18日，公司召开董事会，决议将公司截止2010年末未分配利润共计3,235.82万元中的900.00万元以现金向股东分配股利，2011年3月，上述现金股利分配完毕。

十六、盈利能力分析

（一）营业收入构成及其变化原因

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2011年		2010年		2009年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务收入	25,294.40	95.25	20,889.94	95.53	9,171.97	95.07
其他业务收入	1,261.02	4.75	976.35	4.47	475.58	4.93
合计	26,555.42	100.00	21,866.29	100.00	9,647.55	100.00

报告期内公司营业收入逐年上升，2010年、2011年分别较上年增长126.65%、21.44%。公司主营业务突出，2009年、2010年和2011年公司主营业务收入占营业收入的比例分别为95.07%、95.53%和95.25%。

（1）按产品类别分类

产品名称	2011年		2010年		2009年	
	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)
焊接设备	21,588.38	81.30	18,022.95	82.42	8,237.63	85.39
周边产品	796.65	3.00	739.45	3.38	665.86	6.90
AOI	2,624.76	9.88	2,059.16	9.42	268.48	2.78
高温烧结炉	284.62	1.07	68.38	0.31	-	-
其他产品	1,261.02	4.75	976.35	4.47	475.58	4.93
合计	26,555.42	100.00	21,866.29	100.00	9,647.55	100.00

公司主要业务为焊接设备及其周边产品的销售，报告期内公司焊接设备销售收入占营业收入比重分别为85.39%、82.42%和81.30%。

2009年公司通过收购进入AOI产业，生产并销售AOI检测设备，并于当年实现268.48万元的销售收入，2010年AOI检测设备销售收入达到2,059.16万元，

相比 2009 年增长 666.97%。依托多年焊接设备制造形成的温度控制技术，公司于 2010 年成功研发出高温烧结炉产品，并于产品推出当年实现 68.38 万元的销售收入。

(2) 按产品销售地区分类

地区	2011 年		2010 年		2009 年	
	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)
内销合计	23,802.40	94.10	18,702.89	89.53	8,038.41	87.64
东北	343.28	1.36	252.21	1.21	82.56	0.90
华北	1,295.15	5.12	348.33	1.67	289.76	3.16
华东	7,526.22	29.75	4,859.91	23.26	2,165.92	23.61
华中	632.08	2.50	210.77	1.01	44.87	0.49
华南	13,197.16	52.17	12,726.78	60.92	5,291.80	57.70
西北	73.97	0.29	-	-	19.23	0.21
西南	734.55	2.90	304.89	1.46	144.27	1.57
外销合计	1,491.99	5.90	2,187.05	10.47	1,133.55	12.36
主营合计	25,294.39	100.00	20,889.94	100.00	9,171.96	100.00
其他业务收入	1,261.02	-	976.35	-	475.58	-
合计	26,555.42	-	21,866.29	-	9,647.54	-

注 1: 上表中地域划分标准为华东地区包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、江西、上海，华南地区包括广东、广西、海南，华中地区包括湖北、湖南、河南，华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古，西北地区包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃，西南地区包括四川、云南、贵州、西藏、重庆，东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江。

注 2: 本表仅对公司主营业务收入按地区划分，公司其他业务收入数据未做划分。

2、分产品收入变动分析

产品名称	2011 年			2010 年			2009 年
	收入 (万元)	增长量 (万元)	增长率 (%)	收入 (万元)	增长量 (万元)	增长率 (%)	收入 (万元)
焊接设备	21,588.38	3,565.43	19.78	18,022.95	9,785.32	118.79	8,237.63
周边产品	796.65	57.20	7.74	739.45	73.59	11.05	665.86
AOI	2,624.76	565.60	27.47	2,059.16	1,790.68	666.97	268.48
高温烧结炉	284.62	216.24	316.23	68.38	68.38	-	-
其他产品	1,261.02	284.67	29.16	976.35	500.77	105.30	475.58
合计	26,555.42	4,689.13	21.44	21,866.29	12,218.74	126.65	9,647.55

报告期内，公司营业收入呈快速增长态势，2009-2011 年年均增长率达到 87.63%。公司营业收入增长主要来自于核心产品焊接设备销售收入的增长。

公司其他产品销售收入主要是客户先期购置的焊接设备保修期过后向公司订购锡炉、电机、马达、电子元器件等焊接设备零配件而产生的销售收入。客户

设备维修需求的较大差异导致了公司该部分销售收入的波动性也较大，但所售配件均为焊接设备生产过程中所需原材料或半成品，采购或生产周期均较短，且该部分需求量较小，因此该部分零配件销售需求的波动不会对公司生产安排与财务状况产生重大影响。

（1）焊接设备收入变动原因

2010 年公司焊接设备累计实现销售收入 18,022.95 万元，相比 2009 年末增长 9,785.32 万元，增长比例为 118.79%，增长幅度较大，这主要是因为：


①经济复苏导致下游行业需求大幅度增加

2010 年在各国政府经济刺激政策的作用下，我国国内经济形势与出口环境相比 2008、2009 年均出现较大改善。就电子整机装联设备市场而言，随着电子设备更新速度的加快和全球电子制造产业的强劲复苏，国内焊接设备市场容量也出现爆发式增长，整体市场规模从 2009 年的 5.92 亿元人民币增长至 10.65 亿元人民币，增长比例高达 80%，市场规模的快速扩大为公司业绩的大幅度增长奠定了良好的基础。

②规模优势的形成成为公司赢得超越市场的发展

截至 2010 年底，公司焊接设备产量达到 1,361 台，产能水平在行业位居前列，同时当年所获订单总数量为 1,374 台，新获订单产销率接近 100%，较高的产能储备与产销率使得公司维持了市场领先地位、实现了规模优势。通过数年专业生产焊接设备的经验积累，公司具备了成熟的焊接设备生产技术以及灵活的生产安排能力，在这一良好的生产技术与生产制度保障之下，报告期内公司在维持焊接设备产品高质量标准的同时单位生产成本呈现逐年降低的趋势，这一低成本优势保证了公司在焊接设备市场竞争加剧、产品单价下降的市场条件下仍能扩大销售规模，实现盈利增长。2010 年公司焊接设备销售平均单价基本保持不变，其中部分热销型号产品单价小幅度下调，在经济危机过后众多规模较小的同行业厂商倒闭且下游需求出现恢复性增长的外部环境之下，公司以性价比更高的产品实现了销售规模的大幅度增长，拓展了市场份额。

③新系列产品的成功推出占领高端市场

2010 年，公司下游行业投资恢复迅速，且随着电子产品升级加速厂商对于焊接设备的需求也日益复杂化。公司 2009 年末推出了  高端焊接设备品牌，

其中包括 SAV 系列多功能全自动选择性波峰焊以及 R 系列高效环保回流焊，2010 年上述新系列产品均实现销售，并带动了公司销焊接设备销售单价相比 2009 年出现小幅上涨。SAV 与 R 系列高端产品的推出进一步完善了公司产品结构，未来高端产品的销售增长也将进一步提升公司焊接设备业务的盈利能力。

报告期内 2010 年度公司焊接设备产品所获订单明细如下表所示：

		订单数量（台）	订单总金额(万元)	含税销售单价 (万元)
2009 年度	第一季度	80	1,565.40	19.57
	第二季度	155	2,889.90	18.64
	第三季度	189	3,313.51	17.53
	第四季度	241	4,249.37	17.63
	总 计	665	12,018.17	18.07
2010 年度	第一季度	350	6,360.15	18.17
	第二季度	435	8,317.00	19.12
	第三季度	337	5,951.90	17.66
	第四季度	252	4,730.82	18.77
	总 计	1,374	25,359.86	18.46

如上表所示，截至 2010 年底，公司焊接设备所获订单数量相比 2009 年增长 106.62%，销售订单总金额相比 2009 年增长 111.01%，产品销售单价相比 2009 年小幅上涨。此外，2010 年末公司焊接设备销售收入相比 2009 年度增长 118.79%，收入增长幅度略高于订单总金额增长幅度，这主要是由于公司承接订单时点与确认销售收入时点之间的时差引起的。就平均水平而言，公司焊接设备从签订订单到产品发货周期一般为 45 天，设备调试与验收需要 2 个多月时间，因此公司焊接设备产品从接到订单直至客户验收通过、公司确认销售收入平均需要约一个季度的时间，即公司平均有一个季度的订单金额绝大部分要在下一期才能确认收入，因此各年度内第四季度所获订单金额的差异会导致当年度订单金额增长率与销售收入增长率出现一定差异。由于公司 2010 年度未确认收入的订单总金额相比 2009 年度增幅不大，而当年度自于上期订单的收入确认金额相比 2009 年度增长幅度较大，两者综合影响之下使得公司 2010 年销售收入增长幅度略高于订单总金额增长幅度。

2011 年公司焊接设备累计实现销售收入 21,588.38 万元,相比 2010 年增长 19.78%，增长比例相比 2010 年同期水平出现较大水平下降，这主要是因为：

①下游行业需求增长放缓导致订单量下滑

2011 年公司所获订单情况如下表所示：

		订单数量（台）	订单总金额（万元）	含税销售单价（万元）
2010 年度	第一季度	350	6,360.15	18.17
	第二季度	435	8,317.00	19.12
	第三季度	337	5,951.90	17.66
	第四季度	252	4,730.82	18.77
	总计	1,374	25,359.86	18.46
2011 年度	第一季度	346	6,069.70	17.54
	第二季度	403	7,032.59	17.45
	第三季度	288	5,058.51	17.56
	第四季度	196	3,482.14	17.77
	总计	1,233	21,642.94	17.55

受 2008 年金融危机影响，公司下游行业 2009 年内新增设备投资水平较低，2010 年随着经济环境的改善下游行业设备投资水平出现了恢复性的大幅增长，公司当年内所获订单水平也再创新高。2011 年上半年各季度公司所获订单水平环比来看基本持平，2011 年下半年在国内宏观经济形势影响下订单水平环比开始出现一定程度下降，但就价格水平而言，受价位较高的新型高端焊接设备产品销售稳定的影响，公司焊接设备订单平均价格水平 2011 年各季度环比降幅较低，2011 年全年焊接设备订单平均价格水平相比 2010 年仅小幅下降 4.93%。

②公司验收周期的缩短促进了销售收入的增长

由于公司销售货款 60%左右在设备验收完成后收取，在 2011 年国家宏观货币政策紧缩的大环境下为了缩短公司收款周期，2011 年起公司制定了新的激励政策，将售后服务部门人员的薪酬水平与其完成验收设备的台数挂钩，从而在一定程度上缩短了从设备发货到完成验收的周期。在这一政策的推动下，公司 2010 年底发出商品中超过 90%已在 2011 年上半年确认收入，同时验收周期的缩短也使得 2011 年末订单在当期末形成发出商品的比例下降。因此，公司 2011 年末未确认收入的订单总金额相比 2010 年度大幅降低，而同时 2011 年度来自于上期订单的收入确认金额相比 2010 年度又有所上升，最终使得公司 2011 年焊接设备销售收入确认金额在当年订单总金额相比 2010 年下滑的前提下仍实现了小幅增长。

（2）周边产品收入变动原因

公司所销售的周边产品主要为与焊接设备配套使用的上、下料机，接驳台，出、入板机等小型配套器械。因此周边产品销售是焊接设备销售的衍生业务，公

司主要基于客户整套设备使用便利性的考虑生产与销售周边产品，客户可以在采购本公司焊接设备时自主选择是否同时采购相应的周边产品。除此之外，公司周边产品也少部分根据客户需求单独销售，但公司并不针对焊接设备周边产品对外单独营销，该部分业务也不是公司的核心业务。

2010 年公司周边产品收入上升主要源于销售数量的上涨，2011 年虽然周边产品销售数量基本与 2010 年度持平，但当年内公司新推出了新型的双轨转角机、喷雾机，这些新型设备较高的销售单价提高了 2011 年公司周边产品的销售单价。

（3）AOI 检测设备收入变动原因

全自动光学检测设备是按照光学原理对焊接后的 PCB 板进行焊接质量检测的专用设备，相比传统人工检测其检测精度与单位耗时均有大幅度改进。在当前电子元器件市场需求的快速增长，以及电子元器件生产线 AOI 检测设备配置率仅为 20%-30%的情况下，未来 AOI 检测设备市场规模存在快速扩大的潜力。因此，公司于 2009 年 8 月通过收购深圳市运英软件开发有限公司与生产 AOI 检测设备相关的核心无形资产正式进入 AOI 产品市场，并于当年销售 27 台 AOI 检测设备，实现 268.48 万元的销售收入。

2010 年度，公司 AOI 销售收入相比 2009 年大幅度上升，这主要是由于一方面公司于 2009 年 9 月完成对生产 AOI 相关无形资产的收购，于次月才开始逐渐实现 AOI 产品销售，另一方面，2010 年度公司通过利用销售焊接销售所形成的强大营销平台优势，使得越来越多的客户认识到 AOI 检测设备的重要性与便捷性，加之公司在 2010 年对 AOI 产品进行了全面技术升级与改造，新系列 AOI 产品操作更为便捷、检测效率更好、性价比更高，从而使得 AOI 销售业绩大幅度上涨。

2011 年公司 AOI 产品实现销售收入 2,624.76 万元，相比 2010 年增长 27.47%，2011 年度 AOI 检测设备销售收入增长主要源于当年度 AOI 检测设备销售平均单价的上升。公司于 2010 年推出的在线式 AOI 检测设备于 2011 年内销售规模增长比例较大，在线式 AOI 检测设备相比离线式 AOI 检测设备较高的单价提高了当年度 AOI 检测设备的平均销售单价水平。

（二）营业成本构成及其变化原因

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务成本	14,982.03	96.30	12,011.92	95.41	5,407.35	94.99
其他业务成本	575.98	3.70	577.50	4.59	285.4	5.01
合 计	15,558.01	100.00	12,589.42	100.00	5,692.76	100.00

公司营业成本主要由主营业务成本构成，报告期内主营业务成本收入占营业成本的比例分别为 94.99%、95.41%和 96.30%。

报告期内，公司营业成本按产品类别划分如下：

产品名称	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
焊接设备	12,679.02	81.50	10,024.08	79.62	4,783.93	84.04
周边产品	538.82	3.46	522.13	4.15	450.94	7.92
AOI	1,642.10	10.55	1,427.92	11.34	172.49	3.03
高温烧结炉	122.09	0.78	37.79	0.30	-	-
其他产品	575.98	3.70	577.5	4.59	285.40	5.01
合 计	15,558.01	100.00	12,589.42	100.00	5,692.76	100.00

（三）利润构成分析

项目名称	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
营业利润	4,451.33	93.08	3,927.10	99.46	1,615.72	97.00
营业外净损益	330.72	6.92	21.46	0.54	50.05	3.00
利润总额	4,782.05	100.00	3,948.57	100.00	1,665.77	100.00

最近三年，公司利润主要来源于主营业务利润贡献。无公允价值变动净收益，投资收益和营业外收支对利润影响均较小。公司的主营业务突出，具有良好的盈利能力和持续发展能力。

1、毛利及毛利率分析

（1）毛利构成情况

产品名称	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
主营业务毛利	焊接设备	8,909.36	81.01	7,998.87	86.22	3,453.71	87.33
	周边产品	257.83	2.34	217.32	2.34	214.92	5.43
	AOI	982.65	8.94	631.24	6.80	95.99	2.43
	高温烧结炉	162.52	1.48	30.59	0.33	-	-
其他业务毛利		685.05	6.23	398.85	4.30	190.18	4.81
合计		10,997.41	100.00	9,276.87	100.00	3,954.80	100.00

从毛利构成上看，近年来公司的毛利主要来源于焊接设备产品，报告期焊接设备毛利占公司营业毛利总额的比例分别为 87.33%、86.22% 和 81.01%。

（2）主营产品毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率情况如下表所示：

产品名称	2011 年度	2010 年度	2009 年度
焊接设备	41.27%	44.38%	41.93%
周边产品	32.36%	29.39%	32.28%
AOI	37.44%	30.66%	35.75%
高温烧结炉	57.10%	44.73%	-
主营业务毛利率	40.77%	42.50%	41.04%
其他业务毛利率	54.32%	40.85%	39.99%
综合毛利率	41.41%	42.43%	40.99%

①焊接设备

报告期内公司焊接设备产品毛利变动与单位平均售价、平均成本的变动关系如下表所示：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
单位平均售价（万元）	15.53	15.85	16.34
售价较上年变动比例（%）	-2.01	-3.00	-
单位平均成本（万元）	9.12	8.82	9.49
成本较上年变动比例（%）	3.42	-7.06	-
产品毛利率（%）	41.27	44.38	41.93
毛利率变动量（%）	-3.11	2.34	-
因售价变动影响毛利率变化（%）	-1.17	-4.25	-
因成本变动影响毛利率变化（%）	-1.94	6.70	-

由上表可见，报告期内公司焊接设备平均单价与平均成本均逐年下降，但由于各年度内平均单价与平均成本下降幅度不同从而导致焊接设备毛利率出现波动。

A、售价变动原因分析

报告期内公司焊接设备产品主要型号的平均销售单价（不含税）与当期销售

占比情况如下表所示：

单位：万元

	2011 单价	2011 比例	2010 单价	2010 比例	2009 单价	2009 比例
NSM-450	25.19	0.86%	20.91	2.11%	21.42	2.58%
KK-350	11.67	9.28%	12.13	8.88%	12.82	8.33%
MS-350	14.66	10.14%	14.31	9.41%	13.37	6.35%
MS-450	14.72	11.08%	17.02	10.73%	17.06	13.49%
NS-800	20.26	0.07%	15.83	0.18%	14.81	0.60%
NS-800-N	15.99	0.22%	<u>15.99</u>	-	26.50	0.79%
NS-800II-N	19.03	3.02%	19.83	2.37%	21.15	3.77%
NS-800II	13.36	22.37%	13.67	34.39%	14.71	46.83%
NS-1000II	16.68	7.19%	16.53	11.52%	17.62	7.54%
NS-1000II-N	19.59	4.32%	22.03	9.59%	26.02	5.95%
RAD-0840	27.48	0.72%	35.62	0.44%	<u>35.62</u>	-
RAD-1040	29.45	2.23%	32.17	0.62%	<u>32.17</u>	-
RND-1040	35.73	0.07%	34.19	0.18%	<u>34.19</u>	-
RNS-1040	32.51	1.87%	30.73	0.18%	<u>30.73</u>	-
RS-1000	18.62	1.80%	<u>18.62</u>	-	-	-
ES-800	12.00	11.44%	11.71	6.60%	-	-

注：本表中加下划线的产品单价为该型号产品在当年度无销售而在下一年度实现销售，当年本无销售单价但将本年度单价调整成为与下一年度单价相同。这一调整主要是为了使产品销售结构变动导致平均单价变动幅度的计算不出现误差。产品销售结构变动引起平均单价变化幅度的计算是在假设各产品单价相比上一年度未发生变动的基础上，仅考虑当年产品销售结构发生变动而重新计算出平均单价的变动幅度。鉴于在本年度未实现销售而在下年度内产生销售的产品本年度市价并不为零，若不做出上述调整，将会影响所计算的由于销售结构变动引起平均单价变动幅度的准确性。

2010 年，公司焊接设备产品平均单价相比 2009 年共计下降 0.50 万元。若假设 2010 年公司各产品的单价相比 2009 年不发生变化，则仅由于 2010 年产品销售结构变动导致焊接设备平均单价变化为 16.68 万元，相比 2009 年上升 0.34 万元，即公司 2010 年焊接设备产品销售结构的调整在一定程度上提高了焊接设备平均单价。由上表可以看出，公司原有各型号焊接设备产品 2010 年价格下调的幅度相比 2009 年均有所收窄，且 2010 年实现销售的 SAV 系列多功能全自动选择性波峰焊以及 R 系列高效环保回流焊等新型高端焊接设备较高的价格水平在一定程度上拉高了平均价格，而原有的如 NS-1000II、MS-450、NS-800II 等热销机型销售占比仍较高，这些热销机型 2010 年销售价格的小幅下调最终导致了公司焊接设备产品 2010 年销售均价相比 2009 年出现小幅下降。

2011 年度，公司焊接设备产品平均单价与 2010 年相比仅小幅下降 0.32 万元。

若假设 2011 年各型号单价相比 2010 年不发生变化，则仅由于 2011 年产品销售结构变动导致焊接设备平均单价变化为 15.93 万元，相比 2010 年上升 0.08 万元，由此可见 2011 年公司仍通过焊接设备产品销售结构的调整在一定程度上提高了焊接设备平均单价，2011 年度公司焊接设备产品平均单价小幅下降主要受设备单价下降影响。由上表可以看出，2011 年度公司焊接设备的热销机型与 2010 年度基本相符，其中 MS-450、NS-1000II-N 价格下降较为明显，综合其他热销机型价格稳中有升以及 2011 年新产品价格高于 2010 年平均水平的影响，使得 2011 年度公司焊接设备产品价格水平与 2010 年度基本持平。

B、成本变动原因分析

报告期内，公司焊接设备产品单位成本要素的构成与所占比例如下表所示：

成本构成项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
单位直接材料成本（元）	70,619.40	65,187.37	76,846.55
直接材料占总成本比例	77.42%	73.94%	80.96%
单位直接材料成本变化率	8.33%	-15.17%	-
单位直接人工成本（元）	6,571.23	5,448.45	4,869.35
直接人工占总成本比例	7.20%	6.18%	5.13%
单位直接人工成本变化率	20.61%	11.89%	-
单位制造费用成本（元）	14,025.34	17,526.71	13,203.26
制造费用占总成本比例	15.38%	19.88%	13.91%
单位制造费用变化率	-19.98%	32.75%	-
单位总成本（元）	91,215.97	88,162.52	94,919.16

2009 年下半年起公司将一些如金属板材、金属板架等各型号设备通用的金属材料成本核算方式由归集为直接材料成本变更归集为制造费用成本，这一成本核算方式的变更导致了报告期内公司料工费比例出现较大幅度波动。出于财务分析一致性考虑，通过模拟运算假设报告期内通用金属材料在成本核算中始终计入直接材料，则报告期内公司焊接设备产品单位成本要素的构成与所占比例如下表所示：

成本构成项目	2011 年度	2010 年	2009 年度
单位直接材料成本（元）	78,510.56	75,343.69	80,747.73
直接材料占总成本比例	86.07%	85.46%	85.07%
单位直接材料成本变化率	4.20%	-6.69%	-
单位直接人工成本（元）	6,571.23	5,448.45	4,869.35
直接人工占总成本比例	7.20%	6.18%	5.13%
单位直接人工成本变化率	20.61%	11.89%	-

单位制造费用成本（元）	6,134.18	7,370.37	9,302.08
制造费用占总成本比例	6.72%	8.36%	9.80%
单位制造费用变化率	-16.77%	-20.77%	-
单位总成本（元）	91,215.97	88,162.52	94,919.16

出于财务分析过程中数据核算方式一致性的考虑，本招股说明书以上表数据为基础进行成本变动分析。

由上表可以看出，报告期内公司料、工、费比例平均水平约为 85%、6%、8%，且报告期内直接人工成本占比因生产人员工资提高而逐年上升。2010 年单位制造费用相比 2009 年下降的原因系 2010 年产量大幅增长所致，2011 年尽管产量相比 2010 年有所下降，但公司通过合理排产、新购 CNC 等加工设备减少外发加工费用等措施使得 2011 年单位制造费用相比 2010 年仍有所降低。

以上表模拟运算的结果为基础可以看出，报告期内公司焊接设备产品平均成本的变化主要是由单位直接材料成本的变动所引起。公司焊接设备产品生产过程中所需消耗的原材料种类多达近 4,000 种，在对上表中各直接材料进行归类划分后，其中主要原材料类别报告期内各年度的单台消耗量与采购均价如下表所示：

单位：元

材料类别	2011 年度			2010 年			2009 年		
	单台耗用量	采购均价	成本贡献	单台耗用量	采购均价	成本贡献	单台耗用量	采购均价	成本贡献
冷板	1,165.86	5.16	6,015.84	1,158.60	5.19	6,013.16	1,267.03	4.34	5,499.56
不锈钢板	426.65	11.03	4,705.95	421.90	11.23	4,737.90	429.62	10.25	4,403.65
铝材	215.32	22.87	4,924.37	212.65	21.37	4,544.31	259.39	21.99	5,703.96
钢材	576.43	7.17	4,133.00	571.21	7.07	4,038.45	561.11	7.67	4,303.70
钛材	15.02	145.76	2,189.32	16.86	122.18	2,059.53	25.94	114.93	2,981.03
镀锌花板	191.25	6.47	1,237.39	188.93	6.08	1,148.69	215.91	5.97	1,288.98
铜材	12.43	43.1	535.73	11.17	40.23	449.44	14.91	37.38	557.22
铁氟龙板及其他	9.76	52.63	513.67	9.75	50.62	493.30	14.06	54.37	764.35
金属材料小计	2,612.72	-	24,255.26	2,591.06	-	23,484.77	2,787.97	-	25,502.45
自动控制件	117.46	72.14	8,473.56	117.53	67.73	7,960.46	129.60	72.90	9,448.01
传动外购件	123.07	47.99	5,906.13	120.41	44.69	5,380.91	123.72	52.54	6,500.03
PLC 及温控模块	6.46	869.22	5,615.16	6.45	789.63	5,094.59	6.04	883.10	5,338.11
马达类	19.46	262.16	5,101.63	19.38	249.95	4,844.47	21.30	263.40	5,610.21
变频器	3.43	782.85	2,685.18	3.29	785.02	2,583.63	3.76	777.71	2,927.19
电箱配件	2,011.16	1.47	2,956.41	2,022.54	1.16	2,346.15	2,121.92	1.19	2,524.94
机械件类	470.12	4.67	2,195.46	463.16	4.96	2,297.89	472.83	5.06	2,393.30
开关类	56.37	47.57	2,681.52	54.26	42.22	2,290.75	58.79	46.71	2,745.84
电脑、工控机	1.06	2,112.04	2,238.76	1.12	1,877.64	2,094.01	1.15	1,778.47	2,047.68
KIC 测温、超声波及氧气分析仪	0.08	15,055.81	1,204.46	0.09	15,328.70	1,452.52	0.08	15,948.79	1,222.54
显示器、触摸屏	1.3	924.93	1,202.41	1.41	891.86	1,256.44	1.24	907.95	1,127.77
爪类	364.56	3.32	1,210.34	367.65	3.01	1,106.64	369.77	2.86	1,058.60
轴承类	127.41	9.92	1,263.91	121.76	9.06	1,103.11	127.81	10.64	1,359.81
总计	-	-	66,990.20	-	-	63,296.32	-	-	69,806.49
当年直接材料平均成本	-	-	78,510.56	-	-	75,343.69	-	-	80,747.73
占比	-	-	85.33%	-	-	84.01%	-	-	86.45%

注 1：上表采购均价系当期内各原材料购进总金额与购进数量的简单算术平均数；单台耗用量为公司各期焊接设备产成品材料领料总量除以各期焊接设备产成品投产总数量；

注 2：表中各类金属材料单台耗用量的单位均为公斤，各类非金属材料单台耗用量的单位均为个/件。

由上表可以看出，影响公司单位直接材料成本的两个主要因素为生产焊接设备的单台材料耗用量与材料采购价格，其中单台材料耗用量包括金属材料与非金属材料单台耗用量。金属材料单台耗用量的变化主要与公司当期金属板材利用率相关，非金属材料单机耗用量则主要取决于公司当期焊接设备产品构造以及销售结构的变化。通常情况下，公司生产的焊接设备的内部配置具有一定供客户选择的空間，公司会根据客户的不同需求及其采购预算为客户灵活配置其所需的焊接设备，从而使得公司即使型号相同的设备其具体配置也存在一定的差异，进而导致报告期内公司同一非金属材料或金属材料的单台耗用量出现波动。除此之外，公司对产品的技术改造也会使得材料单机耗用量发生变化。以上表所列示的明细材料为例，报告期内各成本影响因素对公司单位直接材料成本的影响程度如下表所示：

	2009 年度	2010 年度	2011 年度
上期单位直接材料成本（元）	-	69,806.49	63,296.32
本期单位直接材料成本（元）	69,806.49	63,296.32	66,990.20
总成本变动率	-	-9.33%	5.84%
其中：金属材料单台耗用量变化影响	-	-4.41%	0.04%
非金属材料单台耗用量变化影响	-	-2.35%	-0.04%
采购价格变动影响	-	-2.57%	5.84%

2010 年，公司原材料采购成本的下降与材料单台耗用量的下降共同导致了当年单位直接材料成本相比 2009 年出现一定程度下降。2010 年公司不同材料采购均价相比 2009 年变化趋势差异较大，总体来看，金属材料采购均价相比 2009 年平均上升 3.42%，而由于非金属材料采购均价降幅较大从而使得所有材料采购均价相比 2009 年平均下降 1.59%，综合来看当年度材料采购价格的变动对成本变动的的影响程度较小，当年单台直接材料成本的下降的主要原因源于材料单台耗用量的下降，而当期材料单台耗用量的变动主要是因为：

第一，公司通过设备更新、工艺改进以及废料再利用等方式提高金属材料的利用率水平。2010 年随着生产规模的进一步放大，金属材料废材率相比 2009 年出现一定程度下降；

第二，公司焊接设备产品为订单式生产，公司会根据客户订单中对产品配置、

结构的明细要求为其度身定制焊接设备产品。因此，由于客户对产品配置要求的较大差异性也使得公司即使型号相同的设备在配置、结构等方面也存在一定不同。2010 年公司大部分热销型号产品未推出升级机型，当年度非金属材料单台耗费量的变化更多是受订单差异化的影响所致而非产品结构的变化。

第三，公司于 2009 年初开始在员工中大力推行 QCC（品质管理圈）与改善提案奖制度，该制度鼓励员工个人或团队结合自身工作实际情况向主管人员提出有助于公司改善品质、节约成本的提案，公司定期对这些提案中实施效果良好的个人或团队颁发奖金、证书以及公开表彰。通过这一制度建设一方面调动了员工的工作主动性，另一方面也使得公司的生产管理不断完善与优化，在一定程度上降低材料损耗率。

2011 年度公司焊接设备单位总成本的上升主要是源于材料采购价格的上升，由上表中数据可以看出金属材料中钛材的采购单价与 2010 年相比大幅上涨约 20%，非金属材料采购单价平均上涨约 7.5%。2011 年度公司材料利用率水平与 2010 年度相比基本相当，未对当期成本变动构成重大影响。

C、公司主要产品定价能力分析

i、公司较完整的生产加工工序链以及持续的工艺改进使得公司可以通过提高金属材料利用率来降低产品的部分生产制造成本，增强了公司的生产成本控制能力及对客户需求的响应速度。

报告期内，公司焊接设备成本构成中 85% 以上为直接材料成本，因此该项直接材料采购价格对公司经营业绩有较大影响。公司所采购的直接材料可以分为金属材料与非金属材料两大类，其中金属材料价格波动性较大，公司主要通过设备更新、切割工艺改进以及废料再利用等方式提高金属材料利用率以消化材料采购价格的上涨。

ii、公司核心产品焊接设备产品属电子产品生产的专用设备，基本均为定制产品，使得公司拥有一定的成本转嫁能力。

非金属材料相比之下价格波动较小，且公司核心产品焊接设备产品基本均为定制产品，公司一般会依据客户订单的具体需求在设备生产过程中为其配置相应的物料与模块，因此对于该部分定制所需金属与非金属物料或添加选配性能所需金属与非金属物料的价格上涨公司可以在与客户签订合同时将所增加的成本


转嫁给客户，在一定程度上保证了公司的盈利能力维持在较高水平。

报告期内，公司焊接设备直接材料成本敏感性分析如下（假设条件为除单位直接材料成本变动以外，其他因素均保持不变）：

单位直接材料成本变动幅度	毛利率变动幅度		
	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1%	0.98%	0.90%	0.98%
5%	4.95%	4.59%	5.09%
敏感系数	0.98%	0.90%	0.98%

通过上表可以看出报告期内公司综合毛利率对于直接材料采购成本的敏感性程度较为稳定，可见报告期内原材料价格的波动对于公司定价能力与获利能力的影响程度较低。

iii、公司在焊接技术上的持续研发创新以及基于客户需求的研发机制与良好的品牌形象使得公司拥有较强的自主产品定价能力。

焊接设备产品作为资本性设备在行业内未出现垄断的情况下设备销售单价必然随着竞争的加剧与产品的成熟而逐渐下降。但是，不同生产厂家设备的销售单价下降速度会因厂家品牌效应程度不同、设备技术稳定性差异等而异。公司产品在行业内有着较高的知名度，“JT/劲拓”商标荣获 2010 年广东省著名商标，同时也是 2010 年深圳市知名品牌，品牌优势的提升是公司维持与提升产品定价能力的基石。除此之外，公司面向市场、基于客户需求的研发机制使得公司技术更新及时，每年均向市场推出新型产品。由于新产品推向市场时市场缺乏同类产品或同类产品很少，因此，公司可通过对新产品采用成本加成的定价方式来获取较强的定价能力。如公司 2009 年末推出的  高端焊接设备品牌，其中包括 RAD 系列回流焊及模组式选择焊设备等，产品单台价格最低在 30 万元以上，该系列产品 2010 年良好的销售情况在一定程度上提高了公司焊接设备的平均销售单价水平。

②周边产品

报告期内公司周边产品毛利变动与单位平均售价、平均成本的变动关系如下表所示：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
单位平均售价（元）	9,361.31	8,602.27	8,710.84
售价较上年变动比例（%）	8.82	-1.25	-

单位平均成本（元）	6,331.56	6,074.15	5,899.23
成本较上年变动比例（%）	4.24	2.97	-
产品毛利率（%）	32.36	29.39	32.28
产品毛利率变动量（%）	2.97	-2.89	-
因售价变动影响毛利率变化（%）	5.72	-0.86	-
因成本变动影响毛利率变化（%）	-2.75	-2.03	-

鉴于周边产品并非公司核心产品，公司对其研发投入较低，技术改造也较少，从而导致周边产品成本基本随其主要原材料，即金属材料的价格波动而变动，报告期内金属材料采购价格的逐年上升导致周边产品平均成本亦逐年上升。

2011年度公司周边产品毛利率相比2010年略有上升主要是由于当年内公司新推出的双轨转角机、喷雾机等新型号产品较高的销售单价提高了当年度周边产品的平均售价。

③AOI检测设备

公司于2009年通过收购进入AOI市场，当年实现收入268.48万元，毛利率为35.75%。2010年AOI检测设备毛利率达到30.66%，相比2009年下降5.09个百分点，2009年、2010年公司AOI检测设备毛利变动与单位平均售价、平均成本的变动关系如下表所示：

项目	2011年度	2010年度	2009年度
单位平均售价（元）	109,364.85	97,590.45	99,436.59
售价较上年变动比例（%）	12.07	-1.86	-
单位平均成本（元）	68,420.95	67,673.73	63,885.76
成本较上年变动比例（%）	1.10	5.93	-
产品毛利率（%）	37.44	30.66	35.75
产品毛利率变动量（%）	6.78	-5.09	-
因售价变动影响毛利率变化（%）	7.46	-1.21	-
因成本变动影响毛利率变化（%）	-0.68	-3.88	-

由上表可以看出，AOI检测设备单价的下降与平均成本的上升共同导致了产品毛利率水平在2010年出现小幅度下降。AOI检测设备平均成本在2010年上涨5.93%主要由两方面因素所造成：一方面2010年公司对AOI检测设备进行了较多的技术改造与产品升级，当年内推出的新型号AOI检测设备性能大幅提升的同时单台成本也有所提高，另一方面AOI检测设备生产所需消耗的工业相机、XY-Table等核心原材料采购价格相比2009年也出现一定幅度上升。2010年AOI检测设备平均销售价格相比2009年度降低1.86%，变动幅度较小，属于产品价

格的正常波动。

2011 年度公司 AOI 产品平均销售单价相比 2010 年出现较大幅度上涨，这主要由 AOI 产品销售结构的变动所引起。2011 年度单价较高的新型 JTA-220-2M、JTA-420-2M 等在线式 AOI 检测设备销售比重相比 2010 年出现较大幅度提升从而带动了 AOI 产品平均单价的上升。

④高温烧结炉

2010 年公司高温烧结炉产品实现销售，销售毛利率为 44.73%。2011 年度高温烧结炉产品实现销售收入 284.62 万元，平均销售单价为 71.15 万元，销售毛利率为 57.10%，毛利率相比 2010 年出现一定幅度上涨主要因为产品平均售价由 61.82 万元上升至 71.15 万元。未来随着国家对于光伏发电相关优惠扶持政策的逐步出台与落实，公司高温烧结炉产品销售收入规模与毛利率水平均有望进一步提升。

（3）综合毛利率变动分析

最近三年，公司综合毛利率分别为 40.99%、42.43%和 41.41%，综合毛利率保持较高水平。报告期内各类产品毛利对综合毛利率的贡献（即各类产品毛利率×各类产品销售收入占主营业务收入的比率）如下表所示：

产品名称	2011 年度	2010 年度	2009 年度
焊接设备	33.55%	36.58%	35.80%
周边产品	0.97%	0.99%	2.23%
AOI	3.70%	2.89%	0.99%
高温烧结炉	0.61%	0.14%	-
其他产品	2.58%	1.82%	1.97%
合计	41.41%	42.43%	40.99%

从上表可以看出，影响公司综合毛利率水平的主要因素是焊接设备产品的毛利水平，报告期内公司焊接设备产品对综合毛利率的贡献度分别为 35.80%、36.58%和 33.55%。周边产品的毛利贡献度由于周边产品毛利率水平的下降而下滑，AOI 产品的毛利贡献度则由于 AOI 产品收入规模在 2010 年大幅度上涨而出现较大幅度的上升。

（4）公司综合毛利率与同行业公司比较分析

报告期内，公司与可比公司毛利率水平如下表所示：

公司名称	2011 年度	2010 年度	2009 年度
BTU	41.41%	41.36%	27.46%

Applied Materials	41.90%	38.91%	28.54%
日东科技	-	13.38%	13.50%
天龙光电	41.35%	36.39%	35.51%
七星电子	28.70%	30.49%	32.32%
佳士科技	30.49%	34.14%	35.69%
瑞凌股份	27.29%	28.24%	27.78%
京运通	50.27%	43.24%	34.73%
平均	37.34%	35.65%	32.40%
劲拓股份	41.41%	42.43%	40.99%

注 1：以上 2009、2010 年数据均取自各公司年报，2011 年度劲拓股份为全年毛利率，其他可比公司因 2011 年报尚未披露以 2011 年中报数据做比较。其中，七星电子仅选取其较具可比性的集成电路制造设备业务的毛利率。日东科技主营业务中包括一部分经销其他品牌设备，该部分业务毛利率较低从而拉低了其综合毛利率水平，其公开资料中无法获得分业务毛利率，故在计算行业平均值时将其作为异常值剔除。

注 2：Applied Materials 公司会计期间为上年度 11 月 1 日至本年度 10 月 31 日，日东科技会计期间为上年度 4 月 1 日至本年度 3 月 31 日。

注 3：可比公司 2011 中期财务数据均为未经审计数据。

公司所处细分行业为电子工业专用设备制造业大行业下的电子整机装联设备制造行业以及太阳能光伏设备行业，上表中可比公司的选择标准为与公司所处细分行业相同或产品属性与公司产品相近。其中，BTU、Applied Materials 及日东科技为境外上市公司，BTU 产品结构中同样包括焊接设备与光伏设备，Applied Materials 主营业务之一为半导体设备、集成电路设备制造，日东科技主营业务之一为电子组装设备生产与销售；境内上市企业中，天龙光电与京运通均为已上市太阳能光伏设备企业，七星电子核心业务同属于电子设备制造行业，而佳士科技与瑞凌股份均生产焊割设备，与公司核心产品焊接设备属性相近。

由上表可以看出，公司综合毛利率水平略高于国内同行业公司，这主要得益于公司成熟的生产工艺使得公司可以选取不同的材料对产品进行灵活配置来满足客户差异化的需求，同时公司会适时根据市场需求的变化情况淘汰销量下滑的机型并适时推出新产品或原产品的升级机型，这一产品结构的适时调整在一定程度上维持了公司的盈利能力。此外，与同行业内大多数企业机加等工艺流程通过外购或外协的方式完成不同，公司通过采购金属板材原材料自行完成从钣金切割、机加到装配这一完整的工艺流程，这一独立、完整的全流程生产模式为公司保存了一定的利润空间。此外，所列示的公司中除七星电子集成电路制造设备业务与公司业务基本相同外，其他与公司业务存在一定的差异，故其毛利率也与公司毛利率水平存在一定差异，如佳士科技与瑞凌股份产品虽与公司产品同属焊接

产品，但其产品为“钢铁缝纫机”，主要用于建筑、机械制造、造船、钢结构、车辆制造等行业，而公司所生产焊接设备属于电子整机装联生产线上核心设备之一，主要应用于电子元器件与 PCB 线路板焊接过程。

与国外厂商相比，公司的毛利率水平基本与之持平且比其更为稳定，这主要是由于一方面公司的焊接设备产品所面对的主要客户群体与国外厂商基本相同，均为中高端客户，另一方面在经济危机的外部环境影响之下，公司通过积极的销售政策调整与生产成本管理使得毛利率维持在较为稳定的水平。未来预计随着高端焊接设备产品与高温烧结炉产品销售规模的逐步扩大，公司毛利率水平有望在现有水平基础之上小幅上升。

2、营业税金及附加

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
教育费附加	52.91	44.18	20.19
城建税	123.45	23.08	6.73
堤围费	2.66	2.19	0.98
地方教育附加	35.27	-	-
营业税	0.49	-	-
合 计	214.77	69.44	27.89

3、期间费用

公司报告期内期间费用情况如下表所示：

项目	2011 年度			2010 年度			2009 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
销售费用	3,234.83	12.18	21.22	2,668.63	12.20	174.03	973.84	10.09
管理费用	2,709.26	10.20	14.60	2,364.00	10.81	105.02	1,153.08	11.95
财务费用	253.64	0.96	133.08	108.82	0.50	-11.60	123.11	1.28
合 计	6,197.73	23.34	20.54	5,141.46	23.51	128.51	2,250.02	23.32

注：此处占比是指各项期间费用占同期营业收入的比重

(1) 销售费用

公司销售费用主要由销售人员工资与福利、销售运费与保险、差旅费等构成，2009 年、2010 年和 2011 年公司销售费用的金额分别为 973.84 万元、2,668.63 万元和 3,234.83 万元，各期销售费用分别占营业收入的 10.09%、12.20% 和 12.18%。报告期内公司各期主要销售费用项目如下：

项目	2011年度			2010年度			2009年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
工资及福利	1,452.07	44.89	36.71	1,062.18	39.80	174.04	387.60	39.80
运输及保险	545.18	16.85	1.59	536.67	20.11	150.83	213.96	21.97
差旅费	361.01	11.16	6.48	339.03	12.70	200.43	112.85	11.59
业务招待费	283.11	8.75	14.06	248.21	9.30	733.76	29.77	3.06
维修费	252.94	7.82	23.00	208.90	7.83	250.44	59.61	6.12
折旧费	81.27	2.51	30.20	62.42	2.34	49.33	41.80	4.29
展览费	129.63	4.01	18.54	109.36	4.10	29.39	84.52	8.68
合计	3,105.21	95.99	-	2,566.77	96.18	-	930.11	95.51

报告期内公司销售费用增长幅度较大这主要是因为：

①公司 2010 年、2011 年销售费用增速较快主要是由于公司销售模式以直销为主，报告期销售及售后服务人员人数及薪酬与福利的增长是导致公司销售费用增长最主要原因。报告期内 2009 年焊接设备产品整体市场规模受经济危机影响而增速放缓，公司于当年内调整了销售激励政策，调整的主要内容之一即为提高销售人员奖金、福利与其实现销售量与销售收入之间的关联度，且这一政策在 2010 年度、2011 年度持续推广与完善。在这一销售政策调整的作用之下，2010 年公司焊接设备订单数量同比增长 106.62%，直接带动了公司当期销售人员工资、差旅支出的大幅增加。报告期内为拓展公司新产品 AOI 检测设备与烧结炉市场，公司销售人员人数数量有所增加亦带动了销售人员工资与福利费用的持续上涨。此外，2011 年内公司对售后服务人员激励政策的调整也促使销售费用中工资与福利费用、差旅费用在 2011 年内持续上涨。

②公司运费及保险费用的增长主要取决于当期发出商品的总数量以及报告期内销售地区分布。2010 年由于公司焊接设备与 AOI 检测设备销售数量的同时大幅上涨使得该项支出于当年内大幅增长。2011 年度公司发出商品总数有所下降、销售地区中华东地区销售量的增长综合导致了当期运费及保险支出小幅增长。

③ 2009 年受经济危机影响焊接设备市场需求低迷，公司因而于当期减少了大量展销、广告等营销活动，销售增长主要依靠销售人员的营销活动。2010 年随着市场回暖，公司营销活动恢复正常，从而使得当期业务招待与展览费用相比 2009 年均均有较大幅度增长。

（2）管理费用

公司管理费用主要由税费、研发费、管理人员工资与福利、通讯费、办公费用等构成，2009年、2010年和2011年度，公司管理费用的金额分别为1,153.08万元、2,364.00万元和2,709.26万元，各期管理费用分别占营业收入的11.95%、10.81%和10.20%。报告期内公司管理费用主要项目明细如下：

项目	2011年度			2010年度			2009年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	增长率 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
研究开发费	1,192.77	44.03	0.04	1,192.27	50.43	96.32	607.30	52.67
工资及福利	538.57	19.88	20.22	447.97	18.95	121.06	202.65	17.57
办公费	189.74	7.00	36.23	139.28	5.89	100.26	69.55	6.03
折旧及摊销	112.73	4.16	10.15	102.34	4.33	17.20	87.32	7.57
差旅费	97.29	3.59	2.13	95.26	4.03	202.89	31.45	2.73
中介机构费	45.50	1.68	-35.52	70.56	2.98	394.46	14.27	1.24
维护费	110.22	4.07	66.55	66.18	2.80	204.70	21.72	1.88
业务招待费	106.79	3.94	83.97	58.05	2.46	76.66	32.86	2.85
合计	2,393.61	88.35	183.77	2,171.91	91.87	1,213.55	1,067.12	92.54

公司管理费用2010年、2011年较上期分别上涨105.02%、14.60%，增长幅度均低于营业收入增幅，其中主要费用项目变化原因如下：

①如上表所示，公司管理费用支出中50%左右为研发费用支出，研发费用的增减变化在很大程度上决定了公司管理费用的增长幅度。公司采取以项目为导向研发模式，即按项目竞选项目负责人，项目负责人以自愿组合的原则召集合适的技术人员组成项目团队，项目完成后即告团队解散，项目负责人对项目的进度及预定目标负责。公司研发支出实行项目核算制，按项目归集该项目所发生各项费用，其中主要包括了研发人员工资、奖金、福利费用，项目所耗用的材料、水电费用以及研发设备折旧费用、研发场地租赁费用和专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产摊销费用等，研发支出均在发生当期费用化。公司项目制的研发模式使得研发投入金额与营业收入关联度并不十分紧密，主要取决于公司研发项目的进展情况。2009年公司大力推进高端焊接设备研发项目使得当年研发支出增速超过营业收入增速，2010年随着市场回暖，公司除继续投入研发新型高端焊接设备外亦投入了较大资金研发光伏设备、改善AOI设备。2011年公司焊接设备新产品与AOI技改研发项目已完成而新产品PECVD研发项目仍处在样机制造阶段，故导致2011年研发费用支出同比增幅降低。

报告期内公司按项目归集的研发费用发生情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	2009年	2010年	2011年
SAV-450 全自动选择性波峰焊	181.88	-	-
R 系列热风回流焊	264.29	312.14	-
高温快速烧结炉	70.67	333.21	116.35
JTA-300 系列 AOI 离线检测设备	14.94	94.70	-
JTA-400 系列 AOI 炉前检测设备	15.47	137.78	98.94
贴片机精度测试系统	11.34	39.39	-
模组式选择性波峰焊 CELL-450	48.71	275.05	23.69
TAB 台式选择性波峰焊	-	-	71.08
波峰焊传动系统及锡炉部分改进	-	-	47.58
AS 系列热风回流焊	-	-	183.09
PECVD 氮化物沉积系统	-	-	213.88
RS 热风回流焊氮气炉	-	-	85.64
波峰焊锡炉溢锡报警装置	-	-	10.14
自动锡膏检测机 SPI-400 系列	-	-	144.30
红外链条烘干炉	-	-	55.06
JTA-500 系列	-	-	43.00
链式扩散炉	-	-	20.72
JT-PG01 工业控制器	-	-	2.53
波峰焊重载传动系统	-	-	76.77
合计	607.30	1,192.27	1,192.77

② 公司管理费用中工资及福利主要核算公司行政、人事、财务与高管人员的薪酬。报告期内该部分支出持续增长主要是由于员工人数增长与工资水平上调所引起。

③ 报告期内随着公司固定资产规模的不断扩大导致了管理费用中厂房、生产设备维护费用的逐年上升。

（3）财务费用

单位：万元

类别	2011年度	2010年度	2009年度
利息支出	213.94	71.37	104.92
利息收入	-35.31	-31.31	-10.54
汇兑损益	39.32	35.70	1.02
手续费	4.70	3.01	12.9
融资费用	30.98	30.05	14.8
合计	253.64	108.82	123.11

公司财务费用主要构成为支付银行贷款利息。此外，随着人民币的持续升值，公司出口业务产生的汇兑损益金额也不断增长。除此之外，公司各期末按照应付

运英软件无形资产受让款余额与折现利率的乘积确认分期付款的融资费用。

总体来看，公司直销的销售模式使得销售费用随着销售规模的扩大而同步增长，管理费用的增幅则始终低于营业收入增幅。未来随着公司业务量的不断扩大，规模效应将得到更好体现，同时公司也将进一步提升经营和管理效率，严格控制三项费用的增长。

4、营业外收支情况

(1) 营业外收入

报告期内，本公司营业外收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
增值税退税	20.42	5.37	-
政府补助收入	365.46	94.86	50.9
代扣个税手续费返还	5.65	-	-
合 计	391.53	100.23	50.9

报告期内，公司各项政府补助的事由、金额及依据如下表所示：

单位：万元

2009 年度		
补贴事由	金额	依据
企业信息化建设项目资助款	30.00	深宝贸工【2009】10号《关于给予劲嘉彩印集团股份有限公司等二十五家企业信息化建设项目资助的请示》
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助款	10.90	深贸工企字【2009】57号《关于下达2009年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划的通知》
深圳市宝安区企业科技研发投入资助款	10.00	深宝科联【2009】6号《关于“深圳晶辰电子科技股份有限公司研发投入资助”等拨款项目科技研发资金安排的通知》
合 计	50.90	-

单位：万元

2010 年度		
补贴事由	金额	依据
销售额增长奖励资金	3.00	深宝贸工【2010】8号《关于安排深圳市益光实业有限公司等62家重点民营工业企业销售额增长奖励资金的通知》
2009年下半年机电产品及高新技术产品资助	1.01	深圳市科技工贸和信息化委员会机电产品及高新技术产品资助

2009年上半年机电产品及高新技术产品资助	2.00	深圳市贸易工业局机电产品及高新技术产品资助
科技创新奖奖金	20.00	深宝府【2010】67号《关于表彰2009年度深圳市宝安区科技创新奖的通报》
企业国内市场开拓项目资助	17.86	深科工贸信中小字【2010】45号《关于下达2010年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划的通知》
企业改制上市培育项目资助	30.00	深科工贸信中小字【2010】46号《关于下达2010年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》
企业研发投入补贴拨款	21.00	深宝科联【2010】9号《关于“鸿富锦精密工业（深圳）有限公司”企业研发投入补贴拨款项目科技研发资金安排的通知》
合 计	94.86	-

单位：万元

2011年度		
补贴事由	金额	依据
深圳市宝安区区级企业技术中心资金资助	80.00	深宝贸工【2009】143号《关于印发<深圳市宝安区区级企业技术中心资金资助操作规程的通知>》 深宝贸工【2010】156号《关于公布2010年认定的宝安区企业技术中心名单的通知》
贷款贴息	96.00	深宝贸工【2011】13号《关于安排深圳市浩森小额贷款股份有限公司等25家企业相关奖励及补贴资金的通知》
上市补贴资金	100.00	深宝经促【2011】87号《关于安排深圳市洲明科技股份有限公司等13家企业上市补贴资金的通知》
重点民营工业企业销售额增长奖励	10.00	深宝经促【2011】117号《关于安排深圳市三诺电子有限公司等115家重点民营工业企业销售额增长奖励资金的通知》
国家高新技术企业认定补贴款	10.00	深宝科【2011】48号《关于“格兰达技术（深圳）有限公司”国家高新技术企业认定补贴拨款项目科技研发资金安排的通知》
企业研发投入补贴款	30.00	深宝科【2011】50号《关于“鸿富锦精密工业（深圳）有限公司”企业研发投入补贴拨款项目科技研发资金安排的通知》
加快发展财政奖励金	27.00	深科工贸信运行字【2011】112号《关于下达2010年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金计划的通知》
技术进口贴息	10.69	深圳市科技工贸和信息化委员会技术进口贴息
机电产品出口增长奖励	1.77	深圳市财政委员会拨入的机电产品出口增长奖励
合 计	365.46	-

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下表所示：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
处理固定资产净损失	0.72	18.76	0.35
公益性捐赠支出	60.00	60.00	0.37
其他	0.10	-	0.13
合 计	60.82	78.76	0.85

报告期内，公司于 2009 年 5 月参加深圳（里程）狮子会“关爱儿童天使行动”梧桐登高活动捐款 3,700 元；于 2010 年 6 月向贵州省春晖行动发展基金会捐款 60 万元用于在贵州省织金县茶店乡兴办希望小学；于 2011 年 3 月向贵州省春晖行动发展基金会捐款 60 万元用于在贵州省沿河县黑獭乡大溪村兴办希望小学。

5、所得税

报告期内公司所得税缴纳情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
利润总额	4,782.05	3,948.57	1,665.77
所得税费用	704.84	421.92	152.12
其中：本期应缴所得税	735.57	444.41	161.32
递延所得税调整	-30.73	-22.49	-9.21

最近三年，公司的所得税具体缴纳比例详见本节“六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠”之“（一）公司主要税种和税率”。公司在报告期内完全按照适用税率计提并缴纳税款，不存在其他重大纳税调整事项。

本期应缴所得税为根据当期应纳税所得额计算的当期应缴纳的企业所得税；递延所得税调整为期末与期初递延所得税资产的差额，即各期期末的资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异的期末与期初的差额。

（四）影响公司盈利能力的主要因素

1、电子行业及光伏行业固定资产投资需求

公司主要产品无铅波峰焊、无铅回流焊、自动光学检测设备（AOI）是电子行业 PCB 板生产加工所需要的主要设备之一，2010 年投产的高温烧结炉及正在研发的第三代平板式 PECVD 则是太阳能晶硅电池片生产加工所需要的主要设备之一，因此 PCB 板及太阳能晶硅电池片市场的发展将直接影响未来公司的盈利能力。

电子行业方面：首先，中国作为世界的电子产品制造中心，其电子信息产品制造产业在全球的领先地位短期内仍无法撼动。这种市场地位决定了对设备的采购会稳定发展，为电子整机装备行业提供了良好的市场前景。据工信部预测，未来几年，中国消费电子产品市场将持续保持超过 20% 的年均增长率。其次，大量的中国 SMT 代工企业的转型升级及珠三角和长三角等主要电子产业聚集地向中西部转移，同样将给上游的电子专用设备行业及子行业产生很大的需求拉动作用。最后，随着近年来中国劳动力成本的逐年上升及人口红利的逐渐消退，精密的自动化设备对人工的替代作用逐渐显现，具体到 SMT 行业，因公司研发自动光学检测设备及模组式选择波峰焊具有较强的人工替代功能，从而促进该行业对此类设备的投资需求。

光伏行业方面：我国已经成为全球光伏产品最大制造国。据中国电子专用设备行业协会统计，“十一五”期间在光伏产业市场的推动下，我国晶硅太阳能电池设备年均增长率达到 49.8%，成为电子专用设备各类产品中发展最快、也是在电子专用设备产业中占比重最大的一类产品。尽管 2011 年下半年来，受“欧债危机”及美国对中国太阳能电池片生产企业进行“双反调查”的影响，中国光伏产业遭遇了近年来快速发展的第一次挫折，行业发展跌入低谷，但光伏产业危中有机，光伏设备企业正在为光伏行业的再次繁荣积攒力量。根据工信部编制的《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》（征求意见稿）所示，“十二五”主要任务包括提高国产设备和集成技术的研发及应用水平，推动设备企业与光伏产品企业加强技术合作与交流。“十二五”发展重点中包括光伏生产专用设备，其中包括：支持多槽制绒清洗设备，全自动平板式 PECVD，激光刻蚀机，干法刻蚀机，离子注入机，全自动印刷机、快速烧结炉等晶硅太阳能电池片生产线设备和 PECVD 等薄膜太阳能电池生产设备。另据研究机构 IMS Research 预计，2012 年光伏设备市场将跌入谷底但将在 2013 年出现复苏。

经过此轮产业调整的中国电池生产企业未来采购光伏设备的首要考虑因素是性能和技术与国外设备相当但价格相对较低的国产设备，以实现其电池生产成本的降低，而公司研发生产的高温烧结炉、PECVD 等光伏设备相比国外进口设备来说具有较高的性价比，这将有望促使公司的高温烧结炉产品及正在研制的第三代平板式在 PECVD 在未来光伏产业走向复苏时销售规模快速扩大，进而带动

公司利润的快速增长。

2、市场拓展能力

公司是国内 PCBA 生产线焊接设备的主流供应商，在行业内有着较高的知名度，公司的“JT/劲拓”商标荣获 2010 年广东省著名商标，同时也是 2010 年深圳市知名品牌，为国内无铅焊接设备生产领域内的龙头企业。公司拥有的自主品牌有三个，即  /劲拓、、，其中“ /劲拓”主要用于普通焊接设备及 AOI 检测设备，“”主要用于高端焊接设备，“”用于公司光伏设备。清晰的品牌培育与发展推广战略以及不断积累的良好客户口碑为公司的产品赢得了良好的市场竞争力。

公司虽然是刚进入自动光学检测设备与太阳能电池片生产设备领域，但公司在电子行业积累的大量客户资源及产品营销经验为公司自动光学检测设备的扩张与成长提供了可靠的保证。在光伏设备领域，尽管公司面临国外垄断同行的强大竞争，但由于全球太阳能电池片的生产集中在中国，有利于公司充分发挥本土企业在市场文化，客户服务等方面的优势，获取市场份额。公司目前正在与国内最大的太阳能电池片生产企业无锡尚德进行合作，公司研发生产的高温烧结炉已成功进入其产品生产线。公司预计，随着募集资金项目的投产，公司高温烧结炉的产能将大幅提高。公司的市场拓展能力将决定产品的销售情况，销量的高低直接影响公司的利润水平。进入该领域前，公司对光伏市场的前景及盈利能力进行了较充分的市场调研和前期准备工作，结合中国已成为世界最大太阳能电池生产区域的因素，光伏设备产品将具有较大的发展空间及市场回报。

3、技术创新能力

装备制造生产企业要想获得较高的利润就必须根据行业发展不断调整产品结构，提高产品技术含量。经过多年积累与发展，公司拥有一批机械、电器、软件、应用材料等方面的中高级研发人才，在温度控制、运动控制、软件设计及应用、真空技术等方面具备一定的优势。面对未来日益激烈的市场竞争，公司将加大对新产品、新项目的开发力度，不断推出满足市场需要的产品，逐步巩固与拓展公司在行业中的地位。

公司设有专门的研发中心，具有 SMT 焊接设备、检测设备和太阳能电池片生产设备的自主研发实力，掌握了多项核心技术，取得了一系列科研成果，同时

拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，储备了多项拥有较确定市场预期的新产品，较强的研发实力为公司产品结构的调整和升级换代奠定了坚实的基础。

4、成本控制能力

目前，我国 SMT 焊接设备、光伏设备行业集中度高，新产品投入市场初期，存在替代进口、毛利率较高等特点，对产品单位生产成本并不十分敏感，但随着新的竞争者逐步成熟，预计行业总体利润水平将会有所下降，行业利润空间将趋于合理，企业的成本控制能力将是成为影响盈利能力的重要因素之一。

报告期内，公司产品成本中直接材料成本比例在 85% 左右，因此对直接材料成本的控制非常重要。

（五）主要产品售价和原材料价格的敏感性分析

1、产品售价的敏感性分析

报告期内，公司焊接设备销售收入占比始终较高，因此仅对焊接设备作敏感性分析（假设条件为除售价变动以外，其他因素均保持不变）：

焊接设备售价变动幅度	毛利率变动幅度		
	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1%	1.97%	1.97%	2.13%
5%	9.82%	9.96%	10.46%
敏感系数	1.97	1.97	2.13

由上表可以看出，2009 年、2010 年与 2011 年度公司焊接设备产品售价每上升 1%，公司综合毛利率水平分别上升 2.13%、1.97% 和 1.97%，可见焊接设备销售单价是影响公司综合毛利率水平的重要因素之一。

2、直接材料成本的敏感性分析

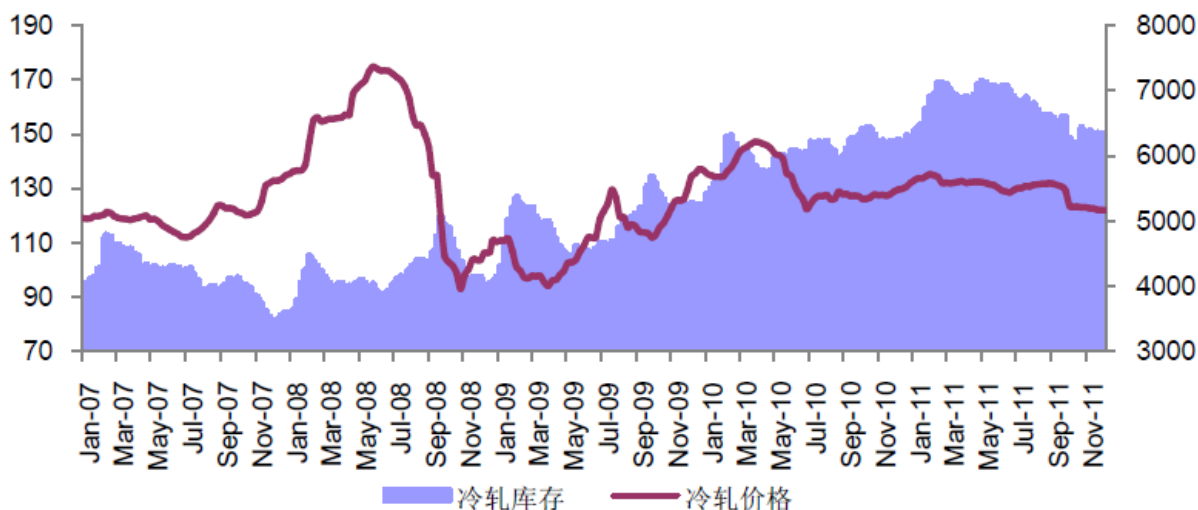
报告期内，公司焊接设备成本构成中 85% 以上为直接材料成本，因此该项成本对公司经营业绩有较大影响，公司焊接设备直接材料成本敏感性分析如下（假设条件为除单位直接材料成本变动以外，其他因素均保持不变）：

单位直接材料成本变动幅度	毛利率变动幅度		
	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1%	0.98%	0.90%	0.98%
5%	4.95%	4.59%	5.09%
敏感系数	0.98%	0.90%	0.98%

(1) 金属材料价格走势分析

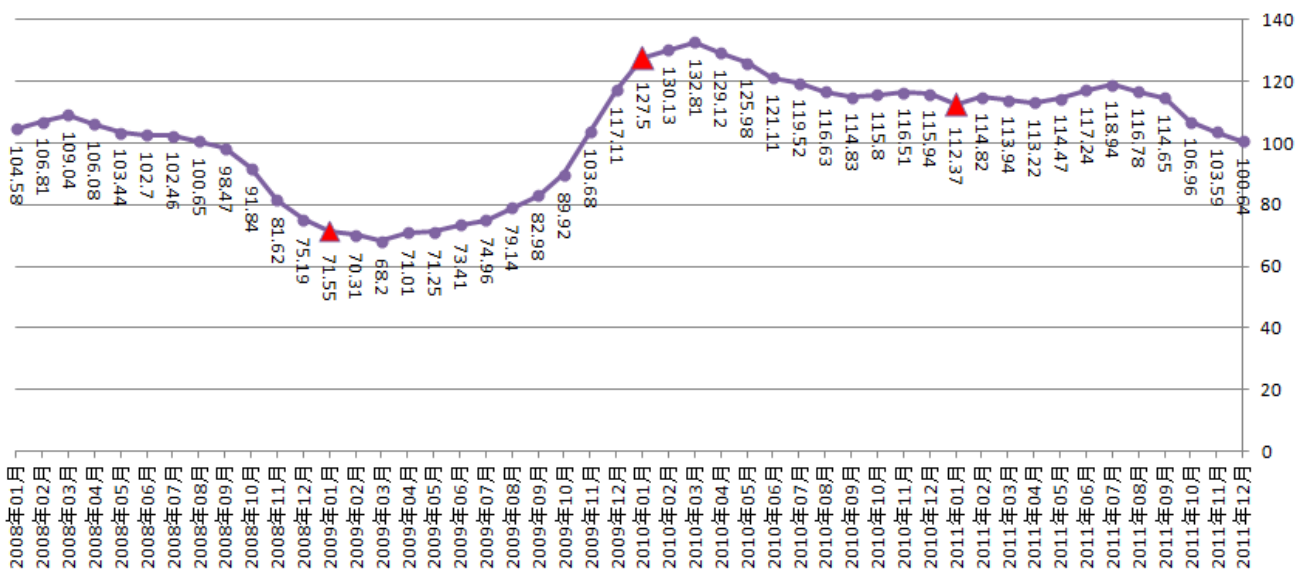
公司生产所消耗的直接金属原材料主要为冷轧板、及铝、不锈钢、铜等有色板材，报告期内此类金属原材料的价格走势如下图所示：

国内冷轧板卷价格走势及库存变化图



数据来源：钢之家，<http://www.steelhome.cn/>

国内有色金属购进价格指数变化图



数据来源：wind 资讯

由以上两图可以看出，受金融危机影响，2008 年内金属材料价格进入下降通道，至 2009 年年中时期触底并开始逐渐上涨，直至 2010 年一季度末再次达到

顶峰，在此之后直至 2011 年中期金属材料平均价格走势较为平稳，2011 年下半年金属材料价格开始出现下降的趋势。预计短期内货币政策转向仍有待时日，房地产调控还可能进一步从严，在各方面因素的综合影响下若 2012 年国内经济增长速度预期将有所放缓，且目前国内冷板、铝材等主要金属材料库存仍然高企，去库存化的过程仍未结束，短期内主要金属材料价格大幅上涨可能性较低。从中长期看，经济增速的下降会导致钢铁产能扩张速度的减缓，由于汽车市场销量下滑导致钢铁价格下跌与保障房建设开工拉动钢铁价格上涨因素对冲，预计主要金属材料价格将在中长期内出现弱势震荡，不排除出现上升的可能性。

（2）非金属材料价格走势分析

公司所采购的非金属材料种类繁多，价格差异较大，单价较高的如 KIC 测温、氧气分析仪等与单价较低的如电箱配件、马达、轴承、开关等均无相关的市场价格统计数据。单价较高的非金属材料基本均为公司标准型号设备的可选配件，公司主要根据客户订单的明细要求决定是否在其采购的设备中安装相关单价较高的非金属材料，因此这部分非金属材料采购成本的上涨基本可以转嫁给客户，其价格的波动对于公司产品的利润水平影响不大。另一方面，公司所耗用的单价较低的非金属材料均为国内产能充足的通用型材料，且公司该种材料主要通过集中采购的方式进行采购，因此公司报告期内历年采购该部分非金属材料的平均价格持续下降，且未来采购单价出现大幅上涨的可能性也较小。

（3）材料价格波动对公司经营成果的具体影响

通过对公司直接材料成本的敏感性分析可以看出，2009 年、2010 年与 2011 年公司焊接设备产品单位直接材料成本每上升 1%，公司综合毛利率水平分别下降 0.98%、0.90%和 0.98%，可见原材料价格的波动对于公司毛利水平的影响程度在报告期内较为稳定，这主要是因为原材料采购对于公司成本的影响一方面取决于其采购价格，另一方面也取决于公司材料的利用率。报告期三年内公司金属材料利用率水平因公司设备更新、切割工艺改进以及废料再利用等方式逐渐提高，非金属材料利用率则因产品构造及销售结构的变动而变动。报告期三年内公司金属材料与非金属材料的利用率水平的改善在一定程度上缓解了原材料价格上升带来的成本上升压力。

十七、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,925.60	3,045.06	1,018.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,305.92	-1,076.72	212.49
筹资活动产生的现金流量净额	135.63	234.5	-507.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.32	-35.7	-1.02
现金及现金等价物净增加额	-284.02	2,167.13	722.14

（一）经营活动产生的现金流量

公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,018.60 万元、3,045.06 万元和 1,925.60 万元。公司最近三年经营活动产生的现金流量净额均为正数，这主要是由于公司采取了较为严格的应收账款管理及回款制度，使得公司的盈利能够得到有效的现金流支持，体现了公司良好的收益质量。与公司同期净利润相比，公司各期现金流量净额均低于净利润值，这主要是由于报告期内公司营业收入快速增长使得经营性应收项目的增长超过应付项目的增长多导致。下表详细列示了将公司净利润调节为经营活动现金流量净额的过程：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	4,077.21	3,526.65	1,513.65
加：资产减值准备	133.58	139.22	61.17
固定资产折旧	499.32	401.18	319.65
无形资产摊销	293.59	238.19	44.25
长期待摊费用摊销	17.30	13.54	3.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.72	18.76	0.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	284.25	137.12	120.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-0.34	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30.74	-22.49	-9.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	675.86	-3,159.54	-1,490.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,641.57	-2,447.25	-1,178.92

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,383.92	4,200.02	1,633.40
经营活动产生的现金流量净额	1,925.60	3,045.06	1,018.60

良好的现金流状况也为维持公司正常的运营及资本性支出提供了很好的资金基础，从根本上保障了公司的偿债能力和现金分红能力。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内公司各期投资活动净现金流量分别为 212.49 万元、-1,076.72 万元和-2,305.92 万元。

2009 年投资活动现金流入 1,010.19 万元，其中 756.71 万元为收回劲同投资股权转让款尾款，253.48 万元为向劲同矿业出售闲置固定资产收入；投资活动现金流出 797.70 万元，均为当期购入固定资产与无形资产所支付现金。

2010 年投资活动现金流入 0.34 万元，系岁月流金 0070 号理财产品投资收益收回现金；2010 年投资活动现金流出 1,077.06 万元，均为当期购入固定资产与无形资产所支付现金。

2011 年度无投资活动现金流入；投资活动现金流出 2,305.92 万元均为当期购入固定资产与无形资产所支付现金。

（三）筹资活动产生的现金流量

报告期内公司各期筹资活动净现金流量分别为-507.92 万元、234.50 万元、135.63 万元。

2009 年筹资活动现金流入总计 3,000 万元，其中包括公司“VS 系列无铅热风回流焊机研发”和“全自动无铅电磁波峰焊锡机研发”项目获得深圳市宝安区科学技术局、宝安区财政局无息贷款 600 万元，以及 2009 年 1 月、2 月向深圳平安银行华强支行借入短期贷款 1,000 万元、400 万元，2009 年 9 月向深圳平安银行新城支行取得短期借款 1,000 万元；筹资活动现金流出总计 3,507.92 万元，其中包括偿还向深圳平安银行华强支行分别于 2008 年 4 月、10 月以及 2009 年 1 月、2 月借入的 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 400 万元贷款，当年偿还贷款利息共计付现 107.92 万元。

2010 年筹资活动现金流入总计 3,000 万元，其中包括 2010 年 3 月向平安银行深圳分行借入短期借款 1,000 万元，2010 年 12 月向招商银行股份有限公司深

圳宝安支行借入长期借款 2,000 万元；筹资活动现金流出总计 2,765.51 万元，其中包括偿还 2009 年 9 月深圳平安银行新城支行 1,000 万元贷款，偿还 2010 年 3 月平安银行深圳分行短期借款 1,000 万元，支付平安银行 600 万元保证金，支付中介机构服务费用付现 95.00 万元以及当期支付贷款利息共计付现 70.51 万元。

2011 年度筹资活动现金流入总计 2,100.37 万元，其中包括本期收回深圳平安银行股份有限公司车公庙支行的担保保证金 600.37 万元，以及 2011 年 2 月向招商银行股份有限公司深圳宝安支行借入长期借款 1,500 万元；筹资活动现金流出总计 1,964.74 万元，其中包括偿还 2009 年深圳市宝安区科学技术局、宝安区财政局无息贷款 600.00 万元，以现金形式向股东分配股利 900.00 万元，当期支付贷款利息共计付现 209.74 万元，以及支付上市中介费用 255.00 万元。

十八、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出包括 2009 年收购运英软件与生产 AOI 检测设备相关资产，资产收购的详细情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、报告期的关联交易”之“（二）偶发性关联交易”之“2、收购运英软件与生产 AOI 检测设备相关资产”。

（二）未来可预见的重大资本性支出及资金需求量

截止本招股说明书签署日，除本次发行募集资金计划投资项目外，公司其他重大资本性支出计划还包括 PECVD 产品研发与投产计划，该计划预计所需投入包括技术转让款、样机生产材料采购款以及生产厂房租金等在内的资金共计人民币 1,800 万元，该笔资金全部由公司自有资金投入，不属于募投资金投资项目范围。关于本次发行募集资金投资项目及其对公司主营业务和经营成果的影响参见本招股说明书“第十一节 募集资金运用”。

十九、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本招股说明书签署日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司无需披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

1、抵押财产情况

公司于 2010 年 12 月与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《最高额抵押合同》，以公司所有的深房地字第 5000469662 号房产为抵押物，为公司与该行签订的 2010 年宝字第 0010408337 号《授信协议》授信额度内的所有贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用等相关费用提供最高额抵押担保。

截至报告期末，除上述抵押事项外，公司无其他需披露的重大财务承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

二十、发行人财务状况和盈利能力的趋势分析

公司自成立以来，保持了稳定发展的态势，整体财务状况良好，综合毛利率水平较高，盈利能力较强。公司有信心在未来几年保持较快的盈利增长，扩大公司经营现金流，持续改善公司财务状况。

目前电子整机装联设备中除贴片机以外其他设备的制造技术国内厂商均已掌握，产品的国产化程度已较高，电子整机装联设备（除贴片机以外）的进口替代在大量生产厂商涌现的背景下已基本完成。近几年来，国内电子整机装联设备生产厂商之间的竞争加剧，从而使得相关设备价格逐年下降，再加之 2008 年经济危机导致市场需求低迷，许多规模较小的设备生产厂商相继因为成本压力过大而退出市场。未来随着行业市场集中度的不断提升，设备销售价格有望逐步稳定，

行业内主要生产厂商由于技术与规模优势也可维持较好的盈利能力。此外，未来国内电子信息产品行业的蓬勃发展会不断产生新的 PCBA 生产线投资需求，且电子信息产品更新换代速度的加快、电子元器件生产精益化与环保化的要求等也会不断缩短电子整机装联设备市场的替换周期，电子整机装联设备市场未来增长空间仍较大。因此，未来公司在维持技术优势与规模优势的基础上有望进一步扩大市场份额，在电子整机装联领域内维持较高的获利能力。

公司目前销售的产品主要为 SMT 焊接设备、AOI 自动光学检测设备，分别占公司 2011 年营业收入的 81.3%、9.89%。虽然报告期内公司焊接设备的平均售价在下降，但近两年平均售价下降幅度均在 3% 以内，为减少焊接设备平均售价下降对公司盈利的影响，公司一方面通过对成熟产品的持续研发投入来促进其升级换代，通过提升产品功能、性能及降低产品使用能耗等手段增加产品附加值以提升最终产品售价；另一方面，通过精简结构，寻找替代材料与元器件、工艺改进等手段来降低产品制造成本来保持公司合理的销售毛利率。报告期内，公司焊接设备毛利率基本稳定在 41% 左右，AOI 自动光学检测设备毛利率保持在 30% 以上。此外，随着公司近两年来对高端焊接设备（如选择性波峰焊、RN 系列/RA 系列回流焊）、在线 AOI 设备、太阳能设备研发投入的加大，公司预计未来几年上述高端设备在公司产品的比重将逐年上升，从而带动公司产品平均售价及毛利率上升，增强公司盈利能力。

在高温烧结炉领域内，国内市场中的进口替代尚处于起步阶段，未来高温烧结炉产品的国产化程度提升空间较大。目前公司已掌握了生产高温烧结炉的核心工艺，生产的高温烧结炉产品也得到无锡尚德等核心太阳能电池生产商的认可，未来通过进一步的技术改进与产能扩建公司有望在高温烧结炉市场中占据先发优势从而快速扩大市场份额，带动公司整体业绩与获利能力的进一步提高。

本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司的生产规模与进一步完善核心产品的生产工艺。募投项目建成后，公司将新增厂房与办公设备等固定资产，使得公司的非流动资产增加，固定资产折旧费用也将相应增长。预计在公司募集资金投资项目业绩释放前期，固定资产折旧的增长将会摊薄公司业绩，但募集资金投资项目达产后，将使公司营业收入与净利润规模大幅度增长。

二十一、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

1、公司股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、子公司股利分配政策

根据发行人子公司惠州市劲拓精密装备有限公司《公司章程》第二十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金金额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

劲拓精密为发行人的全资子公司，因此发行人能够保证劲拓精密利润分配政策的连续性和稳定性，发行人将根据劲拓精密的现金流、经营情况及发行人的现

金流情况来决定劲拓精密的分红政策，从而确保投资者能够获得合理的投资回报。

（二）最近三年股利分配情况

2011年3月11日，公司召开股东大会，决议将公司截止2010年末未分配利润共计3,235.82万元中的900.00万元以现金方式向股东分配股利。2011年3月，上述现金股利分配完毕，公司所有自然人股东均按20%的税率缴纳了个人所得税，并由公司代扣代缴。除此之外，公司报告期内无其他股利分配。

（三）分红回报规划

1、分红考虑因素

本分红回报规划旨在建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持公司股利分配政策的连续性和稳定性，树立良好的资本市场形象。本分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东的意愿和要求，衡量了公司目前盈利及现金流情况、所处发展阶段、项目资金需求等因素后得出。

2、分红回报规划

目前公司正处于成长时期，产能的扩张带来对固定资产投资和营运资金的强烈需求，因此公司当前的股利分配政策更多考虑企业成长的需求，同时兼顾投资者对现金回报的要求，即采取现金分红加股票股利的方式进行利润分配，公司每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的15%。随着公司进入成熟期以后，公司将逐步提高分红比例，以高现金分红的方式分配利润。

3、三年分红计划

为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司发行上市当年及之后两年每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的15%。公司目前经营状况稳定，盈利能力良好，公司有能力强保证上述股利分配计划的顺利实施。

4、履行决策程序

公司上述分红回报规划已经公司第一届董事会第十二次会议、公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

（四）本次发行后的股利分配政策

本次发行上市后，本公司将继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。2011年12月23日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》及修改《公司章程（草案）》利润分配条款的议案。本次发行后公司利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应保持政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配；

公司采取现金方式分配利润时，应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求，并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率，以确保分配方案不影响公司持续经营及发展；

公司采取股票方式分配利润时，应当充分考虑利润分配后的股份总额与公司经营规模相适应，并考虑股份总额增大对公司未来从证券市场融资的影响，以确保分配方案符合公司股东的整体利益。

3、现金分红发放条件及比例

上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：

- （1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；
- （2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；
- （3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元；

公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还

应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

4、股票股利发放条件

公司累计未分配利润达到注册资本的 100% 时，公司可以采取股票股利的方式分配利润。

5、利润分配研究论证机制及决策程序

公司利润分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

董事会审议通过利润分配的议案后，应当及时将议案抄送监事会，并按照章程规定的程序将议案提交股东大会审议；股东大会表决时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

6、利润分配政策调整

公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，公司应按照规定对公司章程相应条款进行修改，并严格履行修改公司章程的相关决策程序。调整后的利润分配政策应符合法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。有关调整利润分配政策的议案，应经董事会审议后提交股东大会审批，同时独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

7、发行人当年未分配利润使用原则

为了保持公司的可持续发展，公司当年未分配利润应作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司主营业务经营，具体用途包括补充公司营运资金、研发投入或与公司主业相关的投资。资金的有效使用将有利于公司扩大经营规模、提高市场占有率和核心竞争能力。

（五）滚存利润的分配安排

根据 2011 年 3 月 11 日召开的公司 2010 年年度股东大会决议，公司将以现金分红的形式向股东分配 900.00 万元利润，本次分红完成后至发行前的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。

第十一节 募集资金运用

一、本次发行募股资金的基本情况

（一）募集资金投资项目概览

根据本公司第一届董事会第九次会议、第十三次会议和 2010 年年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会批准，公司拟向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【 】万元，全部用于公司主营业务相关的项目及其它与主营业务相关的营运资金项目。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【 】，账号为【 】。

本次募集资金投资项目经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于：

单位：万元

序号	投资项目	项目实施主体	投资预算	拟募集资金使用量
1	SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目	劲拓精密	10,517.83	10,517.83
2	研发中心建设项目	劲拓精密	4,142.16	4,142.16
3	其它与主营业务相关的营运资金项目	劲拓股份	-	-

注：劲拓精密为公司设立的全资子公司，公司募投项目第一至第二项均通过其实施。

（二）募集资金使用计划和时间进度

公司本次募集资金投资项目建设期均为 18 个月，预计于 2013 年建成并开始批量生产，2013 年及以后年度为达产年。

首次公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换，目前公司已通过自有资金启动募集资金项目的部分投资，主要用于上述项目的前期土地出让金支出。此次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入资金，其余部分继续投入项目建设。募集资金不足时，不足部分由公司自筹资金解决；募集资金如有剩余，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

（三）募集资金投资项目的立项和环评情况

上述募投项目均涉及到固定资产投资，均已获得立项备案，并取得环评批复意见，具体情况如下表所示：

序号	投资项目	项目备案情况	环评批复
1	SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目	广东省发改委企业投资项目备案号 111300366229001	惠市环建[2011]30 号
2	研发中心建设项目	广东省发改委企业投资项目备案号 111300366229003	惠市环建[2011]32 号
3	其他与主营业务相关的营运资金	-	-

二、募集资金投资项目概况

（一）SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目

1、项目概况

本项目拟在惠州大亚湾原西区第一工业园区内建设国际一流的 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备生产基地，主要产品包括：波峰焊设备、回流焊设备、离线 AOI 检测设备及在线 AOI 检测设备等四类产品，产品技术可达国际同类产品标准。该项目可以很好地满足下游各行业对电子整机装联设备的需求，解决公司市场需求旺盛与产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。

2、项目实施的必要性分析

（1）公司目前的产能已经不能满足市场发展的需要

由于装备制造对生产场地的要求非常严格，随着公司近年来规模的快速扩张，场地资源的限制逐渐成为了制约公司跨越式发展的瓶颈。进入 2010 年以来，公司每月波峰焊、回流焊的平均订单数量已经增长到 110-120 台，AOI 检测设备订单数量也达到了 30 多台，2011 年公司主要产品的产能利用率接近 100%，现有的生产场地已经不能满足生产的需要。为了保障产品质量、性能、以及交货期的准时要求，公司在物流管理、合理化设计以及生产线平衡等方面下了很多功夫，如大力培养高技能的产业工人，根据每天的订单交期变动情况做人员调整，提高应变速度等。在有限的场地空间内，公司已经充分利用了可供利用的各项资源。

未来随着市场需求的持续增长，公司产能与市场需求的矛盾将进一步显现，而本项目的顺利实施将有利于公司突破产能瓶颈，更好地满足下游客户的需求。

（2）项目实施有利于公司优化资源配置，提高规模效益

近十年来，国外一些企业纷纷在国内设厂，并加大在中国的投资力度，对国内电子整机装联设备行业造成较大冲击。尽管近年来以公司为代表的部分国内企业通过技术创新和服务优势已经占据了部分市场的主动，但市场上依然活跃着众多国外先进企业的身影。这些企业凭借着强大的品牌影响力和先进的技术水平，仍可在一定程度上对国内设备制造企业构成威胁。为了在长期的市场竞争中始终把握主动，公司必须进一步占领市场，确立公司在行业内的领导地位。本项目的实施将有利于公司优化资源配置，通过 SMT 焊接设备和 AOI 检测设备的扩产，进一步扩大公司经营规模，更大程度形成规模效益，降低单位产品成本，为公司在以后的竞争中确立优势。

（3）项目的实施有利于公司利润保持持续增长

随着经济的不断发展和新技术的综合应用，现代电子制造业对焊接设备的要求也越来越高，焊接设备的总体发展趋势是高效、优质、低成本、环保、适应新材料、新结构、新功能要求。公司自主研发的无铅系列波峰焊、回流焊等设备全面顺应市场发展趋势，近年来的市场销售情况持续向好发展。但由于产能限制，公司不可能在现有产能基础上持续保持利润的快速增长，如果产能不能够继续提高，公司的增长将陷入停顿状态，不利于公司规模的继续扩张。为了保持公司目前的增长趋势，必须进行 SMT 焊接设备和 AOI 检测设备的扩产。

3、项目的市场前景、竞争状况和新增产能的营销分析

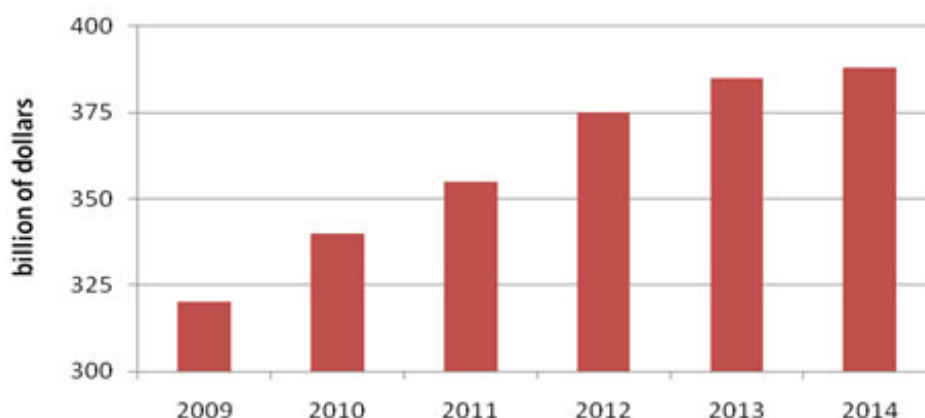
（1）下游电子制造行业的发展趋势

发行人研发生产的电子专用焊接设备、AOI 检测设备等电子整机装联及表面贴装设备广泛应用于计算机、通信、消费电子和工业自动化等行业，因此下游这些行业的快速发展给发行人所处的行业提供了广阔的市场空间。

① 消费电子制造业

据 iSuppli 公司估计，2010 年全球消费电子设备的制造营业收入有望摆脱 2009 年的下滑局面，为未来四年的持续增长奠定基础。在消费需求的带动下，预计 2010 年消费电子的总体 OEM 营业收入将达到 3404 亿美元，比去年的 3207

亿美元增长 6.2%。在接下来的四年,该市场将继续稳步增长,到 2014 年超过 3850 亿美元。下图所示为 iSuppli 公司对 2009-2014 年全球消费电子市场的预测:



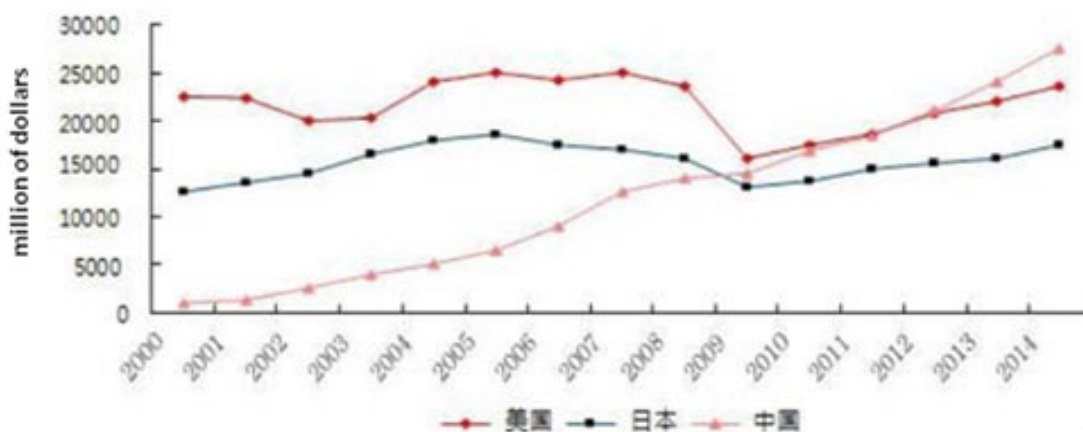
数据来源: iSuppli 市场研究公司

在国内,金融危机后基于政策和内需的双重推动,未来几年国内消费电子市场仍将保持稳定增长的势头。据 CCID 预计,2010-2012 年,国内消费电子市场会保持平稳较快的增长,三年复合增长率会达到 9.3%,到 2012 年实现 7,291.5 亿元的市场规模。

② 汽车电子制造业

据中国汽车工业协会调查显示,目前汽车的发动机、底盘与悬架、车身控制、安防系统等方面,电子控制技术都得到了广泛应用,部分车型电子产品占整车的价值超过了 30%。随着消费者和社会对汽车节能、安全、环保、舒适等的要求越来越高,汽车电子产品和技术在新车型中应用还将越来越多。

近年来,中国汽车电子产业无论是产量增长还是产品结构升级都明显优于欧美市场,汽车产业的高速发展带动了汽车电子产量的快速增长。同时随着国际汽车电子制造能力持续向中国转移,未来几年中国汽车电子市场仍将保持快速平稳增长的良好态势。据 iSuppli 预测,中国汽车电子市场预计将在 2012 年超过美国,届时中国汽车电子销售额将从 2009 年的 160 亿美元增长到 206 亿美元。下图为中国、美国以及日本汽车电子产业收入及预测:



数据来源：iSuppli 市场研究公司

③ 通信设备制造业

我国通信设备制造业前景长期向好，通信是一个基础性、战略性和支柱性的行业，在消除与发达国家“数字鸿沟”的过程中，通信设备扮演重要角色，中国通信设备业仍会保持高速发展。以手机为例，尽管我国手机用户一直增长迅速，但与发达国家或地区相比仍然有很大的差距。2010 年末我国手机普及率为 64.4%（64.4 部/百人）²，而 2009 年末发达国家平均移动电话普及率为 113%³，因此未来若干年中国通信设备制造业仍是发展的黄金时期。“数字差距”是中国通信设备制造业发展的根本动力。

随着 3G 牌照的发放，我国三大运营商开始了投资金额巨大的设备投资，建设期为两到三年，这在短期内极大的刺激了通信设备业的发展。在长期因素和短期因素双重影响之下，中国通信设备制造业前景良好。

④ 航空航天制造业

高端装备“十二五”规划主要分为五个部分：航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备。高端装备制造业是国家规划的七大战略新兴产业之一，属于技术密集、附加值高、成长性强的行业，是提高我国整体制造业竞争力的关键。航空航天产业则被国务院列在高端装备制造业首位，充分显示了该产业的重要性。表明我国已经在航空航天和国防领域有了新技术突破和产业升级，同时说明该产业发展前景可观，未来十年里，航空航天产业将进入一个高速发展时期。

从研发项目来看，未来十年，政府将实施大飞机项目、航空发动机、航空母

² 工业和信息化部，2010 年全国电信业统计公报

³ 国际电信联盟，《Measuring the Information Society 2010》

舰、复合材料、北斗导航系统、高清晰对地观测等一系列的国家重大专项和重点技术关键设备。随着《关于深化我国低空空域管理改革的意见》的出台，低空空域的开放已被提上日程，从事工业、农业、林业、渔业以及医疗卫生、抢险救灾、海洋监测、文化体育等方面的民用航空领域将迎来发展黄金期。而航空航天制造业的发展必然带来高精密高可靠性电子产品的制造需求。

（2）发行人所处电子整机装联设备行业未来的发展趋势

① 国家及地方政策扶持是行业发展的催化剂

近年来，国家大力推进新一代信息技术为产业发展创造良好的外部环境。国家明确提出了重点发展电子制造业及配套服务业中涉及各个领域，如工业机器人、自动化成套设备及激光成套设备以及先进电子制程工艺等。目前，中国正处于经济结构转型的关键时期，未来对电子信息等战略性新兴产业将会有更强的政策支持。

近期政府颁布的一系列促进电子整机装联及表面贴装设备行业发展的政策如下表：

政策文件	发布时间	主要内容
《高技术产业“十一五”规划》	2007年7月	电子信息产业列入产业发展重点，提出全面提升集成电路产业。加快半导体专用设备、仪器和材料的研发和产业化，大力发展电子专用设备产业，推动电子设备制造向高端、成套方向发展
《装备制造业调整和振兴规划》	2009年5月	以集成电路关键设备、平板显示器件生产设备、新型元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺整机装联设备、电子专用设备仪器及工模具等为重点，推进电子信息装备自主化
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2010》（征求意见稿）	2010年7月	重点领域有：无线射频、集成电路、电子专用设备、仪器和工模具、新型显示器件、新型元器件、工业自动化、机器人等
《产业结构调整指导目录（2011年本）》	2011年6月	智能焊接设备、机器人及工业机器人成套系统、表面贴装设备等属于鼓励类产业

② 产业梯度转移所带来的新的机遇

随着东部沿海地区劳动力等要素资源价格的不断攀升，国内电子产业梯度转移的趋势越来越明显。中西部地区将是中国未来十年电子产业成长动能来源，发展潜力巨大。近年来，在国家产业政策推动及产业转移的背景下，中西部各地政府纷纷把发展电子信息等战略性新兴产业作为转变发展方式的重要方向，接连推出关于打造电子信息产业的发展战略和产业布局，进一步拉动了电子整机装联设

备产业的投资增长。

重庆市为实现电子制造业 2011 年销售产值 3000 亿元，占整个工业产值的 21%左右，并逐渐成长为重庆国民经济第一支柱产业的目标，积极实施“5+3”发展战略，提升重庆电子制造业增加值占城市 GDP 的比重，促进工业转型升级。“5+3”发展战略具体包括加快完善“计算机及周边产业链”；推进信息家电及数字视听产业持续快速增长，完善产业配套体系；推动智能化仪器仪表、汽车电子、医疗电子等应用电子产业产业化进程；科学引导 LED 及光伏产业，培育完整产业链，形成硅与非硅并举的国内重要的太阳能光伏产业基地；增强电子专用设备制造业的竞争力，逐步形成一条完整的电子装备产业链。

2011 年 7 月 18 日，成都市对外宣布，将用五年时间，建成全球最大的云服务和终端产品制造基地。成都布局云服务、基础软硬件设备生产和云终端产品制造三大产业集群，并将之“十二五”的产值目标锁定 3000 亿元。据成都海关最新统计，今年上半年，成都结关出口便携式电脑 403.5 万台，内销 33.2 万台，总价值 18.6 亿美元。成都晋升为继江苏、上海、广东后的第四大便携式电脑生产基地。随着仁宝、纬创、联想、戴尔等成都基地，在今明两年相继投产，成都电子信息产业步入加速跃升的黄金期。

③ 产业升级转型及生产设备更新换代加快

产业梯度转移将给电子行业带来新一轮的跑马圈地机遇，从而扩大对电子制造服务及电子整机装联设备的传统需求；而产业的升级转型将提升发行人所处行业配套服务的需求与渗透率，从而带动高端电子制造服务和设备需求。

一方面，电子制造产业传统的劳动密集型发展模式已难以为继，产业的升级转型迫使众多的电子制造企业不得不提升技术，改进工艺和运营流程，同时采用更为先进的 SMT 生产线设备以提高生产效率，减少工作时间；

另一方面，由于新的片式元器件及其封装方式在不断变化，例如 BGA、FC、COB、CSP、MCM 等大量涌现，在生产中不断更新和推广应用，对电子整机装联设备的要求也越来越高。

因此，在电子制造业产业升级转型和先进制造技术不断更新的背景下，不少电子制造企业可能提前进行 SMT 生产线设备更换以节约成本、提高效率，技术升级带来的设备更新换代趋势将不可避免。

（3）发行人焊接设备和 AOI 设备所处细分行业的市场前景

① SMT 焊接设备市场前景

中国已经成为世界第一的 SMT 工业大国，预计这一地位 10 年内不会改变。经过金融危机的洗礼，目前我国电子整机装联设备产业将进入盘整转型期，这将是中国由电子整机装联设备大国向强国转型升级的关键时期。2009 年国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》，提出今后几年的发展重点为：“结合实施电子信息产业调整和振兴规划，以集成电路关键设备、平板显示器件生产设备、新型元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺整机装联设备、电子专用设备仪器及工模具等为重点，推进电子信息装备自主化。”这为 SMT 焊接设备制造业的持续发展提供了可靠的政策支持。

未来在下游电子制造业持续发展、新型封装技术层出不穷、全面无铅化、产业升级以及生产设备更新换代等因素的推动下，电子整机装联焊接设备制造业仍将保持较好的增长。根据电子专用设备工业协会的统计和预测，我国电子整机装联焊接设备制造行业的市场规模从 2005 年的 4.14 亿元增长到 2010 年的 10.65 亿元，年复合增长率为 20.8%；预计未来 5 年的年复合增长率可达到 20%，至 2015 年将达到 26.51 亿元的市场规模。

② AOI 检测设备市场前景

一方面，随着电子产品制造行业整体技术水平的不断发展，以及人们对电子产品美观、便携式的要求日益提高，使得全球电子产品都在向更小、更轻、更薄的方向发展。从源头的电子元器件开始，小型乃至微型化已经成为行业技术发展的不变趋势。伴随这一微型化趋势，传统的人工检测已经逐渐不能适应现代电子生产的工艺需求，客观上必须实现以机器代替人工操作。

另一方面，我国作为劳动密集型产业生产大国，在电子生产领域长期是以较低劳动力成本的人工作业为主，SMT 生产线检测领域亦是如此。目前 AOI 检测设备市场在国内处于刚起步阶段，市场上只有 20%-30% 的 SMT 生产线装配了 AOI 检测设备，而国际领先电子制造企业的 SMT 生产线基本都配置了 AOI 检测设备。即便目前配备了 AOI 检测设备的电子制造企业绝大多数也只在炉后配备一台进行全检（而按照国际经验，每条生产线至少要配置三台 AOI 检测设备放置在生产线不同测试工位）。因此随着行业的发展，未来 AOI 检测设备的装备

率会越来越高，市场空间非常广阔。

（4）发行人在电子整机装联设备行业中的竞争地位

在技术方面，发行人经过多年的技术沉淀积累，已形成较强的技术与产品创新能力。发行人目前拥有 17 项非专利技术、38 项专利技术、15 项软件著作权，这些技术成果为发行人产品在行业中的竞争奠定了良好的基础。

在客户资源和市场开拓方面，公司凭借技术、产品品质、工艺一体化、服务优势，报告期内体现出较强的新客户开发能力。报告期内，发行人客户数量持续增加，2009 年、2010 年和 2011 年新增客户数量分别为 500 家、688 家和 548 家，目前已约有 2,400 家电子制造企业（包含终端用户及 EMS）在使用公司产品，公司在电子整机装联焊接设备企业中形成了较高的客户占有率。凭借在电子整机装联焊接设备领域已经具备的技术和品牌优势，公司在业界已经形成了良好的市场口碑，产品销售网络遍布全球。下游客户多为国内外优秀知名企业，其中国内知名客户包括：富士康、比亚迪，TCL，创维、深圳普联、美的、格力等；国外知名客户包括：Flextronics（伟创力）、西门子（北京）、Jabil 捷普（美国），SANDISK、佳能（中国）、东芝（中国）等。本公司与其中的大部分厂家都建立了长期稳定的合作关系。如公司是全球第二大 EMS 厂商 Flextronics（伟创力）在全球范围内的焊接设备指定供应商。

（5）现有和潜在客户的产能扩张情况

在国家和地方政策的大力支持下和电子产业“西渐”的进程中，下游主要客户受益于承接全球电子制造业产能转移的机遇，纷纷启动产能扩充计划。最近及未来几年下游主要客户的扩产情况如下表：

下游客户	扩产情况
富士康	<ul style="list-style-type: none"> ● 富士康从 2008 年开始，计划在五年内，投资营口科技园项目，项目总投资 10 亿美元，生产印刷电路板、主机板、电脑组装等高科技产品，打造渤海湾最大的电子装备生产基地。 ● 2009 年 8 月，鸿海集团（富士康母公司）与惠普计算机携手合作，在大陆重庆兴建年产能 2,000 万台 NB 生产基地，预估 2012 年投产，年产值达 2,000 亿元人民币。 ● 2010 年 7 月，鸿海集团（富士康母公司）董事会通过了对成都及郑州两地的 6400 万美元投资计划。 ● 2011 年 4 月，富士康投资四川绵阳，拆迁面积将达 2300 亩，而且是一期工程，主要生产智能手机，产能规划 5000 万部。
伟创力	<ul style="list-style-type: none"> ● 2010 年 10 月，伟创力在苏州吴中出口加工区宣布，其苏州工厂第二期生

	产线开工，并同时开建第三期生产线。这一新生产基地占地面积超过 9 万平方米,计划雇佣超过 1.2 万名工程师和制造员工。
台湾纬创	<ul style="list-style-type: none"> ● 2011 年 1 月，台湾纬创集团与成都市双流县政府签订协议，将投资建设笔记本电脑、平板电脑、电视、显示器、移动通讯、智能手机等电脑及电子 3C 相关产品成都制造基地。项目预期总投入 5 亿美元，首期投资总额不低于 1 亿美元；项目计划 2011 年三季度末竣工投产，2012 年底前实现 1000 万台综合产能，2014 年综合产能达到 2000 万台，争取 2016 年综合产能达到 4000 万台。
TCL	<ul style="list-style-type: none"> ● 2011 年 4 月，TCL 集团与新疆乌鲁木齐经济技术开发区合作的新疆产业园项目正式签约，该项目规划 3 条 19-47 寸的 LCD/LED 整机生产线，全部建成后预计年产能可达 105 万台。 ● 2011 年 6 月，TCL 发布公告，斥资 5.61 亿元兴建内蒙工业园液晶电视生产基地，建设期 15 个月，建成后可实现年产 18"~65"LCD 液晶电视 300 万台的生产能力。
创维集团	<ul style="list-style-type: none"> ● 2011 年 6 月，创维数字技术股份有限公司与深圳光明新区签署合作协议，斥资 4 亿打造近百亿产值数字电视研发生产基地。 ● 2011 年 6 月，创维数码(00751)发布公告，旗下南京创维平面显示科技与南京溧水经济开发区管理委员会签订协议，于南京溧水进行冰箱、洗衣机及液晶电视项目投资，投资约 25 亿元人民币。
格力电器	<ul style="list-style-type: none"> ● 2010 年 12 月，格力电器武汉产业园在武汉经济技术开发区正式奠基。该项目总投资 30 亿元，占地面积 1400 亩，全部投产后年产值超过 150 亿元。
海尔集团	<ul style="list-style-type: none"> ● 2010 年末，海尔集团与佛山（三水）市首次签约，建设“海尔—佛山(三水)市场创新产业园”项目，计划投资约 100 亿元，2011 年 6 月，海尔新增投资约 45 亿元。该产业园首期将建设洗衣机、冷柜等六大核心项目，计划于 2012 年 3 月前完工和投产。将形成滚筒洗衣机 300 万台、冰柜 200 万台的年产能。
美的空调	<ul style="list-style-type: none"> ● 2010 年 8 月，美的电器公布其非公开发行 A 股股票募集资金投资项目总体使用计划。扩产计划如下：1、共计 3 个空调项目：包括中央空调（合肥）项目，家用空调（南沙）项目以及家用空调（芜湖）项目。主要生产中央空调，定频、变频家用空调等产品，项目建设周期为 18-24 个月，公司拟以募集资金累计 234,000 万元投入该项目；2、共计 2 个冰箱项目：包括冰箱（荆州）项目及冰箱（南沙）项目。主要生产内销冰箱冰柜产品，以及风冷、直冷冰箱产品，项目建设期 13-24 个月，公司拟以募集资金累计 122,000 万元投入该项目。
合肥三洋	<ul style="list-style-type: none"> ● 2011 年 3 月，在公司公布的非公开发行股票预案中，披露其募集资金的使用计划，其中包括：1、年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目。项目总投资为 62,318 万元，建设期为 24 个月；2、年产 500 万台洗衣机变频技改项目,项目总投资为 27,294 万元，建设期为 12 个月。

注：以上内容根据公开资料整理

下游客户的扩产，必将带动新一轮 PCBA 生产线的扩产，为发行人所处的电子整机装联设备行业带来良好的市场发展空间。

（6）目前及潜在客户的订单或需求意向

发行人自 2011 年 7 月份以来焊接设备签订的合同金额为 8,540.65 万元，AOI 设备签订的合同金额为 1,787.34 万元，发行人订单情况良好。

在电子整机装联设备领域，发行人下游客户资源丰富，与众多客户保持密切的合作关系。目前发行人正进一步与富士康、创维等重点客户接触，推广 AS 回流焊、SPI 等新产品，并与部分客户签署了合作意向。

（7）产能分析及新增产能的落实措施

① 产能分析

基于公司卓越的产品品质，及国内外巨大的市场需求，目前发行人电子整机装联设备（包括电子专用焊接设备和 AOI 检测设备）的产能勉强满足下游行业的需求。2011 年，发行人焊接设备、AOI 设备的生产、销售情况如下：

产品名称	产能	产量	销量	订单量	产能利用率	订单量/产量
焊接设备	1280	1268	1390	1233	99.06%	97.08%
AOI	255	243	240	259	95.29%	106.58%

由上表可见，为尽量满足客户需求，公司生产设备满负荷运行，少量非关键零部件采用外协加工方式，2011 年公司焊接设备和 AOI 设备的产能利用率均已接近 100%，未来产能扩张势在必行。公司 2011 年焊接设备和 AOI 产能与募投项目达产后产能对比如下：

产品名称	产能	产量	产能利用率	募投新增产能
焊接设备	1280	1268	99.06%	750
AOI	255	243	95.29%	600

本项目设计产能为年产各类 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备 1350 台，产值 2.22 亿元，相比公司现有产能，募投项目扩产计划较为稳健。预计投产后首年达产 80%，第二年达产 100%。

② 新增产能的落实措施

发行人是国内同行业中的领先企业，公司已经在业内建立了完善的销售体系，具有畅通的销售渠道和成熟稳定的客户储备。目前发行人在电子专用焊接设备领域已经占据一定市场份额，对本公司近年来的快速发展起到了十分重要的作用。本次募集资金投资项目建成投产后，本公司将依托现有的营销网络，继续加大市场开发力度，进一步巩固和提高公司产品的市场占有率。根据本公司发展战

略，考虑本次募集资金投资项目完成后公司的实际情况，本公司确定了未来几年的市场营销目标和措施，主要包括：

i 根据国内外的市场差异，公司分别制定分区域营销策略。在国内主要采用“直销为主，经销为辅”的营销模式，在国外主要采取“海外经销”模式。未来发行人仍将坚持这一营销模式，在国内重点城市，除现有服务网点外，进一步拓展新的服务网点，下一步发行人计划在武汉、郑州等城市设立网点。

ii 适度发展经销商，拓展新的市场空间。合理发展经销商业务是发行人今后几年的工作重点之一。在未来几年内，本公司将在全球范围内自身服务网点无法覆盖的区域进一步发展经销商，并加大对经销商培育力度，把经销商系统作为公司现有销售队伍的重要补充。

iii 逐步完善销售组织架构，扩大销售队伍，计划将与 SMT 设备（焊接设备与 AOI）相关的销售队伍由现在的近 60 人扩充到 130 人左右。

iv 完善激励约束政策，提高营销团队市场开拓积极性。公司将营销目标任务层层分解，落实到人，月月进行考核。结合销售目标的完成情况及应收账款的回收情况进行奖励，严格执行优胜劣汰和竞争上岗机制。利用良好的激励制度充分激发营销员工的工作热情，打造一支具有凝聚力的销售团队，为市场拓展工作的稳步发展奠定良好的基础。

v 完善售后服务体系建设，加强技术和售后支持，增加售后服务专业人员，目前发行人与 SMT 设备（焊接设备与 AOI）相关的技术支持人员为 90 人，未来将扩充至 150 人，逐步为全国各地销售公司配备专职售后服务人员，促进销售的拓展工作。

基于国家政策的大力支持和下游电子制造行业未来的良好发展前景，以及发行人在电子整机装联设备行业内的竞争地位，并考虑到本次募集资金投资项目的产能将在未来几年内逐步释放，且产能扩张测算相对谨慎等因素，发行人未来消化新增产能的压力不大。

4、项目投资概算

本项目新增投资总额 10,517.83 万元，其中：新增建设投资 9,014.63 万元，铺底流动资金 1,503.21 万元。具体投资构成如下表：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总投资
----	------	------	--------

		T1年	T2年	合计	金比例
1	建设投资	1,959.17	7,055.46	9,014.63	85.71%
1.1	建筑工程	1,959.17	4,125.08	6,084.25	57.85%
1.1.1	土地	536.73	0.00	536.73	5.10%
1.1.2	基建投入	1,422.44	2,844.89	4,267.33	40.57%
1.1.3	装修投入		1,280.20	1,280.20	12.17%
1.2	设备及工器具购置安装		2,930.38	2,930.38	27.86%
1.2.1	生产设备		2,507.10	2,507.10	23.84%
1.2.2	测试设备		174.97	174.97	1.66%
1.2.3	生活设施及办公设备		248.31	248.31	2.36%
2	铺底资金		1,503.21	1,503.21	14.29%
3	项目总投资(1+2)	1,959.17	8,558.67	10,517.83	100.00%

其中，生产设备购置安装投入估算为 2,507.10 万元，具体情况如下表：

单位：万元

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	单价	金额
1	激光切割机	GRU-3030	1	340	340
2	数控冲床	AE2510NT	2	170	340
3	数控冲床	EM2510NT	1	260	260
4	数控折弯机	HDS-8025	2	106	212
5	数控折弯机	FBDIII-1025	2	93	186
6	剪床	LC6030	2	22	44
7	氩焊机	TIG-300	10	2.5	25
8	车床	C6132A1	14	4	56
9	车削中心	4270	1	79	79
10	数控车床	G-CNC6135A	2	10	20
11	铣床	M3	15	3	45
12	CNC 加工中心	YCM-MV86	8	55	440
13	数控龙门钻	GDC1016	1	40	40
14	龙门磨	MH-2010M	1	39	39
15	龙门铣	MH-2080B	2	20	40
16	磨床	KGS-512AH	2	20	40
17	激光打标机	HC-DP-W50	1	6.5	6.5
18	冲床	JH21-110	1	17	17
19	冲床	JH21-25T	2	7	14
20	冲床	JH21-60T	2	10.1	20.2
21	空压机	GA22-10P	3	5	15
22	锯床	G4228	2	3.5	7
23	喷涂设备	TY-B	4	1.25	5
24	烤房	7.4×2.5×3	2	10	20
25	线切割机	DK7740	4	4.5	18
26	线切割机	DK7750	2	5.2	10.4

27	发电机	WVS470	3	35	105
28	磨刀机	TOGIII	1	25	25
29	叉式装卸车	6T	1	20	20
30	叉式装卸车	5T	1	18	18
合 计					2,507.10

5、投资项目建设方案

本项目已惠州大亚湾西区第一工业园区内购置 31,948 平方米工业用地使用权，其中本项目占用土地 19,168.8 平方米，占用建筑面积 29,940 平方米；设计达产年产能可为各型号 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备产品 1,350 台，年产值 2.22 亿元人民币，项目将建设成为国际一流的 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备生产基地。

6、项目实施计划

本项目现已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，并已获报政府主管部门审批。募集资金到位后，项目可立即启动。本项目建设工期为 18 个月，工程计划从募集资金到位后的 18 个月内建设完成并竣工验收。项目的装修施工与设备安装按照国家的专业技术规范和标准执行，项目具体的实施进度安排如下所示：

进度阶段	T1 年		T2 年			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
购买场地	■					
清理场地	■					
工程及设备招标		■	■			
厂房及公用工程建设		■	■	■		
装修工程				■		
设备采购及安装调试					■	
人员招聘及培训					■	
设备试运转、试产						■
验收竣工						■

注：T 表示建设期，Q 表示季度

7、主要原材料、动力供应情况

（1）主要原材料

公司生产 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备产品使用的主要原材料为冷、热轧板、钛板、不锈钢板等金属材料及温控模块、热风马达等电子器件，多数原材料为市场常见品种，且绝大部分来自国产。公司与主要原料供应商均为长期业务伙伴，具有多年的良好合作经验，完全可以保障公司 SMT 焊接设备及 AOI 检测设

备产品的原材料供应需求。

（2）主要能源消耗

本项目在生产过程中所用到的主要能源为电力，电力由惠州市供电局按工业用电的标准供应。

8、项目的选址情况

本项目的选址为惠州大亚湾原西区第一工业园区内，占地面积 19,168.8 平方米，建筑面积 29,940 平方米，用于公司 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备的扩产。发行人子公司劲拓精密已于 2011 年 11 月 22 日取得了惠州市人民政府核发的惠湾国用(2011)第 13210100786 号《国有土地使用权证》，该使用权面积为 31,948.00 平方米，使用权类型为出让，终止日期为 2061 年 4 月 15 日，地类（用途）为工业。

该工业区基础设施完备，供水、供电、通讯、道路、排洪排污等基础设施一应俱全，建设条件优越。

9、项目的环保情况

本项目营运期无生产废水产生，主要污染物有员工生活污水、废气、噪声及固定废物等。员工生活污水经自建生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 类标准和《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）的从严指标后回用 60%，其余尾水排入坪山河，影响较小；粉尘、焊接烟尘及油烟废气经收集并安装净化装置，将废气处理达标后引至楼顶高空排放；生活垃圾交环卫部门处置，边角料、废次品交有资质单位回收利用；采取有效的消声降噪措施，使得噪声排放能够满足排放标准；废涂料、废冷却液等危废物质交有资质单位处置。

公司严格执行国家环境保护相关标准，该项目已取得惠州市环保局出具的“惠市环建[2011]30号”环境影响批复意见。

10、投资项目的效益分析

（1）效益分析的计算依据和说明

项目	计算依据和说明
销售量	达产年产能 1350 台，第一年达产 80%，第二年达产 100%
价格	根据同类产品市场价值估算
税率	企业所得税按 15% 税率计算
基准折现率	12%

（2）项目主要效益指标

本项目投产后主要财务指标如下表：

序号	经济指标	所得税前	所得税后
1	静态投资回收期	4.56 年	5.27 年
2	动态投资回收期	5.46 年	5.84 年
3	内部收益率（IRR）	30.10%	23.20%
4	净现值	5,654.18 万元	3,432.73 万元

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目将在惠州大亚湾原西区第一工业园区内新建厂房进行公司研发中心建设，项目将建设成为公司新技术的储备基地，量产测试基地，以及引进技术的消化吸收和创新基地，项目建成后将具有国际先进的研发和测试水平。

项目总投资4,142.16万元，其中土地投入89.45万元，基建投入655.64万元，装修投入196.69万元，设备投资2700.38万元，流动资金500万元。项目完成后，将形成三个高规格实验室，以及一条晶硅太阳能电池试验生产线。公司将利用这些实验室和示范生产线进行多项新产品和新技术的研发、验证和检测。

2、项目实施的必要性分析

（1）项目的成功实施将有利于巩固公司的技术优势地位

电子专用设备制造业是技术密集型行业，产品技术含量高，附加价值大，集成了机械、信息、自动控制、软件编程等技术，具有高度复杂性、系统性和特殊工艺性。

公司是国家级高新技术企业，公司自成立以来，就格外重视产品的研发及技术进步，研发投入逐年提高。公司已成功打破国外企业在电子整机装联设备上的技术垄断，并达到国际一流技术水平，同时公司不断深入研究创新技术领域，成功研制出太阳能电池片生产关键设备—高温烧结炉，公司现有技术处于行业领先地位。

本研发中心建设项目的实施，可以极大地加强公司对本行业及相关领域的技术和市场信息的获取能力、综合分析能力和判断能力，有效跟踪和研究行业发展趋势，加强引进技术消化吸收和创新，形成具有自主知识产权的产品专有技术，确保公司在以后的市场竞争中持续保持技术领先优势。

（2）公司现有条件不能满足新产品研发的硬件要求

一方面，在未来的几年，公司研发的新产品有希力回流焊、RS-回流焊、模组式选择焊等，另外平板式 PECVD（氮化物沉积设备）、高速高温烧结炉等众多太阳能光伏设备领域的高新技术产品也正在研发中。由于新型设备的研发过程中，需要引入大量先进仪器检测设备，以保障产品质量，而公司现有研发设备无法完全满足需要，因此亟需通过研发中心项目的建设，引入先进的研发检测和试验设备。

另一方面，公司现有研发用房与日常办公场所混杂，研发、试验及检测面积不足，目前已无法安放未来新增的研发、检测设备。而且由于太阳能电池设备在研发中所需的示范线对车间环境（无尘室）和建筑物层高也有独特要求，因此为了更好地实现公司产能与效益进一步提升的要求，迫切需要加大固定资产投入，新建更高标准的厂房及其它配套设施。

3、项目投资概算

本项目总投资 4,142.16 万元。其中，建设投资 3,642.16 万元，铺底流动资金 500 万元。具体投资构成如下表：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额			占项目总投资 金比例
		T1 年	T2 年	合计	
1	建设投资	308.00	3,334.16	3,642.16	87.93%
1.1	建筑工程	308.00	633.78	941.78	22.74%
1.1.1	土地	89.45	-	89.45	2.16%
1.1.2	基建投入	218.55	437.09	655.64	15.83%
1.1.3	装修投入	-	196.69	196.69	4.75%
1.2	设备及工器具购置安装		2,700.38	2,700.38	65.19%
1.2.1	研发设备		2,443.35	2,443.35	58.99%
1.2.2	辅助设备		71.62	71.62	1.73%
1.2.3	生活设施及办公设备		185.41	185.41	4.48%
2	铺底资金		500	500.00	12.07%
3	项目总投资(1+2)	308.00	3,834.16	4,142.16	100.00%

其中：研发设备投入估算 2,443.35 万元，具体购置清单如下：

单位：万元

序号	设备名称	规格型号	数量	金额
1	前清洗机	WEC0122S	1	438.00
2	制绒机	25MW	1	135.00
3	硅片甩干机	FOX01	2	15.60

4	Demo Line	扩散炉	高温扩散炉（3管）	1	300.00	
5		等离子清洗/刻蚀设备	SSE 型 8800	1	16.00	
6		去磷硅玻璃清洗机	满足 50MW 生产线, 125mm 和 156mm 方片兼容	1	60.00	
7		印刷机	全自动 PV1200	2	1,022.00	
8		半自动测试分选机	XJCM-8X	1	8.00	
9		硅片超声波清洗	KWT-1006	1	0.35	
10		实验室去离子水机		1	1.80	
11		烘干炉	自产 DA-700	1	30.00	
12		高温烧结炉	自产 FF-600	1	120.00	
小 计 1					2,146.75	
13		Lab Testing	方块电阻测试仪	RTS-4 型	1	1.35
14			膜厚折射率检测仪	SE400adv-PV	1	33
15	电子分析天平		赛多利斯 ALC-110.4	1	0.7	
16	EL 测试仪		ELMES-Ca	1	22	
17	温度测试仪		Sunkic+Eclipse+优化软件	1	13	
18	工具显微镜		VMT	1	13	
19	射频测试仪		NIPXIe-5663E 10MHZ~6.6GHZ	1	23	
20	少子寿命方块无接触扫描		Semilab WT-2000PV	1	190	
21	判型仪器		PN-30 型	1	0.55	
小 计 2					296.60	
合 计					2,443.35	

4、项目对发行人未来经营成果的影响

本项目为非生产性项目，不进行单独财务评价。项目投资目的是为公司未来开拓新的技术市场领域，实现公司产品结构多元化目标提供基础。项目短期内对公司利润不会产生大的影响，未来研发的新产品上市以后，随着公司产能以及产品生产质量水平的大幅度提高，预计将对公司经营业绩产生重大影响。

5、项目研发成果目标

本项目研发中心的建立，旨在为公司将来进一步提升 SMT 焊接设备和 AOI 检测设备及电子产品周边设备技术提供技术创新研究平台；为公司太阳能光伏设备产品和技术研发提供工艺测试场所和建立示范生产线。进一步提升公司现有的高温烧结炉产品技术和工艺水平，同时重点对平板式 PECVD 和高速高温烧结炉等产品进行关键技术研究，丰富公司的产品体系，拓展新的市场，从而有效提升企业的经营规模及综合竞争力。项目建设完成后，将对希力回流焊、RS-回流焊、AS-回流焊、晶圆植球焊接、高温焊锡回流焊、模组式选择焊、低能耗选择焊、

选择性喷雾机、全新优化波峰焊、平板式 PECVD、高速高温烧结炉等多项产品课题进行技术研究。

研发中心预期形成的成果包括：

- （1）培养一批专业的研发团队，为公司的持续创新增添源源不断的动力；
- （2）形成一批专利或核心技术，在市场竞争中保持强大的优势；
- （3）为公司的产品结构优化提供不断创新的产品线；
- （4）研发成果将为生产高质量、低成本的产品提供支持；
- （5）将研发中心形成的技术成果转化为实际新产品，进一步丰富公司的产品结构。

6、投资项目建设方案

本项目主要建设内容包括：

（1）在惠州大亚湾原西区第一工业园区购置 31,948 平方米工业用地之土地使用权，以其中 3,194.8 万平方米用于本项目研发中心办公场地建设，项目计划占用建筑面积 4600 平方米；

（2）对研发中心场地进行装修、整理，并引进一批研发软硬件设备及原材料、新产品和技术工艺的研发；

（3）投入建设无尘测试实验室、产品基础实验室、产品试验室/试制车间以及一条晶硅太阳能电池生产研究示范线；

（4）新建一幢员工倒班宿舍、食堂及文体活动中心；

（5）建设动力站房、消防水池及门卫室等配套建筑。

7、项目的实施计划

本项目现已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作，并已获报政府主管部门审批。募集资金到位后，项目可立即启动。本项目建设工期为 18 个月，工程计划从募集资金到位后的 18 个月内建设完成并竣工验收。

进度阶段	T1 年		T2 年			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
购买场地						
清理场地						
工程及设备招标						
厂房及公用工程建设						

装修工程					■		
设备采购及安装调试						■	
人员招聘及培训						■	
设备试运转、试产							■
验收竣工							■

注：T 表示建设期，Q 表示季度

8、主要动力供应情况

研发过程中所用到的主要能源为电力，电力由惠州市供电局按工业用电的标准供应。

9、项目的选址情况

本项目的选址为惠州市大亚湾原西区第一工业园区，该园区位于大亚湾中心地带，更处于国务院批准的大亚湾经济技术开发区 9.98 平方公里范围内，园区内各项配套齐全，交通便利、高新技术企业聚集，为本项目研发中心建设提供了良好的人才和技术条件。发行人子公司劲拓精密已于 2011 年 11 月 22 日取得了惠州市人民政府核发的惠湾国用（2011）第 13210100786 号《国有土地使用权证》，该使用权面积为 31,948.00 平方米，使用权类型为出让，终止日期为 2061 年 4 月 15 日，地类（用途）为工业。

工业区基础设施完备，供水、供电、通讯、道路、排洪排污等基础设施一应俱全，建设条件优越。

10、项目的环保情况

本项目营运期主要污染物有污水、废气、噪声及固定废物等。员工生活污水经自建生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 类标准和《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）的从严指标后回用 60%，其余尾水排入坪山河，对纳污水体坪山河水质影响较小；废酸、废碱交有资质单位处置；酸雾、试验废气及油烟废气经收集处理达标后高空排放；生活垃圾交环卫部门处置，试验废弃物交有资质单位处置。

公司严格执行国家环境保护相关标准，该项目已取得惠州市环保局出具的“惠市环建[2011]32号”环境影响批复意见。

（三）其它与主营业务相关的营运资金项目

1、与主营业务相关的营运资金的必要性

（1）公司作为高科技成长企业，在产品研发及采购、销售等环节需要大量营运资金

公司主要从事 SMT 焊接设备及 AOI 检测设备、太阳能高温烧结炉设备等电子工业专用设备产品的生产和销售业务。未来，公司将从产品售前、售后的技术服务，延伸至行业应用解决方案服务，为客户提供全方位的技术及产品服务，提高公司的市场竞争力，提升公司的盈利能力。公司作为国内电子工业专用设备细分行业中的先进企业，在产品研发、采购、销售等主要营运环节均对营运资金的充裕性具有很高的要求。一方面，公司在产品研发阶段，包括研发初期和试产阶段，需要投入较大的基础研究及测试费用；另一方面，公司在产品采购和销售阶段，需要针对客户需求、应用领域等，确定每年的营销计划，并根据预计销售规模组织产品采购。随着项目投产后产品技术水平的提高以及各项主导产品的销售规模快速扩大，相应产品备货等环节所需的营运资金数量也将大幅增加。

（2）公司需要持续保持创新技术研究，以确保核心技术和核心产品的领先地位，必须保持充足的营运资金加大研发投入和引进高级技术人才

作为高科技成长企业，创新技术研究、创新产品的开发和高新技术人才的引进是公司可持续发展的保障，需要持续的资金支持。公司拟通过不断的资金投入，开展多方位的研发活动，吸引更多行业内的优秀人才，进一步提高研究开发能力，确保核心技术和核心产品的领先地位。同时，公司还需要在基础研究方面投入大量资源，进行基础技术的平台化积累，包括更多的核心专利的开发，以巩固和持续发展公司的核心技术能力。目前，公司主要通过稳健的决策方式进行营运资金的管理。本次募集资金到位后，公司可以利用募集资金增加其他与主营业务相关的营运资金，以进一步提高公司资金实力，增强公司项目实施的能力，加大研发投入，满足公司业务不断发展的需求。

2、补充营运资金对公司的财务影响

本次募集资金补充营运资金后，公司的资产负债率进一步降低，提高了公司的偿债能力；公司资产的流动性进一步提高，降低了资金流动性及营业风险。本次募集资金补充营运资金后，短期内可能不会产生经济效益，因此补充营运资金

后公司在短期内净资产收益率可能下降，但随着公司募投项目的达产以及公司经营规模的扩大，公司的盈利能力将不断得到增强。

三、固定资产投资的必要性及新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

（一）固定资产投资的必要性

1、技术升级改造和产品研发需要配套升级研发环境和购置先进的研发工具

公司本次募集资金项目中，SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目、研发中心建设项目的固定资产投资分别为8,477.90万元、3,552.71 万元，总计为12,030.61万元。

本次募集资金运用的两个项目均涉及技术改造和研发类型。其中，SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目因要对现有产品技术和工艺流程进行改造升级，涉及的产品规模更大、复杂程度更高；而研发中心建设项目则需要建立一整套研发实验室和与之相配的先进研发设备。因此，随着产品研发规模的增大以及新技术、新工艺的导入，需要配备更为完善和先进的研发环境。

2、业务发展需要增加和扩大经营场所

随着公司业务规模的迅速发展和人员数量的快速增长，公司对经营场所的规模要求愈来愈大。目前公司现有的厂房利用已达到极限，随着下游产品需求的稳定增长，公司生产经营场所已严重不足。为创造稳定、先进的产品研发和生产环境，进一步优化资产结构，提升公司产能和销量，公司必须投资扩大经营场所，加大对产品研发和生产性房产的投入。

综上所述，本次募集资金投资项目的固定资产支出投资方案是项目顺利开展的必要条件，可以有效保持和提升公司的竞争力，从而使得公司在越来越激烈的市场竞争中持续保持市场领先优势，确保公司的可持续发展。以上募投项目实施前后，公司的生产经营模式不会发生变化。

（二）新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也

将发生较大变化。不考虑“其他与主营业务相关的营运资金”项目，本次发行募集资金投资项目中固定资产投资总额为12,030.61万元，固定资产投资年折旧额总计为787.96万元，将导致公司未来固定资产折旧的大幅增加。

按照公司现行固定资产折旧政策，项目建成投产后新增固定资产年折旧情况如下：

单位：万元

项目 名称	建筑物		机器设备		合计	
	投资额	年折旧额	投资额	年折旧额	投资额	年折旧额
SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目	5,547.53	175.67	2,930.37	304.35	8,477.90	480.02
研发中心建设项目	852.33	26.99	2,700.38	280.95	3,552.71	307.94
合 计	6,399.86	202.66	5,630.75	585.30	12,030.61	787.96

注：折旧年限：①建筑30年；②设备5-10年；③折旧方法：直线折旧法；④净残值率为5%

2009 年、2010 年和 2011 年，公司综合毛利率分别为 40.99%、42.43% 和 41.41%，取毛利率最低的 2009 年数据 40.99% 进行测算，项目建成后，在经营环境不发生重大变化的情况下，如公司存量资产实现的主营业务收入较项目建成前增加 1,922.32 万元，增加的主营业务利润为 787.96 万元，即可消化掉因新项目固定资产投资而导致的折旧费用增加，确保公司主营业务利润不会因此而下降。以 2011 年公司主营业务收入 25,294.40 万元为基础，假设其他经营条件不变，只要公司主营业务收入增长超过 7.6%，就可确保公司营业利润不会因此而下降。而目前公司主营业务收入保持着良好的增长态势，2009 年-2011 年，公司主营业务收入增长率分别为 31.37%、127.76% 和 21.1%，未来保持 7.6% 的增长率具有可行性。因此，以公司目前生产经营状况，足以消化掉上述折旧费的增加，公司未来经营成果不会因此产生不利影响。

四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响

本次募集资金投资项目实施后，对公司财务状况和经营成果的影响如下：

（一）对公司财务状况的影响

1、本次募集资金到位后，公司的资产总额和净资产都将大幅提高，短期内资产负债率水平将进一步降低，防范和抵御财务风险的能力将大幅提高。

2、对短期偿债能力的影响。本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比

率将大大提高，这将进一步增强公司的后续持续融资能力和抗风险能力。

3、募集资金到位期初，公司净资产和总资产将大幅增长，由于投资项目处于建设期，不能马上产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内有较大幅度的降低。但随着募集资金投资项目的逐步达产，将大大增强公司的市场竞争力，公司的盈利能力将逐步提高。

4、公司其他营运资金投入使用后，一方面可以减少公司财务费用，降低资产负债率，优化财务结构，降低财务风险，另一方面可为未来债务融资创造有利条件。

（二）对公司生产能力和技术水平的影响

本次募集资金项目顺利实施后，将从整体上提升公司产品研发和生产能力，以及市场营销能力，系统性扩大公司生产经营规模，进一步满足市场对 SMT 焊接设备、AOI 检测设备等电子工业专用设备产品的巨大需求。随着募投项目的开展实施，以及公司对项目管理上的严格安排及制度完善，将促使公司整体管理水平实现较大跨越，进而增强公司的竞争实力和抵御市场风险的能力。

（三）对公司经营成果和盈利能力的影响

本次募投资金拟投资于“SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目”、“研发中心建设项目”以及“其它与主营业务相关的营运资金项目”，以上述募投项目作为测算对象，上述项目实施投产后五年内对公司经营业绩的影响详细情况如下：

单位：万元

项目	T3 年	T4 年	T5 年	T6 年	T7 年
SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目	3,415.62	4,584.12	4,596.74	4,792.01	4,880.40
研发中心建设项目	-1,288.33	-1,337.26	-1,386.19	-1,435.12	-1,484.05
其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-	-	-	-
募投项目实施对公司利润的影响	2,127.29	3,246.86	3,210.55	3,356.89	3,396.35

注：T1 下半年和 T2 全年为项目建设期，没有产出

通过上表的测算可以看出，上述募投项目实施后从 T3 至 T7 年开始，募投项目将逐年为公司新增利润 2,127.29 万元、3,246.86 万元、3,210.55 万元、3,356.89

万元和 3,396.35 万元。从长远来看，随着募集资金投资项目逐步产生效益，在其它因素不变的情况下，公司的盈利能力将得到提高，净资产收益率将会逐步上升并趋于稳定。本次募集资金投资项目均进行了充分的论证，未来市场前景较好。

五、募集资金专户存储的相关措施

公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金存放于董事会决定的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司在募集资金具体使用过程中，将根据公司业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，保障和不断提高股东收益。

第十二节 未来发展与规划

一、公司发展目标、发展规划及具体经营计划

（一）发展目标

1、发展方向：

2010年，中国已经超过美国成为全球制造业第一大国，但与此地位不相符的是，我国制造业的基础——装备制造业（工作母机），尤其是高端精密装备产业仍相对弱小。具体到电子装备领域，一些关键设备（如贴片机、半导体设备、太阳能电池生产设备、LED生产设备等），几乎被欧、美、日少数企业垄断。高昂的垄断价格严重掣肘了中国新兴制造业的发展，部分造福全人类的产业（如太阳能上网电价的下降、LED节能灯普及等）不能以更快的速度扩大生产规模。

因此，电子产品生产装备是公司坚定不移的发展方向。并且公司认为，越是国外企业占优势甚至垄断的设备，其未来发展的潜力及回报越大。

2、阶段成果：

在专业电子装备领域，通过多年努力，公司生产的电子整机装联设备（波峰焊、回流焊及焊接机器人等）不仅在市场份额及价格上处于领先地位，在关键技术上也已达到世界一流水平。同时公司利用多年的相关技术积累，经过两年多的潜心研发，于2010年成功推出太阳能电池高温烧结炉，并在国内一流太阳能电池生产厂商的生产线上（非试验线）应用，打破了国外企业对该设备的垄断。

3、发展目标：

在从小到大、从弱到强的成长过程中，公司集聚了大量优秀的人才、积累了丰富的经验、增强了未来发展的信心。公司的发展目标始终如一：专注于电子装备制造制造业，不断赶超世界先进水平，打破垄断，成为世界一流的电子装备供应商。

（二）发展规划

在上述发展目标的定位下，基于对电子整机装联设备及太阳能光伏设备市场的发展趋势的分析，制定了如下发展规划：

1、横向：

公司将继续巩固壮大在电子整机装联设备领域的优势地位，以现有关键产品

为中心，向工艺链上下游拓展，由提供单机逐渐转变为提供成套设备，不断丰富产品线。同时为顺应近年来节能环保、电子产品集成度越来越高的趋势，公司将继续加大研发投入，在降低设备能耗的同时，不断提高电子产品生产过程中精密焊接、自动焊接和自动检测的水平，为客户提供能够节能降耗、减少用工、提升附加值的先进装备；

2、纵向：

发行人利用在热工、流体、自动控制、精密加工等方面长期积累的技术优势和成熟经验，成功研制太阳能电池生产线上的关键设备—高温烧结炉。未来发行人将以高温烧结炉上市为突破，进一步向其他炉类设备扩展，积极开拓国内、国外市场，提高公司在电子专用设备领域的市场占有率。

（三）具体经营计划

未来三年内，发行人将强化技术研发投入，增进自主创新能力；加强国际市场开拓，进一步增强公司的成长性。为了实现上述发展目标，发行人围绕增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争力优势方面制定了一系列经营计划，具体说明如下：

1、产品开发计划

未来三年，在巩固现有波峰焊、回流焊、选择焊（焊接机器人）、AOI 检测设备电子整机装联设备在国内同行业中领先地位的同时，公司将逐步加大高附加值产品的研发力度，在产品设计、工艺技术、新材料开发应用及节能环保等方面建立与公司发展相适应的高效的技术创新平台，如研发生产针对下一代先进封装技术的高端 SMT 焊接设备 SELEIT 回流焊；针对高级无尘生产车间的系列回流焊；应用于高价值电子产品生产的模组式选择焊，以及用于在线检测锡膏印刷品质的光学检测设备（SPI）等。

在太阳能光伏设备领域，公司在继续优化高温烧结炉品质和性能的基础上，将通过技术合作开发太阳能电池镀膜设备（PECVD），该产品是太阳能电池生产中必不可少的高科技关键设备，与目前市场上现有的 PECVD 相比，公司研发生产的平板式 PECVD 具有更优异的膜层致密性和钝化效果，能有效减少电池片的表面损伤，并且产量更高。

2、技术开发计划

（1）升级研发实力，建立国家级技术中心

公司将充分利用现有研发技术中心的优势，进一步提高焊接设备的稳定性和可靠性，增强视觉检测设备在全自动生产线中的应用。公司还将建立太阳能电池生产示范测试线，加强在光伏设备领域的技术储备，并积极将技术成果转化为市场效益。

未来公司将继续深化产、学、研合作，通过与国内在机械、电子类学科处于领先地位的学校联合办学、联合建立国家级技术中心和重点实验室、共同承担国家相关科研项目等方式，持续提升公司产品的技术水平和市场竞争力，引领国内行业技术潮流。

（2）加大研发经费投入和培养高层次研发人才

未来公司将继续增加研发费用的投入，每年保持与销售额相匹配的研发支出，以保证公司研发项目的顺利实施，提升公司的核心竞争力。另外，公司将根据业务发展需要，通过内部培养（如派出优秀工程师赴国外进修，委托国内高校培养在职工程硕士生）和外部引进并举的方式，确保公司研发技术人才供给能够满足技术开发和创新的需要。

（3）持续增加研发设备的投入

目前公司拥有各类大型及精密研发试验设备 90 余套，未来公司还将根据技术中心发展需求情况，不断增加更加先进和精密的生产试验设备，持续增强技术水平和研发实力。

3、市场开拓计划

（1）持续拓展国内市场，保持在中高端领域的优势地位

公司目前已经具备强大的销售网络，业务发展遍及全国各地，在国内电子制造产业集聚地区均有服务网点覆盖。今后公司将充分利用电子产业转移规律带来的机遇，新增服务网点，并为现有服务网点增加人员配备，全面提升服务力量。另外，公司还将进一步发挥自身竞争力，实施产品差异化策略，进一步加强与客户的沟通与交流，及时收集市场信息，更好的满足客户的需求，在提高客户对公司品牌的信任度的同时，扩大公司产品在中高端市场领域的份额。

针对太阳能光伏产业的市场现状，在营销策略上，公司将采取突出重点区域，逐渐扩大销售范围的策略，在太阳能电池生产相对集中的市场成熟区域，设立驻

外办事处和售后服务中心。在营销手段上，公司将通过在 B2B、专业报刊杂志等媒体刊登广告，树立公司品牌形象，宣传推广公司产品；同时积极参加国内外各种展销会，直接面对客户展示公司产品，强化客户对本公司产品性能的认识，开拓太阳能光伏设备客户群。

（2）进一步扩大海外市场

在电子整机装联设备方面，公司计划在未来三年内，除在国内市场上逐步实现进口替代外，还将利用品牌形象、规模效应及与海外经销商良好的合作关系等优势，积极开拓国际市场，进一步提高公司产品在国际市场的份额。

目前世界各国都加强了对洁净能源产业的支持，尤其是美国等一些国家重点加强对太阳能电池生产的投入，公司将利用这一政策优势，加强与美国伙伴公司在技术研发、市场营销、客户开拓等方面的全方位合作，积极开发美国市场，进而向全球市场拓展。

（3）推广新工艺，扩大产品市场应用范围

公司将通过向客户提供培训和与客户进行有效沟通等方式，引导客户进行产品工艺革新，强化客户对设备应用范围的认识（如推广选择焊在汽车电子领域的应用等），不断挖掘潜在市场，拓展新用户群体。

4、人力资源发展计划

作为高科技装备制造业公司，人才和技术的积累缺一不可。公司根据今后几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划。未来三年，为适应公司产品结构的调整、市场领域的拓展、管理水平的提升、企业文化的建设等各方面的发展需要，公司将继续坚持以人为本的企业文化理念，在优化开发现有的人力资源的基础上，大力培养和引进高水平技术研发人才、高素质专业管理人才、高技能产业工人等，同时公司将进一步完善人才培养、引进和激励机制，以广阔的职业发展空间、富有竞争力的薪酬体系和良好的工作环境大力吸引并留住人才，在配合公司业务拓展计划的基础上为公司建立充足的人才资源储备。具体的人才计划如下：

（1）高级专业技术人才

公司现有研发人员 95 人，未来三年将达到 180 人。公司将在三年内通过培养与引进相结合的方式，将能带领承接大型专用装备研发设计团队的高水平人才增加到 20-30 名，以保证公司多项研发或改进项目的并行开展和高速推进。

（2）高级专业管理人才

公司在采购供应、生产计划管理、质量管理、市场营销、证券管理与资本运作、人力资源等方面要培养和引进一批精通业务的骨干，通过在中层管理岗位的培养和锻炼，使其成为公司发展的核心管理队伍和高层管理的后备军，并随时可以承担起公司业务扩张和市场拓展的核心人员。公司管理人员全部参加与本职工作相关的职业培训及学习，不断提高管理水平。

（3）高技能产业工人

公司一线生产工人普遍采用经中专技校专业培训的技术工人，未来几年公司计划通过“教、传、帮、带”的手段，大力培养一批能制造精良机器的高技能产业工人。必要时，公司还将从日、德等传统工业强国高薪引入专业人才，提高自身加工水平。

（4）在严格执行国家各项社会保障规定的前提下，不断提高员工的收入及福利，鼓励并尽可能协助员工做好调户口、评职称、安家置业等工作，使员工尽量解除后顾之忧，安心专注于本职工作。

5、收购兼并计划

装备制造业是一般制造业的基础，行业集中度随着市场成熟会越来越高。为配合公司整体战略发展规划方案的实施，公司将在完善产品结构、构建经营合理布局、拓展市场及营销网络等方面积极挖掘相关产业的经营机会。公司将针对国内外经济现状，在电子专业装备行业，发掘部分拥有专有技术、但市场开拓不佳的小企业。一旦发现合适的收购兼并对象，公司将进行详细的可行性研究和方案论证，若方案可行，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，借此不断提升公司产品和市场竞争力、扩大市场占有率。

6、国际化经营计划

欧、美、日装备制造业的传统强国地位，在相当长一段时期还将持续。在条件具备时，公司将在上述地区建立技术中心，充分利用欧、美、日在技术创新、设计以及精密加工方面的优势，吸纳国外优秀人才和技术。同时，公司将持续关注国外新兴经济体的发展，择机投资建厂并占领市场，开展国际化经营，逐渐使企业成为符合国际化规范运作的跨国公司。

7、筹资计划

本次发行募集的资金将在一定程度上满足公司未来一段时间内业务发展的需要。随着业务发展与企业规模的逐步壮大，公司将根据业务发展需要或优化资本结构的需要，选择适当的时机以合理的方式利用资本市场进行再融资。对于未来的资金需求，公司一方面将以规范的运作、良好的经营业绩与稳定的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场中的持续融资能力；另一方面，公司也将适当利用银行贷款，完善公司的资本结构，提高经营效益。

二、拟定发展规划与经营计划所依据的假设条件

发行人制定以上发展规划与经营计划充分考虑了国内外电子专用设备行业和发行人所处的细分子行业的现状以及公司的经营现状，所依据的假设条件如下：

- 1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态，国家产业政策无重大变化，未出现对公司发展产生重大影响的不可抗力因素；
- 2、本公司所属行业保持正常发展态势，不出现重大市场突变；
- 3、本公司现有管理层与核心技术人员继续保持稳定；
- 4、本次发行如期完成，募集资金及时到位。
- 5、无其他不可预见和人力不可抗拒的因素造成的重大不利影响。

三、实施发展规划可能存在的困难

从目前公司的实际情况看，实施上述经营计划面临的主要困难包括：

1、资金瓶颈制约：装备制造业是制造业的基础，是需要长期培育和积累的产业。公司所处的电子专用设备制造行业，国外厂商大多经营历史悠久、技术积累雄厚。为应对激烈的市场竞争，公司需要不断开发新技术和新产品，而这些新技术和新产品的研发必然需要较大规模的资金投入。现阶段，本公司的融资渠道与手段较为有限，仅仅依靠自身的利润滚存积累，无法进行大规模、持续的技术开发投入，有可能错过中国产业结构调整、新能源兴起、制造业大规模内迁以及国外经济不振所提供的发展良机。因此，能否借助资本市场，通过公开发行股票迅速筹集资金，将成为公司发展计划顺利实施的关键所在。

2、人才短缺制约：公司进行新产品的开发需要大量高素质的人才，尤其是

太阳能光伏设备行业对管理、技术复合型人才及优秀财务人员有较大需求，公司未来发展中面临如何进行人才培养、引进和激励的挑战。

3、厂房、设备制约：公司目前厂房使用已接近饱和，而装备制造业厂房因承重、层高、无尘等要求又难以在市场上租到，因此新厂房建设迫在眉睫。另外，由于产品的生产量和科技含量都大幅提高，而外发加工在核心技术保密、产品质量、交货周期方面难以确保。因此本公司所用生产设备，尤其是高精尖的加工设备也亟待增加。

四、本次发行对公司实现发展规划的作用

1、本次公开发行募集资金将为上述规划的实现提供良好的资金保障，有助于强化公司的可持续发展能力与抗风险能力，促进公司提升竞争力；

2、本次发行后，公司知名度、市场影响力与品牌效应等将得到全面提升，从而为公司业务拓展提供强有力的支持，为实现公司发展规划与经营计划创造有利条件；

3、本次发行后，公司将成为公众公司，接受政府监管部门与广大投资者更加全面的监督，从而有利于公司完善治理结构，为公司持续发展提供制度保障。

4、本次发行后，由于新工厂加快建设，公司的制造能力和加工水平将大幅提高。

五、确保实现规划和计划拟采用的方法

公司计划通过本次发行股票，进入资本市场；并利用本次募集资金集中精力完成拟投资项目，从而进一步提高和巩固公司在电子整机装联设备领域的市场地位。为确保实现规划和计划，公司拟采用的方法如下：

（一）加强募集资金管理、认真组织募集资金投资项目实施

如果本次公开发行成功，将为公司实现上述业务目标提供有力的资金支持。公司将认真组织募集资金投资项目的实施，促进公司业务水平的提高与业务规模的扩大。

（二）进一步完善公司的法人治理结构

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运

作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。

（三）加快对优秀人才的培养和引进

鉴于国内电子专用设备制造领域人才的稀缺与公司业务规模扩大对于人才的需求，公司将以本次发行为契机，加快对优秀人才的培养和引进，为公司创新能力和实施能力的不断提升提供良好保障。

六、对未来发展规划与经营计划的声明

本公司对未来发展规划与经营目标的声明如下：公司制定的未来业务发展规划和经营计划是根据公司的使命和远景，结合目前可以预见的业务、市场和技术发展趋势所制定的中长期战略规划。公司将根据上市后公司内部发展和外部环境的实际变动情况，对未来的业务发展规划进行适时的回顾与更新。本公司在创业板公开发行上市后，将以定期报告持续公告规划实施和目标实现情况。

七、业务发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规划是基于目前公司行业地位及经营状况，充分考虑未来行业发展趋势，对现有业务的进一步深化和拓展，符合公司的战略定位。上述规划和计划的实现有助于公司延伸产品体系、优化业务结构，进一步扩大公司的产能，扩大客户对象，开发并占领新的市场，提升整个公司的品牌形象和综合实力。

本次公司首次公开发行股票并上市对公司能否顺利实现上述发展目标将起着至关重要的作用。随着募集资金的到位和经营计划的实施，公司将迎来新的发展机遇，将使公司在产品的研发能力与业务规模方面均跃上新的台阶，帮助公司向规划的战略目标稳步迈进。

第十三节 其他重要事项

一、重大合同协议

重大合同主要指截至本次招股说明书签署日仍在执行中，且合同金额在 150 万元以上、对公司经营活动、未来发展具有重要影响的合同。依此标准，截至本次招股说明书签署日，公司已签署且仍在执行中的重大合同协议如下：

（一）销售合同

鉴于公司主要产品焊接设备与高温烧结炉从签订订单到收到全额货款需要经过生产、发货、调试、验收与收回尾款等较多环节，合同周期较长。截至本次招股说明书签署日，公司仍在执行中且金额达 150 万元以上的重大销售合同列表如下：

单位：万元

序号	签订日期	客户名称	合同内容	合同总金额
1	2010.05.28	宁波高新区七鑫旗科技有限公司	无铅回流焊	175.00
2	2010.07.26	深圳市神舟新锐电脑设备有限公司	无铅回流焊与周边产品、AOI 检测设备	238.10
3	2010.09.23	广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	无铅波峰焊、回流焊及周边产品	164.70
4	2011.01.13	深圳市锐业科技开发有限公司	无铅双轨高端回流焊	167.50
5	2011.01.20	尚德太阳能电力有限公司	烘干烧结一体炉	232.00
6	2011.07.02	东莞市金众电子有限公司	无铅回流焊	168.49
7	2011.08.24	天津钜宝电子有限公司	Seleit 无铅回流焊	608.00
8	2011.10.28	深圳市普联技术有限公司	无铅回流焊	170.40
9	2011.10.28	深圳市普联技术有限公司	无铅回流焊	170.40

（二）技术开发（委托）合同

公司于2010年10月22日与Southwest Equipment Services（美国西南设备服务公司，以下简称“转让方”）签订了《PECVD氮化物沉积系统技术转让合同》，根据该合同约定，转让方将双方合同中约定规格的PECVD氮化物沉积系统技术，包括PECVD氮化物沉积系统设备相关的设计、制造工艺、集成、测试、维护及后续改进等相关技术及相应的知识产权转让给公司，技术转让总价为168.75万美

元。公司将按照合同中约定的付款进度以电汇或信用证的方式向转让方支付技术转让款。经双方约定，本次转让价款为固定价款，不随通胀率以及汇率的变化而改变。

2011年3月25日，发行人与Southwest Equipment Services（美国西南设备服务公司）签订了《合同》（合同号：PO2-2011030003）。根据该合同约定，发行人向该公司购买Test Chamber System for PECVD Nitride Processing，总金额为29.646万美元，质量保证期为1年（人为原因损坏除外）

（三）无形资产转让协议

公司于2009年8月18日与深圳市运英软件开发有限公司签署《无形资产转让协议》，有关该协议详细内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、报告期的关联交易”之“（二）偶发性关联交易”之“2、收购运英软件与生产AOI检测设备相关资产”。

截至报告期末，公司已销售在线AOI检测设备30台，离线AOI检测设备448台，按照协议约定共计应向运英软件支付无形资产转让费用508万元，其中已支付436万元，仍需向运英软件支付的转让价款金额与公司后期AOI检测设备的销售数量相关，但累计支付总金额最高不超过1,308万元。

（四）租赁合同

2010年12月24日，公司与深圳市天富安物业管理有限公司（以下简称“出租方”）签订了《厂房租赁合同书》，出租方将其位于深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角旧村合海工业园二栋一楼厂房及配套宿舍五楼2间、六楼5间共7间出租给公司使用，厂房面积为2,450平方米，租赁期限自2011年1月1日至2013年12月31日止，月租金55,825元，厂房及配套宿舍的租金前两年不变，从第三年起按递增10%计租。

（五）授信协议、抵押合同与贷款合同

2010年12月13日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2010年宝字第0010408337号”的《授信协议》，协议规定循环额度为人民币1,500万元，一次性额度为人民币3,500万元，授信期间自2010年12月17日至2012

年 12 月 17 日。同时，公司与该行签订编号“2010 年宝字第 0010408337 号”的最高额抵押合同，以公司所有的“深房地字第 5000469662 号”位于深圳市宝安区西乡街道鹤洲工业区的厂房（一）【含宿舍（一）、宿舍（二）、门卫（一）、水泵房】为上述授信协议提供抵押担保。此外，公司控股股东吴限与该行签订编号为“2010 年宝字第 0010408337 号”的最高额不可撤销担保书，约定在保证范围内对公司债务承担连带清偿责任。

在上述《授信协议》授信额度下，2010 年 12 月 24 日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订《借款合同》，借入长期借款 2,000 万元，期限为两年，利率为 1-3 年人民币贷款基准利率 5.60%，且每三个月按 1-3 年基准率调整，本金偿还方式为自借款之日起半年后的每季 24 日偿还本金人民币 500 万元，余款于贷款期限届满之日一次性还清。2011 年 4 月 28 日，发行人与招商银行股份有限公司深圳宝安支行（贷款方）签订了《借款合同补充协议》（合同编号为 2010 年宝字第 1010400542 号），发行人与贷款方就 2010 年 12 月 24 日签订的编号为 2010 年宝字第 1010400542 号《借款合同》项下相关事宜达成补充协议，同意自该补充协议签署之日起，发行人在上述借款合同项下尚未偿还的贷款本金由“按借款合同第 3 条约定的计划分期等额归还”变更为“在贷款期限届满之日一次性偿还完毕”，但发行人经贷款方同意后主动提前还款或贷款方依法（或依约）提前收回贷款的情形除外。2011 年 10 月 20 日公司与该行签订了《固定资产借款合同（中长期借款合同）补充协议》（合同编号为 2010 年宝字第 1010400542 号），约定该笔贷款尚未偿还的本金由在贷款期限届满之日一次性偿还完毕改为最低每半年一次频率分期归还本金及相应利息，本金具体还款计划为：2012 年 1 月 1 日归还 50 万元，2012 年 6 月 1 日归还 50 万元，2012 年 12 月 1 日归还 50 万元，2012 年 12 月 24 日归还 1,850 万元。

2011 年 2 月 28 日，发行人与招商银行股份有限公司深圳宝安支行（贷款方）签订了《借款合同》（合同编号：2011 年宝字第 1011400031 号），发行人向贷款方贷款 1,500 万元，用于流动资金周转，贷款期限为 2 年，自 2011 年 2 月 28 日起至 2013 年 2 月 28 日止，利率以定价日中国人民银行公布的 1-3 年人民币贷款基准利率上浮 8%，，每三个月按 1-3 年基准率调整。2011 年 11 月公司与该行签订了《固定资产借款合同（中长期借款合同）补充协议》（合同编号为 2011 年宝

字第 1011400031 号) 约定该笔贷款尚未偿还的本金由在贷款期限届满之日一次性偿还完毕改为按照最低每半年一次的频率分期归还本金及相应利息, 本金具体还款计划为: 2012 年 1 月 1 日归还 50 万元, 2012 年 6 月 1 日归还 50 万元, 2012 年 12 月 1 日归还 50 万元, 2013 年 2 月 28 日归还 1,350 万元。

2011 年 9 月 15 日, 发行人与中国民生银行股份有限公司深圳分行(贷款方) 签订编号为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”《综合授信合同》, 协议约定的授信期间为 2011 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 15 日, 约定的授信额度为 8,000 万元人民币, 最高授信额度可用于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证及进口代付, 在授信期限内, 发行人对已清偿的授信额度可再次申请使用。同时, 发行人控股股东吴限与贷款方签订编号为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”的《最高额担保合同》, 约定为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”《综合授信合同》下发行人的债务提供最高债权额为 8,000 万元的连带保证担保。此外, 发行人与贷款方签订编号为“2011 年深宝安金融综额字 010 号”的《银行承兑协议》, 约定贷款方对汇票承兑时按票面金额的万分之五向发行人收取手续费。

（六）保荐及承销协议

发行人与兴业证券股份有限公司于 2011 年 2 月 28 日签署《承销协议》和《保荐协议》, 由兴业证券股份有限公司担任发行人本次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商, 兴业证券股份有限公司及其组织的承销团对发行人本次公开发行的股票实行余额包销, 发行人将按承销比例支付承销费; 保荐机构在保荐期内, 对发行人的规范运作进行督导, 督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（七）施工合同

2011 年 3 月 11 日, 发行人与深圳市中建南方净化设备有限公司签订了《净化装修工程施工合同》(合同编号: JT-20110304), 根据该合同约定, 深圳市中建南方净化设备有限公司对发行人车间进行净化装修, 总工期为 60 个工作日, 合同价款为 185 万元。

二、发行人对外担保的有关情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对外担保的有关情况。

三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在尚处于诉讼或仲裁阶段的重大事项。

四、发行人控股股东等涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、控股子公司以及本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

发行人控股股东、实际控制人吴限最近三年内无重大违法行为。

五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十四节 有关声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事、监事、高级管理人员：



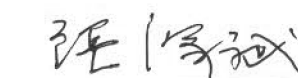
吴 限



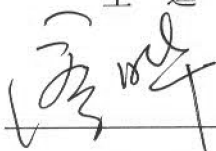
主 逵



朱武陵



张汉斌



廖 晔



罗昌昌



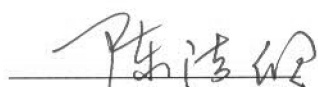
朱 玺



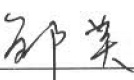
高 凯



罗习雄



陈洁欣



邹 英



谢加云

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

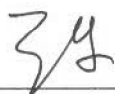


2012年2月21日

保荐机构（主承销商）声明

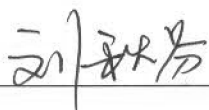
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

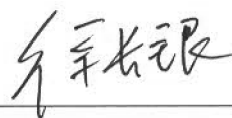


兰荣

保荐代表人：

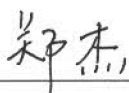


刘秋芬



徐长银

项目协办人：



郑杰



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名： 林云燕
麻云燕

经办律师签名： 张炯
张 炯

邓海标
邓海标



2012 年 2 月 21 日

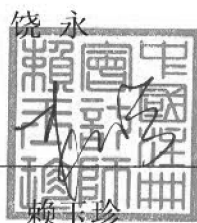
审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



签字注册会计师签名：



深圳市鹏城会计师事务所有限公司



2012年 2月 21日

验资机构声明

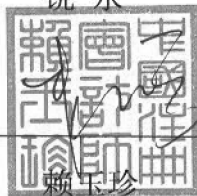
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人签名：




饶永

注册会计师签名：



赖玉珍



谢翠

深圳市鹏城会计师事务所有限公司



2012年2月21日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人（签字）：

黄西勤

注册资产评估师（签字）：

熊 钢

王允星

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司



2012年 2月21日

第十五节 附件

- 1、发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告
- 2、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 3、发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见
- 4、财务报表及审计报告
- 5、内部控制鉴证报告
- 6、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
- 7、法律意见书及律师工作报告
- 8、公司章程（草案）
- 9、中国证监会核准本次发行的文件
- 10、其他与本次发行有关的重要文件